

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



澜起科技股份有限公司

Montage Technology Co., Ltd.

（上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6）

首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（牵头主承销商）



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商



北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
27 层及 28 层



北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼



中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号



山东省济南市市中区经七路 86 号

发行概况

发行股票类型：	人民币普通股（A股）
发行股数：	本次拟发行股份不超过11,298.1389万股
占发行后总股本的比例：	不低于10%
每股面值：	1.00元
每股发行价格：	【】元/股
预计发行日期：	【】年【】月【】日
拟上市的交易所和板块：	上海证券交易所科创板
发行后总股本：	不超过112,981.3889万股
保荐机构（牵头主承销商）：	中信证券股份有限公司
联席主承销商：	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
招股说明书签署日期：	【】年【】月【】日

监管机构声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

合计持有发行人超过 51%股份的股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、合计持有发行人超过 51%股份的股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的全文。

一、相关承诺事项

发行人、公司股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺、关于公司稳定股价的预案及相关承诺、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施、关于持股意向及减持意向的承诺、关于业绩摊薄的填补措施及承诺、未能履行承诺的约束措施、关于欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺及其他重要承诺，详细情况详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“六、相关承诺事项”。

二、发行前滚存利润分配方案

根据公司于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会决议，如公司完成首次公开发行股票并上市，本次公开发行股票并上市前所滚存的可供股东分配的利润（不含已经公司股东大会决议分配的利润），由发行后的新老股东按其持股比例共享。

三、发行后公司股利分配政策和未来三年分红规划

根据发行人于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股东未来分红回报规划的议案》，公司发行上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下：

（一）股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远发展，综合考虑了企业实际情况及发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（二）公司股东回报规划制定原则

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票，现金与股票相结合或

法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合《公司章程（草案）》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（三）股东回报规划制定周期

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求，制定年底或中期分红方案。

（四）发行上市后三年内（含发行当年）的股东分红回报计划

1、公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

3、分红的条件及比例

在满足下列条件时，可以进行分红：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况确定。

4、现金分红的比例和期间间隔

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

5、股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6、决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答

复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

7、公司利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

四、特别风险提示

（一）产品研发风险

集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化，赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。报告期内（2016年至2018年，下同）公司研发费用分别为19,822.69万元、18,826.93万元和27,669.52万元，占营业总成本的比例分别为26.22%、20.03%和27.29%，占比较高。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）公司新产品的开发存在周期较长、资金投入较大的特点，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）由于公司产品技术含量较高，公司存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是对公司技术开发能力的判断错误，导致公司研发项目无法实现或周期延长；（3）由于先发性对于公司产品占据市场份额起到较大的作用，若产品迭代期间，竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品，公司有可能丢失较大的市场份额，从而影响公司后续的发展。

（二）客户集中度较高风险

公司的主营产品为内存接口芯片，内存接口芯片下游为 DRAM 市场，主要客户覆盖了该市场的国际龙头企业。根据相关行业统计数据，2018 年前三季度，在 DRAM 市场，三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名，市场占有率合计超过 90%。这导致公司客户集中度也相对较高，在报告期内公司对前五大客户的销售占比分别为 70.18%、83.69%和 90.10%，客户相对集中。如果公司产品开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，则公司将存在不能持续、稳定的开拓新客户和维系老客户新增业务的可能，从而面临业绩下滑的风险。

（三）供应商风险

发行人为最大程度优化自身产能资源配置，同时考虑经济性原则，采取 Fabless 模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责，并与外协加工厂商建立了稳定、良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研发和产品研发中去，以增强核心竞争力。但是公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外

协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外，晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。报告期内，公司晶圆代工主要委托富士通电子和台积电进行，公司封装测试主要委托星科金朋和矽品科技进行，供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

（四）税收优惠政策风险

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），报告期内公司对外提供特许权使用免征增值税。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），公司符合国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的认定标准，减按10%的适用税率缴纳企业所得税。

Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited 注册地为澳门，根据澳门特别行政区颁布的第58/99/M号离岸业务法律制度，“第十二条一、获许可在澳门地区营运之离岸机构享有下列优惠：a)豁免从事离岸业务获得之收益之所得补充税”，该子公司豁免企业所得税。2018年12月27日澳门特别行政区通过第15/2018号废止离岸业务法律制度，该制度“第四条一、现有从事离岸业务的许可，如在2021年1月1号前未失效或未被废止，则自该日起失效”，即该子公司豁免企业所得税的优惠自2021年1月1日起失效。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，则将对公司的经营业绩产生一定影响，该税收优惠取消后对澜起澳门以前年度的经营业绩不产生任何影响，不会产生纳税调整。若澜起澳门无税收优惠，报告期内发行人利润将相应减少483.12万元、2,391.53万元及6,624.38万元。

（五）无实际控制人风险

发行人股东较多，持股较为分散。发行人所有股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员。除本招股说明书披露的部分股东存在关联关系、一致行动或投票权委托安排外，股东之间不存在其他已签订但未披露的任何

一致行动协议或已实施但未披露的任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实施控制发行人的行为。发行人不存在实际控制人，同时由于公司股权相对分散，上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

（六）知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并在需要时购买必需的第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

（七）DDR5 技术和产品推出的不确定性风险

公司经过多年研发，已拥有成熟的内存接口芯片产品系列，并形成一定竞争优势。但DDR5新技术和新产品的研发仍存在一定不确定性，包括行业标准技术规格书的修订，内存接口芯片电路设计的高复杂度，新一代DDR5内存颗粒以及中央处理器等上下游合作厂商的产品研发进度等，都会影响澜起科技新一代DDR5内存接口芯片的研发和量产进度。预计在未来几年，DDR5相关技术将逐步取代DDR4，在内存接口芯片的技术迭代过程中，如果公司在DDR5的相关技术开发和应用上不能保持领先地位，或者某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，可能对公司的市场竞争力带来不利影响。

（八）津逮[®]服务器平台业务面临的不确定性风险

1、相关业务面临不确定性风险。津逮[®]服务器平台项目具有高投入、高风险和高收益的特点。服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分，也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。但津逮[®]服务器平台技术壁垒高，独创性强，需要公司投入大量资金、人力和时间成本，且项目实施的过程中面临着技术替代、政策环境变化、市场环境变化等诸多不确定因素。尽管公司已于2018年底成功推出了第一代津逮[®]服务器平台产品，但目前还处于市场推广阶段，不是公司报告期内的主要收入来源。未来不排除因技术、市场、政策等因素的影响而导致该项业务的实际开展不

及预期，从而对经营情况造成一定不利影响。

2、津逮[®]服务器平台业务与相关合作方的具体合作模式。津逮[®]服务器CPU是公司 与清华大学、Intel联合研发的，其产品所有权及品牌归属为澜起科技。公司已就津逮[®]服务器CPU所涉及的独立研发核心技术申请专利和集成电路布图设计专有权。在本产品上，通用CPU内核芯片由Intel提供，可重构计算处理器（RCP）的算法由清华大学提供，公司完成整体模块及其他部分芯片设计，并委托第三方进行芯片制造、封装和测试。津逮[®]服务器CPU在报告期内主要处于研发阶段，销售产品主要为工程样品，其中Intel通用CPU内核芯片在津逮[®]服务器CPU成本中的占比在90%左右。

3、募投项目实施后公司新增关联交易对公司的影响。公司向Intel相关主体采购其通用CPU内核芯片，是基于前述背景的正常业务合作与采购。与Intel已发生的交易均经过关联交易决策程序，定价公允。募投项目津逮[®]服务器CPU及其平台技术升级项目实施后，公司将根据届时的市场情况确定与Intel关联交易的规模。未来将根据相关规定履行必要的审核及对外披露程序。募投项目的实施不会造成公司对Intel公司的重大依赖，Intel作为公司股东无法控制公司，不会对公司的独立性产生影响。

4、Intel Capital投资公司主要系看好公司未来盈利前景及技术水平，有意进一步加深合作，同时获取投资回报，其定价相比同期同行业一级市场可比投资估值（动态市盈率），不存在重大差异，相关定价公允。

上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。

五、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况

公司已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十一、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况”。相关财务信息未经审计，其中2018年1-3月和2019年1-3月的财务数据已经瑞华会计师事务所审阅。

2019年1-3月，公司实现营业收入4.05亿元，较2018年1-3月同比增长20.07%；2019年1-3月公司实现归属于母公司股东的净利润2.26亿元，较2018年1-3月同比增长42.02%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2.16亿元，较2018年1-3月同比增长42.25%。

综合公司已完成的收入、利润情况以及目前在执行订单情况审慎评估，在假设不发生其他重大变化的前提下，预计公司 2019 年 1-6 月的营业收入约为 8.20 亿元至 8.80 亿元，较 2018 年 1-6 月同比增长 16%-24%；实现归属于母公司股东的净利润约为 4.20 亿元至 5.00 亿元，较 2018 年 1-6 月同比增长 32%-58%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润约为 4.00 亿元至 4.90 亿元，较 2018 年 1-6 月同比增长 32%-61%。

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营模式，各项业务经营情况，资产规模，税收政策等均未发生重大不利变化。

目录

发行概况	2
监管机构声明	3
发行人声明	4
重大事项提示	5
一、相关承诺事项	5
二、发行前滚存利润分配方案	5
三、发行后公司股利分配政策和未来三年分红规划	5
四、特别风险提示	9
五、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况	12
目录	14
第一节 释义	18
一、普通术语	18
二、专业术语	20
第二节 概览	23
一、发行人及中介机构情况	23
二、本次发行概况	23
三、发行人主要财务数据及财务指标	25
四、发行人主营业务经营情况	25
五、发行人先进性情况	26
六、发行人选择的具体上市标准	28
七、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项	28
八、发行人募集资金用途	28
第三节 本次发行概况	30
一、本次发行基本情况	30
二、本次发行的有关当事人	30
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系	34
四、有关本次发行上市的重要日期	34

第四节 风险因素	35
一、技术风险	35
二、经营风险	36
三、内控风险	39
四、财务风险	40
五、法律风险	41
六、募集资金投资项目风险	42
七、发行失败风险	42
八、预测性陈述存在不确定性的风险	42
第五节 发行人基本情况	44
一、发行人基本情况	44
二、发行人设立情况	44
三、发行人股本形成及变化情况	45
四、境外间接上市、退市及拆除境外架构的情况	57
五、发行人重大资产重组情况	62
六、发行人历次股本验资情况	67
七、发行人的股权结构和组织结构	68
八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介	70
九、公司股东及实际控制人的基本情况	75
十、发行人股本情况	96
十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况	116
十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况	123
十三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况	124
十四、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要承诺	125
十五、公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系	126
十六、董事、监事及高级管理人员的任职资格	126
十七、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况	126
十八、发行人员工及社会保障情况	128
第六节 业务与技术	131
一、公司的主营业务、主要产品及服务	131

二、行业基本情况	142
三、公司销售情况	168
四、公司采购情况	171
五、主要固定资产及无形资产	177
六、公司的技术与研发情况	189
七、公司境外经营情况	200
第七节 公司治理及独立性	201
一、概述	201
二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况	201
三、公司报告期内违法违规行情况	204
四、公司报告期内资金占用和对外担保情况	204
五、内部控制制度的评估意见	204
六、发行人独立运行情况	204
七、同业竞争	206
八、关联方、关联关系和关联交易	207
九、其他交易	222
十、规范关联交易的制度安排	223
十一、报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见	227
十二、本公司减少和规范关联交易的措施	228
第八节 财务会计信息与管理层分析	231
一、财务会计信息	231
二、重要会计政策和会计估计	245
三、非经常性损益	262
四、主要税种及税收政策	263
五、主要财务指标	266
六、经营成果分析	267
七、资产质量分析	287
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析	303
九、公司重大资产重组情况	312
十、期后事项、或有事项及其他重要事项	312
十一、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况	316

第九节 募集资金运用与未来发展规划	319
一、本次发行募集资金运用计划	319
二、募集资金投资项目与目前公司主营业务的关系	324
三、本次募集资金投资项目的具体情况介绍	324
四、业务发展目标	330
第十节 投资者保护	332
一、投资者权益保护情况	332
二、股利分配政策	333
三、报告期内的股利分配情况	336
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排	337
五、股东投票机制的建立情况	337
六、相关承诺事项	338
第十一节 其他重要事项	354
一、重大合同	354
二、对外担保情况	355
三、重大诉讼、仲裁事项	355
第十二节 声明	357
第十三节 附件	387
一、本招股说明书的备查文件	387
二、查阅地点	387
三、查阅时间	387

第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

一、普通术语

公司、发行人、澜起科技	指	澜起科技股份有限公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
本次发行	指	公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为
本招股说明书	指	《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
中电投控	指	中国电子投资控股有限公司
嘉兴芯电	指	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）
WLT	指	WLT Partners, L.P.
珠海融英	指	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）
上海临理	指	上海临理投资合伙企业（有限合伙）
上海临丰	指	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
上海临骥	指	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）
上海临利	指	上海临利投资合伙企业（有限合伙）
上海临国	指	上海临国投资合伙企业（有限合伙）
临桐建发	指	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）
上海临齐	指	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴宏越	指	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴莫奈	指	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）
Xinyun I	指	Xinyun Capital Fund I, L.P.
Xinyun	指	Xinyun Capital Fund, L.P.
Xinyun III	指	Xinyun Capital Fund III, L.P.
臻石一号	指	嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）
臻石二号	指	嘉兴臻石二号投资合伙企业（有限合伙）
臻石三号	指	嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）
中证投资	指	中信证券投资有限公司
中睿一期	指	金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
中睿二期	指	金石中睿二期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
Theon Investment	指	Theon Investment, LP

珠海融扬	指	珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）
泰瑞嘉德	指	新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）
华天宇投资	指	厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
上海华伊	指	上海华伊投资中心（有限合伙）
光大投资	指	中国光大投资管理有限责任公司
西藏长乐	指	西藏长乐投资有限公司
宁波信远	指	宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
杭州调露	指	杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）
上海君弼	指	上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）
Green Spark	指	Green Spark Investment Limited
New Speed	指	New Speed Consultancy Co., Ltd.
TransLink	指	TransLink Capital Partners I, L.P.
Pine Stone Capital	指	Hong Kong Pine Stone Capital Limited
BICI	指	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.
前海珂玺	指	深圳前海珂玺资本管理有限公司
Intel Capital	指	Intel Capital Corporation
SVIC No. 28 Investment	指	SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P.
澜起有限	指	澜起科技（上海）有限公司，发行人前身
澜起开曼	指	Montage Technology Holdings Company Limited
澜起澳门	指	Montage Technology Macau Commercial Offshore Limited
澜起香港	指	Montage Hong Kong Holdings Company Limited
澜起美国	指	Montage Technology, Inc.
澜起宝石	指	Porsche Acquisition Sub, Inc.
澜起电子昆山	指	澜起电子科技（昆山）有限公司
澜起电子上海	指	澜起电子科技（上海）有限公司
澜起半导体	指	昆山澜起半导体有限公司
澜起苏州	指	苏州澜起微电子科技有限公司
Montage Holding	指	Montage Technology Global Holdings, Ltd.
Montage Group	指	Montage Technology Group Limited
Montage HK	指	Montage Technology Hong Kong Limited
Montage Taiwan	指	Montage Technology (Taiwan) Co., Ltd
Montage Semiconductor	指	Montage Semiconductor Holdings Company Limited
澜至半导体	指	上海澜至半导体有限公司

成都澜至	指	澜至电子科技（成都）有限公司
上海澜至	指	澜至电子科技（上海）有限公司
Intel、英特尔	指	Intel Corporation 及其控制子公司
三星电子	指	世界知名的半导体及电子企业
海力士	指	世界知名的 DRAM 制造商
美光科技	指	世界知名的半导体解决方案供应商
富昌电子	指	Future Electronics Inc. 及其受同一控制的关联方
淇诺科技	指	深圳淇诺科技有限公司及其受同一控制的关联方
中电器材	指	CEAC International Limited 及其受同一控制的关联方
虹日科技	指	Hong Ri International Electronics (Hong Kong) Limited 及其受同一控制的关联方
IDT	指	Integrated Device Technology, Inc.
Rambus	指	Rambus Inc.
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
富士通电子	指	Fujitsu Electronics Inc.
星科金朋	指	STATS ChipPAC Ltd.
矽品科技	指	矽品精密工业股份有限公司和矽品科技（苏州）有限公司
台积电	指	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
联华电子	指	United Microelectronics Corporation
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所
瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
申威	指	上海申威资产评估有限公司

二、专业术语

芯片、集成电路、IC	指	一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写。
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，是半导体集成电路制作所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品。
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程。
集成电路封装	指	把从晶圆上切割下来的集成电路裸片（Die），用导线及多种连接方式把管脚引出来，然后固定包装成为一个包含外壳和管脚的

		可使用的芯片成品。 集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境，对集成电路芯片起到机械或环境保护的作用，从而使集成电路芯片能够发挥正常的功能，并保证其具有高稳定性和可靠性。
集成电路测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作。
JEDEC	指	Joint Electron Device Engineering Council 的缩写，电子器件工程联合委员会，为全球微电子产业的领导标准机构
混合安全内存模组	指	采用具有澜起科技自主知识产权的内存监控技术，为数据中心服务器平台提供数据安全功能的内存模组
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程流片。在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片。
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写，中文称为整合元件制造商，即垂直整合制造企业。其经营范围涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装测试、销售等各环节。有时也代指此种商业模式。
Fabless	指	无晶圆厂集成电路设计企业，只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。有时也代指此种商业模式。
晶圆厂	指	晶圆代工厂，指专门负责芯片制造的厂家。
光罩	指	又称光掩模、掩模版（英文称为： Mask 、 Photomask 或 Reticle ），是制造半导体芯片时，将电路印制在硅晶圆上所使用的模具。光罩是根据芯片设计公司设计的集成电路版图来生产制作的，一套光罩按照芯片的复杂程度通常有几层到几十层不等，晶圆制造商根据制作完成的光罩进行晶圆生产。
WAT	指	WAT 是英文 Wafer Acceptance Test 的缩写，意指晶圆验收测试，即半导体硅片在完成所有制程工艺后，针对硅片上的各个电路结构所进行的电性测试，通过电参数来监控各工艺步骤是否正常和稳定。
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，中文称为中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心。
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器。
存储器	指	电子系统中的存储设备，用来存放程序和数据。例如计算机中全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息。
物联网、IoT	指	IoT 是物联网（ Internet of things ）的英文缩写，意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施，具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合。
SoC	指	System on Chip 的英文缩写，中文称为芯片级系统，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
MCU	指	Microcontroller Unit 的英文缩写，中文称为微控制单元，是把中

		央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。
DDR	指	Double Data Rate 的英文缩写，意指双倍速率，是内存模块中用于使输出增加一倍的技术。
MB、MB 芯片	指	MB 是内存接口芯片/内存缓冲芯片（Memory Buffer）的英文缩写。MB 芯片是内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。
DB	指	数据缓冲器，用来存储缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号
RCD	指	寄存缓冲器，又称“寄存时钟驱动器”，用来存储缓冲来自内存控制器的地址/命令/控制信号
FBDIMM	指	全缓冲双列直插内存模组
RDIMM	指	寄存式双列直插内存模组
LRDIMM	指	减载双列直插内存模组
STB、STB 芯片	指	STB 是机顶盒（Set Top Box）的英文缩写。机顶盒是一种连接电视机与外部信号源的设备，它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来。机顶盒芯片具有成熟的前端解调技术和完善的高清解码功能，以及定制的软件服务方案。
Wi-Fi、WIFI、WIFI 芯片	指	Wi-Fi / WIFI 是 Wireless Fidelity 的英文缩写，指一种基于 IEEE 802.11 系列标准的无线局域网。Wi-Fi 芯片包括 Wi-Fi 应用处理器 SoC，网络接口控制器（NIC）和物联网（IoT）Wi-Fi MCU 等。
数据中心	指	数据中心是一整套复杂的设施，不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。它为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务。数据中心是对入驻企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟（其分销商、供应商、客户等）实施价值链管理的平台。

特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及中介机构情况

发行人基本情况			
发行人名称	澜起科技股份有限公司	成立日期	2004年5月27日
注册资本	101,683.25万元	法定代表人	杨崇和
注册地址	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6	主要生产经营地址	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
控股股东	无	实际控制人	无
行业分类	根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。	在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况	无
本次发行的有关中介机构			
保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司
发行人律师	国浩律师（上海）事务所	其他承销机构	无
审计机构	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	上海申威资产评估有限公司

二、本次发行概况

本次发行基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	本次拟发行股份不超过11,298.1389万股	占发行后总股本比例	不低于10.00%
其中：发行新股数量	不超过11,298.1389万股	占发行后总股本比例	不低于10.00%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	无
发行后总股本	不超过112,981.3889万股		
每股发行价格	【】		

发行市盈率	【】倍（每股收益按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	3.56元（按经审计的截至2018年12月31日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）	发行前每股收益 (元/股)	0.87
发行后每股净资产	【】元（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算）	发行后每股收益 (元/股)	【】
发行市净率	【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	主承销商余额包销		
拟公开发售股份股东名称	【】		
发行费用的分摊原则	【】		
募集资金总额	【】		
募集资金净额	【】		
募集资金投资项目	新一代内存接口芯片研发及产业化项目		
	津逮 [®] 服务器 CPU 及其平台技术升级项目		
	人工智能芯片研发项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费用【】万元，评估费用【】万元，律师费用【】万元，信息披露费用【】万元，股份登记费用【】万元，发行手续费用【】万元；其他发行费用由发行人承担		
本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】		
开始询价推介日期	【】		
刊登定价公告日期	【】		
申购日期和缴款日期	【】		
股票上市日期	【】		

三、发行人主要财务数据及财务指标

项目	2018 年度/ 2018-12-31	2017 年度/ 2017-12-31	2016 年度/ 2016-12-31
资产总额（万元）	418,065.74	147,469.33	112,134.41
归属于母公司所有者权益（万元）	361,574.98	118,700.77	88,302.39
资产负债率（母公司）（%）	11.20	15.66	14.16
营业收入（万元）	175,766.46	122,751.49	84,494.46
净利润（万元）	73,687.84	34,691.60	9,280.43
归属于母公司所有者的净利润（万元）	73,687.84	34,691.60	9,280.43
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	69,844.59	27,437.43	315.40
基本每股收益（元）	0.87	0.46	0.12
稀释每股收益（元）	0.87	0.46	0.12
加权平均净资产收益率（%）	37.11	33.52	11.35
经营活动产生的现金流量净额（万元）	96,914.70	22,683.14	38,708.48
现金分红（万元）	29,827.09	-	-
研发投入占营业收入比例（%）	15.74	15.34	23.46

四、发行人主营业务经营情况

（一）主营业务或产品

公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮[®]服务器 CPU 以及混合安全内存模组。经过多年的研发积累，公司产品性能在行业内赢得高度认可，包含公司产品的服务器广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域，满足了新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

公司在内存接口芯片领域深耕十多年，成为全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的主要份额。

2016 年以来，澜起科技与英特尔及清华大学鼎力合作，研发出津逮[®]系列服务器 CPU。基于津逮[®] CPU 及澜起科技的混合安全内存模组而搭建的津逮[®]服务器平台，实

现了芯片级实时安全监控功能，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此平台还融合了先进的异构计算与互联技术，可为大数据及人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。

（二）主要经营模式

本公司的主要经营模式为 **Fabless** 模式，该模式下的企业仅需专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

（三）主要竞争地位

公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，现已成为全球可提供从 **DDR2** 到 **DDR4** 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司发明的 **DDR4** 全缓冲“**1+9**”架构被采纳为国际标准，其相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，占据全球市场的主要份额。

公司是经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局等联合认证的“高新技术企业”，曾荣获“上海市技术发明奖一等奖”、“中国电子学会科学技术奖一等奖”、“全球半导体联盟 2017 年最受尊敬非上市半导体公司奖最终提名”、“‘中国芯’年度重大创新突破产品”、工业和信息化部“制造业单项冠军培育企业”等荣誉称号。

五、发行人先进性情况

（一）技术先进性

基于公司的技术突破和创新能力，公司已拥有多项专利，截至 2019 年 4 月 1 日，公司已获授权的国内外专利达 90 项，获集成电路布图设计证书 39 项，具体情况参见“第六节业务与技术”之“五、主要固定资产及无形资产（二）无形资产”相关内容。

公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

近年来，公司在诸多方面取得显著成绩。2016 年 6 月，中国电子学会认定公司“低功耗 **DDR** 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”；同年 12

月，该项技术及产业化项目荣获“中国电子学会科学技术奖一等奖”；2017年，公司荣获三星电子颁发的“最佳供应商奖”；2018年，公司产品“第二代DDR4内存缓冲控制器芯片”荣获“‘中国芯’年度重大创新突破产品”奖；2018年11月，津逮®服务器CPU及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”；2019年5月，公司“低功耗DDR系列内存缓冲控制器芯片设计技术”项目荣获上海市人民政府颁发的“上海市技术发明一等奖”。

（二）以研发为核心的商业模式

公司的主要经营模式为Fabless模式，该模式下公司无需花费成本建立晶圆生产线，且能充分发挥技术优势快速开发出相关产品，因而该模式被诸多集成电路设计公司所采用。

（三）研发技术产业化情况

公司作为业界领先的集成电路设计公司之一，致力于为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，并逐渐形成内存接口芯片、津逮®服务器CPU以及混合安全内存模组为主的产品系列。在报告期内，主营业务收入分别为84,314.84万元、115,517.45万元和175,766.46万元，净利润分别为9,280.43万元、34,691.60万元和73,687.84万元。

（四）未来发展战略

公司将专注于集成电路设计领域的科技创新，围绕云计算及人工智能领域，不断满足客户对高性能芯片的需求，在持续积累中实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。

公司未来三年的发展目标是通过持续不断的研发创新，提升公司在细分行业的市场地位和影响力。其中，在内存接口芯片业务领域，巩固公司的市场领先地位，在未来三年完成第一代DDR5内存接口芯片的研发和产业化；在数据中心业务领域，持续升级津逮®服务器CPU及其平台，为数据中心提供高性能、高安全、高可靠性的CPU、内存模组等产品，持续提升市场份额；在人工智能芯片领域，公司将聚焦客户需求，挖掘潜在商机，研发有竞争力的芯片解决方案，为公司的可持续发展提供新的业务增长点。

六、发行人选择的具体上市标准

截至 2018 年 12 月 31 日，公司净资产为 361,574.98 万元。同时，发行人 2017 年和 2018 年营业收入分别为 122,751.49 万元和 175,766.46 万元，2017 年和 2018 年净利润分别为 34,691.60 万元和 73,687.84 万元。

综上，发行人符合“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的科创板上市标准。

七、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项

发行人公司治理不存在特殊安排及其他重要事项。

八、发行人募集资金用途

公司本次拟公开发行不超过 11,298.1389 万股 A 股普通股股票，全部用于与公司主营业务相关的项目。

本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投入金额	建设期
1	新一代内存接口芯片研发及产业化项目	101,785.00	101,785.00	3 年
2	津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目	74,520.16	74,520.16	3 年
3	人工智能芯片研发项目	53,713.90	53,713.90	3 年
总计		230,019.06	230,019.06	

上述 3 个项目的总投资约为人民币 230,019.06 万元，拟使用募集资金 230,019.06 万元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次拟公开发行股票募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述 3 个项目的投资需要，资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）超过上述 3 个项目的投资需要，则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后做出适当处理。

本次募集资金运用详细情况请参阅本招股说明书“第九节募集资金运用与未来发展规划”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元
发行规模：	本次拟发行股份不超过11,298.1389万股
占发行后总股本的比例：	不低于10%
每股发行价：	【】元
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
发行市盈率：	【】倍（每股收益按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行后每股收益：	【】元（按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产：	3.56元（按经审计的截至2018年12月31日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产：	【】元（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算）
发行市净率：	【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）
发行方式：	本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及上交所认可的其他发行方式
发行对象：	符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式：	主承销商余额包销
预计募集资金总额和净额：	本次发行预计募集资金总额不超过【】亿元，扣除发行费用后，预计公司发行新股募集资金净额不超过【】亿元
发行费用概算：	本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费用【】万元，评估费用【】万元，律师费用【】万元，信息披露费用【】万元，股份登记费用【】万元，发行手续费用【】万元；其他发行费用由发行人承担
拟上市证券交易所板块：	上海证券交易所科创板

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人：澜起科技股份有限公司

英文名称：Montage Technology Co., Ltd.

法定代表人：杨崇和
住所：上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6
联系电话：021-5467 9039
传真：021-5426 3132
董事会秘书：梁铂钴

（二）保荐人（牵头主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)
北座
联系电话：010-6083 4772
传真：010-6083 3123
保荐代表人：孙洋、王建文
项目协办人：鞠宏程
项目经办人：孙骏、韩非可、陈灏蓝

（三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：毕明建
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
28 层
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
项目经办人：齐飞、吴迪、杜丽君、欧阳塘珂、王琨、许宜哲、甄昊

（四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系电话： 010-65608337

传真： 010-65608450

项目经办人： 董军峰、王一浩、张铁、翁子涵、李重阳、吴乔可、刘松涛

（五）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人： 杨德红

住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系电话： 010-59312997

传真： 010-59312908

项目经办人： 张铎、王立泉、肖扬、张大伟、刘思远

（六）联席主承销商：中泰证券股份有限公司

法定代表人： 李玮

住所： 山东省济南市市中区经七路 86 号

联系电话： 010-59013971

传真： 010-59013945

项目经办人： 孙建华、陈雄、王震、曹溢、刘荣
高翔、陈进进（联席主承销商律师）

（七）发行人律师：国浩律师（上海）事务所

律师事务所主任： 李强

事务所地址： 上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

联系电话： 021-5234 1668

传真： 021-5243 3320

经办律师： 倪俊骥、陈晓纯、葛嘉琪、蔡诚

（八）会计师事务所/验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人： 冯忠、刘贵彬、杨荣华
住所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话： 010-8809 5588
传真： 010-88091199
经办注册会计师： 徐超玉、李建长

（九）资产评估机构：上海申威资产评估有限公司

法定代表人： 马丽华
住所： 上海市东体育会路 816 号 C 座
联系电话： 021-3127 3006
传真： 021-3127 3013
签字资产评估师： 修雪嵩、陈毅夫

（十）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

营业场所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号
联系电话： 021-5870 8888
传真： 021-5889 9400

（十一）保荐人（牵头主承销商）收款银行

开户行： **【】**

（十二）拟上市证券交易所

拟上市交易所： 上海证券交易所
住所： 上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话： 021-6880 8888
传真： 021-6880 4868

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

截至本招股说明书签署日，中信证券投资有限公司直接持有发行人 51,033,325 股（对应发行前持股比例为 5.019%），系本次发行的保荐人和牵头主承销商中信证券的全资子公司。除此之外，公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有公司股份，与公司也不存在其他权益关系。

四、有关本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期：【】年【】月【】日

开始询价推介日期：【】年【】月【】日

刊登定价公告日期：【】年【】月【】日

申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日

股票上市日期：【】年【】月【】日

第四节 风险因素

投资者在评价公司本次公开发售的股票价值时，除应认真阅读本招股说明书提供的其他资料外，还应该特别考虑下述各项风险因素。

一、技术风险

（一）产品研发风险

集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化，赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。报告期内，公司研发费用分别为19,822.69万元、18,826.93万元和27,669.52万元，占营业总成本的比例分别为26.22%、20.03%和27.29%，占比较高。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）公司新产品的开发存在周期较长、资金投入较大的特点，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）由于公司产品技术含量较高，公司存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是对公司技术开发能力的判断错误，导致公司研发项目无法实现或周期延长；（3）由于先发性对于公司产品占据市场份额起到较大的作用，若产品迭代期间，竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品，公司有可能丢失较大的市场份额，从而影响公司后续的发展。

（二）技术泄密风险

通过持续技术创新，公司研发技术平台处于行业内较高水平。自成立以来，公司就十分重视对核心技术的保密，及时将研发成果申请专利，并制定了严格完善的内控制度，保障核心技术的保密性。但存在由于核心技术人员流动、技术泄密，或专利保护措施不力等原因，导致公司核心技术流失的风险。如前述情况发生，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的竞争力产生不利影响。

（三）DDR5 技术和产品推出的不确定性风险

公司经过多年研发，已拥有成熟的内存接口芯片产品系列，并形成一定竞争优势。但DDR5新技术和新产品的研发仍存在一定不确定性，包括行业标准技术规格书的修订，

内存接口芯片电路设计的高复杂度，新一代DDR5内存颗粒以及中央处理器等上下游合作厂商的产品研发进度等，都会影响澜起科技新一代DDR5内存接口芯片的研发和量产进度。预计在未来几年，DDR5相关技术将逐步取代DDR4，在内存接口芯片的技术迭代过程中，如果公司在DDR5的相关技术开发和应用上不能保持领先地位，或者某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，可能对公司的市场竞争力带来不利影响。

二、经营风险

（一）客户集中度较高风险

公司的主营产品为内存接口芯片，内存接口芯片下游为 DRAM 市场，主要客户覆盖了该市场的国际龙头企业。根据相关行业统计数据，2018 年前三季度，在 DRAM 市场，三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名，市场占有率合计超过 90%。这导致公司客户集中度也相对较高，在报告期内公司对前五大客户的销售占比分别为 70.18%、83.69%和 90.10%，客户相对集中。如果公司产品开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，则公司将存在不能持续、稳定地开拓新客户和维系老客户新增业务的可能，从而面临业绩下滑的风险。

（二）供应商风险

发行人为最大程度优化自身产能资源配置，同时考虑经济性原则，采取 Fabless 模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。自公司成立以来，公司已与外协加工厂商建立了稳定、良好的协作关系，外协加工厂商严格按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研究和产品研发中去，以增强核心竞争力。但是公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外，晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。报告期内，公司晶圆代工主要委托富士通电子和台积电进行，公司封装测试主要委托星科金朋和矽品科技进行，供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

（三）经营业绩波动风险

集成电路设计企业的经营业绩很大程度上受下游终端电子产品市场波动的影响。报告期内，公司呈现出较高的成长性，营业收入从 2016 年的 84,494.46 万元增长到 2018 年的 175,766.46 万元，年均复合增长率达 44.23%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从 2016 年的 315.40 万元增长到 2018 年的 69,844.59 万元，年均复合增长率达 1,388.11%。虽然公司的经营业绩呈现高速增长态势，但如受行业周期性因素影响，或者公司未能及时提供满足市场需求的产品和服务，将导致公司未来业绩存在波动的风险。

（四）产品结构单一风险

2016 年、2017 年和 2018 年，发行人内存接口芯片占发行人营业收入比例分别为 66.08%、76.14%和 99.49%，发行人存在产品结构单一的风险。虽然发行人计划提高津逮[®]服务器 CPU 以及混合安全内存模组的销售规模，但如果在短期内出现内存接口芯片需求下降的情况，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

（五）人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。凭借公司研发团队多年来的持续努力钻研，公司技术人员的自主开发能力不断增强。公司针对优秀人才实施了多项激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（六）境外经营风险

发行人产品面向全球市场，同时设有多家境外子公司，且在可预见的未来还将进一步拓展国际市场，同境外的客户及供应商开展合作。由于不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化不同，如果未来海外客户或境外子公司所在国家或地区的经营环境、法律政策发生不利变化，或者发行人国际化管理能力不足，将会对发行人的经营产生不利影响。

（七）津逮[®]服务器平台业务面临的不确定性风险

1、相关业务面临不确定性风险。津逮[®]服务器平台项目具有高投入、高风险和高收益的特点。服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分，也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。但津逮[®]服务器平台技术壁垒高，独创性强，需要公司投入大量资金、人力和时间成本，且项目实施的过程中面临着技术替代、政策环境变化、市场环境变化等诸多不确定因素。尽管公司已于 2018 年底成功推出了第一代津逮[®]服务器平台产品，但目前还处于市场推广阶段，不是公司报告期内的主要收入来源。未来不排除因技术、市场、政策等因素的影响而导致该项业务的实际开展不及预期，从而对经营情况造成一定不利影响。

2、津逮[®]服务器平台业务与相关合作方的具体合作模式。津逮[®]服务器 CPU 是公司 与清华大学、Intel 联合研发的，其产品所有权及品牌归属为澜起科技。公司已就津逮[®]服务器 CPU 所涉及的独立研发核心技术申请专利和集成电路布图设计专有权。在本产品上，通用 CPU 内核芯片由 Intel 提供，可重构计算处理器（RCP）的算法由清华大学提供，公司完成整体模块及其他部分芯片设计，并委托第三方进行芯片制造、封装和测试。津逮[®]服务器 CPU 在报告期内主要处于研发阶段，销售产品主要为工程样品，其中 Intel 通用 CPU 内核芯片在津逮[®]服务器 CPU 成本中的占比在 90%左右。

3、募投项目实施后公司新增关联交易对公司的影响。公司向 Intel 相关主体采购其通用 CPU 内核芯片，是基于前述背景的正常业务合作与采购。与 Intel 已发生的交易均经过关联交易决策程序，定价公允。募投项目津逮[®]服务器 CPU 及其平台技术升级项目实施后，公司将根据届时的市场情况确定与 Intel 关联交易的规模。未来将根据相关规定履行必要的审核及对外披露程序。募投项目的实施不会造成公司对 Intel 公司的重大依赖，Intel 作为公司股东无法控制公司，不会对公司的独立性产生影响。

4、Intel Capital 投资公司主要系看好公司未来盈利前景及技术水平，有意进一步加深合作，同时获取投资回报，其定价相比同期同行业一级市场可比投资估值（动态市盈率），不存在重大差异，相关定价公允。

（八）下游客户出货量下滑风险

根据下游客户（DRAM 生产商）公开披露的资料及行业研究报告分析，DRAM 市场规模预计在 2019 年将出现一定程度的下滑，其主要原因是受行业周期性波动和供求

关系的影响，DRAM 产品的平均销售价格处于下行周期。同时，受行业景气度影响，公司下游客户的总体出货量存在下滑的风险，但公司 2019 年一季度收入及出货量均同比增长，截至目前下游客户出货量的下滑未对公司业绩造成重大不利影响。

如果 DRAM 行业景气度进一步下滑或回升不及预期，将有可能导致内存接口芯片市场规模同步出现下滑或增速放缓，可能对公司未来业绩造成一定不利影响。

（九）中美贸易摩擦风险

公司在报告期内直接销售到美国地区的收入占比较小，在 2018 年占比不足 5%。而且，公司建立了全球化的委托生产和销售布局。公司的主要晶圆代工厂为富士通和台积电，主要封测厂为星科金朋和矽品科技，相关供应商在中国大陆外均有相关产能。同时，公司主要通过全资子公司澜起澳门进行境外采购和销售。上述国家或地区暂未受到中美贸易摩擦的影响。

美国于 2018 年 3 月 22 日公布计划对中国 600 亿美元的商品加征关税，其后中国也采取相应反制措施。在前述贸易摩擦背景下，公司在 2018 年及 2019 年一季度的营业收入和净利润均维持较快增速，主要客户在手订单量保持平稳，公司的业务开展暂未受到中美贸易摩擦的实质影响。

鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业，如果中美贸易摩擦进一步升级，有可能造成产业链上下游交易成本增加，下游需求受限，上游供给不畅，从而有可能公司的经营带来不利影响。

三、内控风险

（一）规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司发展势头良好，公司的资产规模、业务规模迅速扩大。为了逐步提高公司的管理水平，公司不断引入经营管理人才，丰富了董事会成员结构，优化了公司治理制度，加大了员工培训力度，并努力建立有效的考核激励机制和严格的内控制度。如果公司本次发行成功，公司的资产规模与经营规模将实现较大的提升，使得公司的组织结构和经营管理更加复杂，对公司的管理水平将提出更高的要求。虽然在过去的经营实践中，公司已积累了不少管理经验，但是面对资本市场的考验和更高的管理要求，公司仍可能存在一定的管理风险。

（二）内控制度执行不严风险

内部控制制度是保证财务和业务正常开展的重要因素，公司已根据现代企业管理的要求，逐步建立健全了内部控制制度，并不断地补充和完善。若公司有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，将直接影响公司经营管理目标的实现、公司财产的安全和经营业绩的稳定性。

四、财务风险

（一）税收优惠政策风险

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），报告期内公司对外提供特许权使用免征增值税。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），公司符合国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的认定标准，减按10%的适用税率缴纳企业所得税。

Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited 注册地为澳门，根据澳门特别行政区颁布的第58/99/M号离岸业务法律制度，“第十二条一、获许可在澳门地区营运之离岸机构享有下列优惠：a)豁免从事离岸业务获得之收益之所得补充税”，该子公司豁免企业所得税。2018年12月27日澳门特别行政区通过第15/2018号废止离岸业务法律制度，该制度“第四条一、现有从事离岸业务的许可，如在2021年1月1号前未失效或未被废止，则自该日起失效”，即该子公司豁免企业所得税的优惠自2021年1月1日起失效。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，则将对公司的经营业绩产生一定影响，该税收优惠取消后对澜起澳门以前年度的经营业绩不产生任何影响，不会产生纳税调整。若澜起澳门无税收优惠，报告期内发行人净利润将相应减少483.12万元、2,391.53万元及6,624.38万元。

（二）汇兑损益风险

公司日常经营的销售采购业务大部分以美元结算，且发生的美元交易在初始确认时，按交易日的上一月的期末汇率折算为记账本位币金额，但在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，导致公司汇兑损益金额较

大。

2016年、2017年和2018年，公司外汇汇兑损益分别为-1,448.93万元、1,015.91万元和-1,353.40万元，存在一定波动。由于人民币对美元汇率的持续波动，以及未来公司经营规模持续扩大后美元销售额和采购额的进一步增长，公司存在汇兑损益的风险。

（三）存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品构成。2016年、2017年和2018年，公司存货账面价值分别为25,606.94万元、13,251.29万元和12,067.35万元。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，2016年、2017年和2018年，公司存货跌价准备余额分别为8,524.94万元、8,511.12万元和8,076.35万元，占同期存货账面余额的比例分别为24.98%、39.11%和40.09%，比例相对较高。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

（四）毛利率波动风险

公司在报告期内的毛利率分别为51.20%、53.49%和70.54%，毛利率较高，但仍然存在一定的波动。为维持公司较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，如若公司未能契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

（五）净资产收益率及每股收益下降风险

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为0.53%、26.51%和35.18%；2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益为0.82元/股。本次发行完成后，公司净资产及总股本将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，公司存在短期内净资产收益率及每股收益较大幅度下降的风险。

五、法律风险

（一）无实际控制人风险

发行人股东数量较多且持股较为分散。发行人所有股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员。发行人不存在实际控制人，同时由于公司股权相对分散，上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司

控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

（二）知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并在需要时购买必须的第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

六、募集资金投资项目风险

（一）募投项目实施效果未达预期风险

由于本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完成，将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，项目经济效益的分析均为预测性信息，募集资金投资项目建设需要时间，如果未来市场需求出现较大变化，或者公司不能有效拓展市场，将导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。

（二）募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险

募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，年新增折旧及摊销费用较大。如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧及摊销费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

七、发行失败风险

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》，若本次发行过程中，发行人投资价值无法获得投资者的认可，导致发行认购不足，则发行人亦可能存在发行失败的风险。

八、预测性陈述存在不确定性的风险

本招股说明书刊载有若干预测性的陈述，涉及公司所处行业的未来市场需求、公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力、现金流量等方面的预期或相关的

讨论。尽管公司及公司管理层相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论是否能够实现仍然存在较大不确定性。鉴于该等风险及不确定因素的存在，本招股说明书所刊载的任何前瞻性陈述，不应视为本公司的承诺或声明。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称:	澜起科技股份有限公司
英文名称:	Montage Technology Co., Ltd.
注册资本:	101,683.25 万元
法定代表人:	杨崇和
澜起有限成立日期:	2004 年 5 月 27 日
整体变更设立日期:	2018 年 10 月 29 日
公司住所及办公地址:	上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6
邮政编码:	200233
电话号码:	021-5467 9039
传真号码:	021-5426 3132
互联网网址:	http://www.montage-tech.com/cn
电子信箱:	ir@montage-tech.com
信息披露及投资者关系部门	董事会办公室
董事会办公室负责人	傅晓
董事会办公室电话号码	021-5467 9039

二、发行人设立情况

2018年10月12日，澜起有限全体股东共同签署《澜起科技股份有限公司（筹）发起人协议》，将澜起有限经瑞华会计师审计的截至2018年7月31日的账面净资产174,977.06万元为基础，按照1: 0.516554的比例折合为澜起科技股本，计90,385.11万股，每股面值人民币1元，剩余净资产人民币84,591.95万元计入澜起科技的资本公积。同日，澜起有限召开董事会，全体董事参加会议，审议并一致通过将澜起有限变更为股份有限公司及折股方案的议案。2018年10月28日，澜起科技召开创立大会暨2018年第一次股东大会，审议通过公司将澜起有限变更为股份有限公司及折股方案的议案。

瑞华会计师于2018年10月28日出具的《验资报告》（瑞华验字[2018]01500004号），确认截至2018年10月28日，各发起人对澜起科技的出资已经全部到位。

2018年10月29日，公司取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外资备201801389”《外商投资企业变更备案回执》。

2018年10月29日，上海市工商行政管理局就此次整体变更向澜起科技换发了统一社会信用代码为913100007626333657的《营业执照》。

三、发行人股本形成及变化情况

（一）澜起有限设立

澜起有限于2004年由Montage Group独资设立。Montage Group于2004年4月23日签署了《澜起科技（上海）有限公司章程》，决定成立澜起科技（上海）有限公司。

2004年5月14日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2004）152号”《上海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技(上海)有限公司章程和可行性研究报告的批复》，同意澜起科技（上海）有限公司章程和可行性研究报告，澜起有限投资总额为142万美元，注册资本为100万美元。

2004年5月27日，澜起有限取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为“企独沪总字第035939号（徐汇）”《企业法人营业执照》后正式成立。

上海华夏会计师事务所有限公司于2004年6月23日出具的“华夏会外验字（2004）第16号”《验资报告》，确认截至2004年6月11日止，澜起有限已收到股东缴纳的注册资本100万美元。

澜起有限设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Montage Group	100	100.00
	合计	100	100.00

（二）第一次增加注册资本

2005年3月7日，澜起有限董事会决议同意将澜起有限投资总额由142万美元增加到284万美元，注册资本由100万美元增加到200万美元，由Montage Group认缴。

2005年3月24日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2005）96号”《上海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技（上海）有限公司增资的批复》，同意澜起有限此次增资。

随后，澜起有限取得上海市人民政府颁发的注册资本变更完成后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

澜起有限就上述增加注册资本及法定代表人变更事宜相应修改了公司章程、办理了工商变更登记手续并取得变更后的《企业法人营业执照》。

上海沪中会计师事务所有限公司于2005年5月23日出具的“沪会中事（2005）验字第1202号”《验资报告》，确认截至2005年4月14日止，澜起有限新增注册资本100万美元，实缴注册资本200万美元。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Montage Group	200	100.00
	合计	200	100.00

（三）第二次增加注册资本

2006年7月6日，澜起有限董事会决议同意将公司投资总额由284万美元增加到884万美元，注册资本由200万美元增加到500万美元，由Montage Group认缴。

2006年7月18日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2006）347号”《上海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技（上海）有限公司增资的批复》，同意澜起有限此次增资。

随后，澜起有限取得上海市人民政府颁发的注册资本变更完成后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

澜起有限就上述增加注册资本事宜相应修改了公司章程、办理了工商变更登记手续并取得变更后的《企业法人营业执照》。上海上会会计师事务所有限公司于2006年8月17日出具的“上会师报字（2006）第1603号”《验资报告》，确认截至2006年7月28日止，新增注册资本300万美元，累计实缴注册资本500万美元。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Montage Group	500	100.00
	合计	500	100.00

（四）第三次增加注册资本

2007年6月7日，澜起有限董事会决议同意将公司投资总额由884万美元增加到1,884万美元，注册资本由500万美元增加到1,000万美元，由Montage Group认缴。

2007年7月4日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2007）246号”《上海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技（上海）有限公司增资的批复》，同意澜起有限此次增资。

随后，澜起有限取得上海市人民政府颁发的注册资本变更完成后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

澜起有限就上述增加注册资本事宜相应修改了公司章程、办理了工商变更登记手续并取得变更后的《企业法人营业执照》。

上海佳华会计师事务所有限公司于2007年8月1日出具的“佳业外验字（2007）0307号”《验资报告》以及2007年9月3日出具的“佳业外验字（2007）0347号”《验资报告》，确认截至2007年8月17日止，澜起有限新增注册资本共计500万美元，实缴注册资本1,000万美元。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Montage Group	1,000	100.00
	合计	1,000	100.00

（五）第一次股权转让

2010年11月15日，澜起有限董事会决议同意股东 Montage Group 将其所持澜起有限100%股权转让予 Montage HK，转让价格为1,000万美元。同日，Montage Group 与 Montage HK 就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2010年11月29日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2010）923号”《上海市徐汇区人民政府关于澜起科技（上海）有限公司股权转让的批复》，同意澜起有限此次股权转让。

2010年11月29日，澜起有限取得上海市人民政府颁发的股权转让变更完成后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

澜起有限就上述股权转让事宜相应修改了公司章程、办理了工商变更登记手续并取得变更后的《企业法人营业执照》。

此次股权转让完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Montage HK	1,000	100.00
	合计	1,000	100.00

（六）第四次增加注册资本及变更出资币种

2016年3月17日，澜起有限股东作出股东决定，同意：（1）公司变更出资方式，注册资本由1,000万美元变更为人民币78,370,200元；（2）公司投资总额由1,884万美元增加至为人民币2,271,095,325元，注册资本由78,370,200元增加至757,031,775元，新增注册资本678,661,575元由Montage HK出资4,524,382,992元认购，增资款项与新增注册资本的差额计入公司资本公积。2016年5月17日，澜起有限股东作出股东决定，将Montage HK增资款项的出资方式由“合法跨境出资”变更为“等值美元现汇”。

上海市商务委员会于2016年4月5日、2016年5月25日分别出具“沪商外资批[2016]788号”《市商务委关于同意澜起科技（上海）有限公司增资并变更出资币种的批复》以及“沪商外资批[2016]1314号”《市商务委关于同意澜起科技（上海）有限公司变更增资出资方式的批复》，同意澜起有限此次增加注册资本及变更出资币种。

澜起有限取得上海市人民政府颁发的注册资本变更完成后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

澜起有限就上述变更出资币种及增加注册资本事宜相应修改了公司章程、办理了工商变更登记手续并取得了变更后的《营业执照》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月15日出具的“大信验字[2016]第4-00047号”《验资报告》，确认截至2016年6月13日止，澜起有限实际已收到Montage HK认缴的新增注册资本678,661,575元人民币。Montage HK以等值4,524,382,992元人民币的美元现汇出资。澜起有限股东本次出资连同以前出资，累计实缴注册资本757,031,775元。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	Montage HK	757,031,775	100.00
	合计	757,031,775	100.00

（七）第五次增加注册资本

2017年8月，澜起有限拟进行增资，故委托中企华以2017年8月31日为评估基准日对澜起有限股东全部权益价值进行评估。2017年11月24日，中企华出具中企华评报字（2017）第4210号评估报告。上海申威资产评估有限公司于2019年4月1日出具沪申威评报字（2019）第1318号评估报告，进行了追溯评估。

2017年11月30日，澜起有限股东决定，同意由蔴石一号、蔴石二号、蔴石三号、Theon Investment、珠海融扬、珠海融英共六方以不低于上述评估值作为公司投前估值对澜起有限进行现金增资，合计认购澜起有限新增注册资本146,819,325元。

2018年2月11日，澜起有限股东同意澜起有限的投资总额由2,271,095,325元增加至2,711,553,300元，注册资本由757,031,775元增加至903,851,100元，新增注册资本由蔴石一号等六方主体出资833,933,766元认购。

本次新增股东最终受益人均不是发行人的客户或供应商，存在部分发行人员工及其亲属，但上述新增股东最终权益持有人中参与投资的发行人员工及其亲属获取该部分股份与其是否为发行人未来提供服务无关，且获取价格公允。

澜起有限就上述增加注册资本事宜制定新的公司章程，本次增资完成后，公司由外商独资企业变更为中外合资企业。

2018年3月1日，公司取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外资备201800243”《外商投资企业变更备案回执》。

澜起有限就上述增加注册资本事宜制定新的公司章程、办理了工商变更登记手续并取得了变更后的《营业执照》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月11日出具的“大信验字[2018]第4-00026号”《验资报告》，确认截至2018年6月11日止，澜起有限收到新增股东缴纳的出资合计人民币833,933,766元，其中新增注册资本146,819,325元，差额687,114,441元计入公司资本公积。澜起有限股东本次出资连同以前出资，累计实缴注册资本903,851,100元。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
----	------	--------	---------

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	Montage HK	757,031,775	83.757
2	珠海融英	46,176,825	5.109
3	臻石三号	32,972,200	3.648
4	珠海融扬	25,939,975	2.870
5	臻石一号	22,772,325	2.519
6	臻石二号	13,038,000	1.442
7	Theon Investment	5,920,000	0.655
合计		903,851,100	100.000

（八）第二次股权转让

2018年4月26日，澜起有限董事会决议通过股东 Montage HK 将其所持澜起有限 83.757%股权转让给包括中电投控、嘉兴芯电、WLT 在内的 39 名境内外主体。此次股权转让的目的实际为公司拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有澜起有限股权。在完成上述股权转让后，澜起有限穿透后的股权结构保持稳定，未发生重大变化。同日，Montage HK 与 39 名境内外主体就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》，本次股权转让中，每股注册资本对应价格与前次增资一致。

此次股权转让的目的实际为公司拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有澜起有限股权，因此股权最终受益人均为拆除境外架构时的普通股股东指定的主体。此次转让中，除 WLT 和珠海融英最终权益持有人存在部分发行人员工或其亲属外，其余股东最终权益持有人不存在发行人员工、客户或供应商。

2018年4月28日，公司取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外备 201800243”《外商投资企业变更备案回执》。

澜起有限就上述股权转让事宜制定了新的公司章程、办理了工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。

此次股权转让完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	中电投控	161,716,775	17.892
2	嘉兴芯电	21,128,300	2.338
3	WLT	87,816,687	9.716

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
4	珠海融英	69,265,238	7.663
5	上海临理	53,506,750	5.920
6	上海临丰	18,610,575	2.059
7	上海临骥	15,234,825	1.686
8	上海临利	13,339,175	1.476
9	上海临国	13,070,825	1.446
10	临桐建发	9,276,675	1.026
11	上海临齐	7,011,450	0.776
12	嘉兴宏越	44,247,750	4.895
13	嘉兴莫奈	20,634,525	2.283
14	Xinyun I	44,247,750	4.895
15	Xinyun ^注	12,057,500	1.334
16	Xinyun III ^注	2,076,425	0.230
17	臻石一号	22,772,325	2.519
18	臻石二号	13,038,000	1.442
19	臻石三号	32,972,200	3.648
20	中证投资	51,033,325	5.646
21	中睿一期	35,294,550	3.905
22	中睿二期	5,597,200	0.619
23	珠海融扬	25,939,975	2.870
24	Theon Investment	5,920,000	0.655
25	泰瑞嘉德	16,108,750	1.782
26	华天宇投资	9,758,175	1.080
27	上海华伊	21,500,000	2.379
28	光大投资	10,535,175	1.166
29	西藏长乐	10,217,075	1.130
30	宁波信远	10,206,675	1.129
31	杭州调露	9,250,000	1.023
32	上海君弼	8,235,350	0.911
33	Green Spark	7,525,000	0.833
34	Chen Xiao	3,750,000	0.415
35	New Speed	3,125,000	0.346
36	TransLink	3,125,000	0.346

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
37	Pine Stone Capital	2,212,500	0.245
38	BICI	1,047,350	0.116
39	Lip-Bu Tan	500,000	0.055
40	Ko Ping Keung	500,000	0.055
41	前海珂玺	196,250	0.022
42	Xi Jin	100,000	0.011
43	Shun-Wen Chang	100,000	0.011
44	Qian-Shen Bai	50,000	0.006
合计		903,851,100	100.000

注：Xinyun 本次转让时原名称为 CEC Capital Fund, L.P.；Xinyun III 本次转让时原名称为 CEC Capital Fund II, L.P.，现均已更名。

（九）整体变更为股份有限公司

2018 年 10 月 12 日，澜起有限全体股东共同签署《澜起科技股份有限公司（筹）发起人协议》，将澜起有限经瑞华会计师审计的截至 2018 年 7 月 31 日的账面净资产 174,977.06 万元为基础，按照 1: 0.516554 的比例折合为澜起科技股本，计 90,385.11 万股，每股面值人民币 1 元，剩余净资产人民币 84,591.95 万元计入澜起科技的资本公积。同日，澜起有限召开董事会，全体董事审议并一致通过将澜起有限整体变更为股份有限公司及折股方案的议案。2018 年 10 月 28 日，澜起科技召开创立大会暨 2018 年第一次股东大会，会议决议通过公司将澜起有限整体变更为股份有限公司及折股方案的议案。

瑞华会计师于 2018 年 10 月 28 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2018]01500004 号），确认截至 2018 年 10 月 28 日，各发起人对澜起科技的出资已经全部到位。

2018 年 10 月 29 日，公司取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外资备 201801389”《外商投资企业变更备案回执》。

2018 年 10 月 29 日，上海市工商行政管理局就此次整体变更向澜起科技换发了统一社会信用代码为 913100007626333657 的《营业执照》。

本次整体变更完成后，澜起科技各发起人持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	中电投控	161,716,775	17.892

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
2	嘉兴芯电	21,128,300	2.338
3	WLT	87,816,687	9.716
4	珠海融英	69,265,238	7.663
5	上海临理	53,506,750	5.920
6	上海临丰	18,610,575	2.059
7	上海临骥	15,234,825	1.686
8	上海临利	13,339,175	1.476
9	上海临国	13,070,825	1.446
10	临桐建发	9,276,675	1.026
11	上海临齐	7,011,450	0.776
12	嘉兴宏越	44,247,750	4.895
13	嘉兴莫奈	20,634,525	2.283
14	Xinyun I	44,247,750	4.895
15	Xinyun	12,057,500	1.334
16	Xinyun III	2,076,425	0.230
17	箬石一号	22,772,325	2.519
18	箬石二号	13,038,000	1.442
19	箬石三号	32,972,200	3.648
20	中证投资	51,033,325	5.646
21	中睿一期	35,294,550	3.905
22	中睿二期	5,597,200	0.619
23	珠海融扬	25,939,975	2.870
24	Theon Investment	5,920,000	0.655
25	泰瑞嘉德	16,108,750	1.782
26	华天宇投资	9,758,175	1.080
27	上海华伊	21,500,000	2.379
28	光大投资	10,535,175	1.166
29	西藏长乐	10,217,075	1.130
30	宁波信远	10,206,675	1.129
31	杭州调露	9,250,000	1.023
32	上海君弼	8,235,350	0.911
33	Green Spark	7,525,000	0.833
34	Chen Xiao	3,750,000	0.415
35	New Speed	3,125,000	0.346
36	TransLink	3,125,000	0.346
37	Pine Stone Capital	2,212,500	0.245

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
38	BICI	1,047,350	0.116
39	Lip-Bu Tan	500,000	0.055
40	Ko Ping Keung	500,000	0.055
41	前海珂玺	196,250	0.022
42	Xi Jin	100,000	0.011
43	Shun-Wen Chang	100,000	0.011
44	Qian-Shen Bai	50,000	0.006
合计		903,851,100	100.000

（十）第六次增加注册资本

2018年11月23日，公司2018年第一次临时股东大会作出决议，同意 Intel Capital 以 175,074,860 美元的价格认购 101,683,250 股新增股份，SVIC No. 28 Investment 以 19,452,762 美元的价格认购 11,298,150 股新增股份，增资价格系公司与增资方协商确定。此次增资后公司注册资本由 903,851,100 元增加至 1,016,832,500 元。

同日，Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 与公司签署增资协议（以下简称“增资协议”）。增资协议对交割日至公司完成上市日 Intel Capital 享有的相关保护性事项进行了约定，相关权利在公司完成上市之日终止。

根据增资协议约定，交割日至公司完成上市日 Intel Capital 享有的保护性权利主要包括：

- 1、财务信息知情权（合理时间内获取年报和季报的权利）；
- 2、指派董事会观察员事项（有权委派一名董事会观察员列席董事会，但无任何表决权）；
- 3、其他保护性事项，即未经 Intel Capital 同意，公司不得从事如下行为：（1）导致公司解散或清算的行为或为债权人利益提起破产、破产管理等程序；（2）导致公司控制权变更的行为或全部或实质资产的出售、抵押或转让的行为；（3）根据公司章程需要经公司董事会同意的关联交易行为；（4）对公司经营范围进行变更且该变更将对公司履行商业协议产生不利影响。

本次增资的新进股东最终受益人为 Intel 和三星电子，系发行人供应商和客户，但相关股份获取与发行人获得其服务无关。

自 2006 年及 2012 年以来，英特尔、三星电子分别与公司建立了稳定的业务合作关系。经过长期观察和尽职调查，英特尔旗下的 Intel Capital、三星电子间接控制的 SVIC No. 28 Investment，看好公司原海外母公司 Montage Holding 的发展前景，遂决定与 Montage Holding 就相关融资展开谈判，并于 2016 年与 Montage Holding 签署相关协议。

2018 年 4 月，公司拆除境外架构时，因 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 是通过增资方式持有 Montage Holding 的优先股股东，不同于普通股股东，所以 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 与发行人协商以增资的方式成为发行人股东。后经协商谈判，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 于 2018 年 12 月对发行人增资，成为发行人股东。

本次增资对应的投后估值为 17.51 亿美元（约合 120 亿元人民币），对应公司 2018 年扣非后净利润的市盈率倍数为 17.18，与同期同行业一级市场相关投资估值不存在重大差异，具有公允性。

2018 年 12 月 5 日，公司取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外资备 201801552”《外商投资企业变更备案回执》。

公司就上述增加注册资本事宜制定新的章程修正案、办理了工商变更登记手续并取得了变更后的《营业执照》。

瑞华会计师于 2019 年 2 月 28 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2019]01500003 号），确认截至 2019 年 2 月 28 日，本次增资方对澜起科技的出资已经全部到位。

此次增资完成后，澜起科技的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	中电投控	161,716,775	15.904
2	嘉兴芯电	21,128,300	2.078
3	WLT	87,816,687	8.636
4	珠海融英	69,265,238	6.812
5	上海临理	53,506,750	5.262
6	上海临丰	18,610,575	1.830
7	上海临骥	15,234,825	1.498
8	上海临利	13,339,175	1.312

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
9	上海临国	13,070,825	1.285
10	临桐建发	9,276,675	0.912
11	上海临齐	7,011,450	0.690
12	嘉兴宏越	44,247,750	4.352
13	嘉兴莫奈	20,634,525	2.029
14	Xinyun I	44,247,750	4.352
15	Xinyun	12,057,500	1.186
16	Xinyun III	2,076,425	0.204
17	蒋石一号	22,772,325	2.240
18	蒋石二号	13,038,000	1.282
19	蒋石三号	32,972,200	3.243
20	中证投资	51,033,325	5.019
21	中睿一期	35,294,550	3.471
22	中睿二期	5,597,200	0.550
23	珠海融扬	25,939,975	2.551
24	Theon Investment	5,920,000	0.582
25	泰瑞嘉德	16,108,750	1.584
26	华天宇投资	9,758,175	0.960
27	上海华伊	21,500,000	2.114
28	光大投资	10,535,175	1.036
29	西藏长乐	10,217,075	1.005
30	宁波信远	10,206,675	1.004
31	杭州调露	9,250,000	0.910
32	上海君弼	8,235,350	0.810
33	Green Spark	7,525,000	0.740
34	Chen Xiao	3,750,000	0.369
35	New Speed	3,125,000	0.307
36	TransLink	3,125,000	0.307
37	Pine Stone Capital	2,212,500	0.218
38	BICI	1,047,350	0.103
39	Lip-Bu Tan	500,000	0.049
40	Ko Ping Keung	500,000	0.049
41	前海珂玺	196,250	0.019

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
42	Xi Jin	100,000	0.010
43	Shun-Wen Chang	100,000	0.010
44	Qian-Shen Bai	50,000	0.005
45	Intel Capital	101,683,250	10.000
46	SVIC No. 28 Investment	11,298,150	1.111
	合计	1,016,832,500	100.000

四、境外间接上市、退市及拆除境外架构的情况

发行人原间接股东 Montage Group 曾于 2013 年 9 月 26 日在 Nasdaq 股票交易市场挂牌上市，之后于 2014 年完成私有化并下市。Montage Group 在 Nasdaq 上市期间及私有化过程未受到监管部门的行政处罚。上述公司境外上市及退市以及公司原境外架构具体情况如下：

（一）Montage Group Nasdaq 上市情况

1、设立 Montage Group

2004 年 3 月 29 日，Montage Group 在维京群岛注册成立。2006 年 4 月 24 日，Montage Group 将注册地从维京群岛变更至开曼群岛，Montage Group 在维京群岛终止运营，同日，Montage Group 在开曼群岛注册并继续经营，作为后续公司境外架构的资本运作的主体。

2、Montage Group 境外上市

2006 年至 2013 年，Montage Group 多次通过增发股份和股份转让的方式引入 AsiaVest Opportunities Fund IV、Intel Capital(Cayman) Corporation 等新股东。

2013 年 9 月 26 日，Montage Group 在美国 Nasdaq 市场上市交易，股票代码 MONT.O。上市发行价为 10 美元，其中增发新股 5,325,000 股，老股转让 1,775,000 股，共融资 7,100 万美元。

（二）Montage Group 从 Nasdaq 下市情况

1、发出私有化要约

2014年3月10日，Montage Group 宣布其董事会接到上海浦东科技投资有限公司初步的非约束性私有化要约。根据该要约，浦东科投将以每股 21.5 美元的现金收购 Montage Group 全部股份。

2、Montage Group 私有化协议的签署和实施

2014年6月11日，Montage Group 发布公告，Montage Group 同上海浦东科技投资有限公司签署合并计划与协议，该协议已经公司董事会通过，协议约定私有化交易价格为每股普通股 22.60 美元，总交易金额约 6.93 亿美元。

2014年8月1日，Montage Group 发布公告，Montage Group 于 2014 年 7 月 31 日召开股东大会，审议通过了公司同上海浦东科技投资有限公司签署合并计划与协议，批准了 Montage Group 交易的实施。

2014年11月19日，Montage Group 发布公告，Montage Holding 完成对 Montage Group 的收购，交易规模约为 6.93 亿美元，股票于 Nasdaq 退市。

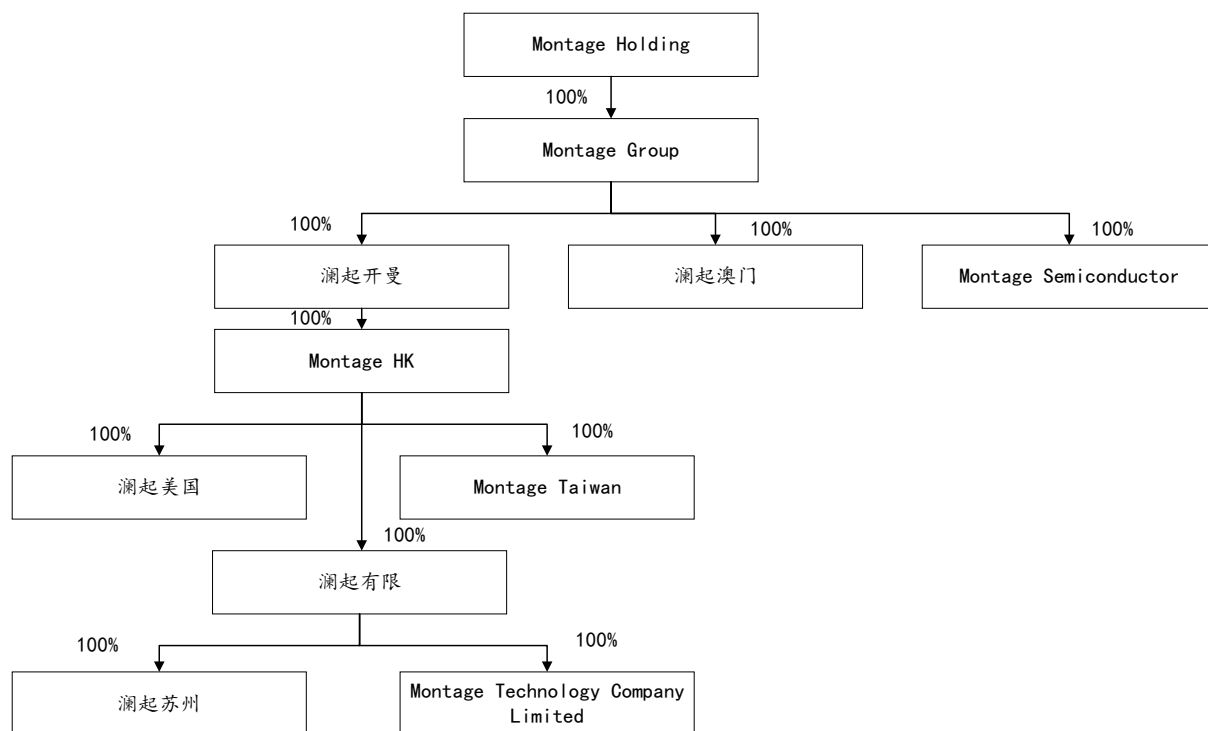
就上述私有化收购，相关实施主体于 2014 年 10 月 24 日取得了商务部出具的编号为境外投资证第 N1000201400012 号《企业境外投资证书》，于 2014 年 10 月 28 日取得了国家发改委出具的编号为发改办外资备[2014]108 号《项目备案通知书》。

私有化后，Montage Group 股权结构如下：

(1) 2014 年 11 月 18 日，Montage Group 股权结构

序号	股东	持有股份数	持股比例
1	Montage Holding	1	100.00%
	合计	1	100.00%

(2) 私有化后，Montage Group 及其下属公司整体架构



3、私有化实施主体 Montage Holding 基本情况

(1) 公司设立

2014年10月22日，CEC Montage Investment Ltd.在开曼注册。2014年11月11日，CEC Montage Investment Ltd.更名为 Montage Technology Global Holdings, Ltd. 作为私有化交易实施平台及后续境外架构的资本运作的主体。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日前的股权调整

Montage Holding 的股东在 2015 年至 2016 年之间，进行了数次股权转让。此外，Montage Holding 于 2016 年 4 月 29 日，向 Intel Capital 发行 A 类优先股 4,067,330 股及向 SVIC No. 28 Investment 发行了 A 类优先股 451,926 股。

截至 2016 年 12 月 31 日，Montage Holding 的普通股股权结构如下：

序号	股东	持有股份数	持股比例
普通股			
1	CEC Industrial Development Investment Inc.	6,468,671	21.36%
2	PKM Holding Co., Ltd.	5,202,011	17.18%
3	Xinyun Capital Fund, L.P.	4,867,252	16.07%
4	Neptune Connection Limited	4,067,330	13.43%

序号	股东	持有股份数	持股比例
5	WLT Partners, L.P.	4,009,145	13.24%
6	持股 5%以下小股东	5,666,862	18.71%
合计		30,281,271	100.00%

(3) Montage Holding 在 2017 年 1 月至 2018 年 5 月的基本情况

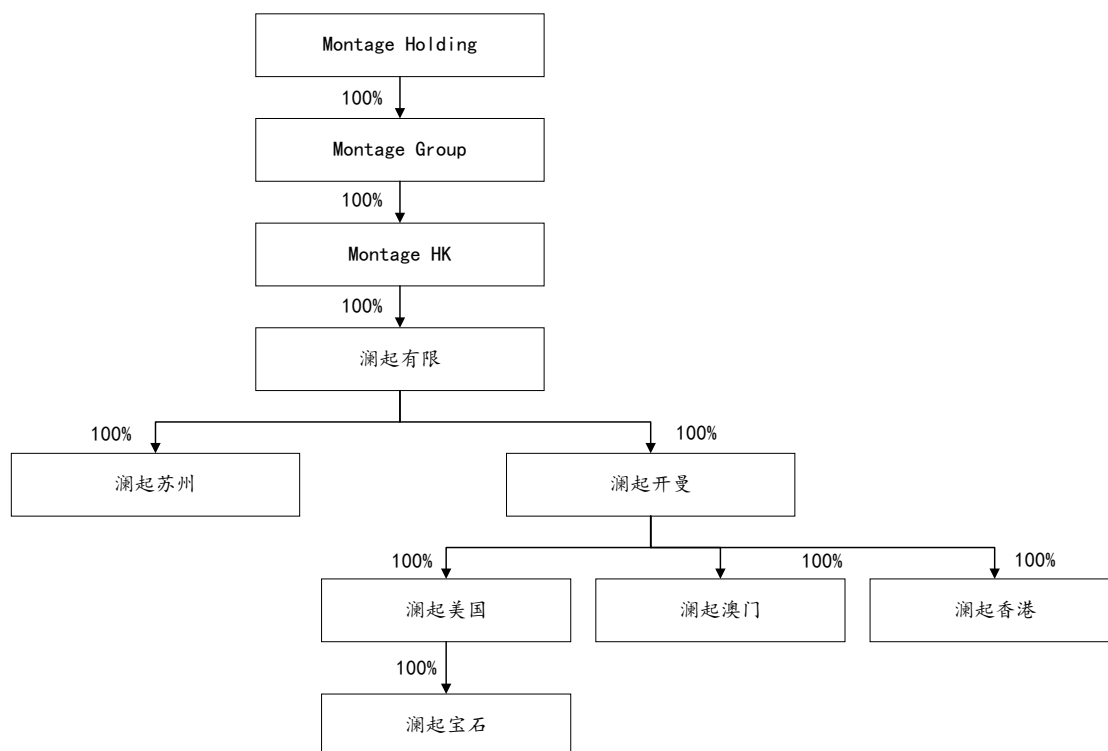
2017 年 1 月至 2018 年 5 月，Montage Holding 第一大股东未发生变化，主要股东保持稳定。2018 年 5 月，澜起有限完成了境外架构的拆除，由 Montage HK 将持有的澜起有限股权转让给原 Montage Holding 层面普通股股东各自指定主体。详见“第五节发行人基本情况”之“三、（八）第二次股权转让”。

(三) Montage Group 退市后境外架构的变动

Montage Group 自境外私有化下市后，为进一步精简管理和层级，对下属公司进行了股权调整，并于 2016 年由澜起有限收购澜起开曼 100% 股权。

有关本次收购的具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“五、（一）2016 年发行人收购同一控制下子公司澜起开曼”。

Montage Holding 在 2016 年 6 月完成下属公司股权调整后，其下属公司股权结构：



2017 年 3 月 Montage HK 根据战略需要设立了成都澜至等主体，从事消费电子芯

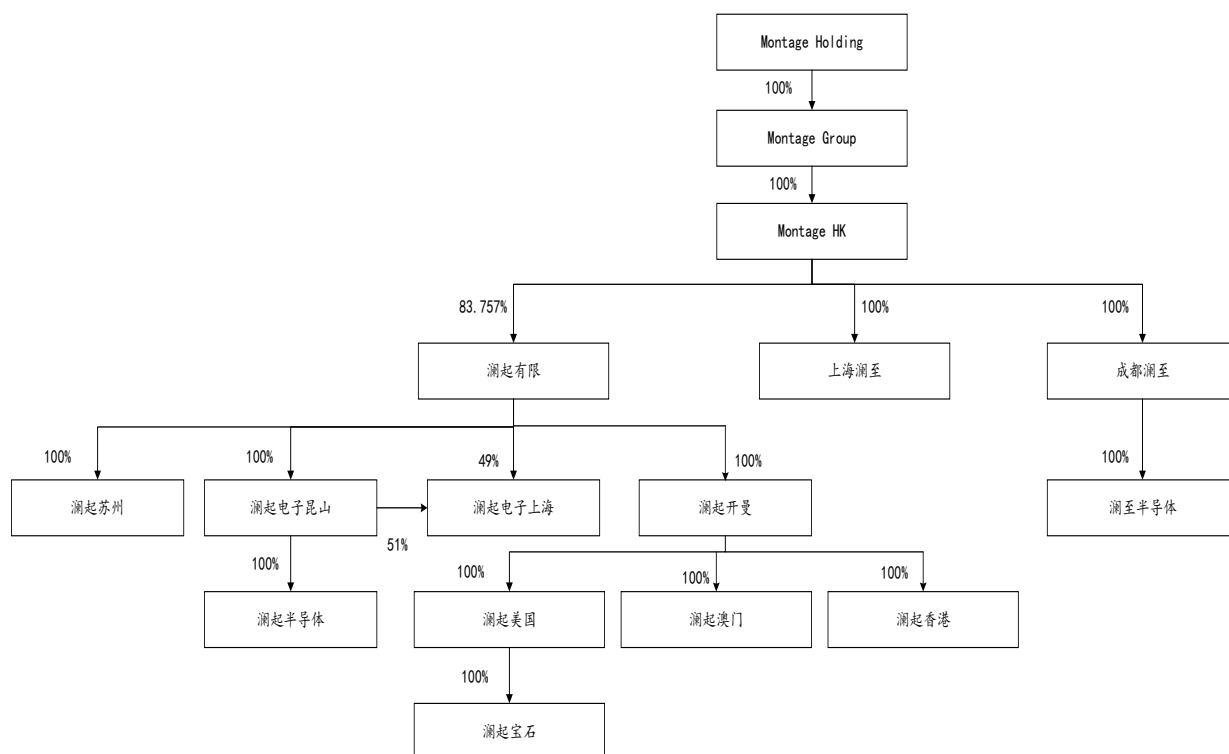
片的研发及产业化。为优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性，Montage Holding 决定澜起有限聚焦于服务器芯片领域，成都澜至聚焦于消费电子芯片领域，让不同业务在不同的主体内独立发展。因此，Montage Holding 决定让澜起有限转让消费电子芯片业务相关资产给成都澜至及其关联方。

有关本次资产转让的具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“五、（二）其他对公司有一定影响的资产重组情况”。

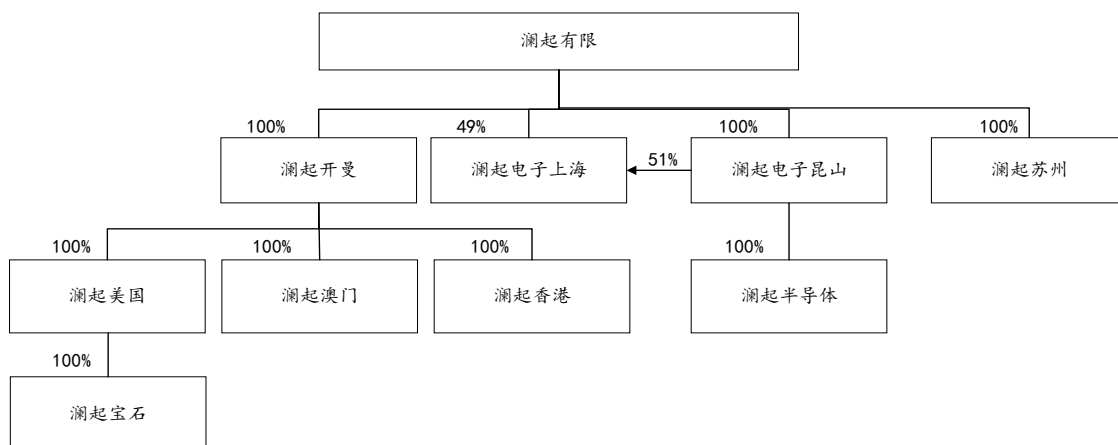
2018 年 4 月，公司决定将境外架构拆除，由 Montage HK 将所持澜起有限全部股权转让给原 Montage Holding 层面普通股股东各自指定主体。至此，澜起有限完成了境外架构的拆除。

有关上述股权转让的具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“三、（八）第二次股权转让”。

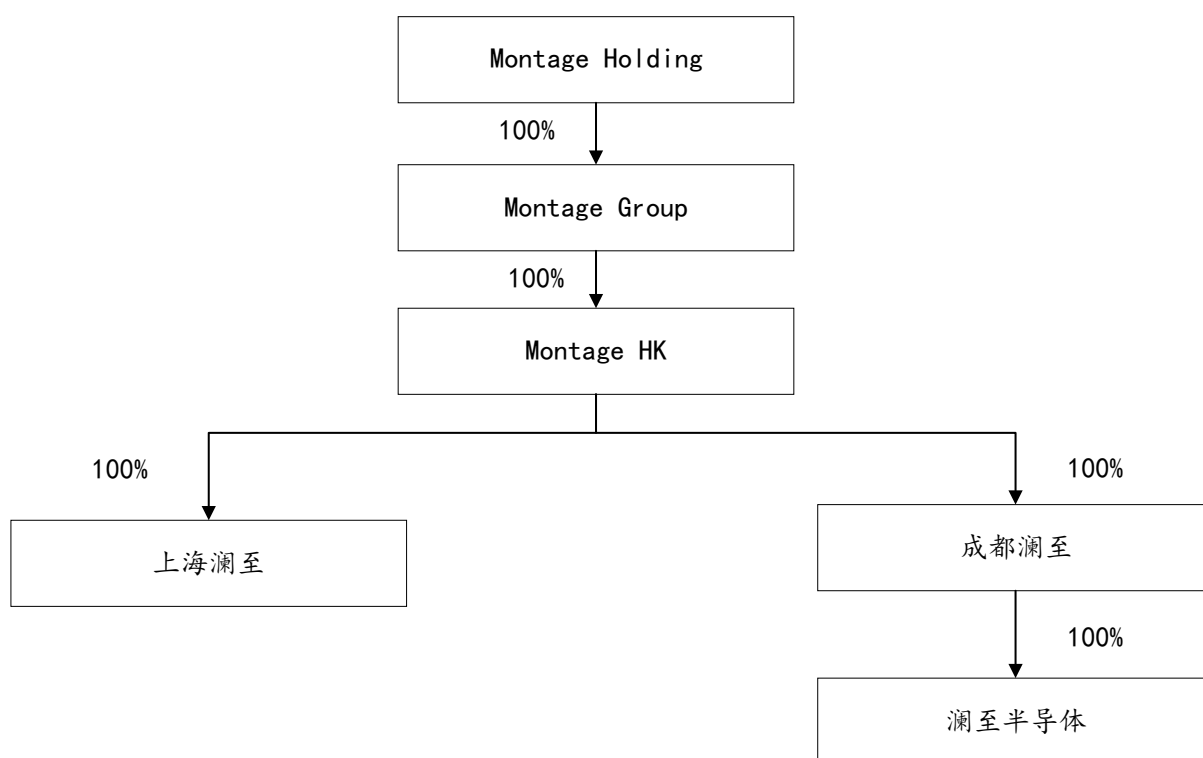
（1）2018 年 4 月，Montage Holding 下属公司股权结构如下：



（2）境外架构拆除后，澜起有限下属公司股权结构如下：



(3) 境外架构拆除后，Montage Holding 下属公司股权结构如下：



五、发行人重大资产重组情况

(一) 2016 年发行人收购同一控制下子公司澜起开曼

Montage Group 在 Nasdaq 退市后，对下属子公司及业务资产进行了调整和整合，将相关海外运营资产整合至澜起开曼主体下。

2016 年 3 月 25 日，为进一步精简管理及股权层级，澜起有限的唯一股东 Montage HK 作出股东决定，同意澜起有限以人民币 4,524,382,992 元的价格受让 Montage

Group 持有澜起开曼的 100% 股权，转让价格系参考 Montage Group 私有化价格。同日，Montage Group 与澜起有限签订股权转让协议。

2016 年 4 月 22 日，澜起有限对澜起开曼的股权收购事项取得国家发展改革委员会办公厅出具的项目备案通知书（发改办外资备[2016]190 号）。2016 年 4 月 27 日，澜起有限就该事项取得上海市商委出具的企业境外投资证书（境外投资证第 N3100201600384 号）。

2016 年 5 月 17 日，澜起有限唯一股东 Montage HK 作出股东决定，将上述交易支付方式变更为等值于人民币 4,524,382,992 元的美元。同日 Montage Group 与澜起有限就该事项签订股权转让协议之补充协议。

2016 年 5 月 31 日，澜起有限就变更投资币种事项取得了上海市商委出具的企业境外投资证书（境外投资证第 N3100201600520 号）。

收购完成后，澜起开曼成为发行人全资子公司。

（二）其他对公司有一定影响的资产重组情况

1、2017 年发行人转让消费电子芯片业务资产

（1）转让的主要原因

自发行人原境外母公司 Montage Group 成立以来，一直保持了持续的运营及研发，发展出内存接口芯片及消费电子芯片两条产品线，消费电子芯片应用于家庭和移动终端，而内存接口芯片应用于云端数据中心。两者在应用领域、产品形态、技术基础、销售渠道、客户构成、业务发展方向等均存在显著差异，且在运营上均有独立的销售、市场以及研发人员支持，业务相对独立。由于原消费电子芯片业务分散在 Montage Group 各个子公司内，2017 年管理层及股东为优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性，决定澜起有限聚焦于服务器芯片领域，成都澜至聚焦于消费电子芯片领域，让不同业务在不同的主体内独立发展，因此决定进行资产重组，将发行人体系内的消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至及其关联方。

（2）受让方基本情况

1) 澜至电子科技（成都）有限公司

成都澜至，成立于 2017 年 3 月 30 日。截至 2018 年 12 月 31 日，成都澜至注册资

本 50,000 万元，是 Montage HK 全资子公司。

2) 上海澜至半导体有限公司

澜至半导体，成立于 2017 年 5 月 25 日。截至 2018 年 12 月 31 日，澜至半导体注册资本 1,000 万元，是成都澜至全资子公司。

3) Montage Group

Montage Group 基本情况请参见本节“四、境外间接上市、退市及拆除境外架构的情况”。截至 2018 年 12 月 31 日，Montage Group 间接持有成都澜至及澜至半导体 100% 股权。

(3) 转让的具体情况

1) 消费电子芯片业务资产处置的相关程序

2017 年 7 月 31 日，Montage Holdings 董事会通过书面决议，同意澜起有限及其子公司出售其消费电子芯片业务相关资产给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group。交易价格以 2017 年 5 月 31 日的评估价值为基础，同时结合交割日的实际情况确定，其中境内资产交易价格为 17,145.06 万元，境外资产交易价格 1,130.99 万美元。

2017 年 7 月 31 日，发行人及其子公司已将其持有的消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group，2017 年 7 月 31 日前已经产生的消费电子业务相关的债权和债务，由发行人承担，债权由发行人收回，债务由发行人支付。

2017 年 7 月 31 日，主要未履行完毕的合同由消费电子芯片业务资产的受让方承接。未履行完毕的销售订单，与客户沟通协商后，由客户重新下订单给由受让方。未完成的采购订单，与供应商协商，晶圆采购订单由受让人重新下单置换发行人原订单，封装测试由发行人关闭工单后，由受让人重新下新的工单的形式承接。受让人在销售和采购订单完成后负责回收和支付相应的款项。

2) 资产转让

针对消费电子芯片业务资产，公司参考相关资产评估报告，并根据交割日相关资产情况进行相应调整后，签订了一系列资产转让协议。

公司与受让方签署的资产转让协议如下：

序号	转让方	受让方	签署时间	被转让资产价格
1	澜起有限	成都澜至	2017/7/31	113,748,794.00 元
2	澜起有限	澜至半导体	2017/7/31	8,370,374.94 元
3	澜起苏州	成都澜至	2017/7/31	233,858.97 元
4	澜起苏州	澜至半导体	2017/7/31	134,788.08 元
5	澜起澳门	Montage Group	2017/7/31	6,553,933.48 美元
6	澜起有限	成都澜至	2017/7/31	48,962,782.20 元
7	澜起澳门	Montage Group	2017/7/31	4,756,000.00 美元

3) 人员转移

2017年7月，公司将消费电子芯片业务相关资产进行转让，同时对相关人员进行转移。澜至有限同澜至半导体签署了《关于STB业务拆分中未结算员工费用转移的说明》，原服务于消费电子芯片业务的员工于2017年7月31日同澜起有限终止劳动关系，并于2017年8月1日同澜至半导体签订劳动合同。转移员工主要包括原消费电子芯片事业部的管理、销售、市场及研发人员以及部分原服务于消费电子芯片业务的后台支持部门人员。

转移人员的结构、转让方与受让方的对应关系如下：

人员类别	人数	转让方	受让方
销售人员	31	澜起有限	澜至半导体
管理人员	9	澜起有限	澜至半导体
研发人员	88	澜起有限	澜至半导体
合计	128		

(4) 转让相关资产的评估值以及评估值与账面值的差异情况、评估基准日至交割日的调整情况

1) 资产评估方式

资产基础法是指通过估算被评估资产的市场公允价值，从而确定被评估资产价值的方法。该类评估方法一般适用于资产转让的资产价值评估，符合消费电子芯片业务除无形资产外其他资产的特性。

收益法是指通过估算被评估资产的未来预期收益并折算成现值，从而确定被评估资产价值的方法。消费电子芯片业务中的无形资产采用了收益法进行估值，收益法通过预

测未来无形资产的收益额并将其折现来确定其价值，经评估机构分析，无形资产未来年度的收益额及所承担的风险均可通过适当的方法合理估测。

2) 相关资产的评估值以及评估值与账面值的差异情况

发行人转让资产的评估基准日是 2017 年 5 月 31 日，转让资产的评估值及账面值差异具体情况如下表：

单位：万元

项目	评估值	账面值	差异	增值率
存货	15,971.70	15,373.39	598.31	3.89%
固定资产	1,087.31	615.77	471.53	76.58%
无形资产	8,162.03	3,181.51	4,980.53	156.55%
其他资产	23.71	23.29	0.42	1.81%
合计	25,244.75	19,193.96	6,050.79	31.52%

相关资产的评估值与账面值主要差异集中在无形资产，主要是因为根据公司会计政策将研发支出全部费用化，账面值均为外购无形资产形成，评估机构结合消费电子芯片业务的未来收入预测，参考行业的无形资产收入分成率和折现率对消费电子芯片相关的无形资产估值，因此导致评估增值。

无形资产经评估出现增值 4,980.53 万元是消费电子芯片相关资产在业务转让中增值 6,050.79 万元的主要原因，并且消费电子芯片业务相关的固定资产和存货出现增值均有合理的原因。

3) 评估基准日与交割日的调整情况和依据

评估基准日 2017 年 5 月 31 日与交割日 2017 年 7 月 31 日资产价值调整情况及依据如下：

①存货：因评估基准日与交割日时间间隔较短，消费电子芯片价格保持总体稳定，发行人按照评估的单价乘以 2017 年 7 月 31 日消费电子芯片的结存数量得出交割日的资产价值。

②固定资产：发行人以评估基准日转让资产的评估值按照评估预测的未来使用年限计提 2 个月折旧后作为交割日的资产价值。

③无形资产：对专利及技术类无形资产，按照收益法确认其评估值，因评估基准日与交割日相近，且市场环境等评估假设未发生变化，因此发行人采用评估基准日的评估

值作为交割日的资产价值。

④其他资产：其他资产主要涉及办公室装修费，发行人以评估基准日的转让资产的评估值按照评估预测的未来使用年限计提 2 个月摊销后作为交割日的资产价值。

（5）转让后，公司与成都澜至不构成同业竞争

2017 年 7 月 31 日后，公司与成都澜至及其子公司均独立运作，不存在业务往来，不存在代垫成本费用或其他利益输送的情形。

截至本招股说明书签署日，成都澜至与公司均独立运作，虽均属于集成电路设计行业，但公司从事的以内存接口芯片为主的服务器芯片业务与成都澜至从事的以机顶盒芯片为主的消费电子芯片业务存在明显差异。

公司目前主要产品包括内存接口芯片以及津逮[®]服务器平台，其中内存接口芯片应用于服务器内存条，是协助中央处理器存取内存数据，提升内存数据访问速度及稳定性的核心逻辑器件，遵循内存接口芯片技术标准，主要为 JEDEC 之 DDR 标准，例如 DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 等；津逮[®]服务器平台是一款高性能的安全可控可信服务器平台，尤其适用于对数据安全有较高要求的数据中心，该服务器平台主要由澜起科技的津逮[®]系列服务器 CPU 和澜起科技具有自主知识产权的混合安全内存模组组成。公司主要客户覆盖了 DRAM 市场的国际龙头企业。

成都澜至销售以机顶盒芯片为主。机顶盒芯片产品包括调谐器、解调器和解码器 SoC 全套芯片以及为客户贴身定制的软件，支持有线、卫星、地面数字电视机顶盒的应用。机顶盒芯片采用的技术标准，即广播模式下的机顶盒声音标准和影像标准，包括 DVB 标准（国际通用广播模式标准）、MPEG2/4（解压缩标准）等。其终端客户主要为机顶盒生产厂家，相对较为分散，其销售模式主要系通过机顶盒领域的专业代销机构淇诺科技、中电器材等，将产品销售至机顶盒制造厂商等。

目前公司同成都澜至在产品线组成、产成品类型、产品功能用途、产品工艺、技术路线与架构、客户渠道等方面均存在显著差异，双方不存在同业竞争。

六、发行人历次股本验资情况

公司及其前身在设立时及设立后共进行过 9 次验资，历次验资情况如下表：

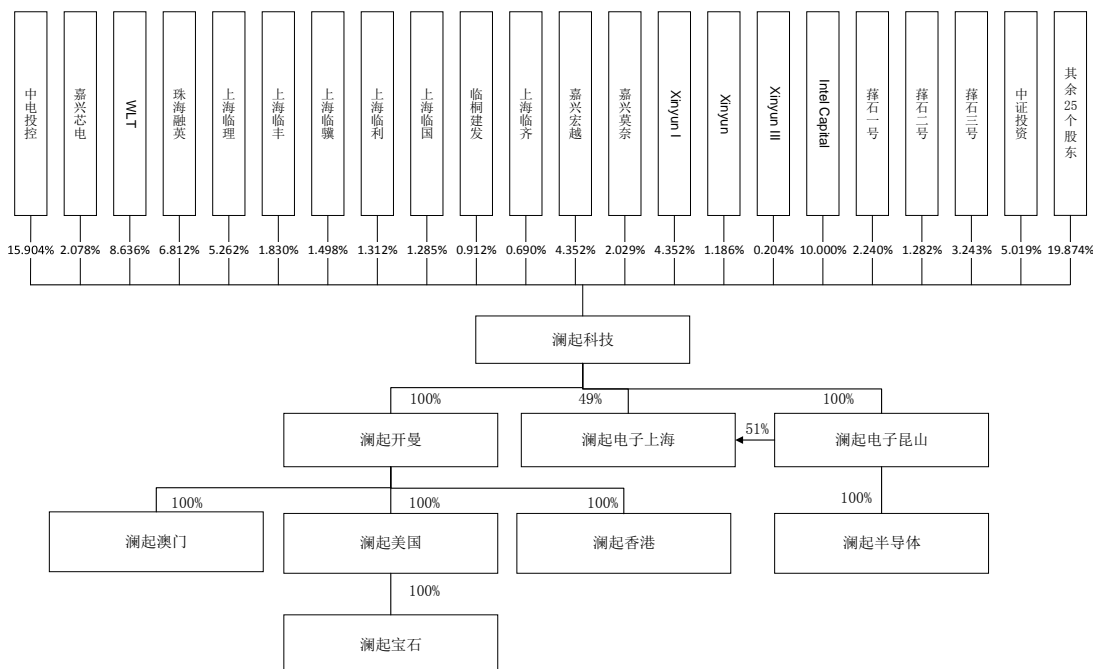
序号	完成工商变更日期	验资目的	验资后实收资本/股本	验资机构	验资报告号
1	2004年5月	发起设立	100万美元	上海华夏会计师事务所有限公司	华夏会外验字（2004）第16号
2	2005年6月	增资扩股	200万美元	上海沪中会计师事务所有限公司	沪会中事（2005）验字第1202号
3	2006年9月	增资扩股	500万美元	上海上会会计师事务所有限公司	上会师报字（2006）第1603号
4	2007年9月	增资扩股	600万美元	上海佳华会计师事务所有限公司	佳业外验字（2007）0307号
5		增资扩股	1000万美元	上海佳华会计师事务所有限公司	佳业外验字（2007）0347号
6	2016年4月	增资扩股并变更出资币种	75,703.1775万元	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信验字[2016]第4-00047号
7	2018年3月	增资扩股	90,385.11万元	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信验字[2018]第4-00026号
8	2018年10月	整体变更净资产投入	90,385.11万元	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	瑞华验字[2018]01500004号
9	2018年12月	增资扩股	101,683.25万元	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	瑞华验字[2019]01500003号

根据相关验资机构出具的《验资报告》，上述验资事项相关的资金投入均已到位。

七、发行人的股权结构和组织结构

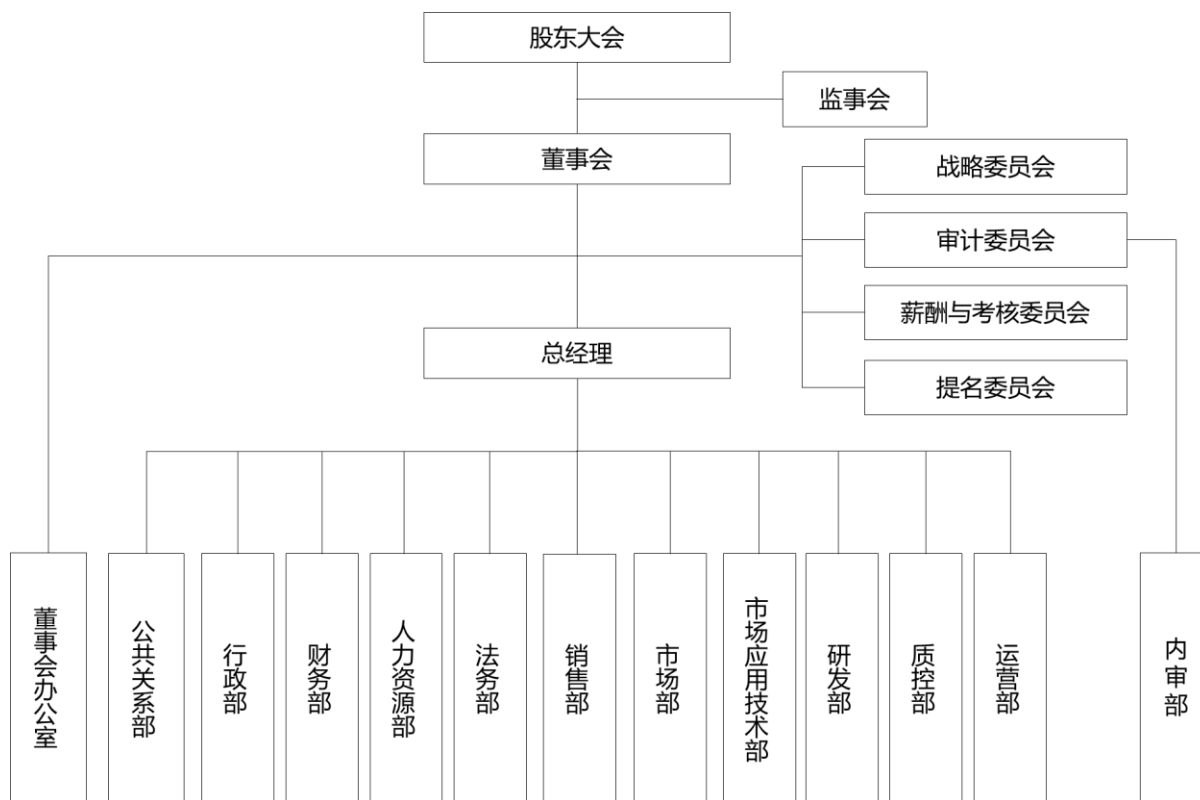
（一）发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：



（二）发行人组织结构的设置情况

截至本招股说明书签署日，发行人组织结构设置情况如下：



（三）发行人主要内部职能部门的工作职责

公司设董事会办公室、行政部、财务部、人力资源部、法务部、公共关系部、销售部、市场部、市场应用技术部、研发部、质控部、运营部、内审部等职能部门。各职能部门的主要职责如下：

职能部门	职责
董事会办公室	负责拟定公司法人治理层面的基本制度和规章，促进股东大会、董事会、监事会规范运作；按法定程序组织公司股东大会、董事会和监事会的召开，进行会议记录并建立完善的档案资料；负责公司资本运作、信息披露及投资者关系等相关工作；负责公司与证券监管部门、新闻媒体、中介机构等部门和机构的沟通与联络
行政部	负责公司日常的行政管理、后勤管理，包括办公环境装修、维护、出差机票预订等
财务部	负责公司财务相关制度的制定和执行，进行日常财务账款管理、运作等；结合业务部门制定财务预算，检查和监督财务预算的执行情况；定期编制财务报告，为管理层决策提供财务数据；向国家税务机关进行定期申报；配合内部和外部审计工作
人力资源部	结合公司经营发展战略制定人力资源规划，负责制定公司各项人力资源管理政策、规章制度、办事流程和操作规范；负责人员的招聘、录用、培养工作；负责绩效考核及薪酬激励制度的制定与实施，负责员工的绩效考核、薪酬福利等相关事宜
法务部	负责合同的拟定、审核、存档等；负责对公司内部的常见法律问题提供解决方案；负责公司谈判、协商等商务活动的法律文件准备；对突发性事件提供法律意见
公共关系部	负责公司对外的公共关系管理，包括各种资质、荣誉的申请、与政府等公共部门的关系协调等工作

职能部门	职责
销售部	负责收集整理客户反馈和市场信息，及时捕获市场发展方向，制定产品销售策略；负责执行销售计划，包括产品销售、推广、以及现场技术支持等工作
市场部	根据市场调研分析、产品技术创新诉求和目标客户需求，负责公司产品战略定位、业务拓展等事务，包括产品定义、项目管理、客户支持等工作
市场应用技术部	负责芯片应用方案设计、技术支持等事务，包括应用方案中软件开发、测试、硬件设计、技术支持等工作
研发部	负责集成电路设计的相关事务，包括数字电路设计、模拟电路设计、芯片验证、后端设计、辅助设计等工作
质控部	负责公司质量管理体系的建立、管理等事务，包括技术流程管理、采购、文档控制、ERP系统管理、IT支持等工作
运营部	负责芯片营运、量产等相关事务，包括物料管理、晶圆工艺设计、芯片封装测试、量产管理等工作
内审部	负责促进公司的有效经营管理并帮助董事会和审计委员会履行其所负有的责任，包括对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估；对资产的安全和完整进行审查和评估；了解和评价公司出现重大风险的可能性，帮助公司改进风险管理等工作

八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介

截至本招股说明书签署日，公司拥有 3 家境内全资子公司以及 5 家境外全资子公司。

（一）发行人的境内全资子公司情况

1、澜起电子科技（昆山）有限公司

澜起电子昆山成立于 2017 年 5 月 26 日，注册资本为 20,000 万元，实收资本为 20,000 万元，住所为昆山开发区夏东街 628 号，经营范围为：“从事电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；集成电路、软件产品、电子元器件、电子产品及其相关电子系统的设计、批发、贸易代理并提供相关配套技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

澜起科技直接持有澜起电子昆山 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起电子昆山经审计的总资产为 29,981.85 万元，净资产为 15,089.37 万元，2018 年度净利润为-2,412.84 万元。

2、昆山澜起半导体有限公司

澜起半导体成立于 2018 年 4 月 10 日，注册资本为 100 万元，实收资本为 100 万元，住所为昆山综合保税区新巷路 116 号 3 号房，经营范围为：“从事电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；集成电路、计算机软件、电子元器件、

电子产品的设计、销售；计算机系统集成；仓储服务（不含危险品）；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。澜起科技通过全资子公司澜起电子昆山间接持有澜起半导体 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起半导体经审计的总资产为 14,704.33 万元，净资产为 4,318.56 万元，2018 年度净利润为 4,218.56 万元。

3、澜起电子科技（上海）有限公司

澜起电子上海成立于 2018 年 4 月 18 日，注册资本为 5,000 万元，住所为上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 620 室 J01，经营范围为：“从事电子科技专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，集成电路、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、电子产品的设计、销售，从事货物进出口及技术的进出口业务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。澜起科技直接持有 49%股权，通过全资子公司澜起电子昆山间接持有 51%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起电子上海股东尚未完成出资，澜起电子上海尚未开展任何经营或发生任何交易。

（二）发行人的境外全资子公司情况

1、境外全资子公司的基本情况

（1）Montage Technology Holdings Company Limited（澜起开曼）

澜起开曼成立于 2010 年 6 月 17 日，发行股数为 50,000 股，每股 1 美元。根据开曼群岛法律，澜起开曼合法有效存续。发行人持有澜起开曼 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起开曼经审计的总资产为 18,292.27 万美元、净资产为 14,292.27 万美元，2018 年度净利润 9,997.70 万美元。

（2）Montage Technology Inc.（澜起美国）

澜起美国成立于 2005 年 10 月 17 日，股本数为 1,000 股，注册地为美国加州。根据美国法律，澜起美国合法有效存续。发行人通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起美国的 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起美国经审计的总资产为 338.08 万美元、净资产为 -99.22 万美元，2018 年度净利润 30.15 万美元。

(3) Porsche Acquisition Sub, Inc.（澜起宝石）

澜起宝石于 2015 年 9 月 22 日完成商业登记注册，股本数为 1,000 股，注册地为美国加州。根据美国法律，澜起宝石合法有效存续。发行人通过全资子公司澜起美国间接持有澜起宝石的 100% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起宝石经审计的总资产为 3.17 万美元、净资产为-0.46 万美元，2018 年度净利润-0.12 万美元。

(4) Montage Hong Kong Holdings Company Limited（澜起香港）

澜起香港于 2016 年 4 月 21 日完成商业登记注册，发行股数为 1 股，每股 1 港币，注册地为香港。发行人通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起香港的 100% 股权。

2016 年 6 月 8 日，澜起香港在台湾地区设立办事处，住址为台北市内湖区基湖路 3 巷 47 号 2 楼。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起香港股东尚未完成出资，澜起香港尚未开展任何经营或发生任何交易。

(5) Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited（澜起澳门）

澜起澳门原名为“Triple Win Macao Commercial Offshore Limited”（以下简称“Triple 澳门”）于 2003 年 5 月 12 日由 Triple Win Holdings Inc. 完成商业登记注册，股本数为 50 万澳门元，注册地为澳门，2007 年 1 月 17 日，Triple 澳门更名为“Sonoma Macao Commercial Offshore Limited”（以下简称“Sonoma 澳门”）。2013 年 4 月 18 日 Triple Win Holdings Inc. 将其所持有的 Sonoma 澳门出资额转让给了 Montage Group，同时 Sonoma 澳门公司名称变更为 Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited（澜起澳门）。2016 年 2 月 5 日，Montage Group 将其持有的澜起澳门出资额转让给了澜起开曼。2018 年 6 月 5 日，澜起澳门在韩国设立外国公司分支机构，住址为京畿道城南市盆唐区 Banga-ro21，2 楼。

发行人采取 Fabless 的生产模式，将晶圆制造、封装和测试均交由外协厂商负责。由于发行人的晶圆制造、封装和测试的供应商及发行人客户大部分位于境外或者使用境外主体与发行人进行交易，因此为了简化交易，发行人通过澜起澳门进行境外采购及销售。

母公司及澜起澳门业务合作模式为：澜起科技主要负责技术开发，并向澜起澳门提供技术授权并收取特许权使用费；澜起澳门依托于母公司的芯片设计成果将产品的生产和封装测试外包至境外第三方工厂，之后将产成品芯片直接销售至第三方客户。

截至本招股书签署日，公司通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起澳门的 100% 股权，澜起澳门的董事为杨崇和及 Stephen Kuong-lo Tai，主要负责境外采购和产品销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起澳门经京澳会计师事务所审计的总资产为 26,459.36 万美元、净资产为 8,900.06 万美元，2018 年度净利润 8,357.88 万美元。公司已聘请有资质的中介机构对公司的内部关联交易安排进行复核审阅，公司每年都按照法律法规要求及时准备并向相关部门提交关联交易同期文档资料。

（三）报告期内发行人注销的全资子公司情况

1、苏州澜起微电子科技有限公司

澜起苏州成立于 2011 年 3 月 3 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，住所为苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-1002 单元，经营范围为：“集成电路设计与线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件的设计、开发、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；从事上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2017 年公司转让消费电子芯片业务资产后，澜起苏州无实质业务。澜起苏州已于 2018 年 11 月 12 日完成税务注销，于 2018 年 12 月 29 日完成工商注销。

2、Montage Technology Company Limited

Montage Technology Company Limited 于 2008 年 4 月 7 日完成商业登记注册，发行股数为 10,000 股，每股 1 港币，注册地为香港。该公司于 2016 年 2 月 19 日注销。

报告期内，Montage Technology Company Limited 无实质业务。

（四）发行人各子公司业务情况

1、子公司的主要业务活动

子公司	主要业务活动
澜起电子昆山	从事研发活动
澜起半导体	从事产品销售

澜起电子上海	报告期未开展经营活动
澜起开曼	境外公司的控股平台
澜起澳门	承担境外采购、产品的销售
澜起美国	提供销售支持服务
澜起宝石	报告期未开展经营活动
澜起香港	报告期未开展经营活动

2、母公司与子公司业务分工安排及主要考虑

主体	业务分工	主要考虑
母公司	决策主体及研发、运营职能	母公司作为集团业务的决策主体，承担部分研发及运营职能
澜起电子昆山	研发职能	业务的区域布局和研发能力的分工与扩展
澜起半导体	从事产品销售	负责部分产品销售
澜起电子上海	从事研发及销售	业务的区域布局和研发能力的分工与扩展
澜起开曼	投资控股	控股境外公司
澜起澳门	境外采购及产品销售	由于发行人的客户和供应商大部分位于境外或者使用境外主体与发行人进行交易，因此为了简化交易，发行人通过澜起澳门进行境外采购及销售。
澜起美国	销售支持服务	为美国等境外客户提供支持
澜起宝石	投资控股	拟用于境外投资、收购
澜起香港	投资控股	拟用于境外投资、收购

（五）母子公司之间的内部交易方式

1、母子公司之间的内部交易方式、定价机制、资金流转情况

母子公司之间的内部交易方式、定价机制、资金流转情况如下：

内部交易方式	定价机制	资金流转情况
销售商品	市场价格	消费电子芯片产品在国内生产后，母公司销售产品给澜起澳门，澜起澳门向母公司支付货款
提供技术开发服务	市场价格	澜起澳门委托母公司对新产品进行研发，并支付给母公司技术开发费用
收取特许权费用	市场价格	对于母公司提供技术的产品，母公司根据销售额向澜起澳门收取产品的特许权费用

2、内部转移定价安排情况

2016 年至 2017 年转让消费电子芯片业务相关资产之前，澜起澳门主要负责境外采购及销售的职能，而母公司负责芯片产品开发及测试的职能，是公司重要的研发中心，为公司新产品研发及试产提供重要保障，母子公司之间的内部交易方式采用澜起澳门委

托母公司提供技术开发服务，并向母公司支付技术开发费用。

2017 年转让消费电子芯片业务相关资产之后，母公司定位于主要承担战略决策、研发和运营的职能，母公司根据自身价值贡献情况向使用母公司技术的销售子公司收取特许权使用费。

九、公司股东及实际控制人的基本情况

（一）持有 5%以上股份的股东基本情况

截至本招股说明书签署日，公司持有 5%以上股份的股东为：1、中电投控及其关联方嘉兴芯电；2、WLT 及其关联方珠海融英；3、上海临理及其关联方，包括上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐；4、嘉兴宏越及其关联方，包括嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III；5、Intel Capital；6、蔺石一号及其关联方蔺石二号、蔺石三号；7、中证投资。

1、中电投控

公司名称	中国电子投资控股有限公司			
成立时间	2012 年 8 月 27 日			
注册资本	148,465.25 万元			
实收资本	148,465.25 万元			
注册地	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 21 层			
法定代表人	邓向东			
主营业务及与发行人主营业务的关系	股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询。与发行人主营业务没有直接关系。			
实际控制人	无实际控制人，第一大股东为中国电子信息产业集团有限公司			
主要财务数据（万元） （已经立信会计师事务所审计）	截止日/期间	总资产	净资产	净利润
	2018-12-31/ 2018 年度	513,560.40	223,745.06	9,042.35

截至本招股说明书签署日，股东构成及出资比例如下表所示：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	中国电子信息产业集团有限公司	30.00
2	北京建信瑞祥投资管理中心（有限合伙）	20.00
3	国新科创股权投资基金（有限合伙）	20.00
4	武汉伊莱克股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15.00

序号	股东名称	出资比例（%）
5	北京亦庄国际投资发展有限公司	15.00
	合计	100.00

2、嘉兴芯电

企业名称	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年1月29日
统一社会信用代码	91330402MA28A6T11A
执行事务合伙人	嘉兴中电朝云投资管理有限公司（委派代表：谢竞彤）
主营业务	实业投资、投资管理。与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼101室-64
普通合伙人	嘉兴中电朝云投资管理有限公司

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	嘉兴中电朝云投资管理有限公司	普通合伙人	0.04
2	天津鹏吉亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	99.44
3	王静	有限合伙人	0.52
	合计		100.00

嘉兴芯电普通合伙人嘉兴中电朝云投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	嘉兴中电朝云投资管理有限公司
成立时间	2016年9月26日
统一社会信用代码	91330402MA28ANKX26
经营范围/主营业务	投资管理、资产管理
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼101室-65

嘉兴中电朝云投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	中电通商融资租赁有限公司	100.00
	合计	100.00

3、WLT Partners, L.P.

企业名称	WLT Partners, L.P.
成立时间	2015年10月15日
公司注册编号	83610

企业名称	WLT Partners, L.P.
普通合伙人	WYK Co.,Ltd
主营业务	投资。与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	合伙权益比例（%）
1	WYK Co.,Ltd	普通合伙人	23.33
2	杨崇和	有限合伙人	23.33
3	Stephen Kuong-lo Tai	有限合伙人	23.33
4	SCGC Capital Holding Company Limited	有限合伙人	30.00
	合计		100.00

WLT 普通合伙人 WYK Co., Ltd.的基本情况如下：

名称	WYK Co., Ltd.
成立时间	2015年10月9日
注册编码	304710
经营范围/主营业务	投资

WYK Co., Ltd.目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Tai kuai Lap	50.00
2	Chao long Wa	50.00
	合计	100.00

4、珠海融英

企业名称	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年2月4日
统一社会信用代码	91440400MA4UM0K41T
执行事务合伙人	杨崇颐；青岛蓝色半岛股权投资管理有限公司（委派代表：贲金锋）
主营业务	股权投资、投资管理。与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	青岛蓝色半岛股权投资管理有限公司	普通合伙人	0.00
2	杨崇颐	普通合伙人	0.00
3	Harmonialux Holdings(Hong Kong) Limited	有限合伙人	100.00

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
	合计		100.00

5、上海临理

企业名称	上海临理投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年11月23日
统一社会信用代码	91310115MA1H75XF98
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司（委派代表：李亚军）
主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海理能资产管理有限公司	普通合伙人	0.08
2	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.08
3	昆山理成盛联股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	20.48
4	上海理成资产管理有限公司	有限合伙人	14.73
5	宁波江湓投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	13.21
6	平潭建发柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9.22
7	西藏派诺投资咨询有限公司	有限合伙人	8.80
8	宁波钰鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.48
9	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.05
10	程义全	有限合伙人	3.97
11	深圳市同创伟业创业投资有限公司	有限合伙人	2.99
12	上海俊颐商务咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2.65
13	上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2.20
14	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）	有限合伙人	1.77
15	深圳市创新投资集团有限公司	有限合伙人	1.77
16	上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.76
17	广州隆玺壹号投资中心（有限合伙）	有限合伙人	0.89
18	上海永徽隆启创业投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	0.89

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
	合计		100.00

上海临理普通合伙人上海理能资产管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司的基本情况如下：

（1）上海理能资产管理有限公司

名称	上海理能资产管理有限公司
成立时间	2013年7月16日
统一社会信用代码	913101130729710765
经营范围/主营业务	资产管理；投资管理
住所	上海市宝山区蕴川路5503号A幢561室

上海理能资产管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	程义全	100.00
	合计	100.00

（2）上海临芯投资管理有限公司

名称	上海临芯投资管理有限公司
成立时间	2015年5月26日
统一社会信用代码	91310115342373528A
经营范围/主营业务	实业投资、投资咨询、投资管理（除经纪）
住所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区1250室

上海临芯投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	李亚军	35.00
2	上海清云图投资合伙企业（有限合伙）	30.00
3	靖昕伟	20.00
4	中原信托有限公司	15.00
	合计	100.00

6、上海临丰

企业名称	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年11月23日

企业名称	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MA1H75XE0B
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司（委派代表：李亚军）
主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	法鳌资本管理（北京）有限公司	普通合伙人	0.45
2	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.27
3	张伟	有限合伙人	23.19
4	萍乡盛誉企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	23.19
5	谭健	有限合伙人	16.24
6	薛超雄	有限合伙人	13.13
7	张益驰	有限合伙人	9.28
8	刘曙光	有限合伙人	4.64
9	沈存礼	有限合伙人	1.95
10	顾然	有限合伙人	1.86
11	华通	有限合伙人	1.39
12	周玟朵	有限合伙人	1.39
13	郝若辰	有限合伙人	0.93
14	张雪菲	有限合伙人	0.93
15	廖茂林	有限合伙人	0.70
16	常亮	有限合伙人	0.46
	合计		100.00

上海临丰普通合伙人法鳌资本管理（北京）有限公司、上海临芯投资管理有限公司的基本情况如下：

（1）法鳌资本管理（北京）有限公司

名称	法鳌资本管理（北京）有限公司
成立时间	2016年3月11日
统一社会信用代码	91110105MA0043NX3P
经营范围/主营业务	资产管理；投资管理；项目投资
住所	北京市朝阳区霞光里 8 号 2 号楼六层 8602A 室

法鳌资本管理（北京）有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	周玟朵	100.00
	合计	100.00

（2）上海临芯投资管理有限公司

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本节（一）持有 5%以上股份的股东基本情况 5、上海临理（2）上海临芯投资管理有限公司部分。

7、上海临骥

企业名称	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 23 日
统一社会信用代码	91310115MA1H75RT5G
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司（委派代表：李亚军）
主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.37
2	深圳市领骥资本管理有限公司	普通合伙人	0.19
3	青岛银邑投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	99.44
	合计		100.00

上海临骥普通合伙人上海临芯投资管理有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司的基本情况如下：

（1）上海临芯投资管理有限公司

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本节（一）持有 5%以上股份的股东基本情况 5、上海临理（2）上海临芯投资管理有限公司部分。

（2）深圳市领骥资本管理有限公司

名称	深圳市领骥资本管理有限公司
成立时间	2015 年 2 月 28 日
统一社会信用代码	914403003197446777

经营范围/主营业务	投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

深圳市领骥资本管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	曹鸿伟	65.00
2	湖北瑞森嘉茂贸易有限公司	35.00
	合计	100.00

8、上海临利

企业名称	上海临利投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年12月7日
统一社会信用代码	91310115MA1H77T49A
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司（委派代表：李亚军）
主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	1.37
2	北京盛世共赢资产管理有限公司	普通合伙人	0.46
3	达孜欧律投资中心（有限合伙）	有限合伙人	44.03
4	江阴优势同创产业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	36.06
5	上海桐彤企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	9.11
6	苏州优势四号投资中心（有限合伙）	有限合伙人	8.98
	合计		100.00

上海临利普通合伙人上海临芯投资管理有限公司、北京盛世共赢资产管理有限公司的基本情况如下：

（1）上海临芯投资管理有限公司

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本节（一）持有5%以上股份的股东基本情况5、上海临利（2）上海临芯投资管理有限公司部分。

（2）北京盛世共赢资产管理有限公司

名称	北京盛世共赢资产管理有限公司
成立时间	2014年11月6日
统一社会信用代码	91110105318162288D
经营范围/主营业务	资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；项目投资；投资管理；投资咨询
住所	北京市朝阳区朝阳门南大街14号二层2412

北京盛世共赢资产管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	中欧盛世资产管理（上海）有限公司	100.00
	合计	100.00

9、上海临国

企业名称	上海临国投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年11月23日
统一社会信用代码	91310115MA1H75XD2G
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司（委派代表：李亚军）
主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	青岛海丝泉宗投资管理有限公司	普通合伙人	0.65
2	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.39
3	青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	有限合伙人	98.97
	合计		100.00

上海临国普通合伙人青岛海丝泉宗投资管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司的基本情况如下：

（1）青岛海丝泉宗投资管理有限公司

名称	青岛海丝泉宗投资管理有限公司
成立时间	2015年9月7日
统一社会信用代码	91370212350344436P

经营范围/主营业务	自有资金对外投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
住所	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001 室

青岛海丝泉宗投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	青岛城投金融控股集团有限公司	36.00
2	王朝晖	32.00
3	深圳泉宗投资有限公司	32.00
	合计	100.00

（2）上海临芯投资管理有限公司

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本节（一）持有 5%以上股份的股东基本情况 5、上海临理（2）上海临芯投资管理有限公司部分。

10、临桐建发

企业名称	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 24 日
统一社会信用代码	91310115MA1H763C6F
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司（委派代表：李亚军）
主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.80
2	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	有限合伙人	40.00
3	宁波典烁投资中心（有限合伙）	有限合伙人	30.00
4	王琳玲	有限合伙人	12.00
5	尤金花	有限合伙人	5.60
6	施金根	有限合伙人	5.60
7	王荣仙	有限合伙人	4.00
8	梅勤峰	有限合伙人	1.00
9	徐晓刚	有限合伙人	1.00

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
	合计		100.00

临桐建发普通合伙人上海临芯投资管理有限公司的基本情况如下：

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本节（一）持有 5%以上股份的股东基本情况 5、上海临理（2）上海临芯投资管理有限公司部分。

11、上海临齐

企业名称	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 23 日
统一社会信用代码	91310115MA1H75Y7XK
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司（委派代表：李亚军）
主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	1.20
2	文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	37.05
3	宁波瀚丰长元股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	24.70
4	郝向东	有限合伙人	24.70
5	崔春	有限合伙人	12.35
	合计		100.00

上海临齐普通合伙人上海临芯投资管理有限公司的基本情况如下：

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本节（一）持有 5%以上股份的股东基本情况 5、上海临理（2）上海临芯投资管理有限公司部分。

12、嘉兴宏越

企业名称	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 17 日
统一社会信用代码	91330402MA28A2DL2A
执行事务合伙人	嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：韩丹）
主营业务	实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务没有直接关系。

主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 101 室-70
---------------	---------------------------------------

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.40
2	上海齐银股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	0.01
3	昆山理弋股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	23.78
4	义乌淳施投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	16.70
5	华峰集团有限公司	有限合伙人	15.20
6	杭州秋祺投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15.20
7	杭州圆成投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	13.31
8	海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.50
9	丽水中盈酉导天行股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.50
10	袁霞	有限合伙人	0.40
合计			100.00

嘉兴宏越普通合伙人嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、上海齐银股权投资基金管理有限公司的基本情况如下：

(1) 嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 12 日
统一社会信用代码	91330402MA28A27P7T
经营范围/主营业务	投资管理
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 101 室-68

嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	袁霞	普通合伙人	80.00
2	刘芳	有限合伙人	20.00
合计		/	100.00

(2) 上海齐银股权投资基金管理有限公司

名称	上海齐银股权投资基金管理有限公司
成立时间	2015 年 11 月 25 日

统一社会信用代码	91310000MA1FL0NK7W
经营范围/主营业务	股权投资管理，投资管理，资产管理
住所	中国（上海）自由贸易试验区东方路 738 号 905 室

上海齐银股权投资基金管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	孙兴华	51.00
2	王路	49.00
	合计	100.00

13、嘉兴莫奈

企业名称	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018 年 4 月 17 日
统一社会信用代码	91330402MA2B9X3B91
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区宏焱投资管理有限公司（委派代表：韩丹）
主营业务	股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与发行人主营业务没有直接关系。
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 120 室-26

截至本招股说明书签署日，嘉兴莫奈目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	宁波梅山保税港区宏焱投资管理有限公司	普通合伙人	0.01
2	上海旗贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	49.79
3	上海霆杨投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	18.37
4	上海涌善投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	10.19
5	上海桓融电子科技合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8.25
6	宁波与君股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.32
7	杨永梅	有限合伙人	2.29
8	袁霞	有限合伙人	1.47
9	天津德瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.44
10	杨玉杰	有限合伙人	0.87
	合计	/	100.00

嘉兴莫奈普通合伙人宁波梅山保税港区宏焱投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	宁波梅山保税港区宏焱投资管理有限公司
成立时间	2018 年 3 月 15 日

统一社会信用代码	91330206MA2AHH893W
经营范围/主营业务	投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0173

宁波梅山保税港区宏焱投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	袁霞	95.00
2	韩丹	5.00
	合计	100.00

14、Xinyun Capital Fund I, L.P.

企业名称	Xinyun Capital Fund I, L.P.
成立时间	2016 年 7 月 29 日
公司注册编号	86620
普通合伙人	Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.
主营业务	投资。与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.	普通合伙人	0.00
2	Green Spark Investment II Limited	有限合伙人	100.00
3	Xinyun Investment I, LLC	有限合伙人	0.00
	合计		100.00

Xinyun Capital Fund I, L.P.普通合伙人 Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.的基本情况如下：

名称	Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.
成立时间	2014 年 4 月 10 日
注册编码	286896
经营范围/主营业务	投资

Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.的目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Yunfeng Investment III, Ltd.	100.00
	合计	100.00

15、Xinyun Capital Fund, L.P.

企业名称	Xinyun Capital Fund, L.P.
成立时间	2014年12月19日
公司注册编号	80503
普通合伙人	Xinyun Capital Management, Ltd.
主营业务	投资。与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	Xinyun Capital Management, Ltd.	普通合伙人	0.00
2	Tonex Controls Limited	有限合伙人	91.74
3	Leslie Nian LEE	有限合伙人	8.26
	合计		100.00

Xinyun Capital Fund, L.P.普通合伙人 Xinyun Capital Management, Ltd.的基本情况如下：

名称	Xinyun Capital Management, Ltd.
成立时间	2014年12月17日
注册编码	294758
经营范围/主营业务	投资

Xinyun Capital Management, Ltd.的目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Yuan Xia	50.00
2	Jimmy Lee	50.00
	合计	100.00

16、Xinyun Capital Fund III, L.P.

企业名称	Xinyun Capital Fund III, L.P.
成立时间	2015年9月30日
公司注册编号	83426
普通合伙人	Xinyun Capital Management III, Ltd.
主营业务	投资。与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	Xinyun Capital Management III,Ltd.	普通合伙人	0.00
2	Li Tong	有限合伙人	56.25
3	Sino French Resources Limited	有限合伙人	16.41
4	Sun Fanghong	有限合伙人	19.79
5	JI MIN Jimmy LEE	有限合伙人	7.55
合计			100.00

Xinyun Capital Fund III, L.P.普通合伙人 Xinyun Capital Management III,Ltd 的基本情况如下：

名称	Xinyun Capital Management III,Ltd
成立时间	2015年9月30日
注册编码	304386
经营范围/主营业务	投资

Xinyun Capital Management III,Ltd 的目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Yuan Xia	50.00
2	Jimmy Lee	50.00
合计		100.00

17、Intel Capital

名称	Intel Capital Corporation
成立时间	1998年4月6日
统一社会信用代码	2880872
经营范围/主营业务	投资
实际控制人	Intel Corporation

Intel Capital 目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	Intel Corporation	100.00
合计		100.00

18、蒋石一号

企业名称	嘉兴蒋石一号投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年1月10日

企业名称	嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MA28BAM3XB
执行事务合伙人	嘉兴铂林投资管理有限公司（委派代表：梁铂钻）、上海君桐股权投资管理有限公司（委派代表：梁铂钻）
主营业务	实业投资、股权投资、投资管理。 与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	嘉兴铂林投资管理有限公司	普通合伙人	0.73
2	上海君桐股权投资管理有限公司	普通合伙人	0.73
3	茅道临	有限合伙人	8.78
4	郭斌林	有限合伙人	5.49
5	文俊	有限合伙人	4.39
6	胡兰	有限合伙人	4.39
7	范卫东	有限合伙人	4.39
8	张一苓	有限合伙人	4.14
9	蒋逸波	有限合伙人	3.84
10	汤伟	有限合伙人	3.73
11	杜永民	有限合伙人	2.96
12	吴顺方	有限合伙人	2.63
13	范杰	有限合伙人	2.63
14	周旻	有限合伙人	2.52
15	黄宏留	有限合伙人	2.42
16	钟宇	有限合伙人	2.19
17	李顺林	有限合伙人	2.19
18	蔡逸	有限合伙人	2.19
19	莫国兵	有限合伙人	2.19
20	孙春来	有限合伙人	2.19
21	韩晓雨	有限合伙人	2.19
22	胡刚	有限合伙人	1.98
23	陆凤英	有限合伙人	1.98
24	郑珉楠	有限合伙人	1.98
25	刘江涛	有限合伙人	1.98
26	柳荫	有限合伙人	1.98

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
27	曾旭	有限合伙人	1.76
28	孙尔俊	有限合伙人	1.76
29	李琳	有限合伙人	1.65
30	徐益平	有限合伙人	1.65
31	王山	有限合伙人	1.65
32	李毅	有限合伙人	1.65
33	王雪峰	有限合伙人	1.65
34	许俊	有限合伙人	1.54
35	黄萌芽	有限合伙人	1.23
36	龚隼宇	有限合伙人	1.19
37	毛惠敏	有限合伙人	1.14
38	李建威	有限合伙人	1.10
39	郭三新	有限合伙人	0.99
40	尤胜仁	有限合伙人	0.99
41	姬轩	有限合伙人	0.99
42	黄有源	有限合伙人	0.75
43	韩晓梅	有限合伙人	0.75
44	陈涛	有限合伙人	0.75
合计			100.00

19、蒋石二号

企业名称	嘉兴蒋石二号投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年1月11日
统一社会信用代码	91330402MA28BAWRXR
执行事务合伙人	嘉兴铂林投资管理有限公司（委派代表：梁铂钻）、上海君桐股权投资管理有限公司（委派代表：梁铂钻）
主营业务	实业投资、股权投资、投资管理。与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	嘉兴铂林投资管理有限公司	普通合伙人	2.56
2	上海君桐股权投资管理有限公司	普通合伙人	2.56
3	张健	有限合伙人	5.76
4	林丽婵	有限合伙人	4.76

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
5	阙宇峻	有限合伙人	4.41
6	李春一	有限合伙人	3.84
7	李凯	有限合伙人	3.45
8	黄允捷	有限合伙人	3.45
9	周中武	有限合伙人	3.45
10	朱深红	有限合伙人	3.45
11	陈李刚	有限合伙人	3.45
12	曹颖	有限合伙人	3.07
13	史明甫	有限合伙人	3.07
14	滕锦	有限合伙人	3.03
15	徐军	有限合伙人	2.88
16	张占房	有限合伙人	2.88
17	张鹏展	有限合伙人	2.88
18	杨全申	有限合伙人	2.88
19	王超	有限合伙人	2.88
20	吴晓明	有限合伙人	2.88
21	张宗山	有限合伙人	2.88
22	陆端	有限合伙人	2.88
23	马骏	有限合伙人	2.68
24	郝苏化	有限合伙人	2.68
25	施奕平	有限合伙人	2.68
26	章其飞	有限合伙人	2.68
27	王丹	有限合伙人	2.68
28	李新岗	有限合伙人	2.68
29	聂远飞	有限合伙人	2.68
30	范然然	有限合伙人	2.68
31	顾宇非	有限合伙人	2.68
32	史刚	有限合伙人	2.53
合计			100.00

20、臻石三号

企业名称	嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年1月13日

企业名称	嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MA28BB1Y29
执行事务合伙人	嘉兴铂林投资管理有限公司（委派代表：曹颖）、上海君桐股权投资管理有限公司（委派代表：曹颖）
主营业务	实业投资、股权投资、投资管理。与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，各合伙人的出资比例如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	嘉兴铂林投资管理有限公司	普通合伙人	1.52
2	上海君桐股权投资管理有限公司	普通合伙人	1.52
3	山岗	有限合伙人	12.93
4	顾杰	有限合伙人	10.62
5	梁铂钴	有限合伙人	9.86
6	苏琳	有限合伙人	7.58
7	王勇	有限合伙人	6.07
8	徐吟	有限合伙人	6.07
9	张亮	有限合伙人	6.07
10	刘新	有限合伙人	4.17
11	贾炜	有限合伙人	3.79
12	王培春	有限合伙人	3.65
13	傅晓	有限合伙人	3.03
14	付群	有限合伙人	3.03
15	江立新	有限合伙人	2.27
16	马青江	有限合伙人	2.27
17	龚芳	有限合伙人	2.27
18	孔德惠	有限合伙人	1.89
19	王立伟	有限合伙人	1.82
20	张勇	有限合伙人	1.82
21	唐冬捷	有限合伙人	1.67
22	陆震	有限合伙人	1.52
23	严钢	有限合伙人	1.52
24	郑海媚	有限合伙人	1.52
25	邱志敏	有限合伙人	1.52
合计			100.00

21、中证投资

公司名称	中信证券投资有限公司
成立时间	2012年4月1日
统一社会信用代码	91370212591286847J
注册资本	1,400,000 万元
住址	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
法定代表人	张佑君
实际控制人	中信证券股份有限公司
主营业务	金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与发行人主营业务没有直接关系。

截至本招股说明书签署日，股东构成及出资比例如下表所示：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	中信证券股份有限公司	100.00
	合计	100.00

（二）实际控制人的基本情况

1、公司股权分散，无控股股东和实际控制人

报告期内，公司的股权架构较为分散。所有股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。同时，公司现有股东除部分股东已在本招股说明书披露的关联关系外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动关系。

综上所述，公司不存在控股股东和实际控制人。

在公司无实际控制人情况下，公司各部门、管理层、董事会、股东大会依据《公司章程》及相关内部制度进行决策分工，公司管理层根据公司股东大会及董事会的决策履行其职权。公司通过建立规范的治理结构和健全的内部控制制度，保证和提高了决策效率。

在日常经营中，如涉及需要由董事会审议的事项，管理层经过初步研究形成提案并提交董事会，董事会会在审议相关事项前将对审议事项进行充分的沟通与讨论。如出现各董事意见不一致的情形，董事会将进一步对审议事项进行研究并对相关方案进行调整。公司董事均为专业人士，在经过充分的沟通及讨论后通常可以形成一致意见。如董事会或股东大会在未来出现重大分歧，董事会或股东大会将根据届时有效的《公司章程》及

相关制度进行表决并形成有效决议，以确保公司业务稳定、生产经营稳定。

对于须要股东大会审议的事项，主要股东会事先充分沟通，股东依据届时有效的《公司章程》《股东大会议事规则》进行表决，公司虽无实际控制人，但自 2017 年 1 月 1 日以来，公司第一大股东未发生变化（均为中电投控控制主体），主要股东（持股前 51% 的股东）也未发生重大变化。公司股东大会能够依照法定程序作出有效决议，不存在出现公司僵局的情形。报告期内所有出席股东对审议事项除需回避表决外，均一致通过。

2、报告期内，公司股权及控制结构、经营管理层和主营业务未发生重大变化

报告期内，公司股权穿透后第一大股东未发生变化，主要股东未发生重大变化，公司股权结构保持稳定。公司董事、高级管理人员未发生重大变化，其主要经营管理层保持稳定，具体参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十七、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况”。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

（三）发行人股份质押或其他权利争议

截至本招股说明书签署日，发行人股东持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

十、发行人股本情况

（一）公司本次发行前后股本情况

公司发行前总股本 101,683.25 万股，本次拟申请发行人民币普通股不超过 11,298.1389 万股，本次发行前后公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	占比（%）	持股数（股）	占比（%）
1	中电投控	161,716,775	15.904	161,716,775	14.314
2	嘉兴芯电	21,128,300	2.078	21,128,300	1.870
3	WLT	87,816,687	8.636	87,816,687	7.773
4	珠海融英	69,265,238	6.812	69,265,238	6.131
5	上海临理	53,506,750	5.262	53,506,750	4.736
6	上海临丰	18,610,575	1.830	18,610,575	1.647

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	占比（%）	持股数（股）	占比（%）
7	上海临骥	15,234,825	1.498	15,234,825	1.348
8	上海临利	13,339,175	1.312	13,339,175	1.181
9	上海临国	13,070,825	1.285	13,070,825	1.157
10	临桐建发	9,276,675	0.912	9,276,675	0.821
11	上海临齐	7,011,450	0.690	7,011,450	0.621
12	嘉兴宏越	44,247,750	4.352	44,247,750	3.916
13	嘉兴莫奈	20,634,525	2.029	20,634,525	1.826
14	Xinyun I	44,247,750	4.352	44,247,750	3.916
15	Xinyun	12,057,500	1.186	12,057,500	1.067
16	Xinyun III	2,076,425	0.204	2,076,425	0.184
17	蒋石一号	22,772,325	2.240	22,772,325	2.016
18	蒋石二号	13,038,000	1.282	13,038,000	1.154
19	蒋石三号	32,972,200	3.243	32,972,200	2.918
20	中证投资	51,033,325	5.019	51,033,325	4.517
21	中睿一期	35,294,550	3.471	35,294,550	3.124
22	中睿二期	5,597,200	0.550	5,597,200	0.495
23	珠海融扬	25,939,975	2.551	25,939,975	2.296
24	Theon Investment	5,920,000	0.582	5,920,000	0.524
25	泰瑞嘉德	16,108,750	1.584	16,108,750	1.426
26	华天宇投资	9,758,175	0.960	9,758,175	0.864
27	上海华伊	21,500,000	2.114	21,500,000	1.903
28	光大投资 ^{SS}	10,535,175	1.036	10,535,175	0.932
29	西藏长乐	10,217,075	1.005	10,217,075	0.904
30	宁波信远	10,206,675	1.004	10,206,675	0.903
31	杭州调露	9,250,000	0.910	9,250,000	0.819
32	上海君弼	8,235,350	0.810	8,235,350	0.729
33	Green Spark	7,525,000	0.740	7,525,000	0.666
34	Chen Xiao	3,750,000	0.369	3,750,000	0.332
35	New Speed	3,125,000	0.307	3,125,000	0.277
36	TransLink	3,125,000	0.307	3,125,000	0.277
37	Pine Stone Capital	2,212,500	0.218	2,212,500	0.196
38	BICI	1,047,350	0.103	1,047,350	0.093

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	占比（%）	持股数（股）	占比（%）
39	Lip-Bu Tan	500,000	0.049	500,000	0.044
40	Ko Ping Keung	500,000	0.049	500,000	0.044
41	前海珂玺	196,250	0.019	196,250	0.017
42	Xi Jin	100,000	0.010	100,000	0.009
43	Shun-Wen Chang	100,000	0.010	100,000	0.009
44	Qian-Shen Bai	50,000	0.005	50,000	0.004
45	Intel Capital	101,683,250	10.000	101,683,250	9.000
46	SVIC No. 28 Investment	11,298,150	1.111	11,298,150	1.000
47	本次发行流通股	-	-	112,981,389	10.000
	合计	1,016,832,500	100.000	1,129,813,889	100.000

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，发行人前十名股东持股情况见下表：

序号	股东名称/姓名	股份（万股）	比例（%）
1	中电投控	16,171.6775	15.904
2	Intel Capital	10,168.3250	10.000
3	WLT	8,781.6687	8.636
4	珠海融英	6,926.5238	6.812
5	上海临理	5,350.6750	5.262
6	中证投资	5,103.3325	5.019
7	嘉兴宏越	4,424.7750	4.352
8	Xinyun I	4,424.7750	4.352
9	中睿一期	3,529.4550	3.471
10	蒋石三号	3,297.2200	3.243
	合计	68,178.4275	67.051

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前，公司共有 6 名自然人股东。该 6 名自然人股东在发行人处的任职及直接持股情况具体如下：

序号	股东姓名	在发行人处任职情况	股份（万股）	比例（%）
1	Chen Xiao	无	375.00	0.369%

序号	股东姓名	在发行人处任职情况	股份（万股）	比例（%）
2	Lip-Bu Tan	无	50.00	0.049%
3	Ko Ping Keung	无	50.00	0.049%
4	Xi Jin	无	10.00	0.010%
5	Shun-Wen Chang	无	10.00	0.010%
6	Qian-Shen Bai	无	5.00	0.005%

（四）最近一年发行人新增股东情况

1、最近一年发行人进行新的股权融资引进的投资者情况

发行人设立以来，发行人新增股东为 Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment，上述股东以约 1.72 美元/股价格对发行人增资，定价依据为公司与增资方协商确定，本次增资于 2018 年 12 月完成工商变更，具体情况如下：

增资时间	股东姓名	持股数量（股）	单价（美元/出资额）	依据
2018.12	Intel Capital	101,683,250	1.72	协商确定
	SVIC No. 28 Investment	11,298,150		

2、最近一年因拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有公司股权的投资者情况

2018 年 4 月 26 日，澜起有限董事会决议通过股东 Montage HK 将其所持澜起有限 83.757% 股权转让给包括中电投控、嘉兴芯电、WLT 在内的 39 名境内外主体。此次股权转让的目的实际为公司拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有澜起有限股权。在完成上述股权转让后，澜起有限穿透后的股权结构保持稳定，未发生重大变化。同日，Montage HK 与 39 名境内外主体就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》，本次股权转让中，每股注册资本对应价格与前次增资（发行人第五次增加注册资本）一致。

时间	转让方	受让方	持股数量（股）	单价（元/出资额）	定价依据
2018.4	Montage HK	中电投控	161,716,775	5.68	与前次增资保持一致
		嘉兴芯电	21,128,300		
		WLT	87,816,687		
		上海临理	53,506,750		
		上海临丰	18,610,575		
		上海临骥	15,234,825		
		上海临利	13,339,175		
		上海临国	13,070,825		

时间	转让方	受让方	持股数量（股）	单价（元/出资额）	定价依据
		临桐建发	9,276,675		
		上海临齐	7,011,450		
		嘉兴宏越	44,247,750		
		嘉兴莫奈	20,634,525		
		Xinyun I	44,247,750		
		Xinyun	12,057,500		
		Xinyun III	2,076,425		
		中证投资	51,033,325		
		中睿一期	35,294,550		
		中睿二期	5,597,200		
		泰瑞嘉德	16,108,750		
		华天宇投资	9,758,175		
		上海华伊	21,500,000		
		光大投资	10,535,175		
		西藏长乐	10,217,075		
		宁波信远	10,206,675		
		杭州调露	9,250,000		
		上海君弼	8,235,350		
		Green Spark	7,525,000		
		Chen Xiao	3,750,000		
		New Speed	3,125,000		
		TransLink	3,125,000		
		Pine Stone Capital	2,212,500		
		BICI	1,047,350		
		Lip-Bu Tan	500,000		
		Ko Ping Keung	500,000		
		前海珂玺	196,250		
		Xi Jin	100,000		
		Shun-Wen Chang	100,000		
		Qian-Shen Bai	50,000		

3、申报前一年新增股东基本情况

申报前一年内发行人通过增资或股权转让引入的股东共 40 名，其中 34 名为经济组

织（包括公司法人、合伙企业等），其余 6 人为自然人股东。

其中，中电投控、嘉兴芯电、WLT、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III、Intel Capital、中证投资，参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、公司股东及实际控制人的基本情况（一）持有 5%以上股份的股东基本情况”。

其他新股东的基本情况如下：

（1）中睿一期

名称	金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 7 月 13 日
统一社会信用代码	91440300349571316F
经营范围/主营业务	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；企业管理咨询（具体项目另行申报）
执行事务合伙人	深圳金石中睿投资管理有限公司（委派代表：张继军）
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

中睿一期目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	深圳金石中睿投资管理有限公司	普通合伙人	0.69
2	珠海百诚立合投资有限公司	有限合伙人	50.21
3	鹏华资产管理有限公司	有限合伙人	42.41
4	深圳润泽一期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6.68
	合计	/	100.00

中睿一期普通合伙人深圳金石中睿投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	深圳金石中睿投资管理有限公司
成立时间	2015 年 5 月 27 日
统一社会信用代码	91440300342662215D
经营范围/主营业务	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、受托资产管理（以上不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；企业管理咨询（具体项目另行申报）

深圳金石中睿投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	国经泰富投资有限公司	100.00
	合计	100.00

(2) 中睿二期

名称	金石中睿二期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年9月2日
统一社会信用代码	914403003500686381
经营范围/主营业务	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；企业管理咨询
执行事务合伙人	深圳金石中睿投资管理有限公司（委派代表：张继军）

中睿二期目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	深圳金石中睿投资管理有限公司	普通合伙人	3.33
2	珠海百诚立合投资有限公司	有限合伙人	50.44
3	鹏华资产管理有限公司	有限合伙人	40.48
4	深圳润泽二期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5.75
	合计	/	100.00

中睿二期普通合伙人深圳金石中睿投资管理有限公司的基本信息及股权结构详见本节十、发行人股本情况（四）最近一年发行人新增股东情况 3、申报前一年新增股东基本情况（1）中睿一期部分。

(3) 泰瑞嘉德

名称	新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年7月27日
统一社会信用代码	91650100MA776KUP9T
经营范围/主营业务	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份
执行事务合伙人	厦门华英汇股权投资合伙企业(有限合伙)（委派代表：NINGYU ZHANG）
主要经营场所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 258 号数码港大厦 2015-846 号

泰瑞嘉德目前的合伙人出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.33
2	苏州市华田宇股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	99.67
	合计		100.00

泰瑞嘉德普通合伙人厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年9月13日
统一社会信用代码	91350203MA2XNMUW9G
经营范围/主营业务	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）
主要经营场所	厦门市同安区新民镇人民政府文化活动综合楼 118 号

厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	厦门英华资本管理有限公司	普通合伙人	60.00
2	张淑荣	有限合伙人	40.00
	合计	/	100.00

（4）华天宇投资

名称	厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年9月18日
统一社会信用代码	91350200MA2XNNUC8Q
经营范围/主营业务	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务
执行事务合伙人	厦门华英汇股权投资合伙企业(有限合伙)（委派代表：王薇）
主要经营场所	厦门市同安区洪塘镇洪塘里 228 号 141 室

华天宇投资目前的合伙人出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.27
2	厦门珑耀投资有限公司	有限合伙人	74.64
3	深圳盛屯集团有限公司	有限合伙人	15.64
4	周由	有限合伙人	9.45
	合计		100.00

华天宇投资普通合伙人厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息及股

权结构详见本节十、发行人股本情况（四）最近一年发行人新增股东情况 3、申报前一年新增股东基本情况（3）泰瑞嘉德部分。

（5）上海华伊

名称	上海华伊投资中心（有限合伙）
成立时间	2016年1月13日
统一社会信用代码	91310000MA1K36A468
经营范围/主营业务	实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询
执行事务合伙人	一村资本有限公司（委派代表：刘晶）
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

上海华伊目前的合伙人出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	一村资本有限公司	普通合伙人	29.01
2	一村资产管理有限公司	有限合伙人	41.67
3	昆山晗村投资中心（有限合伙）	有限合伙人	6.58
4	合肥海鲲佐顺投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6.49
5	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5.81
6	嘉兴君镐投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4.07
7	克拉玛依天诺盛天股权投资管理有限合伙企业	有限合伙人	3.82
8	宁波如厚投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.49
9	赵盛	有限合伙人	0.42
10	仇虹豪	有限合伙人	0.33
11	孙建	有限合伙人	0.17
12	常惠华	有限合伙人	0.17
	合计		100.00

上海华伊普通合伙人一村资本有限公司的基本情况如下：

名称	一村资本有限公司
成立时间	2015年8月18日
统一社会信用代码	91310115351124697B
经营范围/主营业务	投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询
住所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室

一村资本有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	江苏华西村股份有限公司	89.29
2	安徽交控产业发展基金有限公司	10.71
	合计	100.00

（6）光大投资

公司名称	中国光大投资管理有限责任公司
成立时间	1992年8月3日
统一社会信用代码	91100000710931678K
注册资本	111,000.00 万元
住址	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦22层
法定代表人	秦苏宾
经营范围/主营业务	资产受托管理；企业重组、兼并策划；企业管理咨询；投资及投资管理；财务顾问；物业管理
实际控制人	国务院

光大投资目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	中国光大实业（集团）有限责任公司	100.00
	合计	100.00

根据中国光大集团股份公司出具的《关于中国光大投资管理有限责任公司国有股权管理方案的批复》（光大发【2019】65号），澜起科技股份有限公司总股本101683.25万股，其中中国光大投资管理有限责任公司（为国有股权，标注“SS”）持有1053.5175万股，占总股本的1.036%。

（7）西藏长乐

公司名称	西藏长乐投资有限公司
成立时间	2015年7月8日
统一社会信用代码	91540091321327434U
注册资本	30,000.00 万元
住址	拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城1栋5单元3-2号
经营范围/主营业务	投资管理（不含金融和经纪业务）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；企业策划；财务咨询
实际控制人	芦清云
法定代表人	朱平君

西藏长乐目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	乾通科技实业有限公司	100.00
	合计	100.00

（8）宁波信远

名称	宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年11月12日
统一社会信用代码	91330201MA2815EM6L
经营范围/主营业务	股权投资及其相关咨询服务
执行事务合伙人	北京朗玛峰创业投资管理有限公司（委派代表：肖建聪），北京信远资本管理有限公司（委派代表：肖建聪）
主要经营场所	宁波保税区鸿海商贸楼 628-3 室

宁波信远目前的合伙人出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	北京朗玛峰创业投资管理有限公司	普通合伙人	1.08
2	北京信远资本管理有限公司	普通合伙人	0.08
3	北京朗玛永祥投资管理股份公司	有限合伙人	98.84
	合计		100.00

宁波信远普通合伙人北京朗玛峰创业投资管理有限公司、北京信远资本管理有限公司的基本情况如下：

1) 北京朗玛峰创业投资管理有限公司

名称	北京朗玛峰创业投资管理有限公司
成立时间	2010年7月19日
统一社会信用代码	91110108558526079N
经营范围/主营业务	投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计
住所	北京市海淀区北四环西路 58 号 18 层 1818

北京朗玛峰创业投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	肖建聪	99.80
2	梁显宏	0.20

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
	合计	100.00

2) 北京信远资本管理有限公司

名称	北京信远资本管理有限公司
成立时间	2015年9月9日
统一社会信用代码	91110105357934009T
经营范围/主营业务	资产管理；投资管理
住所	北京市朝阳区芍药居北里101号1幢8层1座902

北京信远资本管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	北京信远业隆投资管理有限公司	50.00
2	北京信远置业有限公司	30.00
3	上海厚稳企业管理咨询中心（有限合伙）	20.00
	合计	100.00

(9) 杭州调露

名称	杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年1月7日
统一社会信用代码	91330102MA27WNUB5K
经营范围/主营业务	服务；投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
执行事务合伙人	杭州良盛投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：许玉婷）
主要经营场所	浙江省杭州市上城区白云路26号238室-35号

杭州调露目前的合伙人出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	杭州良盛投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.01
2	北京华富开元财务咨询有限公司	有限合伙人	83.05
3	杭州金研学而投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	16.94
	合计		100.00

杭州调露普通合伙人杭州良盛投资管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	杭州良盛投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年3月18日

统一社会信用代码	913301023281237842
经营范围/主营业务	服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
主要经营场所	上城区凤山新村 217 号 145 室

杭州良盛投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	杭州皇建投资管理有限公司	普通合伙人	20.00
2	毛国华	有限合伙人	80.00
	合计	/	100.00

（10）上海君弼

名称	上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 9 月 15 日
统一社会信用代码	91310000350856933E
经营范围/主营业务	投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件的开发、销售，从事货物及技术的进出口业务
执行事务合伙人	上海君桐股权投资管理有限公司（委派代表：闻威）
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

上海君弼目前的合伙人出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海君桐股权投资管理有限公司	普通合伙人	0.47
2	青岛汇创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	16.01
3	文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	19.65
4	西藏文轩创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	39.30
5	嘉兴云初投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	24.57
	合计		100.00

上海君弼普通合伙人上海君桐股权投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	上海君桐股权投资管理有限公司
成立时间	2015 年 5 月 26 日
统一社会信用代码	913100003423649638
经营范围/主营业务	股权投资管理，资产管理
住所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2029 室

上海君桐股权投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	闻威	78.00
2	翁逸卿	12.00
3	杨博	10.00
	合计	100.00

(11) Green Spark Investment Limited

名称	Green Spark Investment Limited
成立时间	2015年2月10日
公司注册编号	1862216
经营范围/主营业务	投资
实际控制人	YU Feng
董事	黄鑫
住址	Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands

Green Spark Investment Limited 目前的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Yunfeng Fund II,L.P.	100.00
	合计	100.00

(12) Chen Xiao

Chen Xiao, 男, 中国香港永久性居民, 香港永久性居民身份证号是 R60XXXXX。

(13) New Speed Consultancy Co., Ltd.

名称	New Speed Consultancy Co., Ltd.
成立时间	2001年4月20日
公司注册编号	441519
经营范围/主营业务	投资
实际控制人	Shaw Shung-Ho
董事	HUANG Tsong-Jen
住址	Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

New Speed Consultancy Co., Ltd.目前的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Anfu Holdings Limited	100.00
	合计	100.00

(14) TransLink Capital Partners I, L.P.

名称	TransLink Capital Partners I, L.P.
成立时间	2007年4月27日
注册编号	19936
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	TransLink Management I, L.L.C

TransLink Capital Partners I, L.P.目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	TransLink Management I, L.L.C.	普通合伙人	1.57
2	Fairview Capstone Partners LP	有限合伙人	15.57
3	Ant Capital Partners Co., Ltd.	有限合伙人	10.38
4	UMC Capital	有限合伙人	10.38
5	KT Corporation	有限合伙人	10.38
6	NTT Investment Partners Fund, L.P.	有限合伙人	8.31
7	SK Telecom	有限合伙人	6.23
8	Industry Ventures Secondary VII-A, LP	有限合伙人	6.23
9	Hyosung Corporation	有限合伙人	4.15
10	Moon Limited	有限合伙人	4.15
11	Amberbrook VII LP	有限合伙人	2.08
12	NTT Leasing Capital (U.S.A.), Inc.	有限合伙人	2.08
13	The Lin Family	有限合伙人	2.08
14	Tong Yang Life Insurance Co.	有限合伙人	2.08
15	Jung-Hung Yang	有限合伙人	2.08
16	Yuanta Securities Korea Co., Ltd	有限合伙人	2.08
17	SVB Strategic Investors Fund IV, L.P.	有限合伙人	2.08
18	Plaza Create Co. Ltd.	有限合伙人	1.04
19	Real Bless International Ltd.	有限合伙人	1.04
20	Perfect Apex Limited	有限合伙人	1.04
21	Jack Huang	有限合伙人	0.83
22	Hong Chen and Lynn Liu	有限合伙人	0.52

23	Ching-Chien Yu	有限合伙人	0.42
24	Ki Sub Lee	有限合伙人	0.42
25	Pei Yun Lee	有限合伙人	0.42
26	Tai kuai Lap and Chao long Wa	有限合伙人	0.42
27	Nelson Haung	有限合伙人	0.31
28	David Chao and Amanda M. Minami Revocable	有限合伙人	0.21
29	The Park Family	有限合伙人	0.21
30	James Huang	有限合伙人	0.21
31	Leechung Yiu	有限合伙人	0.21
32	Nahm Family	有限合伙人	0.21
33	Young K. Sohn, TTEE Marcy Yanta Sohn	有限合伙人	0.21
34	Kihyun Joo	有限合伙人	0.21
35	Curtis Ling	有限合伙人	0.10
36	Koichi Narasaki	有限合伙人	0.06
37	Koji Osawa	有限合伙人	0.04
	合计	/	100.00

TransLink Capital Partners I, L.P.普通合伙人 TransLink Management I, L.L.C.的基本情况如下:

名称	TransLink Management I, L.L.C.
成立时间	2006年12月15日
注册编码	4269132
经营范围/主营业务	投资

TransLink Management I, L.L.C.目前的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资比例 (%)
1	Jae Eum	19.80
2	Toshiya Otani	19.80
3	Jung Kung Yang	19.80
4	ANT Capital Partners Co., Ltd.	19.80
5	Sung Park	9.90
6	Soundpipe Korea (SPKorea)	9.90
7	CIQ Partners, LLC	1.00
	合计	100.00

(15) Hong Kong Pine Stone Capital Limited

名称	Hong Kong Pine Stone Capital Limited
成立时间	2016年4月11日
注册编号	2359357
经营范围/主营业务	投资
实际控制人	Zhou Jianjun

Hong Kong Pine Stone Capital Limited 目前的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Zhou Jianjun	100.00
	合计	100.00

(16) Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.

公司名称	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.
成立时间	2014年12月18日
注册编号	80560
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	Hua-Captial Cayman, L.P.

Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	Hua-Captial Cayman, L.P.	普通合伙人	1.00
2	SVIC No. 21 New Technology Business Investment L.L.P.	有限合伙人	61.00
3	Qorvo International Pte. Ltd.	有限合伙人	19.00
4	Gaintech Co., Limited	有限合伙人	19.00
	合计		100.00

Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P. 普通合伙人 Hua-Captial Cayman, L.P.的基本情况如下：

名称	Hua-Captial Cayman, L.P.
成立时间	2014年12月18日
注册编码	80513
经营范围/主营业务	投资

Hua-Captial Cayman, L.P.的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	Hua-Capital International Inc.	普通合伙人	1.00
2	Sino Vision Capital Partners,L.P	有限合伙人	99.00
	合计	/	100.00

(17) Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan, 男, 美国国籍, 护照号码是 5307XXXXX。

(18) Ko Ping Keung

Ko Ping Keung, 男, 中国香港永久性居民, 香港永久性居民身份证号码是 A96XXXXX。

(19) 前海珂玺

名称	深圳前海珂玺资本管理有限公司
成立时间	2016年2月22日
统一社会信用代码	914403003600799209
经营范围/主营业务	受托资产管理、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理（不含金融、证券、保险及其它限制项目）；股权投资（不含限制项目）
注册资本	1,000.00 万元
住址	深圳市南山区粤海街道海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 座 33A-2
实际控制人	王珍

前海珂玺目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	王珍	95.00
2	朱后锋	5.00
	合计	100.00

(20) Xi Jin

Xi Jin, 女, 美国国籍, 护照号码是 5312XXXXX。

(21) Shun-Wen Chang

Shun-Wen Chang, 女, 美国国籍, 护照号码是 5612XXXXX。

(22) Qian-Shen Bai

Qian-Shen Bai, 男, 美国国籍, 护照号码是 4521XXXXX。

(23) SVIC No.28 Investment

名称	SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P.
成立时间	2015 年 2 月 5 日
注册编号	214-80-12280
代表人	田溶襄
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	Samsung Venture Investment Co., Ltd.

SVIC No.28 Investment 目前的合伙人权益情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例 (%)
1	Samsung Venture Investment Co., Ltd.	普通合伙人	1.00
2	Samsung Electronics Co., Ltd.	有限合伙人	99.00
	合计		100.00

SVIC No. 28 Investment 普通合伙人 Samsung Venture Investment Co., Ltd.的基本情况如下:

名称	Samsung Venture Investment Co., Ltd.
成立时间	1999 年 10 月 8 日
注册编码	110111-1785538
经营范围/主营业务	投资

Samsung Venture Investment Co., Ltd.目前的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资比例 (%)
1	Samsung Electronics Co., Ltd.	16.33
2	Samsung SDI Co., Ltd.	16.33
3	Samsung C&T Corporation	16.67
4	Samsung Securities Co., Ltd.	16.67
5	Samsung Electro-mechanics Co., Ltd.	17.00
6	Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	17.00
	合计	100.00

(五) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署日, 公司股东间的关联关系情况如下:

序号	关联方名称	持股比例	关联关系
1	中电投控	15.90%	嘉兴芯电的普通合伙人受中电投控控制
	嘉兴芯电	2.08%	
2	WLT	8.64%	合伙人存在近亲属关系 ^{注1}
	珠海融英	6.81%	
3	上海临理	5.26%	受同一普通合伙人控制
	上海临丰	1.83%	
	上海临骥	1.50%	
	上海临利	1.31%	
	上海临国	1.29%	
	临桐建发	0.91%	
	上海临齐	0.69%	
4	嘉兴宏越	4.35%	股东的投票权均受同一主体控制
	嘉兴莫奈	2.03%	
	Xinyun I ^{注2}	4.35%	
	Xinyun	1.19%	
	Xinyun III	0.20%	
5	蒋石一号	2.24%	股东的投票权均受同一主体控制
	蒋石二号	1.28%	
	蒋石三号	3.24%	
6	中睿一期	3.47%	受同一普通合伙人控制
	中睿二期	0.55%	
7	珠海融扬	2.55%	拥有共同的普通合伙人
	Theon Investment	0.58%	
8	泰瑞嘉德	1.58%	受同一普通合伙人控制
	华天宇投资	0.96%	

注 1：珠海融英的执行事务合伙人杨崇颐与发行人董事长杨崇和是姐弟关系

注 2：Xinyun I 将澜起科技表决权委托给 Xinyun Capital Management, Ltd.

除上述关联关系外，本次发行前股东间不存在其他关联关系。

（六）本次发行发行人股东公开发售股份情况

本次发行不涉及原有股东的公开发售股份。

十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况

（一）董事会成员

发行人董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

杨崇和，男，1957 年出生，美国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，美国俄勒冈州立大学电子与计算机工程学硕士及博士。1990 年至 1994 年曾在美国国家半导体等公司从事芯片设计研发工作；1994 年至 1996 年任上海贝岭新产品研发部负责人；1997 年，杨博士与同仁共同创建了新涛科技，该公司于 2001 年与 IDT 公司成功合并，并被评为当年中国十大并购案之一；2004 年杨博士同 Stephen Kuong-lo Tai 共同创立澜起科技，自创立至今任公司董事长兼首席执行官。杨博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士 (IEEE Fellow)。此外，杨博士还荣获多种奖项，其中包括“IEEE CAS 产业先驱奖”和上海市人民政府授予的“白玉兰荣誉奖”。

Stephen Kuong-lo Tai，男，1971 年出生，美国国籍，约翰霍普金斯大学电子与计算机工程学士，斯坦福大学电子工程学硕士。Stephen Kuong-lo Tai 先生拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验。1994 年至 1995 年任 Sigmax Technology 公司资深设计工程师；1995 年至 2003 年参与创建了 Marvell 科技集团并担任该公司的工程研发总监。自 2004 年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理。

邓向东，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空学院学士，北京航空航天大学硕士研究生。1994 年 4 月至 2000 年 1 月任航天五院计财部副处长、处长；2001 年 1 月至 2012 年 3 月任航天科技财务有限责任公司董事、总经理；2012 年 3 月至 2016 年 6 月任中国电子财务有限责任公司董事长。2016 年 6 月至今任中国电子投资控股有限公司总经理，2018 年 12 月至今任中国电子投资控股有限公司董事长。现任澜起科技董事。

李荣信，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士。1992 年至 1996 年任上海贝岭产品工程经理；1996 年至 2006 年任英特尔（中国）有限公司 FPG 上海总监；2006 年至 2007 年任华虹国际（管理）有限公司副总裁；2006 年至 2015 年任上海华虹集成电路有限公司总经理；2015 年至 2019 年任华大半导体有限公司董事、副总经理；2018 年至今任上海佑磁信息科技有限公司总经理。现任澜起科技董事。

李亚军，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学学士，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师职称。1984年至2005年历任邮电部设计院职员、科长、副处长；2005年至2006年任上海浦东新区江山置业有限公司财务总监；2006年至2008年任上海外高桥保税区联合发展有限公司财务部副经理；2008年至2013年任联芯科技有限公司财务总监；2013年至2015年任上海浦东科技发展有限公司副总裁。2015年至今任上海临芯投资管理有限公司董事长、总经理。现任澜起科技董事。

Yao SUN，男，1983年出生，美国国籍，马里兰大学学士，哥伦比亚大学硕士。2008年至今历任中信证券股份有限公司经理、中信证券股份有限公司副总裁、金石投资有限公司总监、中信证券投资咨询有限公司总监。现任澜起科技董事。

Brent Alexander Young，男，1976年出生，美国国籍，康奈尔大学计算机科学文学学士、计算机科学工程硕士，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士。1999年至2000年任Shoppinglist.com软件工程软件工程师；2000年至2004年任Curl公司首席软件工程师；2006年至今历任Intel Corporation（“英特尔公司”）资深软件策划师、全球销售和市场营销部总负责人、销售与产品营销部总监、英特尔公司副总裁、英特尔中国企业战略办公室负责人。现任澜起科技董事。

尹志尧，男，1944年生，美国国籍，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984年至1986年，就职于英特尔中心技术开发部，担任工艺工程师；1986年至1991年，就职于泛林半导体，历任研发部资深工程师、研发部资深经理；1991年至2004年，就职于应用材料，历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官；2004年至今，担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长及总经理。现任澜起科技独立董事。

吕长江，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、会计学教授、博士生导师、复旦大学管理学院副院长、2004-2005年度美国富布赖特高级研究学者，并兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计评论》副主编、《中国管理会计》副主编。曾担任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事。现任澜起科技独立董事。

刘敬东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法博士，中国社会科学院国际法研究所国际经济法室主任，研究员，研究生院教授，博士生导师，美国哥伦比亚大学、瑞士苏黎世大学访问学者。兼任中国法学会WTO法研究会副会长、中国仲裁法学会常务理事、最高人民法院第四届特约咨询员、对外经济贸易大学兼职博士生导师、上海海事大学兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现任澜起科技独立董事。

俞波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学学士。曾任职于中国电子系统工程总公司、电子工业部办公厅新闻信息处、信息产业部办公厅、工业和信息化部办公厅、中国电子学会、中国宋庆龄基金会。现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁、中国电子信息行业联合会副秘书长、中国半导体行业协会副秘书长、澜起科技独立董事等职务。

（二）监事会成员

监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名，职工监事1名。

夏晓燕，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，高级工程师。曾任上海市信息投资股份有限公司业务发展经理、亚洲证券有限责任公司副总裁、东方有线网络有限公司总经理。现任上海云锋新创投资管理有限公司合伙人、荣信达（上海）文化发展有限公司董事长、亦非云互联网技术（上海）有限公司董事、阿里体育有限公司监事、澜起科技监事等职。

梁显效，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学学士。曾任国信证券广州分公司财富管理中心投资顾问、深圳市林奇投资有限公司投资经理、前海股权交易中心企业金融服务三部总经理、中电鑫安投资管理有限责任公司高级投资经理、中电鑫安投资管理有限责任公司副总裁/业务合伙人。现任中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司副总经理/投资总监、澜起科技监事。

施懿，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年7月加入澜起有限，现任澜起科技职工监事、市场部高级传播经理。

（三）高级管理人员

公司共有高级管理人员3名，1名总经理，1名副总经理兼董事会秘书，1名副总经理兼财务负责人。

Stephen Kuong-lo Tai，简历详见前述董事部分。

梁铂钻，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学工学学士，中国科学技术大学工商管理硕士。2004年至2007年任安徽电信规划设计有限公司技术主管；2008年至2010年任安徽和信科技发展有限责任公司市场经营部负责人；2010年至2015年在上海浦东科技投资有限公司任职，历任投资经理、办公室副主任（主持工作）兼董事会办公室副主任、投资二部副总经理（主持工作）、投资总监。2015年10月加入澜起有限，担任副总经理兼董事会秘书。现任澜起科技副总经理兼董事会秘书。

苏琳，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士。1995年至2003年任普华永道会计师事务所审计经理；2003年至2006年任道康宁有机硅贸易（上海）有限公司财务总监；2006年至2007年任道康宁（张家港）有限公司财务总监；2007年9月加入澜起有限，历任财务总监、行政与财务副总裁，副总经理兼财务负责人。现任澜起科技副总经理兼财务负责人。

（四）核心技术人员

公司核心技术人员为公司主要技术负责人及公司相关研发部门负责人。

杨崇和，简历详见前述董事部分。

山岗，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学电子与通信系统硕士。1999年至2001年曾任中兴通讯上海研究一所、新涛科技工程师；2001年至2005年任IDT-新涛科技设计经理。2005年8月加入澜起有限，历任设计总监、应用总监、市场副总裁。现任澜起科技市场应用技术部负责人。

常仲元，男，1959年出生，比利时国籍，比利时鲁汶大学微电子学博士。1990年至2000年任Alcatel Bell Belgium高级IC设计工程师；2000年加入新涛科技，2001年至2010年任IDT副总裁；2010年至2013年任上海贝岭首席技术官。2013年7月加入澜起有限，现任澜起科技研发部负责人。

史刚，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子工程系微电子硕士。1992年至1998年任上海先进半导体公司质量工程师及质量部经理；1998年至2001年任新涛科技营运副总经理；2001年至2004年任IDT-新涛科技营运副总经理；2004年至2012年历任上海新进半导体制造有限公司营运副总裁、第一产品事

业群总经理；2012年至2017年任Diodes Inc分立器件事业群保护类产品事业部总经理兼分立器件事业群中国市场总监。2017年8月加入澜起有限，现任澜起科技运营部负责人。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的兼职情况如下：

序号	姓名	公司职务	任职的其他单位	其他单位职务	备注
1	杨崇和	董事长、核心技术人员	Montage Holding	董事	关联方
2	邓向东	董事	中电鑫安投资管理有限责任公司	董事长	关联方
			中电投控	董事长兼总经理	关联方
			武汉伊莱克启明股权投资基金管理有限公司	执行董事	关联方
			中电通商融资租赁有限公司	董事长	关联方
			中电智慧医疗管理有限公司	董事长	关联方
			中电通商商业保理（天津）有限公司	董事长	关联方
			中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司	董事长	关联方
			中电资产管理（深圳）有限公司	董事长	关联方
			长沙军民先进技术研究有限公司	董事长	关联方
中电长城网际系统应用有限公司	董事	关联方			
3	李荣信	董事	上海佑磁信息科技有限公司	总经理	关联方
4	Yao SUN	董事	博纳影业集团股份有限公司	董事	关联方
			CS Regal Holding Limited	董事	关联方
			Gstone Investment International Limited	董事	关联方
			Jupiter Connection Limited	董事	关联方
			Uranus Connection Limited	董事	关联方
			Neptune Connection Limited	董事	关联方
			Mountain Tiger International Limited	董事	关联方
浙江鸿禧能源股份有限公司	董事	关联方			
5	李亚军	董事	广州新珀尔信息技术股份有限公司	董事	关联方
			威视芯半导体（合肥）有限公司	董事	关联方
			上海临芯投资管理有限公司	董事长兼总经理	关联方

序号	姓名	公司职务	任职的其他单位	其他单位职务	备注
			上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海临骥投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海临齐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海临国投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海临利投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海临理投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海临鸿投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海临鋈电子科技有限公司	执行董事兼、总经理	关联方
			上海临巍电子科技有限公司	执行董事兼、总经理	关联方
			上海临珺电子科技有限公司	董事长兼、总经理	关联方
			上海临豪投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			上海清云图投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			无锡清石华晟投资有限公司	董事长兼总经理	关联方
			新疆浦富股权投资有限公司	执行董事	关联方
			深圳中微电高科技投资有限公司	总经理	关联方
			嘉兴梵晟投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			嘉兴君桐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			嘉兴君建投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
			嘉兴君望投资管理合伙企业（有限合伙）	执行董事、经理	关联方
			浙江临晟投资管理有限公司	执行董事、总经理	关联方
			无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	董事	关联方
6	尹志尧	独立董事	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事长、总经理	无关联关系

序号	姓名	公司职务	任职的其他单位	其他单位职务	备注
			中微惠创科技（上海）有限公司	董事	无关联关系
			中微半导体设备（厦门）有限公司	执行董事	无关联关系
			南昌中微半导体设备有限公司	董事长	无关联关系
			Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	董事	无关联关系
			Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd	董事	无关联关系
			PDF Solution Inc.	独立董事	无关联关系
			普迪飞半导体技术(上海)有限公司	独立董事	无关联关系
7	吕长江	独立董事	江苏镓尼玛新材料股份有限公司	独立董事	无关联关系
8	刘敬东	独立董事	阳光城集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
			京投发展股份有限公司	监事	无关联关系
9	夏晓燕	监事	荣信达（上海）文化发展有限公司	董事长	关联方
			亦非云互联网技术（上海）有限公司	董事	关联方
			阿里体育有限公司	监事	无关联关系
			合娱星展（北京）文化传播股份有限公司	董事	关联方
			上海兴格文化传媒有限公司	董事	关联方
			浙江好酷影视有限公司	董事	关联方
			灵河文化传媒（上海）有限公司	董事	关联方
			北京流金岁月文化传播股份有限公司	董事	关联方
			武汉果派联合影游文化发展有限公司	董事	关联方
			天津银河酷娱文化传媒有限公司	董事	关联方
			广禾堂草本生物科技（上海）有限公司	董事	关联方
			北京伊诺华电动方程式文化发展有限公司	董事长	关联方
			三亚伊诺华电动方程式文化发展有限公司	执行董事	关联方
			地素时尚股份有限公司	董事	关联方
			Rong360 Inc.	董事	关联方
			UNICENTURY GROUP HOLDING LIMITED	董事	关联方
			King Cinema Holdings Limited	董事	关联方
Enova Holdings Limited	董事	关联方			
上海橙恭企业管理有限公司	监事	无关联关系			

序号	姓名	公司职务	任职的其他单位	其他单位职务	备注
10	梁显效	监事	中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司	副总经理	关联方
			盛科网络（苏州）有限公司	董事	关联方
			深圳中电国际信息科技有限公司	董事	关联方
			中电天堃（三亚）投资管理有限责任公司	董事	关联方
			北京可信华泰信息技术有限公司	董事	关联方
			四川特飞科技股份有限公司	监事	无关联关系
11	梁铂钴	副总经理兼 董事会秘书	嘉兴铂林投资管理有限公司	执行董事兼总经理	关联方

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员除上述表格中披露的兼职关系外，无在其他单位的重要任职。公司与公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员的兼职单位的关联关系，详见本招股说明书“第七节公司治理及独立性”之“八、关联方、关联关系和关联交易”。

十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况

（一）持有公司股份情况

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员均没有直接持有公司股份，其通过相关主体间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	与公司关系	间接持股情况
1	杨崇和	董事长、核心技术人员	2.0151%
2	Stephen Kuong-lo Tai	董事、总经理	2.0151%
3	李亚军	董事	0.0248%
4	邓向东	董事	0.1480%
5	梁显效	监事	0.0042%
6	苏琳	副总经理兼财务负责人	0.2951%
7	梁铂钴	副总经理兼董事会秘书	0.3689%
8	山岗	核心技术人员	0.4195%
9	常仲元	核心技术人员	0.3531%
10	史刚	核心技术人员	0.0325%
11	Tai kuai Lap	总经理 Stephen Kuong-lo Tai 的父亲	4.4141%

序号	姓名	与公司关系	间接持股情况
12	Chao long Wa	总经理 Stephen Kuong-lo Tai 的母亲	4.4141%
13	李新岗	职工监事施懿的配偶	0.0344%

除上述情况外，无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

截至本招股说明书签署日，上述个人持有的公司股份不存在被质押或冻结的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员主要对外投资情况如下：

除作为发行人直接或间接股东外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与发行人及其业务相关或与公司存在利益冲突的对外投资。

十三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

公司建立了完善的薪酬制度，公司内部董事、职工代表监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资、奖金、社保福利等构成。其中基本工资及社保福利由劳动合同进行约定；奖金视公司当年度业绩情况进行确定。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴；未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）、非职工代表监事不在公司领取报酬。

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2018 年度在公司领取薪酬的情况如下：

单位：万元

姓名	在本公司的任职	2018 年度
杨崇和	董事长、核心技术人员	1,774.20
Stephen Kuong-lo Tai	董事、总经理	1,787.82
邓向东	董事	-
李荣信	董事	-
李亚军	董事	-
Yao SUN	董事	-
Brent Alexander Young	董事	-

姓名	在本公司的任职	2018 年度
尹志尧	独立董事	-
吕长江	独立董事	3.75
刘敬东	独立董事	3.75
俞波	独立董事	3.75
夏晓燕	监事	-
梁显效	监事	-
施懿	监事	29.60
梁铂钴	副总经理、董事会秘书	120.36
苏琳	副总经理、财务负责人	151.07
山岗	核心技术人员	98.14
常仲元	核心技术人员	108.47
史刚	核心技术人员	103.70

2016 年、2017 年、2018 年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占公司利润总额的比例分别为 9.33%、2.40%、5.32%。

十四、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的相关协议及重要承诺

（一）劳动合同及保密协议

在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员均与公司（或其控股子公司）签署了劳动合同，并与公司签署了《澜起科技（上海）有限公司雇员保密、竞业禁止和发明权利归属协议》，其中对保密、竞业禁止、专利归属等事项均进行了详细约定。

除上述协议外，公司的董事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他协议。自签署协议签订以来，相关董事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。

（二）重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员有关股份锁定的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”有关内容。

十五、公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在近亲属关系。

十六、董事、监事及高级管理人员的任职资格

公司董事、监事、高级管理人员及符合《证券法》、《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。

十七、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况

（一）董事变动情况

时间	董事会成员	提名/委派来源	变动人数情况	变动原因及对生产经营的影响
2017年1月	杨崇和	由股东 Montage HK 委派	-	-
	Stephen Kuong-loTai			
	Jung-Kung Yang			
2018年4月	杨崇和	由股东 WLT 委派	变动1人，增加3人	澜起有限拆除境外架构，将 Montage Holding 董事会平移至境内。对生产经营无不利影响。
	Stephen Kuong-loTai			
	邓向东	由股东中电投控委派		
	李荣信			
	李亚军	由上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐共同委派		
Yao SUN	由股东中证投资委派			
2018年10月	杨崇和	由澜起有限董事会提名	增加3人	澜起有限整体变更设立股份有限公司，选举股份公司第一届董事会成员。董事会由9名董事组
	Stephen Kuong-loTai			
	邓向东			
	李荣信			

时间	董事会成员	提名/委派来源	变动人数情况	变动原因及对生产经营的影响
	李亚军			成，其中新增3名为独立董事。对生产经营无不利影响。
	Yao SUN			
	吕长江			
	刘敬东			
	俞波			
2018年11月	杨崇和	新增董事由公司董事会提名	增加2人	公司第六次增资修改公司章程，为完善公司治理结构，新增董事2名。对生产经营无不利影响。
	Stephen Kuong-loTai			
	邓向东			
	李荣信			
	李亚军			
	Yao SUN			
	Brent Alexander Young			
	周禹鹏			
	吕长江			
	刘敬东			
俞波				
2019年3月	杨崇和	变更1人由公司董事会提名	变更1人	公司1名独立董事因个人原因辞职，公司增补选举1名新独立董事。对生产经营无不利影响。
	Stephen Kuong-loTai			
	邓向东			
	李荣信			
	李亚军			
	Yao SUN			
	Brent Alexander Young			
	尹志尧			
	吕长江			
	刘敬东			
俞波				

（二）监事变动情况

时间	成员	职位	监事会人数	变动原因
2017年1月	Ko Ping Keung	监事	1	
2018年4月	梁显效	监事	1	由股东委派。

时间	成员	职位	监事会人数	变动原因
2018年10月	夏晓燕	监事	3	公司创立大会暨2018年第一次股东大会选举产生第一届监事会非职工监事，职工监事由职工代表大会选举产生，任期三年。
	梁显效	监事		
	施懿	职工监事		

（三）高级管理人员变动情况

时间	成员	职位	高管人数	变动原因
2017年1月	Stephen Kuong-loTai	董事、总经理	3	
	梁铂钴	副总经理、董事会秘书		
	苏琳	副总经理、财务负责人		
2018年10月	Stephen Kuong-loTai	董事、总经理	3	公司第一届董事会第一次会议聘任，任期三年。
	梁铂钴	副总经理、董事会秘书		
	苏琳	副总经理、财务负责人		

（四）核心技术人员变动情况

时间	成员	职位	核心技术人员数	变动原因
2017年1月	杨崇和	核心技术人员	3	
	山岗	核心技术人员		
	常仲元	核心技术人员		
2017年8月	杨崇和	核心技术人员	4	史刚先生2017年8月加入公司
	山岗	核心技术人员		
	常仲元	核心技术人员		
	史刚	核心技术人员		

报告期内，由于业务发展的需要，公司对经营管理团队进行了扩充和调整。公司董事、监事、高级管理人员的调整符合法律法规和规范性文件以及公司章程等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员在报告期内未发生重大不利变化。

十八、发行人员工及社会保障情况

（一）员工人数和构成

发行人2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的在职员工总数分别为338人、204人、255人。截至2018年12月31日，发行人及其子公司

的员工构成情况如下：

项目	结构	员工数量（人）	员工占比
按专业划分	研发技术人员	181	70.98%
	市场销售人员	29	11.37%
	管理支持人员	45	17.65%
	合计	255	100.00%
受教育程度	硕士及以上	110	43.14%
	本科	129	50.59%
	大专	15	5.88%
	大专以下	1	0.39%
	合计	255	100.00%
按年龄划分	50岁（含）以上	18	7.06%
	40-49岁（含）	60	23.53%
	30-39岁（含）	112	43.92%
	30岁以下	65	25.49%
	合计	255	100.00%

（二）员工社会保障情况

公司已与所有在册正式员工签署了劳动合同，并为符合条件的员工办理了社会保险和住房公积金缴存手续。2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日公司为317人、185人、224人缴纳五险，为316人、183人、223人缴纳公积金。未缴纳主要原因为新入职员工及境外员工。

公司及下属各境内子公司已按照中国有关社会保险的法律、行政法规、规章及规范性文件的规定为员工缴付了养老、医疗、工伤、失业及生育保险金。报告期内，公司及下属各境内子公司不存在违反社会保险监管法律的重大违法违规行为，亦不存在因违反社会保险监管法律而受到行政处罚的情形。公司亦取得了相关社保主管部门出具的无违规证明。

公司及下属各境内子公司已在住房公积金主管部门开设了住房公积金缴存账户，并已于职工缴纳住房公积金，在公司缴存住房公积金期间，没有被住房公积金主管部门处罚的记录。公司亦取得了相关住房公积金主管部门出具的无违规证明。

（三）员工薪酬情况

公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展。公司员工薪酬和福利主要由底薪、奖金构成，底薪在事先确定的各职级薪酬区间内，根据每个员工的经验、技能和绩效等确定。

截止本招股说明书签署之日，公司无正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

第六节 业务与技术

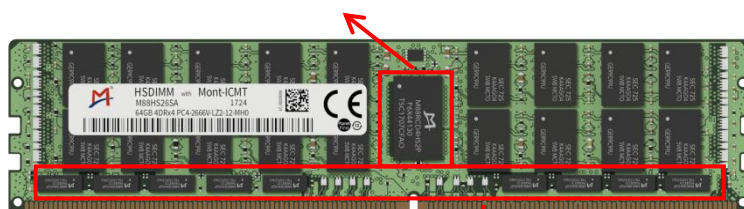
一、公司的主营业务、主要产品及服务

（一）主营业务和主要产品的基本情况

公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮[®]服务器 CPU 以及混合安全内存模组。经过多年的研发积累，公司产品性能在行业内赢得高度认可，包含公司产品的服务器广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域，满足了新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

公司在内存接口芯片领域深耕十多年，成为全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。澜起科技发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC（全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准，其相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的主要份额。

1 颗寄存时钟驱动芯片 (RCD)



9 颗数据缓冲芯片 (DB)

DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC（全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准

2016 年以来，澜起科技与英特尔及清华大学鼎力合作，研发出津逮[®]系列服务器 CPU。基于津逮[®] CPU 及澜起科技的混合安全内存模组而搭建的津逮[®]服务器平台，实现了芯片级实时安全监控功能，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此平台还融合了先进的异构计算与互联技术，可为大数据及人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。

公司秉承“匠心精神”，崇尚“以人为本”，专注于集成电路设计领域的科技创新，在持续积累中实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。近

年来，公司在诸多方面取得显著成绩。2016年6月，中国电子学会认定公司“低功耗DDR系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”；同年12月，该项技术及产业化项目荣获“中国电子学会科学技术奖一等奖”；2017年，公司荣获三星电子颁发的“最佳供应商奖”；2018年，公司产品“第二代DDR4内存缓冲控制器芯片”荣获“‘中国芯’年度重大创新突破产品”奖；2018年11月，津逮®服务器CPU及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”。2019年5月，公司“低功耗DDR系列内存缓冲控制器芯片设计技术”项目荣获上海市人民政府颁发的“上海市技术发明一等奖”公司凭借创新的技术、优质的产品质量和服务，赢得了品牌客户的广泛赞誉，树立了良好的品牌形象，营业收入和盈利水平均保持在较高水平。公司2016年、2017年和2018年分别实现销售收入84,494.46万元、122,751.49万元和175,766.46万元，分别实现净利润9,280.43万元、34,691.60万元和73,687.84万元。

公司目前的主要产品包括内存接口芯片、津逮®服务器CPU及混合安全内存模组。此外，报告期内公司的产品还曾包括消费电子芯片。

1、内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器CPU存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套，并通过服务器CPU、内存和OEM厂商针对其功能和性能（如稳定性、运行速度和功耗等）的全方位严格认证，才能进入大规模商用阶段。因此，研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，长期致力于为新一代服务器平台提供完全符合JEDEC标准的高性能内存接口解决方案。随着JEDEC标准和内存技术的发展演变，公司先后推出了DDR2高级内存缓冲器、DDR3寄存缓冲器及内存缓冲器、DDR4寄存时钟驱动器及数据缓冲器等一系列内存接口芯片，分别应用于DDR2FBDIMM（全缓冲双列直插内存模组）、DDR3和DDR4RDIMM（寄存式双列直插内存模组）及LRDIMM（减载双列直插内存模组）。上述DDR系列内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并逐步占据全球市场的主要份额。



公司内存接口芯片产品基本情况如下：

技术世代	描述	应用
DDR4	第二代+（Gen2 Plus） DDR4 数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM 和 NVDIMM, 支持速率达 DDR4-3200
	第二代+（Gen2 Plus） DDR4 寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM, 支持速率达 DDR4-3200
	第二代（Gen2） DDR4 数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2666
	第二代（Gen2） DDR4 寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2666
	第一代（Gen1） DDR4 数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2400
	第一代（Gen1） DDR4 寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2400
DDR3	DDR3 内存缓冲器芯片	DDR3 LRDIMM, 支持速率达 DDR3-1866
	DDR3 寄存缓冲器芯片（1.5V / 1.35V / 1.25V）	DDR3 RDIMM, 支持速率达 DDR3-1866
	DDR3 寄存缓冲器芯片（1.5V / 1.35V）	DDR3 RDIMM, 支持速率达 DDR3-1333
DDR2	DDR2 高级内存缓冲器芯片	DDR2 FBDIMM

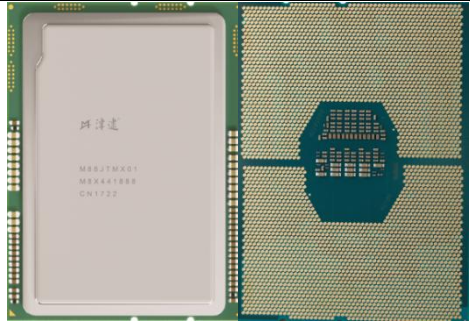
2、津逮[®]服务器平台

津逮[®]服务器平台是一款高性能的安全可控可信服务器平台，尤其适用于对数据安全有较高要求的数据中心，该服务器平台主要由澜起科技的津逮[®]系列服务器 CPU 和澜起科技具有自主知识产权的混合安全内存模组组成。

津逮[®]CPU 是澜起科技推出的一系列具有预检测和动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津逮[®]或其他通用的服务器平台。津逮[®]CPU 在英特尔[®]x86 处理器的基础上集成了清华大学的 DSC 技术，可与澜起科技的混合安全内存模组（HSDIMM[®]）搭配而组成津逮[®]服务器平台，为云计算服务器提供芯片级的动态安全监控功能。此外，津逮[®]CPU 还融合了先进的异构计算与互联技术，可为未来人工智能和大数据应用提供强大的综合数据处理和计算力支撑。

混合安全内存模组采用澜起科技具有自主知识产权的 Mont-ICMT[®]（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可为高端服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，澜起科技推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组（HSDIMM[®]）和精简版混合安全内存模组（HSDIMM[®]-Lite），可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。

津逮[®]服务器平台基本情况如下：

产品类型	产品名称	描述	产品样图
津逮 [®] 服务器 CPU	津逮 [®] 服务器 CPU	采用预检测（PrC）和动态安全监控（DSC）功能的 x86 架构处理器	
混合安全内存模组	标准版混合安全内存模组 (HSDIMM [®])	LRDIMM 型安全内存模组，全面支持命令/地址信号和交互数据的示踪及动态管控	
	精简版混合安全内存模组 (HSDIMM [®] -Lite)	RDIMM 型安全内存模组，支持命令/地址的示踪和内存数据保护	

公司已于 2018 年底成功推出了第一代津逮[®]服务器平台产品，但目前还处于市场推广阶段，不是公司报告期内的主要收入来源。未来不排除因技术、市场、政策等因素的影响而导致该项业务的实际开展不及预期，从而对经营情况造成一定不利影响。

3、消费电子芯片

报告期内，公司产品曾包括消费电子芯片，该产品主要包括机顶盒芯片和 Wi-Fi 芯片。机顶盒芯片提供机顶盒整体解决方案，包括调谐器、解调器和解码器 SoC 全套芯片以及为客户贴身定制的软件，支持有线、卫星、地面数字电视机顶盒的应用。Wi-Fi 芯片主要应用于 Wi-Fi 无线连接。

2017 年管理层及股东出于优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极

性的考虑，公司转让消费电子芯片业务相关资产给成都澜至及其关联方，由其独立运营消费电子芯片业务，自 2017 年 8 月以后公司不再销售及研发消费电子芯片。

（二）主要经营模式

在经营模式上，集成电路产业经历了从单一的IDM模式向IDM与Fabless并存的模式转变。全球集成电路产业按照是否自建晶圆生产线或封装测试生产线分为存在两种经营模式：IDM模式和Fabless模式。在集成电路产业初期，IDM模式是业内唯一的商业模式。而随着智能终端的普及，芯片必须配合智能终端轻薄短小的发展趋势，对晶圆制造制程工艺、封装工艺等方面要求不断提高，企业出于规模经济、建设维护成本、拓展经济效益等方面的考量，选择将晶圆生产及芯片封测交由专业的外协厂商完成，促使行业由单一的IDM模式向专业化分工演进，形成了目前行业内IDM与Fabless并存的经营模式。

IDM模式即垂直整合制造商模式，是指包含电路设计、晶圆制造、封装测试以及投向消费市场全环节业务的企业模式，集成电路设计只是其中的一个附属部门，同时企业拥有自己的晶圆厂、封装厂和测试厂。该模式对企业技术、资金和市场份额要求较高，目前三星电子、英特尔、德州仪器等国际巨头采用这一模式。

Fabless模式即无晶圆厂的集成电路设计企业模式，该模式下的企业仅需专注于从事产业链中的集成电路设计和销售环节，没有自己的工厂，芯片的制造和封装测试分别由产业链对应外包工厂完成。代表企业包括高通、清华紫光展锐等，由于该模式下公司无需花费成本建立晶圆生产线，且能充分发挥技术优势，快速开发出相关产品，因而该模式被诸多集成电路设计公司所采用。

本公司自成立以来，经营模式均为 Fabless 模式，未曾发生变化，并将长期持续。公司专注于从事集成电路行业的设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

1、研发模式

公司的主要经营模式是 Fabless 模式，因此产品设计与研发环节属于公司经营的核心，由多个部门参与执行。公司涉及研发的部门包括研发部、市场应用技术部和运营部，分工明确，相互协作。多年以来，公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行的情况不断的完善和更新，全面覆盖产品研发各阶段，确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强而有效的管控。公司产品的研发流程如下：

(1) 市场需求分析：市场部针对外部市场发展趋势、发展方向与市场发展时间提供前瞻性描述的文档。

(2) 产品需求分析：根据市场需求分析中预测的趋势，进一步详细阐述即将研发产品的特性，满足市场需求。

(3) 芯片定义：定义芯片设计功能和性能指标。

(4) 系统架构设计：对系统架构做整体设计，主要包括硬件和软件的协同设计。

(5) 芯片前端设计：根据产品需求定义的要求，确定芯片基本结构，并完成数字和模拟的电路设计。

(6) 设计验证：根据设计指标要求，形成验证策略并创建验证环境。在已经创建的验证环境中，对设计进行验证。

(7) 后端设计：对芯片进行布局布图方面的设计，利用版图工具生产版图，版图设计完成以后送交芯片代工厂进行生产。

(8) 后仿真验证：主要包括物理验证及后端仿真验证，物理验证包括设计规则，监测、版图电路一致性检查和电学规则监测等；确定布图设计合理性。后端仿真验证主要是监测电路的正确性。

(9) 流片：芯片设计硬件化的过程。由公司提交芯片设计文件，代工厂进行生产。

(10) 生产测试：在芯片流片后，用测试设备对芯片的功能及性能进行评估和测试。

(11) 量产：芯片的功能及性能达到设计要求及质量要求，启动大规模生产。

(12) 推向市场：最终形成可以面向销售的产品。

2、采购模式

在 **Fabless** 模式下，公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。目前公司的主要晶圆制造厂为富士通电子、台积电等，主要封装测试厂为星科金朋、矽品科技等。

发行人与委外厂商合作情况如下：

（1）与委外厂商的权利义务划分

发行人负责及时提供采购预测，下达采购订单、生产工单，在收到成品时确认发票并及时付款；供应商应在商定的交货期内，及时按照订单和工单的要求交付符合质量要求的晶圆和成品，及时通报和处理产线上的异常情况，及时提供存货的库存信息。封装测试供应商还需要提供成品的仓储和向公司的客户直接发货服务。

（2）定价机制及付款政策

定价根据市场价格与供应商协商确定。总原则是在质量符合要求的供应商中，选择性价比最优的。付款政策由发行人和供应商分别协商确定，一般为月结 30-60 天。

（3）产品质量控制措施

1) 进行严格的供应商管理。所有新供应商在进入合格供应商名录之前，必须经过公司的审核和评估；定期对供应商进行基于技术、质量、交期、服务等项目的评估，并发送评估报告给供应商以提升供应商的质量水平和服务能力，对不能满足需求的供应商实行淘汰制度。

2) 通过检测等手段对生产过程中产品质量进行控制。

（4）发行人委外加工验收程序

晶圆在出厂之前均需进行 WAT 电性测试和自动光学检查，运营部对晶圆生产过程中关键参数进行制程能力指数（CPK）管理，将晶圆测试以及封装后测试的良率反馈给晶圆厂，以提高晶圆的质量。

封装测试供应商按来料质量检验（IQC）的标准对收到的晶圆进行检查；确定封装的良率目标和良率控制线，低于目标良率的需提供分析报告和改善措施，低于良率控制线的批次需暂扣并通知运营部进行处理；建立了生产数据自动报告系统，定期提供生产报表和良率信息，以方便运营部监控生产流程；建立了量产可靠性评估体系，封装厂和公司按照 JEDEC 的标准进行定期的可靠性评估，确保产品的质量和可靠性。

公司验收：运营部与研发部、市场应用技术部合作，在测试厂建立测试流程，包括测试机台，测试程序，测试规格，质量保证（QA）流程，以及良率要求等，并完成工程验证数据分析，确认供应商的测试能力满足产品需求。测试完成后对于完成品进行

100%的外观检查，确保产品质量。每批次产品入库前进行 QA 的电性和外观检查，确保测试过程无异常。

产品质量的责任划分与承担机制，良品与不良品的划分标准，报告期内成品的不良率以及不良品的具体处置情况。

晶圆厂的产品如未达到发行人的工艺要求，则需重新提供满足要求的相关产品；封装厂商的产品如未达到发行人的工艺要求，则除需重新提供满足要求的相关产品外，还需要赔偿晶圆的损失。产品出厂后如因供应商责任造成客户的损失，则发行人有权向供应商追溯赔偿。

发行人对于封装和测试的产品质量均有明确的规范。报告期内公司的产品良率一直维持在较高水平。

不良品清单由封装测试厂定期发送给发行人，低于良率的生产工单会与供应商共同研究其原因，运营部根据实际情况对不良品进行隔离，定期对隔离的不良品进行报废处理，报废处理需得到相关负责人审批同意后进行。

（5）委外加工存货保管情况

所有存货均委托委外供应商和委外仓库进行储存保管，并要求供应商提供及时 WIP 报表和库存报表能及时查询详细讯息。在供应商生产场地发生的毁损、灭失由供应商承担责任。

（6）混合安全内存模组的采购情况

公司津逮[®]服务器平台中使用的混合安全内存模组系公司自主研发且拥有知识产权的产品。公司按照需求和产品工艺要求向 DRAM 厂商的经销商采购内存颗粒，并结合公司定制开发的内存接口芯片，由代工厂商代工生产混合安全内存模组。DRAM 内存颗粒作为服务器、计算机等设备的核心元器件，其市场体量巨大且为通用大宗商品，其销售价格相对公开透明。

报告期内，公司主要通过向主要客户的经销商采购 DRAM 内存颗粒，但由于 DRAM 内存颗粒有充足的经销商货源可供公司选择，不会导致公司对单一客户的依赖，也不会影响公司对客户的议价能力。

3、运营模式

（1）运营管理

1) 运营计划：销售和运营部每个月定期召开销售预测会议，销售部提出六至九个月的销售预测，运营部根据销售预测会议后决议提出生产计划和确认安全库存需求；

运营部于每月提供晶圆生产预测给晶圆供应商，并按照现有晶圆库存和预测计划进行生产计划分析，以确认新增需求计划，在月末向相关供应商下发下月生产订单；

运营部于每月中根据现有库存和在途库存，以及根据销售预测计划后拟定六个月的后端封装测试计划，并提供相关封测厂相应预测，在月末向相关供应商下发下月生产订单；

运营部在执行生产计划时应按照实际销售的情况适时地调整委外加工数量，以避免多于库存或是呆滞库存产生。

2) 委外加工：运营部根据销售预测计划所拟定的晶圆需求数量后提交采购申请，运营部在申请核准后将采购订单提供给晶圆厂安排生产；

运营部根据生产预测计划所需求的委外加工数量在系统内建立“委外加工单”，并将此委外加工单提供给合格供应商安排封装测试生产；

运营部应监控委外加工生产状态，同时委外供应商须每日提供及时在制品报表，这样运营部可以掌握实际生产进度，如有异常需及时和向委外供应商和内部相关部门联系并处理；

3) 存货管理：存货管理包含原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品的管理；

所有存货均委托委外供应商和委外仓库进行储存保管，并要求供应商提供及时在制品报表和库存报表能及时查询详细讯息；

成品之良品和不良品须放置于不同系统库位，并且在实物的储存上做识别隔离存放；

不良品的部分，供应商应定期提供不良品库存报表，并在我司相关部门核准后做定期报废；

成品库存出货应在销售订单下由运营部安排出货计划，并提交此出货需求给委外供应商做出货安排；

4) 报废处理：目前生产过程中所产生的不良品均在材料审查会议（MRB）的核准后通知供应商就地报废；

运营部每年定期提出呆滞库存处理需求，并由相关销售、市场、财务部门及公司总经理核准后进行继续保留处理或是报废处理；

原材料报废须经由相关运营部负责人、财务部负责人和公司总经理核准后做报废处理；

客户退货产品的处置和报废按照当时退货时所提出的处置要求进行重工或报废；

5) 存货盘点：公司每年年底实施年度存货盘点，由财务部召集相关单位进行存货盘点作业；

财务部制定盘点计划，召开盘点会议，将盘点时间、方式及截止点等注意事项告知相关单位；

相关单位依据盘点计划知会客户及厂商配合，除紧急状况外暂停进、出货；

运营部通知委外供应商对其内部存货先进行初盘，并提供初盘内容；

由盘点人、保管人及监盘人共同进行复盘，核对帐实是否相符，并将盘点结果记录在存货盘点清单上，确认存货数据；

盘点负责人将盘点结果报送财务部，财务部比较实际盘点数及帐载数的差异，确认盘盈亏数额，并产生存货盘盈亏报表。如有重大盈亏，需深入追查原因并及时报权责主管核定解决方案后完成账务处理。

4、销售模式

报告期内，公司内存接口芯片面向 DRAM 市场的国际龙头企业，下游相对集中，该部分业务以直销为主，代销为辅的模式进行销售，设有专门的销售团队及当地办事处同客户进行及时接洽；公司原消费电子芯片业务则由于终端客户相对分散，因此主要采取代销的方式进行销售，主要的代销商包括淇诺科技、中电器材等。公司销售流程如下：

(1) 制定销售计划。销售部每年四季度根据公司发展规划及市场预测编制次年年度的销售计划，同时综合考虑单位成本、毛利率、客户需求量、市场价格、与客户谈判结果等因素，制订定价策略，呈总经理核准。每季度，销售部参考历史数据、销售目标和各客户的需求情况，及时调整下个季度的销售计划。如遇特殊事项导致的计划调整（如临时生产、生产停工等），由销售部与市场部、运营部沟通确认调整后的计划，并向总经理请示。

(2) 合同管理。合同由销售部发起，在谈判过程中，需就合同所涉及的商业、法律、财务等相关细则与销售、法务、财务同事沟通。合同需在与客户谈判和内部沟通达成一致后起草。合同应当准确体现合同方的商业目的和条件，明确双方的权利和义务和违约责任，做到条款内容完整，表述准确严谨。合同终稿需经法务部最终审核确定后，方可申请盖章。

(3) 销售发货。销售人员接获客户的采购申请单邮件后，在系统中创建销售订单，选择需要销售的商品型号，录入销售数量、销售单价以及货运地址等信息。运营部在接收到销售订单后根据供应商的生产计划以及库存情况安排发货日期。供应商会每天定时通过邮件与系统接口传输销售出库明细表，内容包括当日出库的商品编号、批次号、数量、对应库位等关键信息，并由系统自动校验报告准确性。

(4) 开票及收款。销售发货后，系统会自动确认“已发货未开票收入”，并同时结转成本。财务部对于销售订单的已发货未开票部分确认开票后，电子发票会根据销售订单的发货部分自动生成。电子发票生成后，系统自动将“已发货未开票收入”转为“已发货已开票收入”。如需开具人民币增值税发票，财务部会按要求另行出具增值税专用发票。财务部每两天会对银行账户的收款进行确认，确认相关信息后在系统中核销对应的发票，并生成相关凭证。

(5) 退换货的处理措施。公司在收到客户的退换货申请后，核实退货的原因，如确实是公司的原因导致的退货，则通过相关部门负责人审批后根据客户的要求退货或换货，对于未经授权审批的退换货委外供应商不予受理。因产品质量退回的产品，运营部门讨论处置方案，在得到相关部门负责人、总经理审批同意后定期进行报废处理。

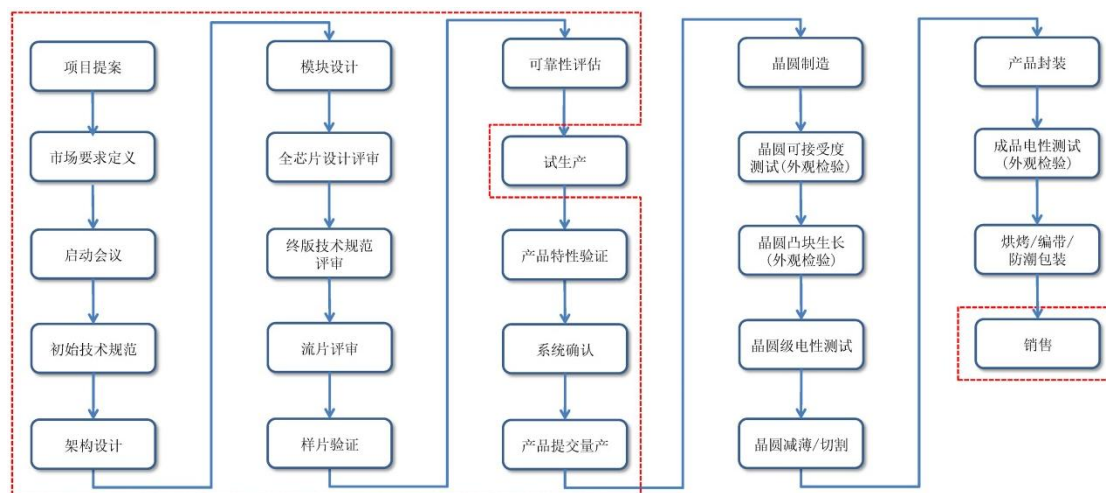
(三) 主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

2017年管理层及股东出于优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性的考虑，公司转让消费电子芯片业务相关资产给成都澜至及其关联方，由其独立运营消费电子芯片业务，自2017年8月以后公司不再销售及研发消费电子芯片。

在报告期内，除上述产品变化以外，公司主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。

(四) 业务流程示意图

公司主要产品的业务流程示意图如下：



注：红色框线标注为公司自主完成，其余由委外厂商完成。

上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节系由公司自主完成，其余环节由委外厂商完成。

（五）环保情况

公司从事的主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形。公司主要业务为集成电路芯片设计及销售，主要采购原材料为晶圆，公司及其子公司均不直接从事生产制造业务，不涉及相关的环保回收政策，报告期内不存在环保违法违规行。公司在经营活动中严格遵守国家、地方相关环保法律法规，报告期内未受到与环保相关的行政处罚。

二、行业基本情况

（一）发行人所属行业

公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮[®]服务器CPU以及混合安全内存模组。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门及监管体制

公司所属行业主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，该部门主要职责为：制定行业发展战略、发展规划及产业政策；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进相关科研成果产业化。

中国半导体行业协会是公司所属行业的行业自律组织，主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；行业自律管理；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

工业和信息化部、中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。《集成电路产业“十二五”发展规划》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策法规的提出对大力发展集成电路行业产生了积极而又深远的影响。

2、主要法律法规及产业政策

集成电路行业是国民经济支柱性行业之一，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程，因此受到各国政府的大力支持。自 2000 年以来，我国政府将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路行业的发展，主要如下：

集成电路行业法律法规及产业政策

序号	发布时间	发布单位	政策名称	与行业相关内容
1	2000 年	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	该政策作为集成电路产业的核心政策，为软件企业和集成电路生产企业给予税收方面的优惠。
2	2000 年	财政部、国税总局、海关总署	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策》	该政策提出了对增值税一般纳税人销售其自行生产的集成电路产品（含单晶硅片），按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 6% 的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发集成电路产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税等相关税收优惠措施，极大鼓励了集成电路产业发展。

序号	发布时间	发布单位	政策名称	与行业相关内容
3	2002 年	财政部、 国税总局	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策》	把优惠范围扩大到集成电路产业上游的设计企业和下游的制造商。
4	2006 年	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	纲要提出发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键，并将“突破制约信息产业发展的核心技术，掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术，提高自主开发能力和整体技术水平”作为信息产重要的发展思路。纲要还将“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”（01 专项）、极大规模集成电路制造技术及成套工艺（02 专项）作为 16 个重大专项的前两位，并在科技投入、税收优惠、金融支持、知识产权保护等方面提出了政策和措施。
5	2006 年	原信息产业部	《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》	纲要的发展目标为到 2020 年，我国建立较为完善的科技创新体系。在未来 5-15 年间，重点发展集成电路、软件技术、新型元器件技术等 15 个领域的关键技术，其中集成电路领域重点发展的关键技术包括 MEMS 技术和新型、高密度集成电路封装、测试技术。同时，规划纲要提出加强芯片设计、制造、封装和测试之间的分工、协作与配套，加大集成电路产业链各环节的建设力度。
6	2009 年	国务院	《电子信息产业调整和振兴规划》	该规划作为电子信息产业综合性应对金融危机措施的行动方案，规划期为 2009 年至 2011 年。规划指出，之后三年，电子信息产业围绕九个重点领域，完成如下三个任务：第一，确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长；第二，突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术；第三，通过新应用带动新增长。同时继续完善集成电路产业体系，支持骨干制造企业整合优质资源，加大创新投入，推进工艺升级，支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合。
7	2010 年	国务院	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	提出着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。
8	2011 年	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，在财税、投融资、研究开发、进出口等各方面制定了许多优惠政策。投融资方面，积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。

序号	发布时间	发布单位	政策名称	与行业相关内容
9	2012年	工业和信息化部	《集成电路产业“十二五”发展规划》	规划的发展目标为到“十二五”末，产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，结构调整取得明显成效，产业链进一步完善，形成一批具有国际竞争力的企业，基本建立以企业为主体的产学研用相结合的技术创新体系。顺应集成电路产品向功能多样化的重要发展方向，大力发展先进封装和测试技术，推进高密度堆叠型三维封装产品的进程，支持封装工艺技术升级和产能扩充，提高测试技术水平和产业规模。
10	2012年	国务院	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	提出大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工艺技术，先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和期间工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势。
11	2013年	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	将集成电路测试设备列入战略性新兴产业重点产品目录。
12	2014年	工业和信息化部	《国家集成电路产业发展推进纲要》	提出突出企业主体地位，以需求为导向，以整机和系统为牵引、设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和机制体制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推动集成电路产业中的突破和整体提升，实现跨越发展，为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑。纲要提出设立国家产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。支持设立地方性集成电路产业投资基金。鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。
13	2015年	国务院	《中国制造 2025》	将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维（3D）未组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力。
14	2016年	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》	大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成了一批新增长点。
15	2016年	财政部、国家税务总局、国家发改委、工业和信息化部	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）	明确了在集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批取消后，规定集成电路设计企业可以享受《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）有关企业所得税减免政策需要的条件，再次从税收政策上支持集成电路设计行业的发展。

序号	发布时间	发布单位	政策名称	与行业相关内容
16	2016年	国务院	《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》（国发[2016]43号）	将“核高基”、集成电路装备等列为国家科技重大专项，发展关键核心技术，着力解决制约经济社会发展和事关国家安全的重大科技问题，建成一批引领性强的创新平台和具有国际影响力的产业化基地，造就一批具有较强国际竞争力的创新型领军企业，在部分领域形成世界领先的高科技产业。
17	2017年	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	明确集成电路等电子核心产业地位，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品和服务。
18	2017年	国务院	《政府工作报告》	加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、新能源、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。
19	2017年	国务院	《新一代人工智能发展规划》	抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国
20	2017年	工业和信息化部办公厅	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》	智能化成为技术和产业发展的重要方向，人工智能具有显著的溢出效应，将进一步带动其他技术的进步，推动战略性新兴产业总体突破，正在成为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。
21	2018年	财政部、国家税务总局、国家发改委、工业和信息化部	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2018]27号）	对满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止的优惠政策。
22	2018年	工业和信息化部办公厅	《工业和信息化部办公厅关于印发<2018年工业通信业标准化工作要点>的通知》（工信厅科函〔2018〕99号）	大力推进集成电路军民通用标准等重点领域标准体系建议，进一步强化技术标准体系建设。

上述政策和法规的发布和落实，为集成电路及其专用设备制造行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的经营环境，促进了本土集成电路及其专用设备行业的发展。

（三）行业发展情况及未来发展趋势

1、全球集成电路行业概况

（1）行业概况

集成电路行业作为全球信息产业的基础，经历了 60 多年的发展，如今已成为世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业，业内企业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。

根据美国半导体行业协会统计，2017 年全球集成电路行业总收入为 4,122 亿美元，较 2016 年度增长 21.6%，全球各主要地区的半导体市场均有增长。美国半导体市场增长 35%，成为全球半导体市场增长最快的地区；欧洲增长 17.1%；日本增长 13.3%；亚太地区增长 19.4%。其中，中国大陆地区的集成电路产业规模为 802 亿美元（5,411.3 亿元），增长率为 24.8%，对亚太地区半导体市场增长做出了很大的贡献。

2016 年至 2018 年全球各国家/地区半导体市场规模

国家/地区	销售额（百万美元）			增长率（%）		
	2016	2017	2018E	2016	2017	2018E
美国	65,537	88,494	103,340	-4.7	35.0	16.8
欧洲	32,707	38,311	40,826	-4.5	17.1	6.6
日本	32,292	36,595	39,013	3.8	13.3	6.6
亚太地区（除日本）	208,395	248,821	268,051	3.6	19.4	7.7
合计	338,931	412,221	451,230	1.1	21.6	9.5

数据来源：全球半导体贸易统计组织

根据全球半导体贸易统计组织的预测，到 2018 年美国半导体市场仍有 16.8% 的增长，欧洲和日本的增长率都保持在 6.6% 左右，亚太地区的平均增长率降至 7.7%，但中国大陆地区仍将保持 20% 以上的增速，中国大陆地区将成为 2018 年全球半导体市场增速最快的地区之一。

从全球竞争格局的角度看，目前少数巨头企业占据了全球半导体产业的主导地位，2017 年前十大厂家市场占比达到了 58.4%，整个市场较为集中。全球前十大半导体厂商机构情况如下表所示：

2017 年全球前十大半导体厂商销售收入

单位：百万美元

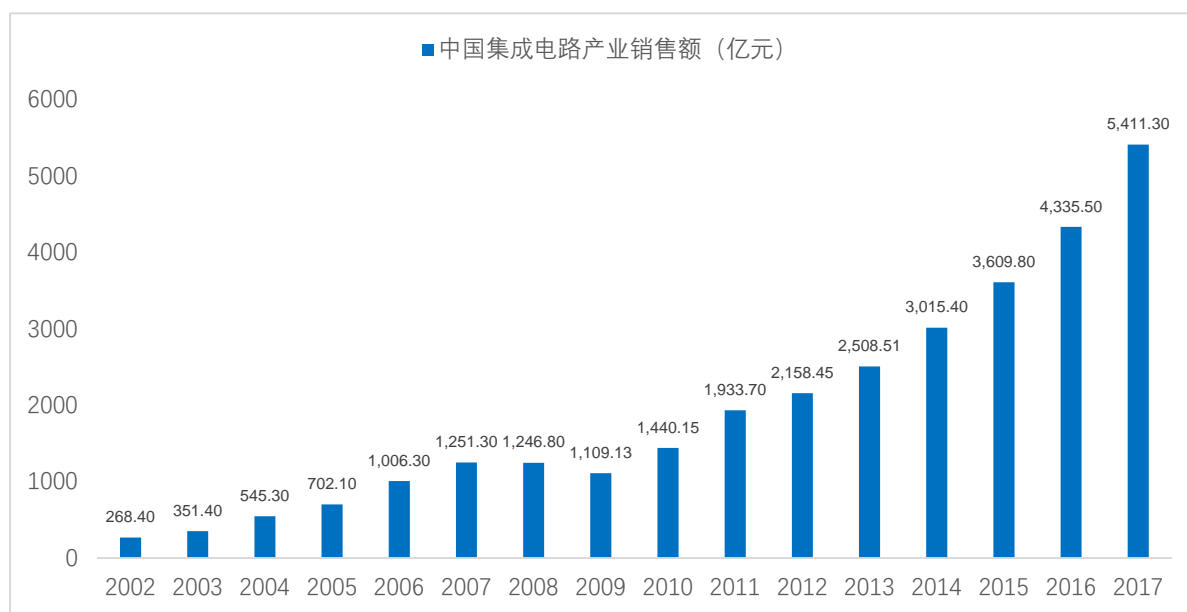
排名		公司	2017 年销售额	2016 年销售额	2017 年增长率 (%)	2017 年市场份额 (%)
2017	2016					
1	2	Samsung (三星)	61,215	40,104	52.6	14.6
2	1	Intel (英特尔)	57,712	54,091	6.7	13.8
3	4	SK Hynix (海力士)	26,309	14,700	79.0	6.3
4	6	Micron Technology (美光)	23,062	12,950	78.1	5.5
5	3	Qualcomm (高通)	17,063	15,415	10.7	4.1
6	5	Broadcom (博通)	15,490	13,223	17.1	3.7
7	7	Texas Instrument (德州仪器)	13,806	11,901	16.0	3.3
8	8	Toshiba (东芝)	12,814	9,918	29.2	3.1
9	17	Western Digital (西部数据)	9,181	4,170	120.2	2.2
10	9	NXP (恩智浦)	8,651	9,306	-7.0	2.1
合计			245,302	185,778	32.0	58.4

数据来源：Gartner

2、中国集成电路行业概况

我国本土集成电路产业的起步较晚。在国家及地方政府多项政策的支持和指引，国家集成电路产业投资基金和地方专项扶持基金的推动，以及社会各界的共同努力下，我国集成电路产业从无到有，企业创新能力逐步提升，已经在全球半导体市场占据举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会披露，自 2002 年以来，我国集成电路产业规模得到快速增长。2017 年，中国集成电路产业总销售额高达 5,411.3 亿元，比上年增长 24.8%。

2002年-2017年中国集成电路产业规模情况



数据来源：中国半导体行业协会

产业结构上，集成电路产业主要可分为集成电路设计、集成电路制造及集成电路封装测试三个部分。在2017年我国集成电路产业发展中，设计业销售额为2,073.5亿元，同比增长26.1%；芯片制造业销售额为1,448.1亿元，同比增长28.5%；封装测试业销售额为1,889.7亿元，同比增长20.8%。均保持了超过20%的高速增长。其中集成电路设计行业发展势头尤其迅猛，多年来均保持高速增长。自2016年以来，集成电路设计业总规模已超过封装测试业，在集成电路产业中占比第一。

2013-2017年我国集成电路设计业、芯片制造业和封装测试业的销售规模及增长率

单位：亿元

年份		2013	2014	2015	2016	2017
IC 设计业	销售额	808.8	1,047.4	1,325.0	1,644.3	2,073.5
	增长率	30.1%	29.5%	26.5%	24.1%	26.1%
芯片制造业	销售额	600.9	712.1	900.8	1,126.9	1,448.1
	增长率	19.9%	18.5%	26.5%	25.1%	28.5%
封装测试业	销售额	1,098.8	1,255.9	1,384.0	1,564.3	1,889.7
	增长率	6.09%	14.3%	10.2%	13.0%	20.8%
产业链合计	销售额	2,508.5	3,015.4	3,609.8	4,335.5	5,411.3
	增长率	16.2%	20.2%	19.7%	20.1%	24.8%

数据来源：中国半导体行业协会

但是，大陆集成电路产业相较发达国家仍有一定发展空间，表现在我国的集成电路产业的产业结构依旧不够合理，整体行业分散，技术和研发水平远落后于国际先进水平。

第一是设计、制造和封装产值比例不合理。尽管近几年集成电路设计产业发展迅速，但大陆地区集成电路设计业占全行业仅为 38%，封装测试业占比为 35%，而在世界范围内，集成电路设计的产值占比接近 60%，集成电路封装测试环节的份额占比不到 20%。集成电路设计的毛利率水平一般要远高于测试和封装，通常情况下集成电路设计类公司的平均毛利率在 40%左右的水平，晶圆制造类公司的毛利率约为 30%，而测试封装企业的平均毛利率仅在 20%左右。总体而言，中国大陆地区集成电路产业仍然大量集中在附加值和技术含量较低的产业链环节，未来将继续推进向设计环节转型。

第二是我国大陆集成电路企业结构相对分散，与发达国家相比结构不合理。目前大陆集成电路产业市场集中度相对较低。以集成电路设计为例，中国前十大集成电路设计企业 2017 年的市场份额占比在 38.01%，而在全球市场，2017 年前十大集成电路设计企业市场份额高达 73.34%。从业态来看，集成电路产业具有技术密集和资本密集的属性，行业发展趋势有利于强者恒强。中国大陆地区集成电路行业市场集中度偏低的情况反映出国内集成电路企业的力量弱小，缺乏能够独立做大做强的领军企业。

第三是我国集成电路产品自给率偏低。2017 年中国集成电路市场进口金额 2,601.4 亿美元，同比增长 14.6%；出口金额 668.8 亿美元，同比增长 9.0%；2017 年进出口逆差 1,932.6 亿美元。国内集成电路产品的自给率偏低的情况仍然没有得到明显改观。从进口集成电路的产品结构来看，除去进口大量单位价值很高的 CPU 以外，我们每年进口的集成电路中有相当一部分属于中低端产品。对于这部分市场，大陆本土的集成电路企业完全能够短时间内迅速渗透，与发达公司开展竞争，减少对境外市场的依赖。

3、中国集成电路设计行业概况

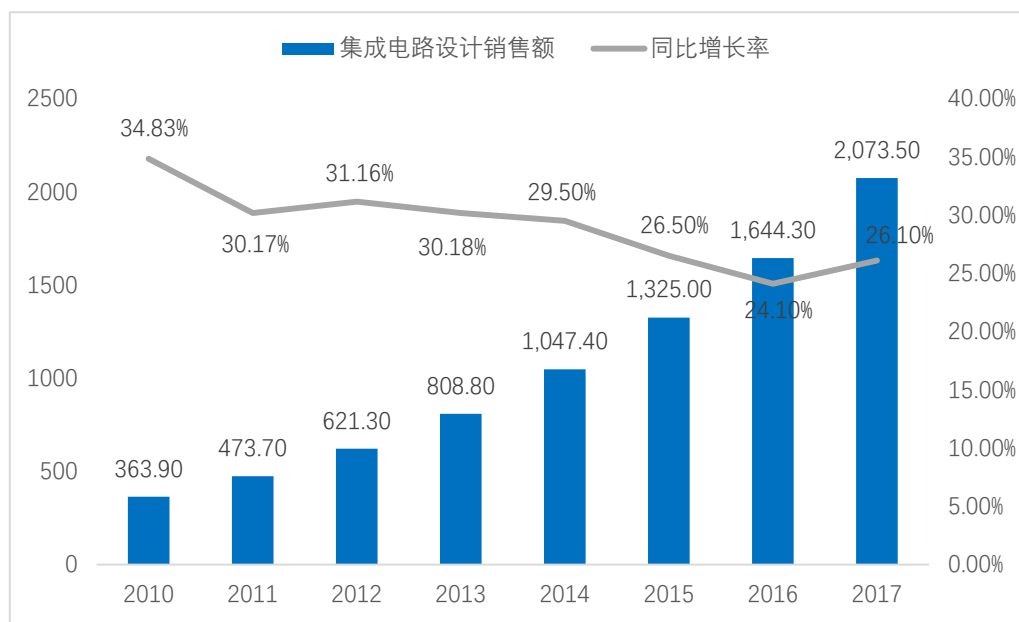
（1）产业规模

近些年来，在国家政策扶持以及市场应用带动下，中国集成电路产业保持快速增长，继续保持增速全球领先的势头。受此带动，在国内集成电路产业发展中，集成电路设计业始终是国内集成电路产业中最具发展活力的领域，增长也最为迅速。根据中国半导体行业协会统计，集成电路设计业销售收入从 2010 年的 363.9 亿元增长到 2017 年的

2,073.5 亿元, 年均复合增长率为 28.22%, 占全球集成电路设计业的比重提升至 30.50%, 增速较为可观。

2010 年-2017 年中国集成电路设计行业销售额及增长情况

单位：亿元



数据来源：中国半导体行业协会

(2) 地域分布

受我国各地区经济发展水平、制造业密集程度和人才储备影响, 我国集成电路设计业主要集中分布在珠三角地区、长三角地区、京津环渤海地区和以重庆、西安、成都、武汉等中心城市圈为重点的中西部地区。2017 年各地区销售规模总体维持增长趋势, 其中长三角、珠三角地区仍是我国集成电路设计业最为集中的两个地区, 京津环渤海地区位居第三, 中西部地区规模虽小, 但发展速度较快。

2016-2017 年我国 IC 设计业主要地区的发展情况

地区及主要城市		2016 年		2017 年	
		销售规模 (亿元)	同比增长	销售规模 (亿元)	同比增长
长三角地区	上海	338.30	21.59%	376.91	11.41%
	杭州	56.99	54.78%	75.11	31.80%
	无锡	65.00	33.72%	95.00	46.15%
	苏州	32.50	25.97%	40.00	23.08%

	南京	34.00	-2.86%	50.00	47.06%
	合肥	13.42	872%	24.67	83.83%
	小计	540.21	26.8%	661.69	22.49%
珠三角地区	深圳	420.00	10.53%	579.17	37.90%
	珠海	27.60	55.00%	46.00	66.67%
	香港	12.40	34.34%	15.20	22.58%
	福州	15.06	0.74%	15.13	0.46%
	厦门	21.00	16.67%	32.00	52.38%
	小计	496.06	12.75%	687.50	38.59%
京津环渤海地区	北京	325.61	19.71%	365.00	12.10%
	天津	13.71	14.45%	19.01	38.66%
	大连	7.03	14.87%	7.99	13.66%
	济南	8.00	56.56%	11.45	43.13%
	小计	354.35	20.00%	403.45	13.86%
中西部地区	成都	38.00	22.50%	46.70	22.89%
	西安	35.96	2.19%	77.16	114.57%
	武汉	25.00	-	33.00	32.00%
	重庆	7.00	-25.90%	9.48	35.43%
	长沙	22.00	431%	27.00	22.73%
	小计	127.96	74.83%	193.34	51.09%
合计		1,518.52	23.04%	1,945.98	28.15%

数据来源：ICCAD2016，ICCAD2017 会议资料整理

（3）企业情况

2017 年我国集成电路设计企业整体经营水平持续增长，优势企业成绩瞩目。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》发布和其他一系列鼓励政策的颁布，集成电路设计行业成为目前中国集成电路产业中竞争最为激烈的领域。自 2015 年来，各地政府采取各种优惠措施吸引国内成熟的设计企业在异地开设分支机构，截至 2017 年，我国集成电路设计企业的总量已达 1,380 家，较 2015 年的 736 家上升了近一倍。同时，中国集成电路设计业不仅在企业数量上有进一步的提升，在发展质量上也获得了显著的成绩。2017 年中国大陆前十大企业的销售总额达到 788.20 亿元，同比增长了 14.65%。

4、数据中心及服务器市场概况

（1）数据中心发展概况

根据 Gartner 报告显示，2017 年全球 IT 支出约为 3.5 万亿美元，而云计算市场规模占全球 IT 支出的比重快速提升，从 2010 年的 1.99% 上升到 2017 年的 6.47%，预计到 2019 年将达到 9.25%。对于传统 IT 的替代是云计算价值的重要体现。2017 年全球云计算规模将达到 2,602 亿美元，预计到 2020 年将达到 4,114 亿美元，2018-2020 年复合增速将达 16.5%。云计算服务规模的扩张带动底层云基础设施建设和上层云具体行业应用相关产业的发展，尤其是对推动数据中心需求在全球范围内持续增长，起到了至关重要的作用。数据中心作为云计算的物理基础，2017 年全球数据中心市场规模达 534.7 亿美元，过去三年全球市场增速基本保持在 15%-20% 之间，行业成长性突出。

从全球分布来看，北美占据了半壁江山，其次为亚太地区，占比 30.3%，第三位西欧则为 15.8%。但从增速上来看，亚太地区潜力最大，连续三年增速超过 30%，其中又以中国、印度等国增长最为迅猛，拉动了全球新一代基础设施建设进入高速期。根据中国 IDC 圈数据，2017 年国内 IDC 市场规模接近 950 亿元，过去三年增速保持在 40% 左右，显著高于全球平均水平。受益于国内在线数据量的持续爆发式增长以及云计算产业的高景气度，国内 IDC 市场未来仍将保持强劲增长势头，其产品形态、市场格局将会快速与欧美市场趋同。

从发展趋势来看，云计算显著推升数据中心市场进入门槛，并加速市场集中度提升。随着云计算成为数据中心的主要需求方，云计算厂商出于业务需求、运营管理等诉求，希望采用超大规模的数据中心（规模大于一万个标准机架）。思科预计到 2021 年，全球超大型数据中心数量将超过 600 个，并承载全球数据中心中 53% 的服务器安装量、69% 的运算能力、65% 的数量存储能力，以及 55% 的数据流量。同时，随着市场对 IDC 网络互联要求、运营稳定性要求的持续提升，IDC 产业技术门槛也将显著提升。此外，近年来全球 IDC 市场并购活动明显趋于频繁，2017 年全球 IDC 市场累计并购额达到 200 亿美元，涉及并购案例数 48 起，预计未来将呈现头部厂商强者愈强的格局。

（2）服务器市场发展概况

服务器是占数据中心成本中的最大部分。2017 年，政府信息化、行业互联网+、数字化转型，以及大数据、人工智能时代下数据量与数据结构的改变，加速对传统的 IT

架构进行变革，中国服务器市场也保持快速增长势头。国家正在大力推进中国制造 2025、智慧政务、智能交通、智慧医疗、智能电网等行业信息化建设，从“互联网+”向“AI+”的不断演进，对利用云计算、大数据、AI 等先进技术创新的产品和服务需求不断高涨，由此带动服务器产品市场的不断繁荣。根据赛迪顾问调研数据显示，2017 年，中国服务器市场销量达到 280.81 万台，销售额达到 668.80 亿元，分别比 2016 年同期增长 15.6%和 15.8%。其中，x86 服务器市场销量为 278.2 万台，占中国服务器市场总销量的 99.1%；x86 服务器销售额为 591.9 亿元，占中国服务器总销售额的 88.5%，x86 服务器已经成为当前市场应用的主流，占据绝对主导地位。

2017 年，互联网仍是 x86 服务器市场销售额最大、增速最高的行业市场，主要推动力来自阿里、腾讯、百度等互联网巨头对超大规模数据中心的投资。此外，政府、电信、交通等行业市场的增速也普遍高于市场平均水平，拉动行业采购的主要动力是行业数字化转型。

2017 年中国 x86 服务器市场行业结构

行业	销售量占比	销售额占比
互联网	27.9%	29.6%
政府	19.2%	17.6%
电信	9.4%	10.4%
教育	8.6%	7.3%
制造	7.1%	7.0%
交通	4.0%	4.1%
电力	3.1%	3.3%
医疗卫生	3.1%	3.0%
证券与其它金融	2.8%	2.9%
银行	2.4%	2.7%
保险	2.3%	2.6%
物流与邮政	2.1%	1.9%
石油石化	1.7%	1.7%
科研	1.2%	1.3%
批发零售	1.4%	1.3%
煤炭与其它能源	0.7%	0.6%
其它	3.0%	2.7%

合计	100%	100%
----	------	------

数据来源：赛迪顾问

随着移动互联、云计算、大数据、物联网等技术的日趋成熟，电信与互联网、政府、交通、制造等传统行业对服务器市场的需求将明显提升。此外，人工智能技术的发展将推动 AI 平台建设需求的爆发式增长，“AI+”的产业化进程将不断加快，公共安全、视频 AI、车载 AI 等领域将产生巨量 AI 计算需求，新兴市场将成为服务器市场全新的增长点。

2018-2020 年中国 x86 服务器市场行业销售额结构预测

单位：亿元

年度	2018E	2019E	2020E	年均复合增长率
银行	18.80	21.40	24.20	14.3%
保险	17.36	19.22	21.08	10.8%
证券与其它金融	18.77	20.64	22.51	10.0%
制造	45.23	48.86	52.49	8.1%
电力	21.77	24.14	26.51	11.0%
石油石化	11.26	12.62	13.98	12.2%
煤炭与其它能源	4.19	4.62	5.05	10.3%
交通	28.52	32.00	36.48	14.2%
电信	71.90	81.08	90.26	13.7%
互联网	213.00	248.70	288.40	18.1%
科研	8.42	9.44	10.46	12.2%
医疗卫生	20.51	23.32	26.13	13.9%
批发零售	8.79	9.78	10.77	11.4%
物流与邮政	12.58	13.96	15.44	11.3%
政府	124.00	143.00	164.00	16.4%
教育	48.50	52.90	57.40	10.0%
其它	17.80	19.32	20.84	8.7%
合计	691.40	785.00	886.00	14.4%

数据来源：赛迪顾问

（3）内存接口芯片发展概况

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI（德州仪器）、Intel、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年-2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866 MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI（德州仪器）等	2008 年-2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年-2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的运行速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品	澜起科技、IDT、Rambus	2017 年至今

目前全球市场中可提供内存接口芯片的主要厂商共有三家，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus。根据公开数据，2018 年以来上述三家公司对应的内存接口芯片业务收入均呈现持续增长趋势。由于内存接口芯片的价格较为稳定，其市场规模的增长主要来源于内存出货量的增加。相比于全球服务器出货量的增长，由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，服务器中配置内存数量也随之增长，导致内存接口芯片的增长率高于服务器市场的增速。

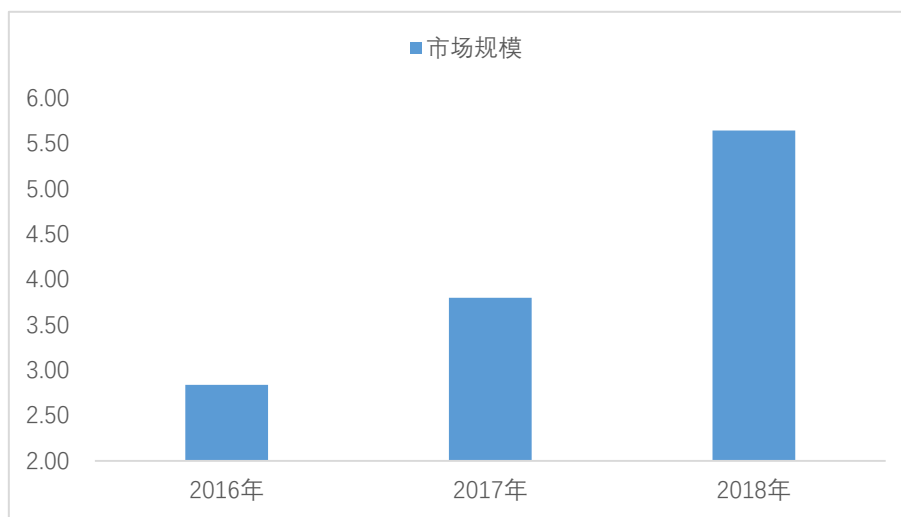
最近三年，DDR4 技术的发展进入了成熟期，成为了内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能，用以支持更高速率和更大容量的内存。2016 年初主流的内存接口芯片支持的最高传输速率为 2400MT/s，2018 年底的主流内存接口芯片支持的最高传输速率为 2933MT/s，最近三年内内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升。

2018 年底，全球各大主要内存芯片厂商已经公布了各自的 DDR5 研发进度，未来 DDR5 内存技术有望实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。澜起科技正全程参与 JEDEC 组织对最新的 DDR5 内存接口产品的规格定义。DDR5 内存接口芯片相比于前一代 DDR4 内存接口芯片，可以支持更高的速率以及更低的电压。

根据 Gartner 公司公布的 2018 年第四季度以及 2018 年度全球 X86 服务器市场调查报告，2018 年全年全球服务器出货量为 1,290.4 万台，销售额为 705.3 亿美元。根据 IDT 和 Rambus 定期报告公开披露数据和发行人相关收入推算，2018 年全球内存接口芯片市场规模约为 5.7 亿美元，占全球服务器市场规模的份额为 0.81%。

2016 年至 2018 年内存接口芯片市场规模情况

单位：亿美元



数据来源：根据公开数据整理

5、行业未来发展趋势

(1) 以新兴产业需求为导向，发展集成电路产业新动能

人工智能、高端应用处理器、高性能计算、5G、汽车驾驶辅助系统、虚拟货币等新兴领域是驱动现阶段集成电路设计领域继续向前发展的重要驱动力。在上述领域需求的刺激下，预计在未来几年，如高精度度的数据转换芯片、高速的射频传输芯片等集成电路产品都将被更为广泛地应用各类智能移动终端、工业机器人、新能源汽车、可穿戴设备等新兴产品中。由于这些新兴领域的电子产品在全球都处于初期发展及应用阶段，在国家政策的扶持以及市场需求的双重带动下实现产品自主化的可能性较高，如果能够把握住市场发展机遇，未来这些新兴领域不但将成为集成电路市场新的增长蓝海，也将为国内集成电路产业带来前所未有的发展契机。

(2) 云计算、5G、AI 等驱动未来 5 年服务器增长

根据 IDC 公开数据及外部研究整理，目前服务器市场以企业用户为主，数据中心规模服务器集群约占 30%，预计 2021 年超大型数据中心将占服务器安装量 53%，占公有云服务器安装量的 85%。数据中心的 ICT 设备采购成本中服务器约占 70%以上，总体拥有成本中服务器相关成本占比约 60%以上。大规模云数据中心催生了电源和散热等共享式的多节点服务器出现，2018Q1 云服务器贡献了一半以上的增长，而未来 5G 建网的 IT 化趋势下，针对边缘计算的微型服务器也将会在未来 3-5 年显著成长。以 CPU+GPU、FPGA、ASIC 等形态为主的异构计算架构新趋势，AI 服务器持续保持高速增长。云计算、5G、AI、IOT 将成为未来 5 年推动服务器增长的主要驱动力。

（3）信息安全成为我国国家战略的重要组成部分

我国一直高度重视信息安全产业的发展。2015 年，国家主席习近平在第二届世界互联网大会上提出，共同构建网络空间命运共同体，并将信息安全上升到国家战略高度。2016 年 11 月，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国网络安全法》，并于 2017 年 6 月 1 日开始实施，强调了金融、能源、交通、电子政务等行业在网络安全等级保护制度的建设。2016 年 12 月，国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，是我国第一次向全世界系统、明确地宣示和阐述对于网络空间发展和安全的立场和主张。2017 年 1 月，工业和信息化部制定印发了《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020 年）》，紧扣“十三五”期间行业网络与信息安全工作面临的重大问题，对“十三五”期间行业网络与信息安全工作进行统一谋划、设计和部署。2019 年 1 月，网络安全等级保护 2.0 已在国家安标委最终审批，正式标准有望出台，其主要变化体现在范围更广、力度更大且对新兴领域安全提出要求，有望带动信息安全整体市场需求增长。

（4）行业龙头日趋集中，强者恒强

集成电路行业是技术密集型、资本密集型的行业。从技术方面，集成电路产品的工艺和制造技术难度高、研发周期长，较高的技术壁垒使得行业龙头企业在短时间内难以被赶超。近 10 年来，集成电路技术经历了特征尺寸不断减小、新材料的导入、晶体管机构的改进、晶圆向大尺寸转进、制造设备向自动化和高产出率转化、先进封装不断替换传统封装，芯片设计向系统设计过渡。所有这些技术创新均有效推动了行业资源向龙头集中。

从资金方面，企业设计和研发一款芯片需要投入大量的资金，花费 1-2 年甚至更长的时间，并调动上下游的制造、封装测试等环节通力合作。由于终端对产品性能的提升和需求的多样化，集成电路行业的投资额近年来也不断突破最高水平。高昂的研发费用和指数式增长的产能投资使中小规模的集成电路企业望而却步，未来高端工艺的竞争将日趋集中。

由此，集成电路行业的特点决定了“强者恒强”的格局，中小型企业会因为投入有限而影响研发进度，很难与行业龙头正面抗衡。在内存接口芯片领域，也正是经过了十余年的专注研发和持续投入，澜起科技的相关产品成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，成为全球能提供此类芯片的领先企业。

（四）面临的机遇与挑战

1、行业机遇

（1）国家政策大力扶持。集成电路行业是信息化社会的基础行业之一，行业设计水平是一个国家科技实力的重要体现，更对国家安全有着举足轻重的战略意义。近年来，国家各部门相继推出了一系列政策鼓励和支持集成电路行业发展。2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》，明确提出将核心电子器件、高端通用芯片作为 16 个重大专项之一。2014 年 6 月，工业和信息化部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出“到 2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%，企业可持续发展能力大幅增强。”2014 年 10 月，国家集成电路产业基金成立，给行业注入新动力。

（2）国家对高端芯片需求较大。在全球集成电路市场增长的带动下，国内集成电路产业快速发展，市场需求持续攀升。随着云计算、大数据、物联网等产业的逐步成熟，我国已成为全球半导体市场规模增速最快的地区之一。与旺盛的市场需求形成鲜明对比的是，我国集成电路产业整体竞争力不强，在高端通用 CPU 和存储器领域对进口依赖较大，存在一定技术空缺。因此，近年来我国不断推出相关政策并提供资金推动集成电路产业的发展，并与此同时积极通过并购及引进技术和人才等手段提升企业竞争力。

（3）集成电路产业重心转移带来巨大机遇。在集成电路全球市场增长乏力的态势下，中国大陆市场表现强劲，已经成为世界最大的集成电路芯片市场。在这一趋势带动下，芯片制造业厂商如台积电、中芯国际、日月光等纷纷在大陆投资建厂和扩张生产线，

下游晶圆加工工艺持续改进，国内封装测试企业技术水平达到国际先进水平，为集成电路设计企业提供了充足的产能基础。

（4）下游制造业升级。随着《中国制造 2025》、“互联网+”行动指导意见等一系列国家战略的持续深入实施，下游制造业的升级换代进程加快，其中汽车电子、工业控制、消费电子等集成电路应用的重要领域维持较快增速。下游市场处于平稳发展的态势，直接影响集成电路产业链的持续扩张，有利于维持集成电路设计行业需求端的规模增长。

（5）新兴市场孕育机会。在即将到来的物联网和人工智能时代，创新科技产品的诞生将给集成电路设计行业带来新的机会。目前，物联网、5G、医疗、人工智能等新兴产业将成为行业新的市场推动力，广阔的市场空间给行业带来了新的发展机遇，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内集成电路设计公司将会出现发展的新契机。

2、行业挑战

（1）高端专业人才不足。集成电路设计行业是典型的技术密集行业，在电路设计、软件开发等方面对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求。经过多年发展，我国已经累积出一批人才，但由于行业发展时间较短、技术水平较低，且人才培养周期较长，和国际顶尖集成电路企业相比，高端、专业人才仍然十分紧缺。未来一段时间，人才匮乏仍然是制约集成电路设计行业快速发展的瓶颈之一。

（2）我国集成电路技术的国际竞争力有待提升。国际市场上主流的集成电路公司大都经历了四十年以上的发展。国内同行业的厂商仍处于一个成长的阶段，与国外大厂依然存在技术差距，尤其是制造及封装测试环节所需的高端技术支持存在明显的短板，目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导地位。因此，产业链上下游的技术水平也在一定程度上限制了我国集成电路设计行业的发展。

（五）发行人产品的市场地位

公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，现已成为全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被采纳为国际标准，相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，占据全球市场的主要份额。

公司是经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局等联合认证的“高新技术企业”，曾荣获“上海市技术发明奖一等奖”、“中国电子学会科学技术奖一等奖”、“全球半导体联盟 2017 年最受尊敬非上市半导体公司奖最终提名”、“‘中国芯’年度重大创新突破产品”、工业和信息化部“制造业单项冠军培育企业”等荣誉称号。

报告期内，公司所获资质及荣誉称号如下表所示：

2016 年以来发行人所获主要资质及荣誉称号清单

年份	序号	奖项名称	颁发时间	颁奖机构
2019 年	1	上海市技术发明奖一等奖	2019 年 5 月	上海市人民政府
2018 年	1	2018 年国家级企业技术中心	2018 年 12 月	国家发展改革委高技术产业司
	2	第二十届中国专利优秀奖	2018 年 12 月	国家知识产权局
	3	2018 年第十三届“中国芯”年度重大创新突破产品	2018 年 11 月	中国电子信息产业发展研究院
	4	制造业单项冠军培育企业	2018 年 11 月	工业和信息化部
	5	2017-2018 年度“IC 中国”风眼创新企业暨独角兽	2018 年 4 月	中国半导体市场年会
	6	IC Insights 全球前 50 大及中国前 10 大集成电路设计公司	2018 年 3 月	IC Insights
	7	首届集成电路产业联盟创新奖	2018 年 3 月	集成电路产业技术创新战略联盟
2017 年	1	2017 年最受尊敬非上市半导体公司奖最终提名	2017 年 11 月	GSA
	2	2017 年第十二届“中国芯”最佳市场表现产品奖	2017 年 10 月	工业和信息化部软件与集成电路促进中心
	3	2016-2017 年中国半导体市场年度创新企业奖	2017 年 3 月	赛迪顾问股份有限公司
2016 年	1	2016 年度中国电子学会科学技术奖一等奖	2016 年 11 月	中国电子学会
	2	第十届（2015 年度）中国半导体创新产品和技术奖	2016 年 3 月	中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社

（六）行业技术水平及特点

1、内存 DDR 技术的发展情况

DDR 是 Double Data Rate 的英文缩写，意指双倍速率，是内存模块中用于使输出增加一倍的技术。DDR 是 21 世纪初主流内存规范，各大芯片组厂商的主流产品均支持

DDR 标准规范。当前 DDR 技术的发展情况来看，DDR4 正处于成熟期，而 DDR5 即将步入市场。一方面 DDR 的快速发展，使市场对内存接口芯片的技术水平要求更高；另一方面随着云计算、大数据等新兴技术的快速普及，服务器的需求增多，进而不断催动市场对于内存的需求。随着 DDR 的不断升级换代，内存接口芯片的技术也随之不断升级。

内存	基本情况
DDR	首代 DDR 产品，是 SDR SDRAM 的升级版。这个时期，IDT 研发出一款 13-26 位寄存器缓冲器，专为匹配内存而设计，用于 2.3-2.7V 下的 DDR266、DDR333 以及 2.5-2.7V 下的 DDR400。
DDR2	DDR2 拥有两倍于上一代 DDR 内存预读取能力，且在节能方面做得更加优秀。这一时期，第一代的高级内存缓冲器出现，成为全缓冲双列直插内存模组（FBDIMM）架构最为关键的芯片。它解决了传统并行式内存架构速度与容量难以兼顾的问题，使服务器和高性能计算机的性能有了质的飞跃，但同时因为使用量多而出现功耗大的问题。
DDR3	DDR3 相较于 DDR2，提供了更高的运行效能与更低的电压。此阶段内存接口芯片得到一步发展，通过减低内存控制器的负载和改善信号完整性，从而增加内存系统的支持容量和带宽。同时在可靠性与功耗方面也做了进一步提升，以提高此时期服务器的内存容量和数据处理速度。
DDR4	DDR4 在传输速率和数据可靠性上做了进一步提升（8n-bit 内存预读取，最高可实现 32 位），并采用 1.2V 工作电压，更为节能。从这一时期开始，由于技术的更加成熟，内存接口芯片的发展进入繁荣时段，规格更加齐全，在性能功耗方面达到更高水准。并可在所有 JEDEC 定义的 DDR4 LRDIMM 和 RDIMM 上实现更高密度、更快速率的数据处理。此外，有些产品还可以支持 NVDIMM（非易失性双列直插内存模组）模式，为计算机内存体系增加了新层级的功能，实现 DRAM 速率级的非易失性内存访问。
DDR5	DDR5 采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步，实现 4800MT/s 的超高运行速率，是 DDR4 最高速率的 1.5 倍。目前应用于 DDR5 的第一代内存接口芯片正处于进一步研发中。

2、内存接口芯片技术与内存 DDR 技术的发展路径、发展阶段以及产品推出时间等方面的匹配性

内存接口芯片技术与内存 DDR 技术发展路径、发展阶段以及产品推出时间的匹配情况在 DDR3 之前与之后有所不同。在 DDR2 和 DDR3 世代，最新的内存技术首先应用在台式电脑上，之后才在服务器上应用；从 DDR4 世代开始，最新的内存技术首先在服务器上应用。目前内存接口芯片主要应用于服务器上，相关发展阶段和产品推出时间的匹配性参见下表：

DDR 技术世代	内存面世时间（主要厂商）	澜起科技内存接口芯片面世时间	
		描述	认证时间
DDR2	2003 年	高级内存缓冲器（AMB）芯片	2008 年 6 月

DDR3	2007 年	寄存缓冲器芯片、内存缓冲器芯片	2011 年 8 月
DDR4	2014 年	寄存时钟驱动器芯片、数据缓冲器芯片	2013 年 10 月
DDR5	研发中	寄存时钟驱动器芯片、数据缓冲器芯片	研发中

根据 DDR 内存技术和澜起科技内存接口芯片推出的时间表显示，内存接口芯片是紧跟 DDR 内存技术的更新换代而不断演进。针对最新的 DDR5 内存技术，澜起科技正在研发相应的内存接口芯片。

3、内存接口芯片技术的行业平均水平以及“1+9”架构的技术先进性

因为内存接口芯片需满足 JEDEC 制定的相关行业标准，凡是可提供相关产品且经认证的公司，其技术水平均已满足 JEDEC 基本标准。

在 DDR4 世代，澜起科技发明了“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，并贡献给行业组织，成为 DDR4 内存接口芯片的重要标准之一。在符合行业标准的前提下，各市场参与者在产品能耗、信号完整性、产品可靠性等方面进行竞争，其产品具体的实现方式和实现路径等存在差异。

（1）“1+9”分布式缓冲内存子系统框架与传统架构对比：

性能对比项	传统架构	“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架
技术架构	数据连接线长，负载重，数据延迟大	信号走线短，负载轻，数据延迟小
技术水平	信号完整性差，带宽低： -最高工作速度仅能达到 1866MT/s -最大容量为 64GB	信号完整性好，数据带宽高： -工作速度可达 3200MT/s -最大容量为 128GB
芯片性能	功耗集中，散热问题突出	功耗分散，散热性好

（2）“1+9”分布式缓冲内存子系统框架对行业的贡献：

“1+9”架构已被 JEDEC 采纳为国际标准，成为 DDR4 LRDIMM 的标准设计，提升了公司的国际话语权，凸显了公司的技术水平及技术能力。

（3）“1+9”架构的技术先进性：

由公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计，创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲控制器芯片的分布结构布局，大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。

（七）行业内的主要企业

集成电路设计行业属于技术密集型行业，而内存接口芯片则具有更高的技术门槛。内存接口芯片的研发是为了解决服务器 CPU 的高处理速度与内存存储速度不匹配的问题，该产品领域具有良好的发展前景，因此在行业初期吸引了大量的行业主要厂商进入，DDR2 阶段的行业参与者超过 10 家。随着内存接口芯片技术的发展和行业精细化分工要求的提高，行业集中度逐步提升，到 DDR3 阶段，行业主要参与者明显减少。而进入 DDR4 阶段，目前在全球范围内从事研发并量产服务器内存接口芯片的主要包括 3 家公司，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus。技术驱动的特点使公司在激烈的竞争中脱颖而出，目前在行业内公司已确立了领先的行业地位。

（八）与同行业可比公司的比较情况

1、同行业可比公司经营情况

目前，国内公司中暂无与公司在业务模式、产品种类上均完全可比的竞争对手。在全球范围内，现阶段从事研发并量产服务器 DDR4 内存接口芯片的主要有 3 家公司，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus。根据可比公司披露的定期报告统计，总体上看，2018 年澜起科技和 IDT 在内存接口芯片市场占有率较为接近，Rambus 占比则相对较小。上述相关的公司基本情况如下：

（1）IDT (IDTI.O)

IDT 成立于 1980 年，总部位于美国，是一家为通信、计算机和消费类行业提供组合信号半导体解决方案的公司。IDT 可提供 DDR3 和 DDR4 LRDIMM 存储器接口解决方案、Serial RapidIO[®]、PCI Express[®]交换机和网桥、信号完整性产品和电源管理解决方案，以满足企业服务器应用的需求。根据 IDT2019 年财年前三季度定期报告统计，其 2019 财年前三季度营业收入 70,458.70 万美元，净利润 8,782.60 万美元，其中内存接口芯片领域收入为 20,678.70 万美元，约占总收入比例为 30%。

（2）Rambus (RMBS.O)

Rambus 成立于 1990 年，总部位于美国，是一家技术解决方案研发公司，并同时提供安全研发、高级 LED 照明设备和显示器以及拟真移动媒体领域的产品于服务。Rambus 从创立之初便致力于高端存储产品的研究与开发，目前产品应用于高性能个人电脑、图形工作站、服务器和其他对带宽和时间延迟有一定要求的设备。根据 Rambus

2018 年年报披露，其 2018 年营业收入 23,120.10 万美元，净利润-15,795.70 万美元，其中内存接口芯片领域收入为 3,640.00 万美元，约占总收入比例为 15%。

2、市场地位、技术实力、业务数据及指标情况

澜起科技成立于 2004 年，是全球内存接口芯片的主要供应商之一，凭借领先的技术水平，在 DDR4 阶段逐步确立了行业领先优势，公司 2018 年营业收入 175,766.46 万元，净利润 73,687.84 万元。澜起科技发明了 DDR4 全缓冲“1+9”架构，最终被 JEDEC 国际标准采纳。公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，同时正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。目前，公司根据内存模组制造商的研发进度，积极布局研发 DDR5 内存接口芯片，新一代产品能够有效支持 DDR5 的高速、低功耗等要求。公司将全力确保领先的研发进度，保证公司能够在现有的市场份额基础上实现持续稳定增长。

综上，报告期内澜起科技内存接口芯片业务收入迅速攀升，已成为该市场的领先企业。

（九）公司的竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）持续的创新研发能力与领先的技术优势

澜起科技自创立以来，专注于持续的技术研发和产品创新。公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

澜起科技以技术创新为基础，发明了 DDR4 全缓冲“1+9”架构，最终被 JEDEC 国际标准采纳。澜起科技凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，同时正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。

公司的核心技术基于自主知识产权，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至 2019 年 4 月 1 日，公司已获授权的国内外专利达 90 项。

（2）领先的市场地位和客户资源

经过 10 多年的发展和积淀，公司已成为国际知名的芯片设计公司，目前公司核心产品广泛应用于各类服务器，直接服务于 DRAM 市场中的主要参与者，终端客户涵盖众多知名的国内外互联网企业及服务器厂商，在内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位，实现国内自主研发产品在该领域的突破。

（3）全球化的产业布局

公司不仅扎根中国，还在美国硅谷、韩国等地建立了分支机构或办事处，派驻工程师及销售人员进行直接对接，深入了解众多国际产业巨头，深入了解行业发展及技术水平变化趋势，亲身经历整个行业变更，把握瞬息万变的行业动态及创新方向，有效地提升了公司的国际市场影响力及研发效率。同时通过全球化的产业布局，公司可以合理调配全产业资源，发挥产业协同效应，提高了公司的运营效率，有效地控制了成本。

（4）人才优势

公司董事长杨崇和博士曾在美国国家半导体公司等企业任职，并于 1997 年与同仁共同创建硅谷模式的集成电路设计公司新涛科技。杨崇和博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow），积累了丰富的设计、研发和管理经验。公司总经理 Stephen Kuong-lo Tai 先生曾参与创建 Marvell 科技集团并就任该公司的工程研发总监，拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验。

公司核心团队多毕业于国内外著名高校，在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新，目前已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术人才。公司员工中 70% 以上为研发技术类工程师，且研发技术人员中 50% 以上拥有硕士及以上学位，为公司持续的产品创新提供了重要的人才基础。

（5）显著的行业生态优势

公司深耕于服务器内存接口芯片市场，同全球主流的处理器的供应商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商，建立了长期稳定的合作关系。自 2016 年，公司携手

Intel、清华大学及国内知名服务器厂商，进一步开发津逮®服务器平台产品，大力拓展数据中心产品市场。公司在芯片设计技术上长期积累，并深度参与行业标准制定。通过与行业生态系统内主要企业的协同、分工、合作，公司深度优化整合行业生态系统内市场资源和技术资源，具备显著的行业生态优势。

（6）品牌优势

公司成立至今获得了多项荣誉。2016年6月，中国电子学会认定公司“低功耗DDR系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”；同年12月，该项技术及产业化项目荣获“中国电子学会科学技术奖一等奖”；2017年，公司荣获三星电子颁发的“最佳供应商奖”；2018年，公司产品“第二代DDR4内存缓冲控制器芯片”荣获“‘中国芯’年度重大创新突破产品”奖；2018年11月，津逮®服务器CPU及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”；2019年5月，公司“低功耗DDR系列内存缓冲控制器芯片设计技术”项目荣获上海市人民政府颁发的“上海市技术发明一等奖”。这一系列荣誉的获得，充分显示出市场对于公司品牌的认可。

2、竞争劣势

集成电路设计行业具有竞争激烈、研发投入大、不确定性较高、产品更新换代较快的特点。公司为保证快速应对市场变化，需要维持较高的研发投入，存在一定的资金压力。公司目前资产和收入规模相对国际行业龙头较小，在抗风险能力上存在一定劣势。

（十）行业发展态势

1、市场需求状况

内存接口芯片的下游客户主要为三星电子、海力士、美光科技为代表的内存模组制造商，需求规模较大，且保持较快增速，是2017年存储器市场乃至全球半导体市场欣向荣的重要推手。2017年全球存储器的销售额达到1,240亿美元，增幅达到61.5%，其中DRAM销售额达到720亿美元，较2016年增长76.8%。根据相关行业统计数据，DRAM市场的主要供应商三星电子、海力士、美光科技的市场占有率合计超过90%，呈现出了很高的市场集中度。存储芯片市场需求巨大且具有很强的增长潜力，随着大数据、物联网、人工智能等新兴产业的发展，存储产业的规模与重要性都将大大提升。

2、市场供给状况

目前全球市场中可提供 DDR4 内存接口芯片的主要厂商共有三家，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus。根据三家公司的定期报告显示，内存接口芯片相关业务收入均保持较快增速。由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，服务器中配置内存条的数量快速增长，因此内存接口芯片的增长率预计将高于服务器增长速度。结合全球服务器出货量的未来增长预期，以及内存技术和服务器发展趋势，可以推测内存接口芯片的市场规模仍将保持快速增长。

三、公司销售情况

（一）主营业务收入的主要构成

报告期内，公司销售收入及占比分产品情况如下：

单位：万元

产品应用类别	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务收入	175,766.46	100.00%	115,517.45	94.11%	84,314.84	99.79%
其中：内存接口芯片	174,865.26	99.49%	93,466.80	76.14%	55,832.67	66.08%
消费电子芯片	-	-	21,291.01	17.34%	28,482.17	33.71%
津逮 [®] 服务器平台	901.20	0.51%	759.64	0.62%	-	-
其他业务收入	-	-	7,234.04	5.89%	179.62	0.21%
合计	175,766.46	100.00%	122,751.49	100.00%	84,494.46	100.00%

（二）销量及价格变动情况

报告期内，公司产品销量及价格变动情况如下：

项目		主营业务收入	其他业务收入	合计
2018 年	收入（万元）	175,766.46	-	175,766.46
	数量（个）	96,420,573	-	96,420,573
	单价（元/个）	18.23	-	18.23
2017 年	收入（万元）	115,517.45	7,234.04	122,751.49
	数量（个）	106,160,658	5,409,388	111,570,046
	单价（元/个）	10.88	13.37	11.00
2016 年	收入（万元）	84,314.84	179.62	84,494.46

项目		主营业务收入	其他业务收入	合计
	数量（个）	86,324,888	-	86,324,888
	单价（元/个）	9.77	-	9.79

发行人报告期内分产品销量及价格变动情况如下表：

分类		2018年度	2017年度	2016年度
内存接口芯片	销售数量（颗）	96,418,800	53,595,657	36,284,845
	平均单价（元）	18.14	17.44	15.39
消费电子芯片	销售数量（颗）	—	52,563,431	50,040,043
	平均单价（元）	—	4.05	5.69

报告期内，发行人产品销售单价持续上升，其具体原因如下：

（1）发行人于 2017 年 7 月转让了产品平均单价较低的消费电子芯片业务相关资产，自 2017 年 8 月后不再从事消费电子芯片业务；而随着产品平均单价较高的内存接口芯片销售收入不断增长，其占总收入的比重不断提高。

（2）内存接口芯片某一代具体产品的生命周期里，销售单价逐步降低；但随着技术迭代后，新产品因技术先进而售价将有所提高，因此内存接口芯片产品的平均销售单价在报告期内稳中有升。

随着技术更新和产品迭代，DDR4 世代中 Gen1.0、Gen1.5、Gen2.0、Gen2plus 产品因技术和性能升级平均销售单价有所提高；同时在每一子代的生命周期里，随着时间推移，销售单价逐年降低。

随着单价较高的新产品销售占比逐渐提升，报告期内内存接口芯片的平均销售单价逐年上升。其中，单价较高的 DDR4 Gen 2.0 子代产品销售数量占比逐年上升，对报告期内内存接口芯片平均销售单价提升的影响最大。

2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因系：①2017 年其他业务收入中包含 4,791.88 万元的消费电子芯片业务的晶圆原材料的销售，单片晶圆的价格较高；②2017 年其他业务收入中包含房租的转租收入 402.63 万元，无对应的数量。

2017 年公司主营业务收入单价为 10.88 元，其他业务收入单价为 13.37 元。其他业务收入主要来自于公司转让消费电子芯片业务相关资产中涉及半成品、原材料的转让收入，以及房租转租收入。其他业务收入具体销售情况如下：

项目		销售金额（万元）	销售数量	销售单价（元）
半成品（颗）		1,376.96	2,425,618.00	5.68
原材料	辅料（颗）	662.58	2,980,472.00	2.22
原材料	晶圆（片）	4,791.88	3,297.00	14,534.06
房租		402.63	1	-

由此可见，2017年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价主要原因是：原材料晶圆以整片销售，销售单价较高，此外房租转租收入的销售数量按照1计量。

（三）报告期内前五大客户销售情况

报告期内，公司的主要客户是富昌电子、海力士、海太半导体、金士顿、淇诺科技、三星电子、中电器材（按照客户名称的首字母拼音排序）等。报告期各期公司向前五名客户销售的情况如下：

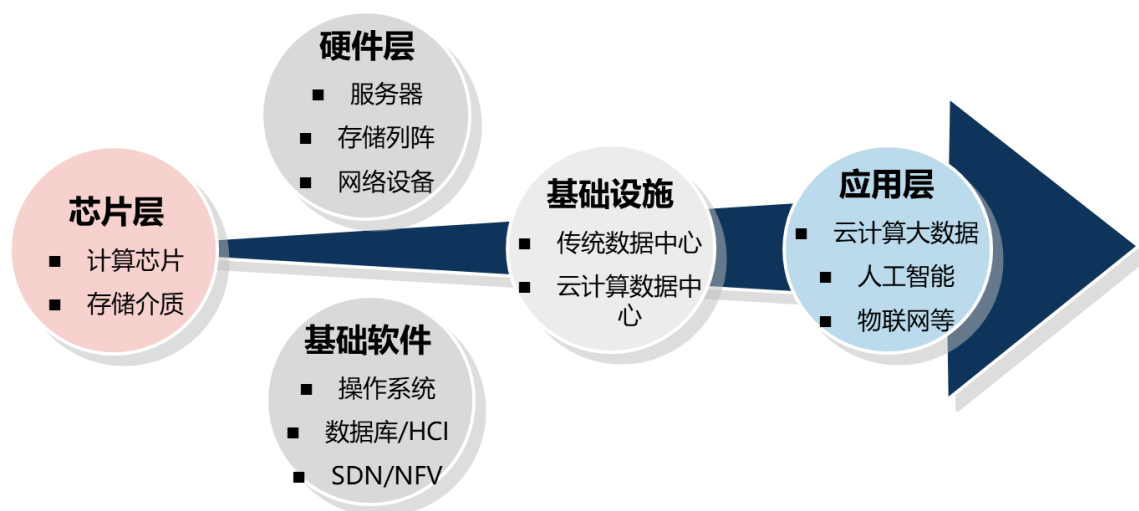
年份	序号	客户名称	营业收入（万元）	占比
2018年	1	客户A	47,335.46	26.93%
	2	客户B	44,462.00	25.30%
	3	客户C	36,518.00	20.78%
	4	客户D	15,882.96	9.04%
	5	客户E	14,150.43	8.05%
	合计			158,348.84
2017年	1	客户A	29,245.46	23.82%
	2	客户C	27,733.52	22.59%
	3	客户B	21,680.19	17.66%
	4	成都澜至	16,024.01	13.05%
	5	客户D	8,062.88	6.57%
	合计			102,746.06
2016年	1	客户A	23,456.88	27.76%
	2	客户B	13,645.89	16.15%
	3	淇诺科技	9,837.03	11.64%
	4	客户C	7,576.79	8.97%
	5	中电器材	4,780.45	5.66%
	合计			59,297.04

公司的客户集中符合行业特性，公司与前述客户的合作关系具有历史基础，保持了长期合作关系，公司系采用公开、公平的方式独立获取业务，相关的业务具有稳定性及

可持续性。2017年，公司转让消费电子芯片业务相关资产，导致关联方成都澜至销售金额较大，相关产品最终通过成都澜至销售给淇诺科技等消费电子芯片经销商。报告期内，公司对单一客户不存在重大依赖。

（四）公司下游产业链情况

公司所处的产业链架构如下图所示：



服务器是云计算和人工智能行业的基础设施，而 CPU 和 DRAM 内存是服务器的两大核心部件。公司目前的主营产品均属于产业链的芯片层环节，其中内存接口芯片直接面向 DRAM 存储器市场，津逮[®]服务器平台直接面对服务器市场，而公司的终端客户则覆盖云计算和人工智能行业，因此公司为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，下游主要客户也属于云计算和人工智能行业的重要参与者。

四、公司采购情况

（一）采购产品、原材料、能源或接受服务的情况

公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。其中硅片晶圆的生产由晶圆代工厂完成，而芯片的封装测试由封测厂完成。由于公司不直接从事生产活动，不采购生产所需的能源。

报告期内，晶圆、封装测试等分别提供采购数量、平均单价、采购金额变动情况如下：

分类	2018年度	2017年度	2016年度
----	--------	--------	--------

分类		2018年度	2017年度	2016年度
晶圆	采购金额（万元）	19,445.85	23,610.77	26,590.55
	采购数量指数	67.32	86.13	100.00
	平均单价指数	108.64	103.09	100.00
封装测试	采购金额（万元）	29,709.44	24,047.95	18,628.81
	采购数量指数	131.07	118.66	100.00
	平均单价指数	121.68	108.79	100.00

注：晶圆、封装测试的采购数量和平均单价以 2016 年为基数，基准指数为 100，报告期内晶圆和封装测试采购数量指数和平均单价指数体现为对应 2016 年基数的增长或下降情况

由于技术架构及工艺不同，公司的内存接口芯片成本构成中封装测试占比较大，消费电子芯片成本构成中晶圆占比较大。2017 年 7 月公司将消费电子芯片业务资产进行了转让，此后不再从事消费电子芯片相关业务。因此，报告期内公司晶圆采购数量及金额均呈下降趋势。随着内存接口芯片销售量不断提升，封装测试的采购数量及金额均呈上升趋势。

由于内存接口芯片的工艺要求比消费电子芯片高，其晶圆和封装测试的单位成本比消费电子芯片高，随着报告期内公司内存接口芯片销售占比不断上升，所以晶圆和封装测试的采购单价呈逐年上升趋势。

2018 年晶圆等材料采购成本较 2017 年大幅下降的原因，主要是 2017 年数据中包含 2017 年 1-7 月消费电子芯片的晶圆等材料采购金额 9,691.85 万元。

报告期内采购量与产品销售、库存的匹配关系如下表：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
采购金额	59,066.94	59,090.96	49,535.97
产品销售成本	51,773.40	57,095.23	41,230.91
期末库存	20,143.71	21,762.42	34,131.88
采购金额/产品销售成本	1.14	1.03	1.20
期末库存/采购金额	0.34	0.37	0.69

2016 年至 2018 年采购金额与产品销售成本的比率分别为 1.20、1.03 和 1.14，基本保持稳定。2017 年发行人转让了消费电子芯片相关资产（包括对应存货），存货余额大幅下降。2017 年和 2018 年期末库存与采购金额的比率分别为 0.37 和 0.34，基本保持稳定。综上所述，发行人的采购量与产品销售、库存余额具有较好的匹配性。

（二）报告期内前五大供应商采购情况

报告期内，公司的主要供应商包括富士通电子、Intel 公司、联华电子、台积电、星科金朋、矽品科技（以上按拼音首字母排序）等，公司各期向前五名供应商采购的情况如下：

年份	序号	供应商名称	不含税金额 (万元)	占比
2018 年	1	供应商 L	28,358.35	48.01%
	2	供应商 H	17,538.09	29.69%
	3	供应商 I	4,315.76	7.31%
	4	供应商 G	2,708.58	4.59%
	5	供应商 K	1,343.95	2.28%
	合计			54,264.73
2017 年	1	供应商 L	20,376.03	34.48%
	2	供应商 H	15,252.71	25.81%
	3	供应商 Q	5,982.86	10.12%
	4	供应商 K	3,612.85	6.11%
	5	供应商 R	2,670.56	4.52%
	合计			47,895.02
2016 年	1	供应商 Q	15,987.63	32.27%
	2	供应商 L	12,127.82	24.48%
	3	供应商 H	10,241.10	20.67%
	4	供应商 K	6,501.00	13.12%
	5	供应商 R	1,330.58	2.69%
	合计			46,188.12

报告期内，公司与各大晶圆制造厂和封装测试厂合作情况良好。由于晶圆制造厂和封装测试厂属于资本和技术密集型产业，符合供应商条件的厂商较为有限，因此公司向前五名供应商采购金额较大且集中度较高，符合行业特性。公司对单一供应商不存在重大依赖。公司供应商主要为行业内知名企业，采购价格符合市场标准。公司供应商均不存在不具备生产资质与公司进行交易的情形。

报告期内，发行人晶圆和封装测试供应商情况如下：

1、报告期内晶圆采购前五名供应商情况

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占晶圆采购总额比例
2018 年度	供应商 H	17,532.17	29.68%	90.16%
	供应商 I	1,868.21	3.16%	9.61%
	供应商 R	45.46	0.08%	0.23%
	小计	19,445.85	32.92%	100.00%
2017 年度	供应商 H	14,944.85	25.29%	63.30%
	供应商 Q	5,713.91	9.67%	24.20%
	供应商 R	2,668.49	4.52%	11.30%
	供应商 I	283.51	0.48%	1.20%
	小计	23,610.77	39.96%	100.00%
2016 年度	供应商 Q	15,938.22	32.18%	59.94%
	供应商 H	10,143.39	20.48%	38.15%
	供应商 R	316.03	0.64%	1.19%
	供应商 I	192.91	0.39%	0.73%
	小计	26,590.55	53.68%	100.00%

注：上述晶圆采购金额不包括流片费用，报告期内公司合作的晶圆厂仅有富士通电子、联华电子、台积电、中芯国际（以上按拼音首字母排序）四家

2、报告期内封装测试采购前五名供应商情况

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占封装测试采购总额比例
2018 年度	供应商 L	28,358.35	48.01%	95.46%
	供应商 K	1,343.95	2.28%	4.52%
	供应商 S	7.14	0.01%	0.02%
	小计	29,709.44	50.30%	100.00%
2017 年度	供应商 L	20,376.03	34.48%	84.74%
	供应商 K	3,612.85	6.11%	15.02%
	供应商 T	53.89	0.09%	0.22%
	供应商 U	4.27	0.01%	0.02%
	供应商 V	0.90	0.00%	0.00%
	小计	24,047.95	40.70%	100.00%
2016 年度	供应商 L	12,127.82	24.48%	65.10%
	供应商 K	6,501.00	13.12%	34.90%

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占封装测试采购总额比例
	小计	18,628.81	37.61%	100.00%

注：报告期内公司合作的封测厂包括 Raytek Semiconductor, Inc、深圳市小瑞科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、星科金朋、矽品科技、中芯长电半导体（江阴）有限公司

2018 年向供应商 H 集中采购晶圆主要由于：（1）由于公司转让了消费电子芯片业务相关资产，晶圆采购总额减少，同时 2018 年公司与原先仅为消费电子芯片提供晶圆代工的供应商不再进行交易，因此集中度有所上升；（2）晶圆制造企业投入巨大，除了 IDM 企业能够自建晶圆生产线自用之外，全球仅有少数企业具备实力建设用于代工的晶圆生产线，因此晶圆采购集中具有行业普遍性和商业合理性；（3）供应商 H 的晶圆加工在全球居于领先地位，拥有先进的晶圆生产线，制造工艺满足公司对晶圆代工的要求；（4）公司与供应商 H 自 2006 年开始合作，已经建立深厚的合作关系；（5）为实现规模经济效益，公司向供应商 H 进行集中采购。

2018 年向供应商 L 集中采购封装测试的原因：（1）由于公司转让了消费电子芯片业务相关资产，2018 年公司与原先仅为消费电子芯片提供封装测试的供应商不再进行交易，因此集中度有所上升；（2）封装测试同晶圆制造一样均为资本与技术密集型产业，需要投入大量资源建设，因此封装测试采购集中具有行业普遍性和商业合理性；（3）公司对封装要求较高，供应商 L 为国际领先的封测供应商，封测工艺满足公司需求；（4）公司与供应商 L 自 2006 年开始合作，建立了良好的合作关系；（5）为实现规模经济效益，公司向供应商 L 进行集中采购。

在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。为实现规模经济效益，公司会向部分供应商进行集中采购，上述供应商的采购占比分布符合行业规律。报告期内发行人第一大供应商占公司采购总额的比重始终未超过 50%，不存在对单一供应商重大依赖的情形。

报告期内，发行人前五名供应商变动较小，其中主要封装测试厂商均为星科金朋和矽品科技。晶圆采购前五名供应商主要变化为中芯国际自 2017 年 8 月起不再是发行人的晶圆供应商，因中芯国际是发行人消费电子芯片的主要晶圆供应商，发行人于 2017 年 7 月转让消费电子芯片业务相关资产后不再向其采购晶圆。

公司的主要均为国际领先的晶圆代工及封测供应商，与发行人保持了良好的合作关系，具备稳定性及可持续性，能够保障公司的生产需求。同时，发行人也在不断认证新的合格供应商，降低供应商集中度较高的潜在风险。

（三）存货管理、盘点的内部控制制度及执行情况

发行人为规范存货的管理，保障资产的安全和运营的效率，发行人制定了《存货管理制度》与《存货盘点管理制度》，按照存货管理制度的要求进行管理，定期进行存货盘点，相关的内控制度及执行情况如下：

1、存货管理包括原材料、委托加工物资及产成品的管理。根据《存货管理制度》相关规定，委外供应商仓库按照制订的要求对各种存货的存储和管理要求进行妥善保管；

2、明确与委外供应商的权利义务关系。发行人通过合同、订单、工单的形式委托委外供应商进行制作和加工产品，委外供应商则有按照约定保证产品的数量、质量并按时交货，如存货放置在委外供应商的仓库则其有妥善保管的义务。发行人运营部门人员保持与委外供应商的联系，并定期现场走访委外供应商，监督其义务的履行情况。

3、产成品不合格品由委外供应商根据《存货管理制度》中相关规定做识别隔离存放，经发行人运营部门内部审批确认后做定期报废。委外厂商的正常加工损耗报废在系统作业时已自动处理，无须另行申请报废。委外加工良率若低于约定良率时，发行人运营部协委外供应商共同查明原因并给出解决方案。

4、存货的出货作业由运营部下达指令到委外供应商，委外供应商仓库依照出货要求，安排相应存货出货至指定地点并提供相应装箱单，供收货方核查确认；

5、运营部门要求委外供应商每日传输出入库明细数据及库存数据，出入库明细数据经运营部门人员确认后，更新至发行人 ERP 系统。运营部门人员每周对异常数据进行处理，确保批量数据传输的完整性与准确性。发行人财务部每月底针对发行人 ERP 系统库存与委外供应商系统库存进行核查是否相符，若不符合时及时向相关部门提出，并追查原因。

6、发行人组织人员定期对存货进行盘点。与委外供应商及客户沟通后编制存货盘点计划并通知相关人员，盘点人员需包括运营部门、财务部门及委外存库的管理人员；按照委外仓库提供的《存货盘点明细表》进行盘点，运营部门、财务部门及委外存库的人员共同参与盘点，盘点表需参与盘点人员全部签字；如委外仓库存在盘盈亏则在委外

供应商系统调整《存货明细表》。然后按盘点后的《存货盘点明细表》与发行人财务系统中的《存货明细表》进行核对，如存在盘盈盘亏的情形，财务部门编写《盘点盈亏报告表》，并填写数额差异原因的说明及对策后，呈报财务部负责人、运营部负责人及总经理审批；对于盘盈盘亏或毁损的存货应分清责任，及时向公司管理层做出书面请示，批复后按规定进行账务处理。

五、主要固定资产及无形资产

报告期内，公司主要固定资产包括电子设备和办公设备，无形资产包括软件、IP授权和离岸业务执照，上述资产均为公司研发与日常经营所必须的资源要素，不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，对公司持续经营不存在重大不利影响。

（一）固定资产

1、固定资产概况

截至2018年12月31日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限（年）	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
电子设备	3-5	3,920.67	1,759.84	-	2,160.83	55.11%
办公设备	3-5	467.03	312.83	-	154.19	33.02%
合计		4,387.70	2,072.68	-	2,315.03	52.76%

2、房屋建筑物

截至2019年4月1日，发行人无房屋所有权及土地使用权，发行人租赁房屋的具体情况如下：

	承租方	出租方	租赁期限	房屋坐落	租赁面积
1	澜起科技	上海新兴技术开发区联合发展有限公司	2018.01.01-2020.12.31	上海市宜山路900号1幢A6楼	1,706.19 m ²
2	澜起科技	上海新兴技术开发区联合发展有限公司	2016.11.01-2019.10.31	上海市宜山路900号1幢A7/8楼	3,425.72 m ²
3	澜起澳门	MG Overseas Limited	2018.04.24-2021.04.23	澳门亚美打利庇庐大马路22至44号，南湾大马路559至569号，十三	146.26 m ²

	承租方	出租方	租赁期限	房屋坐落	租赁面积
				楼 C13 及 D13	
4	澜起美国	HUDSON METRO PLAZA,LLC	2013.07.23-2024.04.30	Suite 500, 101 Metro Drive, San Jose, California	4,654（平方英尺）
5	澜起电子上海	上海嘉定新城科创发展有限公司	2018.04.13-2020.04.12	上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 602 室 J01	5 m ²
6	澜起半导体	昆山世远物流有限公司	2018.02.01-2038.01.31	昆山开发区综合保税区新巷路 116 号 3 号房	200 m ²
7	澜起电子昆山	昆山金融产业园投资开发有限公司	2019.02.01-2024.01.31	昆山市开发区夏东街 628 号 1 层展厅、7 层、11 层、12 层	5,439.39 m ²
8	澜起澳门之韩国分支机构	明日系统（韩文名：명일시스템즈）	2018.09.01-2020.08.31	京畿道城南市盆唐区 Banga-ro 21, 2 楼	201.3 m ²

（二）无形资产

1、主要无形资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无形资产账面金额如下：

单位：万元

项目	取得方式	摊销年限	账面原值	累计摊销	账面价值
软件	外购	3 年	311.22	296.18	15.04
IP 授权	外购	3 年	4,309.23	1,763.13	2,546.10
离岸业务执照	外购	5 年	84.98	49.05	35.93
合计			4,705.43	2,108.36	2,597.07

（1）注册商标

截至 2019 年 4 月 1 日，公司拥有 22 项中国境内注册商标，具体如下：

序号	注册号/申请号	注册人	类别	有效期限
1	4440528	澜起科技	42	2028-10-27

序号	注册号/申请号	注册人	类别	有效期限
2	4451771	澜起科技	9	2028-10-06
3	4451770	澜起科技	42	2028-11-06
4	11129003	澜起科技	9	2023-11-13
5	11129061	澜起科技	42	2023-11-13
6	12590573	澜起科技	9	2024-10-13
7	12590691	澜起科技	42	2024-12-06
8	12590599	澜起科技	35	2024-12-06
9	12590549	澜起科技	9	2024-10-13
10	12590668	澜起科技	42	2025-08-13
11	12590627	澜起科技	35	2024-12-06
12	7636568	澜起科技	9	2021-03-06
13	7636567	澜起科技	42	2021-09-06
14	4451772	澜起科技	42	2028-08-20
15	19514309	澜起科技	9	2027-05-13
16	19514517	澜起科技	42	2027-05-13
17	19515624	澜起科技	9	2027-05-13
18	19515394	澜起科技	42	2027-05-13
19	20213070	澜起科技	9	2027-07-27
20	20213461	澜起科技	42	2027-07-27
21	20213228	澜起科技	9	2027-07-27
22	20213367	澜起科技	42	2028-02-27

截至 2019 年 4 月 1 日，公司拥有 16 项中国境外注册商标，具体如下：

序号	注册号/申请号	注册人	类别	有效期限	国家或地区
1	3568903	澜起美国	9,42	2029-02-03	美国
2	4672486	澜起美国	9,42	2025-01-13	美国
3	5387538	澜起科技	9,42	2028-01-23	美国
4	5387539	澜起科技	9,42	2028-01-23	美国
5	302610468	澜起美国	9,35,42	2023-05-15	香港特别行政区
6	302610459	澜起美国	9,35,42	2023-05-15	香港特别行政区
7	45-0055778	澜起美国	9,35,42	2025-04-23	韩国
8	5709328	澜起美国	9,35,42	2024-10-10	日本
9	N/78154	澜起澳门	9	2021-02-28	澳门特别行政区

序号	注册号/申请号	注册人	类别	有效期限	国家或地区
10	N/78155	澜起澳门	35	2021-02-28	澳门特别行政区
11	N/78156	澜起澳门	42	2021-02-28	澳门特别行政区
12	N/78157	澜起澳门	9	2021-02-28	澳门特别行政区
13	N/78158	澜起澳门	35	2021-02-28	澳门特别行政区
14	N/78159	澜起澳门	42	2021-02-28	澳门特别行政区
15	01633609	澜起澳门	9,35,42	2024-03-15	台湾地区
16	01633610	澜起澳门	9,35,42	2024-03-15	台湾地区

(2) 专利

截至 2019 年 4 月 1 日，公司在中国大陆已获授权的专利共 44 项，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日
1	澜起科技	测量及补偿接收机参数的方法及装置	发明	ZL200910055538.1	2009-07-29	2013-08-14
2	澜起科技	产生读使能信号的方法以及采用该方法的存储系统	发明	ZL200910054716.9	2009-07-13	2013-08-21
3	澜起科技	信号处理方法及接收机	发明	ZL200910195503.8	2009-09-11	2013-08-21
4	澜起科技	存储器模组及存储器模组内的数据交换方法	发明	ZL200910200826.1	2009-12-25	2013-05-08
5	澜起科技	数据率转换装置及方法	发明	ZL201010004098.X	2010-01-18	2014-02-12
6	澜起科技	Σ - Δ 模数转换器	发明	ZL201410155996.3	2014-04-17	2018-03-27
7	澜起科技	写入电路、读取电路、内存缓冲器及内存条	发明	ZL201110193167.0	2011-07-11	2015-07-08
8	澜起科技	数据读写系统	发明	ZL201110193328.6	2011-07-11	2016-02-10
9	澜起科技	分布式缓存芯片组中的数据缓存器的地址分配方法	发明	ZL201110221491.9	2011-08-03	2015-05-13
10	澜起科技	需要分配地址的器件、器件系统及地址分配方法	发明	ZL201110353925.0	2011-11-10	2016-06-29
11	澜起科技	用于内存系统的电压与时序校准方法	发明	ZL201110443575.7	2011-12-27	2016-01-13
12	澜起科技	高速广播信道的校准方法	发明	ZL201110383787.0	2011-11-28	2015-06-10

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日
13	澜起科技	端接器件系统	发明	ZL201110310543.X	2011-10-13	2016-03-02
14	澜起科技	参数动态校准电路及能动态校准参数的器件	发明	ZL201110422264.2	2011-12-15	2015-09-02
15	澜起科技	一种信号延迟控制电路	发明	ZL201110349001.3	2011-11-08	2015-03-04
16	澜起科技	主从式超前负载补偿稳压装置	发明	ZL201110449754.1	2011-12-28	2014-09-24
17	澜起科技	过流保护电路	实用新型	ZL201220251647.8	2012-05-31	2013-01-02
18	澜起科技	具有单端转差分能力和滤波作用的宽带低噪声放大器	发明	ZL201210337302.9	2012-09-12	2016-05-11
19	澜起科技	自适应谐波抑制接收装置及方法	发明	ZL201310321111.8	2013-07-26	2017-08-25
20	澜起科技	一种老化测试装置	实用新型	ZL201420872896.8	2014-12-29	2015-05-13
21	澜起科技	接地针、插接板及老化测试装置	实用新型	ZL201620680723.5	2016-06-30	2017-04-12
22	澜起科技	低功耗的高速收发器	发明	ZL200610066292.4	2006-03-31	2012-05-09
23	澜起科技	具有多个信号路径的CMOS集成的超外差电视接收器	发明	ZL200610065683.4	2006-03-23	2009-03-11
24	澜起科技	用于DC偏移消除环路的集成DSP及方法	发明	ZL200610066644.6	2006-04-17	2011-07-27
25	澜起科技	正交振幅调制(QAM)接收器的盲均衡器	发明	ZL200610076306.0	2006-04-18	2011-08-24
26	澜起科技	桥接存储总线的存储接口	发明	ZL200610098537.1	2006-07-04	2012-11-14
27	澜起科技	对频谱反转的数据辅助检测	发明	ZL200710187158.4	2007-11-21	2013-04-10
28	澜起科技	片上端接电路	发明	ZL200710302225.2	2007-12-20	2012-05-09
29	澜起科技	低密度奇偶校验(LDPC)解码器	发明	ZL200910005371.8	2009-02-20	2014-02-26
30	澜起科技	帧体模式信息和系统信息的检测	发明	ZL200810007400.X	2008-03-18	2012-05-02
31	澜起科技	已注册DIMM存储器系统	发明	ZL200910161562.3	2009-08-04	2014-10-29

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日
32	澜起科技	信号发生器、电子系统以及产生信号的方法	发明	ZL201310724584.2	2013-12-24	2018-05-04
33	澜起科技	一种稳压器及稳压的方法	发明	ZL201410041038.3	2014-01-27	2017-10-13
34	澜起科技	接收机电路以及用于控制接收机电路增益的方法	发明	ZL201510021413.2	2015-01-15	2018-11-13
35	澜起科技	干扰处理方法和装置	发明	ZL201510586354.3	2015-09-15	2018-10-23
36	澜起科技	线圈及制备应用于电感元件的线圈的方法	发明	ZL201310460042.9	2013-09-29	2018-12-28
37	澜起科技	缓冲存储器及用于控制内部存储器数据访问的装置和方法	发明	ZL201510035868.X	2015-01-23	2018-10-19
38	澜起科技	噪声功率估计器,接收机及噪声功率估计的方法	发明	ZL201510924645.9	2015-12-11	2019-02-01
39	澜起电子 昆山	时钟和数据恢复	发明	ZL200610127032.3	2006-09-21	2010-08-11
40	澜起电子 昆山	芯片上电源调节器	发明	ZL200610104100.4	2006-08-01	2011-01-05
41	澜起电子 昆山	用于时钟信号的分布的系统	发明	ZL200710079621.3	2007-02-28	2011-06-01
42	澜起电子 昆山	桥接存储器总线的存储器接口	发明	ZL200610145117.4	2006-11-13	2010-08-11
43	澜起电子 昆山	一种到达接口总线的集成电路及其构成的存储器	发明	ZL200710123316.X	2007-06-20	2012-01-11
44	澜起电子 昆山	寄存器读取机构	发明	ZL200710112430.2	2007-06-21	2011-11-09

截至 2019 年 4 月 1 日,公司在境外已获授权的专利共 46 项,具体如下:

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
1	澜起科技	Method and Apparatus for Measuring and Correcting Receiver Parameters	发明	US8340167B2	2009-08-20	2012-12-25	美国
2	澜起科技	Method for Generating Read Enable Signal and Memory System using the Method	发明	US7983100B2	2009-08-20	2011-07-19	美国

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
3	澜起科技	Method and Apparatus for Processing Signal	发明	US8103236B2	2010-01-04	2012-01-24	美国
4	澜起科技	Memory Module and Method for Exchanging Data in Memory Module	发明	US9361250B2	2010-10-13	2016-06-07	美国
5	澜起科技	Data Rate Conversion Device and Method	发明	US8554817B2	2010-03-19	2013-10-08	美国
6	澜起科技	Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter	发明	US9219495B2	2015-03-17	2015-12-22	美国
7	澜起科技	Receiver Circuit and Gain Controlling Method thereof	发明	US9425759B2	2015-05-07	2016-08-23	美国
8	澜起科技	BUFFER DEVICE, METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING ACCESS TO INTERNAL MEMORY	发明	US9836415B2	2015-06-02	2017-12-05	美国
9	澜起科技	SIGNAL MIXING METHOD AND MIXER	发明	US9705711B2	2016-04-29	2017-07-11	美国
10	澜起科技	APPARATUS FOR MONITORING DATA ACCESS TO INTERNAL MEMORY DEVICE AND INTERNAL MEMORY DEVICE	发明	US9934165B2	2015-12-28	2018-04-03	美国
11	澜起科技	INTERFERENCE PROCESSING METHOD AND APPARATUS	发明	US9838052B2	2016-06-30	2017-12-05	美国
12	澜起科技	ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY DEVICE AND METHOD FOR VERIFYING DATA FOR SUCH MEMORY DEVICE	发明	US9740561B2	2016-02-03	2017-08-22	美国
13	澜起科技	Write Circuit, Read Circuit, Memory Buffer and Memory module	发明	US8843801B2	2012-08-15	2014-09-23	美国
14	澜起科技	Data Read/Write System	发明	US9026726B2	2013-01-30	2015-05-05	美国
15	澜起科技	Method for Allocating Addresses to Data Buffers in Distributed Buffer Chipset	发明	US9201817B2	2012-05-29	2015-12-01	美国

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
16	澜起科技	Device Requiring Address Allocation, Device System And Address Allocation Method	发明	US9003154B2	2012-08-15	2015-04-07	美国
17	澜起科技	Voltage and Timing Calibration Method Used in Memory System	发明	US9104533B2	2012-12-14	2015-08-11	美国
18	澜起科技	Wideband Active Balun LNA Topology with Narrow-Band Filtering and Noise Cancelling	发明	US9054648B1	2013-12-10	2015-06-09	美国
19	澜起科技	Adaptive Harmonic Rejection Receiving Device and Method	发明	US9203452B2	2013-12-17	2015-12-01	美国
20	澜起科技	Winding and Method for Preparing a Winding Applied to an Inductive Device	发明	US9240272B2	2013-10-30	2016-01-19	美国
21	澜起科技	DIGITAL DELAY-LOCKED LOOP AND LOCKING METHOD THEREOF	发明	US9614534B1	2016-05-23	2017-04-04	美国
22	澜起科技	SIGNAL GENERATOR, ELECTRONIC SYSTEM COMPRISING THE SIGNAL GENERATOR AND METHOD OF GENERATING SIGNALS	发明	US9240879B2	2014-01-13	2016-01-19	美国
23	澜起科技	Voltage Regulator and Method of Regulating Voltage	发明	US9240758B2	2014-03-01	2016-01-19	美国
24	澜起科技	DEVICE AND METHOD FOR CLOCK SIGNAL LOSS DETECTION	发明	US9231576B1	2014-07-22	2016-01-05	美国
25	澜起科技	NOISE POWER ESTIMATOR, RECEIVER AND METHOD FOR NOISE POWER ESTIMATION	发明	US9794008B2	2015-12-22	2017-10-17	美国
26	澜起科技	Branching memory-bus module with multiple downlink ports to standard fully-buffered memory modules	发明	US7389381B1	2006-04-05	2008-06-17	美国

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
27	澜起科技	Branching fully-buffered memory-module with two downlink and one uplink ports	发明	US7477526B1	2005-12-29	2009-01-13	美国
28	澜起科技	Branching memory-bus module with multiple downlink ports to standard fully-buffered memory modules	发明	US7904655B2	2008-05-05	2011-03-08	美国
29	澜起科技	Signal transmitting circuit	发明	US10033429B2	2017-06-29	2018-07-24	美国
30	澜起科技	CIRCUIT AND METHOD FOR REDUCING MISMATCH FOR COMBINED CLOCK SIGNAL	发明	US10164622B2	2016-07-25	2018-12-25	美国
31	澜起科技	SDIO 設備及其應用之電子裝置和資料傳輸方法	发明	I602063	2015-04-14	2017-10-11	台湾地区
32	澜起开曼	High Speed Transceiver with Low Power Consumption	发明	US7368950B2	2005-11-16	2008-05-06	美国
33	澜起开曼	Integrated DSP for a DC Offset Cancellation Loop	发明	US7864088B2	2006-01-27	2011-01-04	美国
34	澜起开曼	Clock and Data Recovery	发明	US7672417B2	2006-08-31	2010-03-02	美国
35	澜起开曼	On-chip Supply Regulators	发明	US7366926B2	2006-06-13	2008-04-29	美国
36	澜起开曼	Hybrid Modulus Blind Equalization for Quadrature Amplitude Modulation QAM Receivers.	发明	US7599449B2	2006-04-10	2009-10-06	美国
37	澜起开曼	Systems and methods for the distribution of differential clock signals to a plurality of low impedance receivers	发明	US7558980B2	2007-01-04	2009-07-07	美国
38	澜起开曼	Memory Interface to Bridge Memory Buses.	发明	US7558124B2	2006-03-28	2009-07-07	美国
39	澜起开曼	Memory Interface to Bridge Memory Buses	发明	US7577039B2	2006-08-10	2009-08-18	美国
40	澜起开曼	Dynamic Burn-in Systems and Apparatuses	发明	US7915902B2	2006-10-18	2011-03-29	美国

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
41	澜起开曼	Calibration of Read/Write Memory Access via Advanced Memory Buffer	发明	US7865660B2	2007-04-16	2011-01-04	美国
42	澜起开曼	Register Read Mechanism	发明	US7774661B2	2007-04-16	2010-08-10	美国
43	澜起开曼	Data Aided Detection of Spectrum Inversion	发明	US8306156B2	2007-10-17	2012-11-06	美国
44	澜起开曼	On-die Termination Circuit	发明	US7764082B2	2007-11-20	2010-07-27	美国
45	澜起开曼	Low Density Parity Check (LDPC) Decoder	发明	US8201049B2	2008-02-23	2012-06-12	美国
46	澜起开曼	Registered DIMM Memory System	发明	US8654556B2	2008-08-04	2014-02-18	美国

（3）集成电路布图设计

截至 2019 年 4 月 1 日，公司共拥有 39 项集成电路布图设计证书，具体情况如下：

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
1	M88RS2000E	BS.09500385.1	2009-07-14	2008-09-08	2009-09-01	澜起科技	消费电子芯片
2	M88TS2022	BS.09500542.0	2009-10-09	2009-09-03	2009-11-17	澜起科技	消费电子芯片
3	M88CS2200	BS.09500543.9	2009-10-09	2009-09-14	2009-11-17	澜起科技	消费电子芯片
4	M88MB6000	BS.10500704.8	2010-10-19	2010-02-08	2010-12-07	澜起科技	内存接口芯片
5	M88SSTE32882H	BS.10500705.6	2010-10-19	2010-07-26	2010-12-07	澜起科技	内存接口芯片
6	M88TT2800	BS.10500706.4	2010-10-19	2010-06-18	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片
7	M88DS3102	BS.10500707.2	2010-10-19	2010-08-26	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片
8	M88CS2200B	BS.10500708.0	2010-10-19	2010-09-06	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片
9	M88TC2800	BS.11500147.6	2011-03-24	2010-11-24	2011-04-20	澜起科技	消费电子芯片
10	M88DD3000 (M88DD3001, M88DD3100)	BS.11500148.4	2011-03-24	2010-09-17	2011-04-20	澜起科技	消费电子芯片
11	M88TS2022C	BS.11500955.8	2011-10-10	2011-05-04	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
12	M88DS3102D	BS.11500956.6	2011-10-10	2011-05-23	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片
13	M88CS2200B2	BS.11500957.4	2011-10-10	2011-07-05	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片
14	M88VS3001	BS.12501356.6	2012-10-09	2012-07-20	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
15	M88TC3000	BS.12501354.X	2012-10-09	2012-07-10	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
16	M88RM3000	BS.12501355.8	2012-10-09	2012-04-30	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
17	M88MB6000B	BS.11500383.5	2011-06-02	2011-03-22	2011-08-22	澜起科技	内存接口芯片
18	M88MB6000C	BS.12500210.6	2012-02-22	2011-10-12	2012-03-06	澜起科技	内存接口芯片
19	M88MCB-LP01	BS.12500900.3	2012-07-16	2012-03-27	2012-09-05	澜起科技	内存接口芯片
20	M88MB6000D1	BS.12501357.4	2012-10-09	2012-08-06	2012-11-21	澜起科技	内存接口芯片
21	M88VS3001B	BS.13500607.4	2013-06-04	2013-05-16	2013-08-08	澜起科技	消费电子芯片
22	M88DDR4DB01	BS.13501090.X	2013-08-21	2013-04-03	2013-10-15	澜起科技	内存接口芯片
23	M88SSTE32882H6	BS.145500144	2014-03-03	2012-03-25	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片
24	M88DDR4RCD01B	BS.145001253	2014-03-03	2013-10-25	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片
25	M88DDR4DB01A	BS.14500127X	2014-03-03	2014-01-13	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片
26	M88DDR4RCD01C	BS.145501272	2014-06-10	2014-05-26	2014-07-02	澜起科技	内存接口芯片
27	M88DDR4DB01B	BS.145501264	2014-06-10	2014-01-13	2014-07-02	澜起科技	内存接口芯片
28	M88DDR4RCD02	BS.155505033	2015-05-20	2015-01-20	2015-06-12	澜起科技	内存接口芯片
29	M88DDR4DB02	BS.15550908X	2015-11-19	2015-08-04	2015-12-16	澜起科技	内存接口芯片
30	M88DR4RCD02+	BS.16551571.6	2016-08-28	2016-03-31	2016-09-21	澜起科技	内存接口芯片

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
31	M88DR4DB02P	BS.16551823.5	2016-11-03	2016-06-30	2016-11-21	澜起科技	内存接口芯片
32	M88MB6000DS	BS.175521549	2017-01-10	2014-05-12	2017-01-26	澜起科技	内存接口芯片
33	M88RCD4XS2P	BS 17553473X	2017-10-17	2016-09-30	2017-12-05	澜起科技	津逮 [®] 服务器平台
34	M88RCD4HS2P	BS 175534705	2017-10-17	2016-12-22	2017-12-04	澜起科技	津逮 [®] 服务器平台
35	M88DB4HS2P	BS 175534691	2017-10-17	2017-01-06	2017-12-04	澜起科技	津逮 [®] 服务器平台
36	M88RCD4XS2P-B1	BS.185561403	2018-08-19	2018-04-17	2018-09-28	澜起科技	津逮 [®] 服务器平台
37	M88DR4DB02P-A4	BS.18556139X	2018-08-19	2018-03-20	2018-09-28	澜起科技	内存接口芯片
38	M88DR4RCD02P	BS. 185569684	2018-11-07	2017-04-19	2018-12-04	澜起科技	内存接口芯片
39	M88DDR4RCD01	BS.13501087.X	2013-08-21	2013-04-03	2013-10-15	澜起电子 昆山	内存接口芯片

上述集成电路布图设计的权利人和创作者同为公司，各项集成电路布图设计专有权与发行人产品存在一一对应关系，创作者、权利人不存在发行人以外的法人、自然人。

布图设计专有权的保护期为 10 年。在 2019 年内即将到期的布图设计专有权（登记号：M88RS2000E、M88TS2022、M88CS2200）共有三项，均为消费电子芯片相关产品的布图设计。公司现有的消费电子芯片布图设计均因技术迭代，相关产品已不再销售，且公司已于 2017 年 8 月后不再从事消费电子芯片相关业务，所以此三项布图登记的过期对公司未来的生产经营不会造成任何影响。

公司所从事的集成电路设计行业技术更新较快，某一款产品从设计研发、登记布图设计到量产销售，直至产品生命周期结束通常不超过 10 年。所以，一方面，在新产品研发成功后，积极申请布图设计专有权登记有利于保护公司知识产权；另一方面，一旦相关布图设计专有权保护期到期后，该产品的生命周期基本结束，不会给公司的后续经

营造成实质性影响。对于后续即将到期的集成电路布图设计专有权，公司主要通过不断进行技术创新，推陈出新，积极申请新的布图设计专有权以增强公司技术竞争力。

（4）域名

根据域名证书及相关备案信息，截至 2019 年 4 月 1 日，公司及其子公司持有的域名备案情况如下：

序号	主办单位名称	网站备案/许可证号	网站域名	审核通过日期
1	澜起科技	沪 ICP 备 18002431 号-1	montage-tech.com.cn	2019-3-5
2	澜起科技	沪 ICP 备 18002431 号-1	montage-tech.cn	2019-3-5
3	澜起科技	沪 ICP 备 18002431 号-2	montage-tech.com	2019-3-5
4	澜起电子昆山	苏 ICP 备 19010941 号-1	montage-techks.com.cn	2019-3-14

六、公司的技术与研发情况

（一）公司的核心技术情况

公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

在国家政策的大力支持下，公司历经十余年的专注研发和持续投入，成为全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司的核心技术完全基于自主知识产权，突破了一系列关键技术壁垒。由公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计，创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲控制器芯片的分布结构布局，大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。该技术架构最终被 JEDEC 国际标准采纳，提升了国际话语权，为推动国内集成电路设计产业的进步做出了显著的贡献。

公司提出了一种内存接口校准算法，发明了新型高速、低抖动收发器，解决了多点通讯、突发模式下内存总线的信号完整性问题。在服务器内存最大负载情况下，该技术可支持 DDR4 内存实现最高速率（3200MT/s），达到国际领先水平。

此外，公司还提出一种先进的内存子系统的低功耗设计技术，发明了新型自适应电源管理电路，并采用动态时钟分配等创新技术，显著降低了相关内存接口芯片产品的功耗。

公司已拥有多项专利，截至 2019 年 4 月 1 日，公司已获授权的国内外专利达 90 项，获集成电路布图设计证书 39 项，具体情况参见本节之“五、主要固定资产及无形资产（二）无形资产”相关内容。公司核心技术产品的产业化情况如下：

序号	核心技术产品名称	用途	技术来源	所处阶段
1	DDR2: AMB	为高性能的服务器和 workstation 提供基于 FBDIMM 的内存解决方案	自研	量产
2	DDR3: MB	为市面通用的服务器平台提供高速、高性能、低功耗的内存解决方案，助力云计算产业的快速发展	自研	量产
3	DDR3: RCD			
4	DDR4: RCD	提升云计算服务器及内存子系统所需的性能、系统扩展性和功耗效率	自研	量产
5	DDR4: DB			
6	Gen1.0 津逮®CPU	为云计算服务器提供芯片级的动态安全监控功能	联合研发	量产
7	Gen1.0 混合安全内存模组	为数据中心服务器平台提供可靠的数据安全性，满足不同应用场景下各种级别数据安全的需求	自研	量产

1、内存接口芯片在云计算和人工智能领域发挥的具体作用

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，包含寄存时钟驱动器（RCD）和数据缓冲器（DB），其位于 CPU 到内存模组存储颗粒的命令地址总线通路和数据总线通路上，是内存模组的核心控制芯片。内存接口芯片主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

而服务器是支持云计算和人工智能的重要硬件平台，云计算和人工智能服务厂商均需要采购大量服务器，甚至组建专用数据中心。因此公司的主要产品——内存接口芯片作为服务器中的核心芯片之一，是云计算和人工智能领域重要的电子元器件之一。

公司研发的用于云计算和人工智能领域的内存接口芯片具体作用包括：

（1）通过将数据从 CPU 装载到内存模组上来计算，从而实现减轻 CPU 运算负担，同时在内存端将大量原始数据精炼出有效数据供 CPU 处理。

（2）公司产品加入了矢量运算模块来专门支持人工智能应用里的矩阵运算，达到加速人工智能计算的目的。

2、津逮®服务器平台的具体架构及公司的技术体现

津逮[®]服务器平台具体架构包括如下方面：在硬件层面，包括津逮[®]服务器 CPU、混合安全内存模组；在固件层面，包括专用服务器 BIOS 和可重构处理器固件；在软件层面，用于实现动态安全监控的服务管理软件等。

服务器平台的整体设计由澜起科技负责，其中津逮[®]服务器 CPU 是由澜起科技与清华大学、Intel 联合研发，混合安全内存模组由澜起科技独立研发，可重构处理器固件由澜起科技和清华大学联合研发，专用服务器 BIOS 和用于实现动态安全监控的服务管理软件由清华大学及其他合作伙伴研发并提供。

津逮[®]服务器 CPU 品牌、产权及销售收入均归公司所有，目前在收入层面不存在利益分享机制。目前公司津逮[®]服务器平台仍处于市场推广阶段，尚未大规模销售，预计公司将采取商业上惯用的知识产权授权费方式向清华大学支付技术使用费。截至本招股说明书签署日，具体细节还在协商中，报告期内公司与清华大学未发生利益分享或成本费用的支付。公司同 Intel 之间合作模式系正常的商业采购，除 Intel 因支持公司与下游服务器厂商合作给予公司部分研发补贴外，公司同 Intel 之间不存在相关成本、费用的支付约定，以上合作方式符合正常的商业惯例。

3、津逮[®]CPU 对“先进的异构计算与互联技术”的融合和其他功能的介绍

津逮[®]CPU 和混合安全内存模组构成津逮[®]服务器平台。津逮[®]CPU 除了通用 CPU 的基本功能以外，其可重构计算模块实现了先进的异构计算，高速数据跟踪模块与混合安全内存模组之间实现了互联技术，从而达到了对“先进的异构计算与互联技术”的融合。津逮[®]CPU 除预检测和动态安全监控功能外，还包括支持国密算法的加解密、可信启动等功能。津逮[®]服务器平台是公司的技术，其中融合了合作伙伴的相应功能模块。

4、混合安全内存模组 HSDIMM[®]的定位、用途、拟实现的商业目的

混合安全内存模组采用澜起科技具有自主知识产权的 Mont-ICMT[®]（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可为高端服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，澜起科技推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组（HSDIMM[®]）和精简版混合安全内存模组（HSDIMM[®]-Lite），可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。公司所提供的混合安全内存模组其主要功能是数据保护和动态管控，而客户开发的内存模组是标准化内存产品，两者所对应的是不同的市场需求，不存在直接竞争关系。

（二）研发项目及进展情况

1、研发项目基本情况

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的研发项目分别处于可行性研究和设计优化过程中，具体情况如下：

序号	项目名称	研发目的	所处阶段及进展情况	目前在研项目所对应的研发人员数量
1	Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片	可应用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	34 人
2	Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片	可应用于 DDR5 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	35 人
3	Gen2.0 津逮 [®] 处理器	为服务器平台的核心计算引擎，从而为数据中心市场提供安全可控服务器 CPU 解决方案。	可行性研究	45 人
4	Gen2.0 DDR4 混合安全内存模组及所需的 RCD/DB 芯片	基于澜起 M88HS26SA 架构研发的 128GB 大容量混合安全内存模组。新架构可支持大容量内存颗粒架构。	可行性研究	17 人
5	Gen2.0 DDR4 精简混合安全内存模组及所需的 RCD 芯片	基于澜起 M88SC26HA 的架构，提升内存读写速度及数据实时保护速度达到 DDR4 3200MT/s。	可行性研究	12 人
6	高能效比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	可编程 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。AI 处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。	可行性研究	15 人
7	用于数据中心的 AI 处理器芯片	AI 处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。	可行性研究	30 人

公司主要研发部门包括市场应用技术部、研发部以及运营部，各部门之间相互配合，相互协作。除上述参与具体研发项目的人员外，其他研发技术人员分别从事通用技术平台的研发设计、技术文档的撰写等相关工作。

报告期内，Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片项目和 Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片项目合计投入 0,720.22 万元和 12,828.91 万元。其余项目尚处于可行性研究阶段，报告期内尚未投入项目相应的研发经费。

2、相关研发项目与行业技术水平的比较

（1）内存接口芯片

内存接口芯片技术未来将实现更高的传输速率和支持更大的内存容量。公司将凭借在 DDR4 世代确立的技术领先优势，进一步研发新一代内存接口芯片产品，不断推动

行业技术标准的提升，并形成一定技术壁垒，因此相关研发项目处于行业领先水平。

2016年6月，中国电子学会认定公司“低功耗 DDR 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”。

（2）津逮[®]服务器平台

津逮[®]服务器平台结合了公司的内存监控技术，清华大学的动态安全监控与可重构计算架构，以及 Intel 的 CPU 技术，为数据中心产品市场提供安全、可靠的运算平台，具有独创性。该产品在提供安全性的同时还保障了性能优势，处于行业领先水平。2018年11月，津逮[®]服务器 CPU 及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”。

（3）人工智能芯片

公司将人工智能芯片作为未来业务发展方向，聚焦客户需求，长远布局，对相关技术进行积极的研发储备工作，拟达到的研发目标处于行业领先水平。

3、公司与清华大学、Intel 合作研发的情况

报告期内，公司与清华大学、Intel 合作研发津逮[®]服务器 CPU，其中发行人负责整体模块及部分芯片的设计，清华大学提供可重构计算处理器（RCP）的算法，Intel 提供其通用 CPU 内核芯片，并由公司委托第三方进行芯片制造、封装和测试。

2015年9月，公司与清华大学、Intel 就合作事宜签署谅解备忘录，三方约定，将基于英特尔 x86 架构的可重构计算研究与关于存储缓冲器的研究进行结合，以提供一个整体服务器平台解决方案。备忘录中确定了研发成果归属的基本原则：共同开发的知识产权的所有权，将通过公平且各方同意的机制在三方之间进行分配。各方将继续拥有其原有的知识产权，并且对在合作过程中由其单独开发的任何知识产权享有所有权。2016年1月，发行人与 Intel 就合作细节签署了合作协议，双方就合作的具体事宜如分工、知识产权保护及归属等权利义务进行了约定。

该联合研发项目研发成果为津逮[®]系列服务器 CPU 及其平台，该成果中包含了发行人的核心技术。津逮[®]服务器 CPU 品牌及产品产权归澜起科技所有。

报告期内，津逮[®]服务器 CPU 处于研发阶段，其销售收入占发行人收入比重较低，对报告期内发行人的经营影响较小。但该系列产品将作为发行人未来三年的重点发展方向之一。

4、报告期内与其他单位合作研发的情况

报告期内公司与其他单位合作研发的情况如下：

合作单位名称	合作协议主要内容	权利义务划分约定	保密措施
聚辰半导体股份有限公司（简称“聚辰半导体”）	澜起科技和聚辰半导体合作开发 DDR5 EEPROM 产品	双方各自享有在开发过程中由各自独立开发的技术和知识产权；合作开发费用由双方各承担 50%	合同双方均已在协议中约定了较为详尽的保密条款
Global Mixed-Mode Technology（简称“GMT”）	澜起科技和 GMT 合作开发（1）电源管理芯片（PMIC）；（2）温度传感器（TS）	双方各自享有在开发过程中由各自独立开发的技术和知识产权；合作开发费用由双方各承担 50%	
清华大学与 Intel	三方联合开发津逮 [®] 服务器 CPU 及其平台	公司负责整体模块及部分芯片的设计，清华大学提供可重构计算处理器（RCP）的算法，Intel 提供津逮服务器平台中的 CPU 内核芯片；津逮 [®] 服务器 CPU 品牌及产品产权归澜起科技所有	

5、研发项目对应产品的预计量产时间，产业化后的预计销售情况及市场空间，对发行人及竞争对手产品的替代性

公司研发项目对应产品的具体情况如下：

序号	项目名称	预计量产时间	产品替代性	技术迭代周期与风险
1	Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片	2021-2022	产品虽基于 JEDEC 行业标准，但产品替代须经过 CPU 厂商，DRAM 厂商和 OEM 厂商的认证，将逐步替代 DDR4 世代的芯片。	每一代的产品迭代周期约为 18 个月。公司会在 4800MT/s 的产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品。
2	Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片	2021-2022	产品虽基于 JEDEC 行业标准，但产品替代须经过 CPU 厂商，DRAM 厂商和 OEM 厂商的认证，将逐步替代 DDR4 世代的芯片。	每一代的产品迭代周期约为 18 个月。公司会在 4800MT/s 的产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品。
3	Gen2.0 津逮 [®] 处理器	2021-2022	产品基于公司的内存监控技术，清华大学的动态安全监控与可重构计算架构，以及 Intel 的 CPU 技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在澜起科技，清华大学和 Intel 的技术基础上，继续开发新一代的津逮 [®] 处理器。

4	Gen2.0 DDR4 混合安全内存模组及所需的 RCD/DB 芯片	2021	产品基于公司的内存监控技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。
5	Gen2.0 DDR4 精简混合安全内存模组及所需的 RCD 芯片	2021	产品基于公司的内存监控技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。
6	高能效比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	2021-2022	AI 处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。产品瞄准全新市场。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。
7	用于数据中心的 AI 处理器芯片	2021	AI 处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。产品瞄准全新市场。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。

注：以上预计量产时间为公司根据现有研发进度的合理估计，存在不确定性

产业化后的预计销售情况及市场空间：

（1）内存接口芯片业务：根据公开数据，2016 年以来澜起科技、IDT 和 Rambus 对应的内存接口芯片业务收入均呈现持续增长趋势。新一代内存接口芯片产业化后公司预计销售情况将在现有内存接口芯片业务基础上进一步提升。市场规模也将在全球数据中心和服务器市场的快速发展带动下保持持续增长趋势。

（2）津逮[®]服务器平台：目前第一代津逮[®]服务器平台已具备量产能力，客户包括联想、长城等国内知名企业。公司大力拓展数据中心产品市场，提供更为安全、可靠的运算平台，与行业生态系统内主要企业的需求相契合，因此基于当前的客户拓展情况，该产品的销售有望成为公司的业绩增长点。此外，津逮[®]服务器平台受下游数据中心和服务器市场发展的推动，预计未来市场空间较乐观。

（3）人工智能芯片：国家对人工智能的扶持政策持续加码，人工智能芯片作为人工智能行业发展的基础，具有广阔的市场空间。

公司在研项目中内存接口芯片及津逮[®]服务器平台相关产品，均是根据目前主流行业相关标准研发，在未来 5 年内暂无被其他新技术完全取代的风险；人工智能芯片系瞄准新的市场应用，公司会紧跟行业前沿技术。

6、公司 DDR5 产品的研发情况

针对最新的 DDR5 内存技术，公司正在研发相应的内存接口芯片。如果公司 DDR5 内存接口芯片可以在行业量产前顺利推出，则公司可继续保持在 DDR4 世代所实现的行业领先地位，享受行业成长带来的收入增长机会。如果公司在 DDR5 内存接口芯片的开发上不能保持领先地位，可能对公司的市场竞争力带来不利影响，从而造成公司市场份额的下降。

同时，公司通过诸多举措推动公司在 DDR5 内存接口芯片领域继续保持行业领先地位，具体情况如下：

（1）积极参与行业标准制定

根据目前 JEDEC 组织关于 DDR5 内存接口芯片的初步定义，其基本技术框架是基于 DDR4 世代基础上进行性能升级和技术突破，主要表现为功耗降低的同时提升工作频率和传输速度，基本技术框架未发生重大变化。公司目前正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定，保持公司在 DDR5 内存接口芯片领域的技术领先地位。

（2）推出第一代工程样片

2018 年，公司启动了 DDR5 内存接口芯片的工程版芯片研发，目前已经完成第一代工程版芯片流片及功能验证，各项指标和功能符合预期。未来，澜起科技将根据 JEDEC 组织关于 DDR5 内存接口芯片后续推出的完整规格书优化芯片设计，并有望于 2020 年底前完成第一代 DDR5 内存接口芯片量产版的研发工作。

（3）核心研发人员保持稳定

集成电路行业是“以人为本”的行业，公司内存接口芯片的核心技术均基于自主研发。报告期内，公司研发团队人员结构稳定且不断吸引优秀人才加盟，主要研发部门在核心技术人员的带领下潜心研发，实现了在 DDR4 世代的技术领先。公司建立了科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、职业发展机会、工作环境与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展。

（4）产业链深度合作

公司经过 10 多年的发展积淀和全球化的战略布局，深耕于服务器内存接口芯片市场，与全球主流的 CPU 厂商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商建立了长

期稳定的合作关系。通过与产业链内各主要企业的协同、分工、合作，公司深度理解客户及合作伙伴需求，并在研发过程中积极支持客户及合作伙伴的研发进度，从而建立了良好的客户关系。这有利于公司产品可以快速获得客户和合作伙伴的认可，有利于公司保持市场领先地位。

（三）研发投入情况

公司始终鼓励创新，重视研发工作，其核心技术均系自主研发结果。报告期内，公司研发费用整体保持稳定，具体情况如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发投入（万元）	27,669.52	18,826.93	19,822.69
营业收入（万元）	175,766.46	122,751.49	84,494.46
占比	15.74%	15.34%	23.46%

发行人始终将自主研发、开放创新作为保持技术先进性的重要战略。相关研发投入具有显著的技术先进性，同时产品保持一定迭代更新速度，技术储备丰富。

未来，公司将持续加大研发投入，加强技术研发和创新，增加公司持续竞争能力，同时积极稳妥地推动募投项目的建设，丰富技术储备，尽快实现项目收益，提升经营效率和盈利能力。

（四）核心技术人员和研发团队情况

1、核心技术人员、研发技术人员占员工总数的比例

截至2018年12月31日，公司研发技术人员181人，占员工总数比达70.98%，其中核心技术人员4人，占比1.57%。

2、核心技术人员的学历背景构成、取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况，对公司研发的具体贡献：

杨崇和，男，1957年出生，美国俄勒岗州立大学电子与计算机工程硕士及博士。杨崇和博士于2010年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow）。此外，杨博士还荣获多种奖项，其中包括“IEEE CAS 产业先驱奖”和上海市政府授予的“白玉兰荣誉奖”。自公司成立以来，杨博士一直担任公司董事长兼首席执行官，主要分管公司的战略发展和技术研发方向，其参与的职务发明共获得授权及申请专利21项，为公司主要专利发明人之一。

山岗，男，1975年出生，北京航空航天大学电子与通信系统硕士，曾经荣获中国电子学会科技进步奖一等奖，上海市科学技术奖三等奖等。山岗先生目前担任市场应用技术部（公司的研发部门之一）负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共获得授权及申请专利31项，为公司主要专利发明人之一。

常仲元，男，1959年出生，比利时鲁汶大学微电子学博士。常博士曾在IEEE学术期刊和国际会议上发表了论文逾20篇，其中3篇发表于ISSCC会议，并作为第一作者在美国出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。常仲元先生目前担任研发部负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共获得授权及申请专利3项，为公司主要专利发明人之一。

史刚，男，1969年出生，复旦大学电子工程系微电子硕士。史刚先生目前担任运营部（公司的研发部门之一）负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共申请专利1项。

3、公司对核心技术人员实施的约束激励措施

公司建立并实施了严格的保密管理制度和内控管理制度，与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，对可能引发泄密的行为进行了限定并对涉及技术等影响公司重大利益的事项设置了相应的保密措施进行管理。此外，公司实行了有效的激励制度，为核心技术人员提供具有竞争力的薪酬福利，且所有核心技术人员均间接持有公司股权，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展，有效防范了泄密风险。

4、报告期内核心技术人员的主要变动情况及对公司的影响

史刚先生于2017年8月加入公司担任运营部负责人，其他核心技术人员均在公司长期任职未发生变化。综上所述，最近2年内公司核心技术人员未发生重大不利变化。

5、公司的人才策略

公司采取引进、培养相结合的人才策略，不断完善创新人才保障制度，进一步增强对创新人才的吸引力和凝聚力，多途径引进高层次科技人才，公司50%以上的研发人员至少拥有硕士及以上学位，为公司的产品创新提供了重要的技术基础。同时，公司制定有相关的人员培训管理办法，重视研发人才的培养和储备，以多种方式开展对人才的多方位培养，已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术人才，积极营造适合研发人员成长的工作环境，保证技术创新的可持续性。

为保持技术的不断创新和完善，公司对有重要贡献的研发人员进行专项奖励，包括晋升岗位、提高收入待遇、增加培训机会等方式，充分调动专业人才的积极性和开拓性，提升公司的自主创新能力。同时，公司注重加强专业技术及管理技能的全员培训，将持续的人力资源开发作为实现人力资本增值的目标，不断提高员工整体素质。

（五）技术与研发的组织体系与创新机制

1、研发组织体系

公司注重新产品的开发和创新，设立了专门的研发部负责全面推进公司技术进步，不断调整和优化产品结构，促进产品更新换代。公司涉及研发的部门包括研发部、市场应用技术部、运营部。研发部与市场部共同制定设计规格，与市场应用技术部共同验证产品功能，与运营部共同完成量产认证。

市场部根据市场调研分析、产品技术创新诉求和目标客户需求，提出新产品开发提案，完成立项审批，启动新产品开发流程。研发部搭建产品设计环境，进行产品设计。产品最终由市场应用技术部执行验证并由运营部执行量产认证以完成产品量产部署。

2、创新机制

公司重视技术创新，坚持以市场为导向安排研发计划。在技术创新项目的筛选上，公司专注市场调研与分析，以目标客户新增需求为驱动，形成对创新项目的开发思路，围绕现有产品和技术成果，进行技术研发、结构设计、工艺优化等多方面的深入研究。同时，根据新兴市场的发展趋势，不断进行技术升级和储备，持续保持现有产品的更新换代，加快对市场需求的响应速度。以市场为导向的技术研发，保障了创新项目的实用性，有效提高了公司研发投入的转化率。

公司每年在预算中安排一定比例的预算作为研发费用，为技术创新和技术储备提供物质保障。公司鼓励员工进行职务发明，对于申请的专利和布图设计成功的相关团队给予奖励。公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖产品开发立项、产品设计、产品验证、产品应用、产品量产认证等阶段，确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强而有效的管控。公司会定期或不定期召开会议对研发进度和技术储备情况进行审核及研讨，督促研发进度，确保研发成果与市场需求保持一致。

七、公司境外经营情况

公司的供应商及客户大部分位于境外或者使用境外实体与公司进行交易，公司的主要境外经营主体包括澜起澳门、澜起美国，其中发行人通过澜起澳门进行境外采购及销售，通过澜起美国为美国等境外客户提供支持。

报告期内公司境外销售的具体产品类型包括内存接口芯片和消费电子芯片，其中内存接口芯片境外销售占整个报告期境外销售的比重达到 95% 以上。由于内存接口芯片的主要客户为 DRAM 厂商，大部分都在境外，公司在境外分支机构与其进行直接联系，并已建立了长期稳定的合作关系。

公司在境外的销售模式以直销为主，代销为辅。定价策略主要是基于市场价格经买卖双方协商确定。

第七节 公司治理及独立性

一、概述

公司成立以来，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计工作制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》等相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略，审计，董事和高级管理人员的管理和考核，董事和高级管理人员的提名、甄选等工作，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》。报告期内，公司治理不存在重大缺陷。

发行人不存在特别表决权股份或类似安排，不存在协议控制架构。

二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况

（一）股东大会的运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。

自公司设立以来，截至本招股说明书签署日，公司共计召开了 4 次股东大会，相关股东或股东代表出席了会议，其中发行人 2019 年第一次临时股东大会的通知期限不足

规定的通知时限，但全体股东均在该次股东大会通知发出前，对于股东大会的通知时间进行了豁免，并同意缩短股东大会通知期限，股东大会决议有效。

（二）董事会制度的运行情况

1、董事会的构成

公司董事会对股东大会负责。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司董事会设董事长 1 名，董事长由公司董事担任，以董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，且审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占二分之一以上的比例并担任主任委员；审计委员会主任委员是会计专业人士。

公司董事会战略委员会由经董事会选举的杨崇和、Stephen Kuong-lo Tai、邓向东、李荣信、Brent Alexander Young、尹志尧组成，其中杨崇和为主任委员。

公司董事会审计委员会由经董事会选举的吕长江、刘敬东、李亚军 3 名董事组成，其中吕长江、刘敬东为独立董事，吕长江为会计专业人士并担任主任委员，审计委员会下设内审部为日常办事机构。

公司董事会薪酬与考核委员会由经董事会选举的俞波、吕长江、Yao SUN 3 名董事组成，其中俞波、吕长江为独立董事，并由俞波担任主任委员。

公司董事会提名委员会由经董事会选举的刘敬东、俞波、杨崇和 3 名董事组成，其中刘敬东、俞波为独立董事，并由刘敬东担任主任委员。

公司董事会各专门委员会按照各项实施细则等相关规定召开会议，审议各委员会职权范围内的事项，各委员会履行职责情况良好。

2、董事会制度运行情况

公司第一届董事会成立于 2018 年 10 月 28 日。截至本招股说明书签署日，公司共召开 6 次董事会会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（三）监事会制度的运行情况

1、监事会的构成

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，其中 2 名成员由股东大会选举产生，另 1 名成员由公司职工代表大会选举产生。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表民主选举产生或更换。

2、监事会制度的运行情况

公司第一届监事会成立于 2018 年 10 月 28 日公司创立大会召开之日。截至本招股说明书签署日，公司共召开了 3 次监事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（四）独立董事制度及运行情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了规范的独立董事制度，以确保独立董事议事程序，并完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用。本公司现有独立董事 4 名，独立董事人数占公司 11 名董事人数超过三分之一，其中包括 1 名会计专业人士。独立董事出席了历次召开的董事会并对相关议案进行了表决。

公司建立独立董事制度以来，独立董事在公司董事、高级管理人员的聘用、关联交易、公司重要管理制度的拟定及重大经营的决策等方面均发挥了重要作用。

（五）董事会秘书制度及运行情况

根据《公司章程》及《董事会秘书工作制度》等规定，公司设董事会秘书 1 名，对董事会负责。公司董事会秘书由梁铂钴担任。董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》认真履行其职责，负责筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议，确保了公司董事会及其专门委员会、监事会和股东大会依法召开、

依法行使职权，及时向公司股东、董事、监事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会及其专门委员会、监事会和股东大会正常行使职权发挥了重要作用。

三、公司报告期内违法违规行为情况

公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到相关主管机关的重大处罚。

四、公司报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，公司的关联资金往来情况详见本节之“八、关联方、关联关系和关联交易”中披露的相关情况。报告期内公司不存在其他资金被主要股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，或者为主要股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

五、内部控制制度的评估意见

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。公司于2018年12月31日按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）注册会计师对内部控制制度的鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况进行了鉴证，并出具《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、发行人独立运行情况

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均具有独立性。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

公司主营业务、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；公司股权权属清晰；公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的产品研发、采购和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场独立开展业务的能力，公司不存在控股股东、实际控制人，不存在同业竞争的情形。公司运营部直接面向市场独立采购，负责公司生产经营所需的原材料、辅助材料等的采购。公司研发部门独立进行技术和产品研发，拥有独立的研发设备和人员体系，具有相应的知识产权和专利技术。公司制订了完备的销售管理制度，具有独立完整的销售系统。

（二）资产完整情况

公司设立及此后历次增资，股东的出资均已足额到位。公司拥有自身独立完整的经营资产，产权明确，与公司股东资产之间界限清晰。公司具备与生产经营有关的系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的知识产权、专利技术等资产的所有权或使用权。截至本招股说明书签署日，公司全部资产均由公司独立拥有或使用，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资源的情形。

（三）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举或聘任产生，不存在主要股东单方面指派或干预董事、监事及高级管理人员任免的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在公司主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务并领薪；公司的财务人员未在本公司主要股东及其控制的其他企业中兼职。

（四）机构独立情况

公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系，并制定了相适应的股东大会、董事会和监事会的议事规则，以及独立董事、董事会各专门委员会和总经理的工作细则等。根据业务经营需要，公司设置了相应的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规

章制度。公司内部经营管理机构与公司主要股东及其控制的其他企业完全分开，独立行使经营管理职权，不存在与公司主要股东及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形。

（五）财务独立情况

公司设立后，已依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司拥有独立的银行账号并独立纳税，与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。公司独立对外签订合同，不存在与公司主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

七、同业竞争

（一）本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

本公司无控股股东及实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形。

公司同成都澜至的不存在同业竞争，具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“五、（二）其他对公司有一定影响的资产重组情况”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司主要股东中电投控及其关联方嘉兴芯电；WLT 及其关联方珠海融英；上海临理，包括上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐；嘉兴宏越及其关联方，包括嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

1、本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与澜起科技股份有限公司（以下简称“发行人”）构成同业竞争的业务或经营，与发行人不存在同业竞争。

2、本单位将采取有效措施，保证本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。

3、本单位将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。

4、本单位不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

5、本单位不会利用发行人的股东地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。

6、如本单位违背上述承诺，给发行人造成了直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用，本单位愿承担全部赔偿责任。

7、本承诺函自签署之日起生效，并在发行人有效续存且本单位直接或间接持有发行人股份期间内持续有效、不可撤销。

八、关联方、关联关系和关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，公司主要关联方包括：

1、控股股东、实际控制人及其控制或担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业

本公司不存在控股股东及实际控制人。

2、直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东及其关联方

序号	关联方名称	持股情况
1	中电投控	持有发行人 15.904%股份
	嘉兴芯电	持有发行人 2.078%股份
2	Intel Capital	持有发行人 10.000%股份
3	Intel Corporation	间接持有发行人 10.000%股份
4	WLT	持有发行人 8.636%股份
	珠海融英	持有发行人 6.812%股份
5	上海临理	持有发行人 5.262%股份
	上海临丰	持有发行人 1.830%股份
	上海临骥	持有发行人 1.498%股份
	上海临利	持有发行人 1.312%股份
	上海临国	持有发行人 1.285%股份
	临桐建发	持有发行人 0.912%股份
	上海临齐	持有发行人 0.690%股份

6	中证投资	持有发行人 5.019%股份
7	中信证券	间接持有发行人 5.019%股份
8	嘉兴宏越	持有发行人 4.352%股份
	嘉兴莫奈	持有发行人 2.029%股份
	Xinyun I	持有发行人 4.352%股份
	Xinyun	持有发行人 1.186%股份
	Xinyun III	持有发行人 0.204%股份
9	臻石一号	持有发行人 2.240%股份
	臻石二号	持有发行人 1.282%股份
	臻石三号	持有发行人 3.243%股份

3、发行人的控股子公司、参股公司

关于发行人的控股子公司、参股子公司情况请参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介”。

4、控股股东、实际控制人控制的其他企业

本公司不存在控股股东及实际控制人，不存在控股股东、实际控制人控制的其他企业。

5、公司董事、监事、高级管理人员

序号	关联方名称	关联关系
1	杨崇和	董事长
2	Stephen Kuong-lo Tai	董事兼总经理
3	邓向东	董事
4	李荣信	董事
5	李亚军	董事
6	Yao SUN	董事
7	Brent Alexander Young	董事
8	尹志尧	独立董事
9	吕长江	独立董事
10	刘敬东	独立董事
11	俞波	独立董事
12	夏晓燕	监事会主席
13	梁显效	监事

序号	关联方名称	关联关系
14	施懿	职工监事
15	梁铂钻	副总经理兼董事会秘书
16	苏琳	副总经理兼财务负责人

6、其他关联自然人

本公司将本公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员界定为本公司的关联方。关系密切的家庭成员包括其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况请参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员概况”相关内容。

7、其他关联方

序号	关联方名称/姓名	关联关系或备注
1	中电通商融资租赁有限公司	发行人股东中电投控控制的企业
2	CEC Tongshang Company Limited	发行人股东中电投控控制的企业
3	中电信用服务有限公司	发行人股东中电投控控制的企业
4	中电智慧医疗管理有限公司	发行人股东中电投控控制的企业
5	成都中电明通股权投资基金中心(有限合伙)	发行人股东中电投控控制的企业
6	中电通商实业发展(上海)有限公司	发行人股东中电投控控制的企业
7	中电通商商业保理(天津)有限公司	发行人股东中电投控控制的企业
8	嘉兴中电朝云投资管理有限公司	发行人股东中电投控控制的企业
9	CEC Industrial Development Investment Inc.	发行人股东中电投控控制的企业
10	PKM Holding Co., Ltd.	过去十二个月曾间接持有公司 5%以上股权
11	中信寰球商贸(上海)有限公司	发行人股东中证投资控制的企业
12	宏明(上海)投资管理有限公司	发行人股东中证投资控制的企业
13	中信证券(青岛)培训中心酒店管理有限公司	发行人股东中证投资控制的企业
14	GRANMEEN INTEL SOCIAL BUSINESS LIMITED	发行人股东 Intel Capital 控制的企业
15	Intel Products(M)SDN.BHD	报告期内发生交易的关联企业
16	Intel Technology SDN.BHD	报告期内发生交易的关联企业
17	Componentes Intel de Costa Rica,S.A	报告期内发生交易的关联企业
18	Intel Semiconductor (US) LLC	报告期内发生交易的关联企业

19	Intel Americas Inc.	报告期内发生交易的关联企业
20	Montage HK	公司董事长杨崇和、董事 Stephen Kuong-lo Tai 曾担任董事的企业
21	Montage Group	公司董事长杨崇和曾担任董事的企业
22	Montage Holding	公司董事长杨崇和担任董事的企业
23	上海澜至	公司董事长杨崇和曾担任执行董事的企业
24	成都澜至	公司董事长杨崇和曾担任执行董事的企业
25	澜至半导体	公司董事长杨崇和曾担任执行董事的企业
26	Zaiart (BVI) Technology Limited	公司董事长杨崇和关系密切的家庭成员担任董事的企业
27	Harmonialux Holdings Limited	公司董事 Stephen Kuong-lo Tai 关系密切的家庭成员控制的企业
28	Harmonialux Holdings(Hong Kong) Limited	公司董事 Stephen Kuong-lo Tai 关系密切的家庭成员控制的企业
29	WYK Co.,Ltd	公司董事 Stephen Kuong-lo Tai 关系密切的家庭成员控制的企业
30	中电鑫安投资管理有限责任公司	公司董事邓向东担任董事长、法定代表人的企业
31	武汉伊莱克启明股权投资基金管理有限公司	公司董事邓向东担任执行董事、法定代表人的企业
32	天津伊莱克长庚企业管理合伙企业(有限合伙)	公司董事邓向东控制的企业
33	鑫安资本有限责任公司	公司董事邓向东控制的企业
34	中电资产管理（深圳）有限公司	公司董事邓向东担任董事长的企业
35	长沙军民先进技术研究有限公司	公司董事邓向东担任董事长的企业
36	中电长城网际系统应用有限公司	公司董事邓向东担任董事的企业
37	天津伊莱克晨星企业管理合伙企业(有限合伙)	公司董事邓向东控制的企业
38	上海佑磁信息科技有限公司	公司董事李荣信担任法定代表人、总经理的企业
39	上海安路信息科技有限公司	公司董事李荣信曾担任法定代表人、董事长的企业
40	华大半导体有限公司	公司董事李荣信曾担任董事、副总经理的企业
41	晶门科技有限公司	公司董事李荣信曾担任董事长的企业
42	上海贝岭股份有限公司	公司董事李荣信曾担任董事的企业
43	博纳影业集团股份有限公司	公司董事 Yao SUN 担任董事的企业
44	Mountain Tiger International Limited	公司董事 Yao SUN 担任董事的企业
45	CS Regal Holding Limited	公司董事 Yao SUN 担任董事的企业
46	Gstone Investment International Limited	公司董事 Yao SUN 担任董事的企业
47	Jupiter Connection Limited	公司董事 Yao SUN 担任董事的企业
48	Pluto Connection Limited	公司董事 Yao SUN 曾担任董事的企业

49	Uranus Connection Limited	公司董事 Yao SUN 担任董事的企业
50	Neptune Connection Limited	公司董事 Yao SUN 担任董事的企业
51	浙江鸿禧能源股份有限公司	公司董事 Yao SUN 担任董事的企业
52	嘉兴康帅股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事李亚军控制的企业
53	上海君尧商务咨询中心	公司董事李亚军控制的企业
54	上海宏天元投资有限公司	公司董事李亚军曾担任董事的企业
55	广州新珀尔信息技术股份有限公司	公司董事李亚军控制并担任董事的企业
56	威视芯半导体（合肥）有限公司	公司董事李亚军担任董事的企业
57	上海临芯投资管理有限公司	公司董事李亚军担任法定代表人、董事长、总经理的企业
58	上海临鸿投资合伙企业（有限合伙）	公司董事李亚军担任执行事务合伙人委派代表的企业
59	无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	公司董事李亚军担任执行事务合伙人委派代表的企业
60	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）	公司董事李亚军担任执行事务合伙人委派代表的企业
61	上海临望电子科技有限公司	公司董事李亚军担任执行董事、总经理的企业
62	上海临巍电子科技有限公司	公司董事李亚军担任法定代表人、执行董事、总经理的企业
63	上海临珺电子科技有限公司	公司董事李亚军担任董事长、总经理的企业
64	上海临豪投资合伙企业（有限合伙）	公司董事李亚军担任执行事务合伙人委派代表的企业
65	上海清云图投资合伙企业（有限合伙）	公司董事李亚军担任执行事务合伙人委派代表的企业
66	无锡清石华晟投资有限公司	公司董事李亚军担任法定代表人、董事长、总经理的企业
67	新疆浦富股权投资有限公司	公司董事李亚军担任法定代表人、执行董事的企业
68	深圳中微电高科技投资有限公司	公司董事李亚军担任总经理的企业
69	嘉兴君望投资管理有限公司	公司董事李亚军控制并担任法定代表人、执行董事的企业
70	嘉兴梵晟投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事李亚军担任执行事务合伙人委派代表的企业
71	嘉兴君桐投资合伙企业（有限合伙）	公司董事李亚军担任执行事务合伙人委派代表的企业
72	嘉兴君建投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事李亚军担任执行事务合伙人委派代表的企业
73	浙江临晟投资管理有限公司	公司董事李亚军担任法定代表人、执行董事、总经理的企业
74	无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	公司董事李亚军担任董事的企业
75	DIGILENS, INC.	公司董事 Brent Alexander Young 关系密切的家庭成员担任董事的企业
76	SEEBRIGHT INC.	公司董事 Brent Alexander Young 关系密切的家庭成员担任董事的企业

77	SHOCASE, INC.	公司董事 Brent Alexander Young 关系密切的家庭成员担任董事的企业
78	CRYPTOWORKS,LLC	公司董事 Brent Alexander Young 关系密切的家庭成员担任董事的企业
79	Jatheon Technologies INC.	公司董事 Brent Alexander Young 关系密切的家庭成员担任董事的企业
80	荣信达（上海）文化发展有限公司	公司监事夏晓燕担任法定代表人、董事长的企业
81	亦非云互联网技术（上海）有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
82	合娱星展（北京）文化传播股份有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
83	上海兴格文化传媒有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
84	浙江好酷影视有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
85	灵河文化传媒(上海)有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
86	北京流金岁月文化传播股份有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
87	武汉果派联合影游文化发展有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
88	天津银河酷娱文化传媒有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
89	广禾堂草本生物科技（上海）有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
90	北京伊诺华电动方程式文化发展有限公司	公司监事夏晓燕担任董事长的企业
91	地素时尚股份有限公司	公司监事夏晓燕担任董事的企业
92	三亚伊诺华电动方程式文化发展有限公司	公司监事夏晓燕担任执行董事的企业
93	Rong360 Inc.	公司监事夏晓燕担任董事的企业
94	UNICENTURY GROUP HOLDING LIMITED	公司监事夏晓燕担任董事的企业
95	King Cinema Holdings Limited	公司监事夏晓燕担任董事的企业
96	Enova Holdings Limited	公司监事夏晓燕担任董事的企业
97	昶源(天津)股权投资基金管理有限公司	公司监事夏晓燕关系密切的家庭成员担任法定代表人、执行董事、经理的企业
98	上海品赋投资管理有限公司	公司监事夏晓燕关系密切的家庭成员担任董事的企业
99	浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司	公司监事夏晓燕关系密切的家庭成员担任董事的企业
100	永昌源(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	公司监事夏晓燕关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人的企业
101	正昌源(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	公司监事夏晓燕关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人的企业
102	安胃（上海）智能医疗科技有限公司	公司监事夏晓燕关系密切的家庭成员担任执行董事、法定代表人的企业
103	中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司	公司董事邓向东担任董事长的企业
104	盛科网络（苏州）有限公司	公司监事梁显效担任董事的企业
105	深圳中电国际信息科技有限公司	公司监事梁显效担任董事的企业

106	中电天堃（三亚）投资管理有限责任公司	公司监事梁显效担任董事的企业
107	北京可信华泰信息技术有限公司	公司监事梁显效担任董事的企业
108	嘉兴铂林投资管理有限公司	公司高级管理人员梁铂钻担任执行董事、总经理的企业
109	上海星在文化传播有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员担任董事长、总经理的企业
110	上海辰光商务咨询服务有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员控制并担任执行董事的企业
111	上海牡丹影视传播有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员担任董事的企业
112	上海元气餐饮管理有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员担任董事的企业
113	上海佑玛道商贸有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员担任董事的企业
114	重庆星在文化传播有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员任董事的企业
115	无锡星在餐饮管理有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员担任董事长的企业
116	上海星在舞台设计有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员担任董事长的企业
117	上海浦秀园文化发展有限公司	公司高级管理人员苏琳关系密切的家庭成员担任副总经理的企业
118	TransLink Management I, L.L.C	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任 Managing Member 的企业
119	TansLink Management II, L.P	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任 Managing Member 的企业
120	TansLink Management II, L.L.C	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任 Managing Member 的企业
121	TansLink Management III, L.L.C	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任 Managing Member 的企业
122	TansLink Management IV, L.L.C	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任 Managing Member 的企业
123	TansLink Management China Mobility, L.L.C	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任 Managing Member 的企业
124	JUNG-KUNG YANG	过去十二个月曾担任公司董事
125	Winking Entertainment Ltd	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
126	Adwo Media Holdings Ltd	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
127	Ejoule International Ltd	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
128	Pakal Technologies, Inc	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
129	UBiAi International(Cayman) Ltd	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
130	Axonne Inc	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业

131	Dcard Holdings Ltd	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
132	深圳易马达科技有限公司	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
133	X2 Power Technologies Ltd	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
134	Memoright(Cayman) Co., Ltd	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
135	Parade Technologies Ltd	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
136	GCS Holdings Inc	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
137	GrandTech C.G. Systems Inc	公司原董事 JUNG-KUNG YANG 担任董事的企业
138	Ko Ping Keung	过去十二个月曾担任公司监事
139	Smartsens Technology (Cayman) Co Ltd	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
140	博通集成电路（上海）股份有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
141	固高科技（香港）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
142	丘钛科技（集团）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任独立董事的企业
143	Silicon Federation International Limited	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
144	固高科技（深圳）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
145	辉芒微电子（深圳）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
146	上海固高欧辰智能科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
147	芯联集成电路（上海）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
148	芯联电科技（苏州）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事、总经理的企业
149	灵铄电子科技（上海）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事长、法定代表人的企业
150	启攀微电子（上海）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事长、法定代表人的企业
151	睿魔智能科技（东莞）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任副董事长的企业
152	深圳开阳电子股份有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
153	深圳市银星智能科技股份有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
154	逸动智能科技（东莞）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
155	安徽省天鸿利半导体有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
156	东莞松山湖国际机器人研究院有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
157	东莞松山湖教育发展有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
158	东莞远铸智能科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
159	创达特（苏州）科技有限责任公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业

160	天利半导体（深圳）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
161	北京方益集成电路设计有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
162	东莞松山湖机器人产业发展有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任副董事长的企业
163	MacDermid Graphocs Solutions.LLC	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
164	舟山纳瓦科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事长的企业
165	深圳市枫芒科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
166	清芒智能科技（东莞）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
167	奇航（东莞）信息科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
168	东莞霍曼科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
169	卧安科技（东莞）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
170	安迪威数码有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
171	亚洲数码联盟有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
172	Brizan Investment Adviser Limited	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
173	清水湾香港盈瓴有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
174	駿創科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
175	豪保有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
176	固高投资（香港）有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
177	恒基兆业发展有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
178	恒基兆业地产有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
179	智活研发有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
180	SENSETHINK TECHNOLOGY LIMITED	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
181	华硅有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
182	VTECH HOLDINGS LIMITED	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
183	逸动科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业
184	智翔科技有限公司	公司原监事 Ko Ping Keung 担任董事的企业

（二）关联交易

报告期内，公司关联交易的简要汇总情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经常性关联交易				
Intel Semiconductor (US) LLC	采购商品	2,704.00	-	-
Intel Americas Inc.	采购商品	4.58	-	-
Intel Corporation	销售商品	79.08	667.21	-

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Intel Products(M)SDN.BHD	销售商品	364.08	71.71	15.06
Intel Technology SDN.BHD	销售商品	9.63	18.64	-
Componentes Intel de Costa Rica,S.A	销售商品	108.14	-	-
Intel Semiconductor (US)LLC	研发费用补贴	157.30	784.10	-
合计		3,426.81	1,541.66	15.06
偶发性关联交易:				
Montage Group	销售商品	-	4,310.47	-
成都澜至	销售商品	-	11,310.91	-
成都澜至	资产转让	-	4,983.64	-
澜至半导体	资产转让	-	850.52	-
Montage Group	资产转让	-	3,351.33	-
CEC Tongshang Company Limited	关联借款利息	153.81	468.81	-
上海澜至	转租办公室	-	364.52	179.62
成都澜至	转租办公室	-	38.11	-
Montage HK	退还的股利分配款	-	-	7,864.07
上海辰光商务咨询服务有限公司	接受劳务	-	40.00	34.76
上海佑玛道商贸有限公司	采购商品	7.82	-	-
合计		161.63	25,718.31	8,078.45

报告期内，公司关联交易的具体情况如下：

1、经常性关联交易

报告期内，公司的经常性关联交易情况如下：

(1) 关键管理人员薪酬

2016 年、2017 年和 2018 年，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬总额分别为 721.51 万元、622.51 万元、3,874.30 万元。

(2) 采购商品

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Intel Semiconductor (US) LLC	采购商品	2,704.00	-	-
Intel Americas Inc.	采购商品	4.58	-	-

合计	2,708.58	-	-
----	-----------------	---	---

2018 年公司第一代津逮[®]服务器平台研发成功，其中该产品需采购 Intel 的 CPU 及研发工具，采购价格为双方协商按公允价格购买。2018 年公司向 Intel Semiconductor (US) LLC 采购 2,704.00 万元，向 Intel Americas Inc. 采购 4.58 万元，合计采购 2,708.58 万元，占公司营业成本比例为 5.23%。

（3）销售商品

报告期内，公司产生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Intel Corporation	销售商品	79.08	667.21	-
Intel Products(M)SDN.BHD	销售商品	364.08	71.71	15.06
Intel Technology SDN.BHD	销售商品	9.63	18.64	-
Componentes Intel de Costa Rica,S.A	销售商品	108.14	-	-
合计		560.93	757.56	15.06

报告期内，公司根据 Intel 采购需求，向其销售澜起科技的混合安全内存模组等产品，销售价格为双方协商按公允价格销售。2016 年、2017 年及 2018 年销售金额分别为 15.06 万元、757.56 万元及 560.93 万元，占公司营业收入比分别为 0.02%，0.62% 及 0.32%。

（4）同 Intel 之间的津逮[®]服务器 CPU 开发项目款项

2017 年，公司同 Intel 签署相关合作协议，作为津逮[®]服务器 CPU 的合作伙伴，Intel 同公司联合开发服务于客户的津逮[®]服务器 CPU 相关产品，由 Intel 向公司提供研发支持，合计金额为 210 万美元。

报告期内，公司因合作开发补贴产生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Intel Semiconductor (US)LLC	研发费用补贴	157.30	784.10	-
合计		157.30	784.10	-

为了支持合作伙伴研发应用包含 Intel 技术的相关产品，2017 年 9 月公司与 Intel 签署了一次性工程费用（以下简称“NRE”）协议。根据 NRE 协议，针对相关的研发、

测试、验证、发布等工作约定了具体的补贴金额和支付时间安排，Intel 根据研发项目的关键节点完成进度支付研发补贴费用。报告期内，Intel 公司根据相关协议，分别于 2017 年、2018 年支付补贴资金 784.10 万元及 157.30 万元。

2018 年来自 Intel 的研发费用补贴较 2017 年有一定程度下降，主要系公司与 Intel 签订的相关协议中，约定了研发费用的补贴条件系根据津逮[®]服务器平台达成具体研发进度时发放。根据协议，触发相关研发补贴的主要节点均发生在 2017 年，因此在 2017 年中确认的研发费用补贴较高。

2、偶发性关联交易

（1）向关联方转让消费电子业务商品及资产

2017 年，公司将消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group，实现了业务层面的分离，具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“五、（二）其他对公司有一定影响的资产重组情况”。

报告期内，公司因资产转让产生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Montage Group	销售商品	-	4,310.47	-
成都澜至	销售商品	-	11,310.91	-
成都澜至	资产转让	-	4,983.64	-
澜至半导体	资产转让	-	850.52	-
Montage Group	资产转让	-	3,351.33	-
合计		-	24,806.87	-

2017 年因转让消费电子芯片业务资产产生的关联交易合计 24,806.87 万元，其中影响销售收入 15,621.38 万元，占公司总营业收入比例 12.73%。上述交易价格系参考转让资产的评估价值确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（2）本公司向关联方出借资金

2017 年 3 月 31 日，澜起澳门与 CEC Tongshang Company Limited 签订《借款协议》，约定由澜起澳门向 CEC Tongshang Company Limited 出借资金共计 3,000.00 万美元，借款期限 6 个月，年化利率 3.2%，自借款划付之日起算。同时中电通商融资

租赁有限公司与澜起澳门签订《应收账款质押合同》，由中电通商融资租赁将其持有的5亿美元应收账款质押给澜起澳门，作为本次CEC Tongshang Company Limited借款本金及利息等费用的担保。2017年4月6日，澜起澳门将本次借款划出。2017年9月8日，澜起澳门与CEC Tongshang Company Limited签订《借款协议变更协议》，将借款期限延展至12个月，其余条款不变。2018年4月6日，CEC Tongshang Company Limited偿还本金及相关利息。

报告期内，公司因向CEC Tongshang Company Limited出借资金产生的利息收入情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018年度	2017年度	2016年度
CEC Tongshang Company Limited	关联借款利息	153.81	468.81	-
合计		153.81	468.81	

上述借款利率参考了市场利率，定价公允，对公司的生产经营成果无重大影响。

（3）本公司向关联方转租办公室

2017年7月公司向成都澜至及其关联方转让资产前，公司与成都澜至及上海澜至存在转租办公室的情形，公司与出租方签订场地租赁协议，承租办公室，并将部分办公室以平价转租给成都澜至及上海澜至。

2017年7月公司完成对成都澜至及其关联方的资产转让，在原租期结束后，公司与成都澜至及澜至半导体分别与出租方重新签订租赁协议，前述转租交易终止。

报告期内，公司因转租办公室产生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018年度	2017年度	2016年度
上海澜至	转租办公室	-	364.52	179.62
成都澜至	转租办公室	-	38.11	-
合计		-	402.63	179.62

2016年、2017年公司转租办公室合计金额分别为179.62万元和402.63万元，均为平价转租，对公司的生产经营成果无重大影响。

（4）同 Montage HK 及 Montage Group 间的资金往来

报告期期初，公司同 Montage HK 及 Montage Group 为同一控制下主体，存在资金拆借用于日常经营、利润分配、资金往来等情形。

报告期内，公司同 Montage HK 及 Montage Group 资金拆借情况

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
Montage Group	11,636.14	2015-12-30	2016-5-30	已归还
Montage Group	3,424.73	2015-12-30	2016-6-29	已归还
Montage HK	2,907.54	2015-12-30	2016-4-29	已归还

报告期内，公司同 Montage HK 间的退还的股利分配款情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Montage HK	退还的股利分配款	-	-	7,864.07
合计		-	-	7,864.07

（6）其他采购

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
上海辰光商务咨询服务有限公司	接受劳务	-	40.00	34.76
上海佑玛道商贸有限公司	采购商品	7.82	-	-
合计		7.82	40.00	34.76

报告期内，公司其他采购为公司经营采购的办公用品及会议用品的费用，于 2016 年、2017 年向上海辰光商务咨询服务有限公司支付服务费用 34.76 万元及 40.00 万元，2018 年向上海佑玛道商贸有限公司采购办公用品支付 7.82 万元。上述关联交易金额较小，对公司经营成果无重大影响。

（三）关联方往来款项余额

1、应收账款

单位：万元

关联方	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31

关联方	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
成都澜至	4,218.84	6,653.84	-
Montage Group	-	941.00	-
Intel Corporation	-	73.86	-
Intel Technology SDN.BHD	-	18.35	-
合计	4,218.84	7,687.05	-

2017年12月31日，公司应收成都澜至6,653.84万元，应收Montage Group 941.00万元，系业务资产转让中公司销售的消费电子芯片业务相关存货的转让款余款。应收Intel Corporation 73.86万元，应收Intel Technology SDN.BHD 18.35万元，系向公司采购交易中的货款。

2018年12月31日，公司应收成都澜至4,218.84万元，系根据付款协议尚未支付的相关资产转让余款，成都澜至已于2019支付该笔款项。

2、预付款项

单位：万元

关联方	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Intel Semiconductor (US) LLC	69.38	-	-
合计	69.38	-	-

2018年12月31日，公司预付Intel Semiconductor (US) LLC 69.38万元，系公司采购CPU产品的货款。

3、其他应收款

单位：万元

关联方	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
CEC Tongshang Company Limited	-	19,750.40	-
Montage Group	-	1,616.25	-
成都澜至	2,604.82	2,604.82	-
澜至半导体	-	489.52	-
Intel Semiconductor (US) LLC	-	784.10	-
上海澜至	-	-	106.40
合计	2,604.82	25,245.09	106.40

2016年12月31日，公司其他应收上海澜至106.40万元，系当时同一控制下关

联企业之间的转租。

2017年12月31日，公司其他应收 CEC Tongshang Company Limited 19,750.40 万元，系澜起澳门根据协议向 CEC Tongshang Company Limited 的借款 3000 万美金。其他应收 Montage Group 1,616.25 万元、其他应收成都澜至 2,604.82 万元、其他应收澜至半导体 489.52 万元，系业务资产转让中公司转让的消费电子芯片业务相关资产的转让款余款。其他应收 Intel Semiconductor(US) LLC 784.10 万元，系公司应收的合作开发补贴 120 万美元。

2018年12月31日，公司其他应收成都澜至 2,604.82 万元，系业务资产转让中公司转让的消费电子芯片业务相关资产的转让款余款，成都澜至已于 2019 支付该笔款项。

4、其他应付款

单位：万元

关联方	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
上海澜至	-	-	817.72
澜至半导体	3.59	-	-
合计	3.59	-	817.72

2016年12月31日，公司对上海澜至的其他应付款余额为 817.72 万元，主要系代收应付上海澜至员工 2014 年私有化股权激励款，公司已于 2019 年初完成对相关其他应付款的支付。

九、其他交易

截至本招股说明书签署日，公司股东 SVIC No. 28 Investment 持有发行人 1.11% 的股份，其关联方三星电子为公司主要客户之一。

报告期内，公司向其销售产品为内存接口芯片，且销售金额随着公司销售收入的增加逐年上升，2018 年公司对其销售收入超过 4 亿元。

公司根据市场情况，针对不同型号的产品同其进行协商议价，相关交易均履行了公司经营管理的决策程序。公司向三星电子及其关联方的销售单价同其他第三方客户销售单价相比不存在重大差异，其销售的定价原则、定价依据等未因 SVIC No. 28 Investment 投资公司发生改变，相关定价公允。

十、规范关联交易的制度安排

公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易制度》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。主要规定如下：

（一）《公司章程》的规定

《公司章程》第七十七条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会的决议应充分披露非关联股东的表决情况。

公司应当在股东大会决议中对此做出详细说明，对非关联股东的投票情况进行专门统计，并在决议中披露。

审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）股东大会对关联交易事项的表决，普通决议应由除关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；特别决议，应由除关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的决议无效；

（六）股东大会审议有关关联交易事项时，有关关联关系的股东应该回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会做出如实说明。”

《公司章程》第一百零四条规定：“董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外

投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。”

《公司章程》第一百零七条规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权批准：

（七）公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上的关联交易（上市公司提供担保除外），但公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易应由股东大会审议。”

《公司章程》第一百一十七条规定：“一名董事不得在一次董事会会议上接收超过二名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事出席会议。”

（二）《股东大会议事规则》的规定

《股东大会议事规则》第二十九条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

《股东大会议事规则》第三十五条规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

（三）《董事会议事规则》的规定

《董事会议事规则》第十条规定：“董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。”

《董事会议事规则》第十一条规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权审议批准以下事项：

（七）公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上的关联交易（上市公司提供担保除外），但公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易应由股东大会审议。”

《董事会议事规则》第四十二条规定：“委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。”

《董事会议事规则》第四十六条规定：“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。该董事可以参加讨论该等事项的董事会会议，并就有关事项发表意见，但不得就该等事项参加表决，亦不得就该等事项授权或代理其他董事表决。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。关联董事回避后出席董事会的无关联关系董事人数不足三人时，应将该事项提交股东大会审议并对该等交易作出相关决议。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”

（四）《独立董事工作细则》的规定

《独立董事工作细则》第十七条规定：“为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：（一）根据《公司章程》的规定，对于需要公司董事会或股东大会审议的关联交易应由独立董事二分之一以上同意后，提交董事会或股东大会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”

《独立董事工作细则》第二十一条规定：“独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（四）根据《公司章程》的规定，需要公

司董事会或股东大会审议的重大关联交易事项。”

（五）《关联交易制度》的规定

《关联交易制度》第十条规定：“公司关联交易应当遵循以下基本原则：（一）符合诚实信用的原则；（二）不损害公司及非关联股东合法权益原则；（三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；（四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或财务顾问；（六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。”

《关联交易制度》第十四条规定：“公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：（一）任何个人只能代表一方签署协议；（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：1、交易对方；2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职的；3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四款的规定为准）；5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四款的规定为准）；6、中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。（四）股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：1、交易对方；2、拥有交易对方直接或间接控制权的；3、被交易对方直接或间接控制的；4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；6、中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。”

《关联交易制度》第十五条规定：“公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。”

《关联交易制度》第十六条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大

会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。”

《关联交易制度》第十七条规定：“根据《公司章程》的规定，对于需要公司董事会或股东大会审议的关联交易应由独立董事二分之一以上同意后，提交董事会或股东大会讨论。”

《关联交易制度》第十八条规定：“公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应当将该交易提交股东大会审议。独立董事对上述交易发表单独意见。公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。”

《关联交易制度》第十九条规定：“公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上的关联交易（上市公司提供担保除外）由董事会批准。董事会可将除需要股东大会及董事会审议的关联交易事项授权公司董事长或总经理批准，有利害关系的人士在总经理会议上应当回避。”

十一、报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见

（一）关联交易履行程序情况

公司 2019 年 2 月 22 日第一届董事会第四次会议、第一届监事会第二次会议和 2019 年 3 月 5 日 2019 年第一次临时股东大会上，在关联董事和股东回避表决下，非关联董事和股东审议通过了《关于确认公司 2016、2017、2018 年各项关联交易的议案》，对 2016 至 2018 年度发生的关联交易进行了确认。

上述董事会和监事会会议中，独立董事和监事会成员未发表不同意见。

综上，发行人已发生关联交易的决策过程与《公司章程》相符，关联董事和关联股东在审议相关交易时已回避表决，独立董事和监事会成员未发表不同意见。

（二）独立董事对关联交易的意见

公司独立董事对于报告期内公司关联交易发表意见：

“公司 2016、2017、2018 年度各项关联交易，均按照公允、合理的原则进行定

价，不存在损害公司及股东合法利益的情形。”

十二、本公司减少和规范关联交易的措施

（一）不断提高公司治理水平，严格规范关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理准则中明确规定了关联交易的决策程序，要求关联股东和关联董事分别在股东大会和董事会审议有关关联交易事项时采取回避表决的措施；在《独立董事工作细则》规定了独立董事对关联交易事项的职权和要求；在《关联交易制度》中就关联关系的界定、关联交易的内容、关联交易的实施权限及信息披露做出了明确规定，保证公司与关联方进行交易符合公开、公平、公正的三公原则。公司将不断提升内部治理水平，严格遵守以上规章制度，按规定履行程序，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

公司在业务、机构、资产、人员、财务上均独立于各关联方，公司具备面向市场的独立运营能力。公司将根据实际情况规范和减少关联交易，杜绝发生不必要的关联交易。对于正常的、有利于公司发展的、预计将持续存在的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格履行公司的决策程序和关联方回避制度，遵守有关合同协议的规定，做好信息披露工作，切实维护其他股东的权益。

（二）主要股东及董事、监事、高级管理人员出具的承诺函

澜起科技股份有限公司主要股东中电投控及其关联方嘉兴芯电；WLT 及其关联方珠海融英；上海临理及其关联方，包括上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐；嘉兴宏越及其关联方，包括嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III, L.P.出具了《关于关联交易问题的承诺函》，具体承诺如下：

1、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除澜起科技及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式侵占澜起科技资金。

2、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、本单位及本单位控制或影响的其他企业与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

4、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止关联交易。

澜起科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员出具《关于关联交易问题的承诺函》，承诺如下：

1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。

2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止该等关联交易。

第八节 财务会计信息与管理层分析

一、财务会计信息

瑞华会计师对公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度、2017年度、2018年度的合并及公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，并出具了“瑞华审字[2019]01500039号”标准无保留意见的《审计报告》。

非经特别说明，本节所列财务数据，均引自经瑞华会计师审计的公司财务报告，或根据其中相关数据计算得出；公司提醒投资者关注和阅读本招股说明书附件之财务报表及审计报告全文，以获取全部的财务会计信息。非经特别说明，本节所列财务数据均为合并口径。

（一）合并报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：			
货币资金	3,679,991,286.52	687,785,870.02	454,350,944.85
应收票据及应收账款	241,149,221.21	119,257,936.02	58,796,433.62
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	241,149,221.21	119,257,936.02	58,796,433.62
预付款项	1,127,606.00	269,404.25	3,031,159.49
其他应收款	30,030,818.73	253,554,886.96	20,367,622.01
其中：应收利息	3,910,273.97	1,477,982.33	51,318.54
应收股利	-	-	-
存货	120,673,539.09	132,512,927.60	256,069,373.64
其他流动资产	13,559,819.74	232,823,013.41	285,860,439.08
流动资产合计	4,086,532,291.29	1,426,204,038.26	1,078,475,972.69
非流动资产：			
固定资产	23,150,271.53	7,323,745.15	12,164,203.35
在建工程	3,354,629.91	-	-

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
无形资产	25,970,718.92	20,788,374.67	17,948,135.59
长期待摊费用	1,702,797.13	3,344,987.97	2,002,483.65
递延所得税资产	39,946,688.52	17,032,130.67	10,753,256.70
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	94,125,106.01	48,489,238.46	42,868,079.29
资产总计	4,180,657,397.30	1,474,693,276.72	1,121,344,051.98
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	74,377,569.10	107,313,316.50	112,210,378.92
预收款项	-	56,082,907.92	29,366,930.63
应付职工薪酬	178,958,525.67	58,031,978.48	33,923,218.03
应交税费	47,431,535.71	16,452,943.38	11,292,235.67
其他应付款	126,256,238.02	29,976,477.45	33,439,384.81
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	58,440,420.22	-	-
流动负债合计	427,023,868.50	267,857,623.73	220,232,148.06
非流动负债：			
递延收益	137,883,763.87	19,828,000.00	18,088,000.00
非流动负债合计	137,883,763.87	19,828,000.00	18,088,000.00
负债合计	564,907,632.37	287,685,623.73	238,320,148.06
股东权益：			
股本	1,016,832,500.00	757,031,775.00	757,031,775.00
资本公积	1,831,073,283.54	66,184,927.14	66,184,927.14
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	73,002,697.56	14,937,153.45	57,869,365.96
盈余公积	30,744,788.49	36,478,525.97	19,085,794.56
未分配利润	664,096,495.34	312,375,271.43	-17,147,958.74
归属于母公司股东权益合计	3,615,749,764.93	1,187,007,652.99	883,023,903.92
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	3,615,749,764.93	1,187,007,652.99	883,023,903.92

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债和股东权益总计	4,180,657,397.30	1,474,693,276.72	1,121,344,051.98

2、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	1,757,664,583.13	1,227,514,932.70	844,944,635.26
其中：营业收入	1,757,664,583.13	1,227,514,932.70	844,944,635.26
二、营业总成本	1,014,050,218.74	939,836,352.65	756,044,737.50
其中：营业成本	517,733,992.05	570,952,308.32	412,309,129.40
税金及附加	822,303.81	3,078,326.10	4,784,967.14
销售费用	127,216,436.19	68,927,261.69	52,237,040.31
管理费用	112,784,352.24	51,790,479.61	47,754,089.97
研发费用	276,695,196.11	188,269,250.98	198,226,869.86
财务费用	-34,515,915.88	3,075,288.56	-14,667,200.71
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	21,097,004.42	7,223,775.55	361,206.33
资产减值损失	13,313,854.22	53,743,437.39	55,399,841.53
加：其他收益	21,984,190.58	12,017,648.50	-
投资收益（损失以“－”号填列）	17,304,593.27	6,195,816.79	473,164.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	56,810,372.99	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	782,903,148.24	362,702,418.33	89,373,062.31
加：营业外收入	3,359,318.71	10,000.00	9,820,120.52
减：营业外支出	30,263.93	342,369.72	100,679.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	786,232,203.02	362,370,048.61	99,092,503.78
减：所得税费用	49,353,764.81	15,454,087.03	6,288,218.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	736,878,438.21	346,915,961.58	92,804,284.98
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	736,878,438.21	316,813,088.95	187,809,448.54
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	30,102,872.63	-95,005,163.56

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
(二) 按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	736,878,438.21	346,915,961.58	92,804,284.98
六、其他综合收益的税后净额	58,065,544.11	-42,932,212.51	37,541,256.62
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	58,065,544.11	-42,932,212.51	37,541,256.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58,065,544.11	-42,932,212.51	37,541,256.62
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	58,065,544.11	-42,932,212.51	37,541,256.62
6、其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	794,943,982.32	303,983,749.07	130,345,541.60
归属于母公司股东的综合收益总额	794,943,982.32	303,983,749.07	130,345,541.60
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	0.87	0.46	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.87	0.46	0.12

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,586,139,312.67	1,218,707,427.65	826,420,066.97
收到的税费返还	4,564,018.98	36,245,552.11	31,414,691.08
收到其他与经营活动有关的现金	334,262,213.53	30,942,089.95	275,092,841.87
经营活动现金流入小计	1,924,965,545.18	1,285,895,069.71	1,132,927,599.92
购买商品、接受劳务支付的现金	565,201,323.23	563,352,872.31	455,132,917.40
支付给职工以及为职工支付的现金	187,322,659.84	134,996,920.85	186,941,487.29
支付的各项税费	44,870,822.65	41,662,817.99	3,464,735.92
支付其他与经营活动有关的现金	158,423,737.78	319,051,082.22	100,303,694.35
经营活动现金流出小计	955,818,543.50	1,059,063,693.37	745,842,834.96
经营活动产生的现金流量净额	969,147,001.68	226,831,376.34	387,084,764.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,794,600,000.00	490,764,000.00	161,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,394,319.30	6,195,816.79	473,164.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,575,553.18	48,390,670.03	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,828,569,872.48	545,350,486.82	161,473,164.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,894,430.06	57,634,932.49	4,612,575.67
投资支付的现金	1,910,600,000.00	450,000,000.00	379,533,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,928,494,430.06	507,634,932.49	384,145,575.67
投资活动产生的现金流量净额	-99,924,557.58	37,715,554.33	-222,672,411.12

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,932,068,992.62	-	4,524,382,992.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,932,068,992.62		4,524,382,992.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,830,442.78	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	4,553,910,324.03
筹资活动现金流出小计	239,830,442.78	-	4,553,910,324.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,238,549.84	-	-29,527,332.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,109,746.24	-31,765,479.18	25,101,025.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,637,570,740.18	232,781,451.49	159,986,047.79
加：期初现金及现金等价物余额	686,585,546.34	453,804,094.85	293,818,047.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,324,156,286.52	686,585,546.34	453,804,094.85

（二）母公司报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：			
货币资金	2,002,930,223.45	21,409,521.96	153,945,212.30
应收票据及应收账款	399,385,684.93	246,953,197.65	83,626,639.67
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	399,385,684.93	246,953,197.65	83,626,639.67
预付款项	162,606.48	246,935.85	1,125,753.29

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
其他应收款	303,602,794.87	31,530,085.60	18,951,211.04
其中：应收利息	3,910,273.97	-	51,318.54
应收股利	274,528,000.00	-	-
存货	-	-	91,179,175.62
其他流动资产	4,466,506.37	131,806,703.93	77,390,081.06
流动资产合计	2,710,547,816.10	431,946,444.99	426,218,072.98
非流动资产：			
长期股权投资	777,093,763.12	777,093,763.12	577,093,763.12
固定资产	12,870,840.20	6,470,459.02	10,063,019.35
无形资产	11,579,020.26	19,397,448.14	652,845.97
长期待摊费用	1,695,344.93	3,295,593.67	1,902,201.61
递延所得税资产	2,575,120.32	2,698,264.76	702,889.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	805,814,088.83	808,955,528.71	590,414,719.92
资产总计	3,516,361,904.93	1,240,901,973.70	1,016,632,792.90
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	282,980.66	3,351,117.23	42,825,046.63
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	173,199,696.72	54,491,291.56	30,648,387.33
应交税费	29,379,487.87	16,299,997.91	9,198,014.40
其他应付款	176,183,424.76	101,858,254.29	43,527,345.89
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	58,440,420.22	-	-
流动负债合计	379,045,590.01	176,000,660.99	126,198,794.25
非流动负债：			
递延收益	14,650,000.00	18,328,000.00	17,788,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	14,650,000.00	18,328,000.00	17,788,000.00

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债合计	393,695,590.01	194,328,660.99	143,986,794.25
股东权益：			
股本	1,016,832,500.00	757,031,775.00	757,031,775.00
资本公积	1,831,073,283.54	66,184,927.14	66,184,927.14
盈余公积	30,744,788.49	36,478,525.97	19,085,794.56
未分配利润	244,015,742.89	186,878,084.60	30,343,501.95
股东权益合计	3,122,666,314.92	1,046,573,312.71	872,645,998.65
负债和股东权益总计	3,516,361,904.93	1,240,901,973.70	1,016,632,792.90

2、母公司利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	509,812,071.36	539,315,588.75	428,016,452.48
减：营业成本	-	252,588,340.45	292,222,297.38
税金及附加	743,504.00	2,960,223.91	4,768,512.34
销售费用	32,159,811.93	22,808,433.10	29,308,154.78
管理费用	98,742,103.57	40,339,823.96	35,787,223.81
研发费用	197,828,551.66	76,458,181.97	37,891,088.41
财务费用	-13,768,375.32	9,448,386.35	-14,406,768.10
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	831,838.79	785,542.89	309,604.63
资产减值损失	1,965,759.11	6,362,002.53	694,700.44
加：其他收益	14,972,173.88	11,717,648.50	-
投资收益（损失以“-”号填列）	289,729,529.05	3,316,382.19	-3,945,432.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	50,806,135.38	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,842,419.34	194,190,362.55	37,805,811.29
加：营业外收入	2,000.00	-	8,373,594.74
减：营业外支出	-	194,101.66	100,485.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,844,419.34	193,996,260.89	46,078,921.01
减：所得税费用	54,549,546.75	20,068,946.83	3,492,101.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,294,872.59	173,927,314.06	42,586,819.70

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	442,294,872.59	134,183,586.42	81,445,293.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	39,743,727.64	-38,858,473.94
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-	-
6、其他	-	-	-
六、综合收益总额	442,294,872.59	173,927,314.06	42,586,819.70

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	371,639,760.00	397,319,975.12	436,134,749.84
收到的税费返还	4,060,709.11	36,245,552.11	31,414,691.08
收到其他与经营活动有关的现金	31,412,551.71	128,025,332.26	96,014,079.69
经营活动现金流入小计	407,113,020.82	561,590,859.49	563,563,520.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,765,433.03	182,663,696.86	271,138,234.72
支付给职工以及为职工支付的现金	158,431,656.54	109,299,325.10	146,303,075.89
支付的各项税费	44,558,893.66	39,515,720.73	3,231,323.32
支付其他与经营活动有关的现金	36,364,965.82	87,950,509.33	45,692,675.50
经营活动现金流出小计	248,120,949.05	419,429,252.02	466,365,309.43

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	158,992,071.77	142,161,607.47	97,198,211.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,444,000,000.00	215,000,000.00	161,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,391,255.08	3,316,382.19	473,164.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,895,150.60	31,542,830.04	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	2,199,022.44
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,457,286,405.68	249,859,212.23	163,672,186.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,103,399.09	39,416,862.28	3,029,466.92
投资支付的现金	1,660,000,000.00	480,000,000.00	4,704,382,992.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,672,103,399.09	519,416,862.28	4,707,412,458.92
投资活动产生的现金流量净额	-214,816,993.41	-269,557,650.05	-4,543,740,271.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,932,068,992.62	-	4,524,382,992.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,932,068,992.62		4,524,382,992.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,830,442.78	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	239,830,442.78		
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,238,549.84		4,524,382,992.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-563,603.03	-5,122,121.44	3,887,212.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,635,850,025.17	-132,518,164.02	81,728,144.08
加：期初现金及现金等价物余额	20,880,198.28	153,398,362.30	71,670,218.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,656,730,223.45	20,880,198.28	153,398,362.30

（三）注册会计师审计意见

瑞华会计师审计了澜起科技财务报表，包括2018年12月31日、2017年12月31日、

2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度、2017年度、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

瑞华会计师针对澜起科技出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2019]01500039号），认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澜起科技2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度、2017年度、2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

（四）关键审计事项

关键审计事项是瑞华会计师根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，瑞华会计师不对这些事项单独发表意见。瑞华会计师确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、收入确认

（1）事项描述

公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮[®]服务器 CPU 以及混合安全内存模组。澜起科技 2016 至 2018 年度的营业收入分别为 844,944,635.26 元、1,227,514,932.70 元和 1,757,664,583.13 元，且报告期内营业收入快速增长。由于收入是澜起科技的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，瑞华会计师将收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，瑞华会计师实施的主要程序如下：

- 1) 了解和评价澜起科技与销售及收款相关的内部控制制度的设计和执行；
- 2) 执行分析性复核程序，评价销售收入和毛利变动的合理性；
- 3) 执行抽样测试，检查了客户订单、发票、仓库发货单等文件，并与海关出口报关数据等支持性文件进行了核对；
- 4) 根据客户交易的特点与性质，对应收账款余额和销售收入金额选取样本执行了函证程序；

5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，检查销售收入是否计入恰当的会计期间。

2、存货跌价准备

(1) 事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起科技合并财务报表中存货账面余额 201,437,141.74 元，存货跌价准备余额 80,763,602.65 元，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。澜起科技的存货为芯片产品，存在技术更新和产品过时的风险，且在确定存货的可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，计提存货减值的金额对合并财务报表影响较大，瑞华会计师将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对存货跌价准备，瑞华会计师实施的主要程序如下：

- 1) 了解和评价澜起科技存货跌价准备相关的内部控制制度的设计和执行；
- 2) 对澜起科技存货实施监盘，检查了存货的数量、状况；
- 3) 获取澜起科技存货的期末库龄清单，结合产品的特点，对库龄较长的存货产生原因进行检查；
- 4) 获取澜起科技存货跌价准备计算表，对存货的可变现净值及存货的减值计提金额进行复核。

3、消费电子芯片业务转让

(1) 事项描述

2017 年 7 月 31 日，澜起科技将与消费电子芯片业务相关的资产转让给关联企业成都澜至、澜至半导体及 Montage Group。鉴于此次交易涉及终止经营和关联方交易，并且转让定价涉及管理层运用重大会计估计和判断，瑞华会计师将此次消费电子芯片业务的转让作为 2017 年度的关键审计事项。

(2) 审计应对

针对消费电子芯片业务转让，瑞华会计师实施的主要审计程序如下：

- 1) 了解和评价公司资产处置相关的内部控制制度的设计和执行；
- 2) 获取用于本次资产处置的资产评估报告，评价资产评估报告所采用的评估方法的恰当性、分成率和折现率等主要参数的合理性，从而判断资产处置定价的合理性；
- 3) 获取管理层编制的本次资产处置收益明细表，复核资产处置收益的准确性；

4) 检查资产处置的董事会决议、协议、发票、权属变更记录及期后收款情况，判断资产处置相关的会计处理是否恰当。

（五）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、合并财务报表范围及变化情况

（1）合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表范围变更情况说明

①2016年发生的同一控制下企业合并

1) 2016年发生的同一控制下企业合并概况

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例（%）	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
澜起开曼	100.00	受同一母公司控制	2016-5-31	获得股东同意并实际取得公司控制权

注：公司合并澜起开曼时，公司、澜起开曼受同一母公司 Montage HK 控制。

单位：元

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	2015年被合并方的收入	2015年被合并方的净利润
澜起开曼	293,687,875.38	80,513,091.81	935,339,672.34	216,240,621.25

2) 合并成本

合并成本	澜起开曼
—现金	4,524,382,992.00

3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	澜起开曼	
	合并日	上年年末
资产：		
货币资金	333,081,466.21	218,440,011.53
应收款项	78,132,297.09	35,990,604.61
预付账款	742,789.30	376,414.84
其他应收款	66,914,349.39	212,923,250.66
存货	166,230,157.21	199,978,966.34
其他流动资产	956,159.89	105,723.54
固定资产	3,375,037.99	3,667,008.97
无形资产	18,391,568.71	19,059,693.06
长期待摊费用	197,188.69	307,124.82
递延所得税资产	1,435,067.27	1,721,133.03
负债：		
应付账款	29,881,075.30	39,468,483.41
预收账款	29,198,236.48	23,767,841.99
应付职工薪酬	891,284.69	3,094,565.86
应交税费	707,178.95	606,019.44
其他应付款	39,313,723.65	124,983,199.28
递延所得税负债	2,370,819.56	2,340,044.67
净资产	567,093,763.12	498,309,776.75
减：少数股东权益		
取得的净资产	567,093,763.12	498,309,776.75

②其他原因的合并范围变动

1) 2018年度合并范围较2017年增加三级子公司2家：澜起半导体、澜起电子上海。

其中：澜起半导体由公司二级子公司澜起电子昆山设立并持有其100.00%股权；澜起电子上海由公司及其二级子公司澜起电子昆山共同设立，公司持有其49.00%股份，公司二级子公司澜起电子昆山持有其51.00%股份。

2) 2017年度合并范围较2016年增加1家二级子公司，系2017年投资设立的澜起电子昆山，公司持有其100.00%股权。

3) 2016年度合并范围较2015年合并范围减少1家二级子公司，系注销子公司Montage Technology Company Limited；增加一家三级子公司，系澜起香港。

二、重要会计政策和会计估计

经营成果方面主要分析影响营业收入、利润总额和净利润5%以上事项；资产质量方面主要分析占流动资产或非流动资产比例5%以上事项；偿债能力方面主要分析占负债总额5%以上事项；上述三个方面年度间财务数据变动，主要分析变动金额重大且变动比例超过30%的事项；现金流量表主要分析经营活动现金流量；其他方面分析主要考虑会对公司未来经营成果、财务状况、现金流量、流动性及持续经营能力造成重大影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。

（一）会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

（二）记账本位币

人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

发行人报告期内不存在非同一控制下企业合并。

（四）合并财务报表的编制方法

本公司合并范围包括公司及全部控制的子公司。

（五）现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的上月的月末汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑

差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的上月的月末汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的上月的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

（七）金融工具

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（2）金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

报告期内，发行人金融资产主要系应收款项。应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

应收款项减值是以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（4）金融负债

报告期内，发行人不存在金融负债。

（八）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将金额为人民币500.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄
其他组合	（1）合并范围内及对关联公司资金拆借的应收款项（2）房租押金

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	个别认定法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	-	-
其中：3个月以内	0.00	0.00
3~12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

b. 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
其他组合	对组合内关联方应收款项、房租押金单独测试计提坏账	

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司将金额为人民币500.00万元以下的应收款项确认为单项金额不重大的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（九）存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按计划成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十）长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。本公司对子公司投资采用成本法核算。

（十一）固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入公司，且其成本

能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“（十五）长期资产减值”。

（十二）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“（十五）长期资产减值”。

（十三）无形资产

（1）无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“（十五）长期资产减值”。

（十四）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司的长期待摊费用主要包括租赁房屋装修款等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十五）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）职工薪酬

公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（十七）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十八）股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（十九）收入

报告期内公司主要收入为商品销售收入。收入确认原则系：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售模式分为三类：直销、经销、代销。

对于直销、经销：本公司的商品销售根据与客户签订的销售合同（订单）发货，在商品送达客户指定的交货地点，取得对方客户确认时作为风险报酬的转移时点，确认销售收入；其中本公司的出口销售业务，根据与客户签订的销售合同（订单）发货，公司持发票、送货单等原始单证进行报关出口，完成出口报关手续作为风险报酬的转移时点，根据出库单、发票和报关文件确认销售收入。

对于代销：如客户购买本公司的产品超过一定期限仍未实现对外销售时，客户可以退货给本公司的，或产品最终售价在客户销售给最终客户时才能确定的，则在收到客户对外销售的清单时，确认销售收入。

（二十）政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补

助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

此外，对与子公司相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资

产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十二）其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（二十三）重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（8）预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

三、非经常性损益

（一）非经常性损益的具体内容及金额

以下非经常性损益以合并财务报表数据为基础，并经瑞华会计师事务所出具的《关于澜起科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（瑞华核字[2019]01500001号）核验。

报告期公司非经常性损益具体内容、金额明细如下：

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动性资产处置损益	-	56,617,078.36	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	828,060.84	-	732,908.63
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,156,129.74	12,027,648.50	8,984,641.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,538,086.49	4,688,074.79	-
委托他人投资或管理资产的损益	30,447,093.27	6,195,816.79	473,164.55
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-	80,513,091.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,142,500.00	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,329,054.78	-149,075.09	1,890.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小计	44,155,925.12	79,379,543.35	90,705,697.83
所得税影响额	5,723,424.88	6,837,898.51	1,055,365.86
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	38,432,500.24	72,541,644.84	89,650,331.97

（二）非经常性损益对当期经营成果的影响

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
归属于母公司股东的非经常性损益	3,843.25	7,254.16	8,965.03
归属于母公司所有者的净利润	73,687.84	34,691.60	9,280.43
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比重	5.22%	20.91%	96.60%
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	69,844.59	27,437.43	315.40

2016年至2018年，公司的非经常性损益分别为8,965.03万元、7,254.16万元和3,843.25万元，分别占各期比例为96.60%、20.91%和5.22%，比例逐年下降。2016年公司的非经常性损益金额及占比较大主要系2016年公司为进一步精简管理及股权层级，澜起有限受让了Montage Group持有的澜起开曼100%股权，自年初至合并日的当期净利润为8,051.31万元计入非经常性损益所致；2017年公司的非经常性损益主要系2017年公司转让消费电子芯片业务资产所致；2018年公司的非经常性损益主要系理财产品投资收益及政府补助所致。

四、主要税种及税收政策

（一）主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按税法规定的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，税率为免税、零税率、6%、11%/10%、17%/16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

报告期内公司及子公司企业所得税税率为：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10.00%
苏州澜起微电子科技有限公司	12.50%、25.00%
澜起电子科技（昆山）有限公司	25.00%
昆山澜起半导体有限公司	25.00%
澜起电子科技（上海）有限公司	25.00%
澜起澳门	豁免，详见注1

纳税主体名称	所得税税率
澜起开曼	详见注2
澜起香港	16.50%，详见注2
澜起美国	详见注3
澜起宝石	详见注3

注1：澜起澳门注册地为澳门，根据澳门特别行政区颁布的第58/99/M号离岸业务法律制度，“第十二条一、获许可在澳门地区营运之离岸机构享有下列优惠：a) 豁免从事离岸业务获得之收益之所得补充税”，该子公司豁免企业所得税。2018年12月27日澳门特别行政区通过第15/2018号废止离岸业务法律制度，该制度“第四条一、现有从事离岸业务的许可，如在2021年1月1号前未失效或未被废止，则自该日起失效”，即该子公司豁免企业所得税的优惠自2021年1月1日起失效。

注2：澜起开曼注册地为英属开曼群岛，不征收企业所得税，澜起香港注册地为香港特别行政区，执行香港利得税税率16.50%。

注3：澜起美国和澜起宝石注册地为美国，2016年-2017年度执行美国联邦超额累进税率15.00%-35.00%，加利福尼亚州州税8.84%；2018年1月起，根据《减税和就业法案》规定：美国联邦企业所得税税率将由35.00%降至21.00%。

（二）税收优惠及批文

1、增值税

公司增值税率为免税、零税率、6%、11%/10%、17%/16%。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号附件3第一条第（二十六）款，纳税人提供技术转让免征增值税。公司提供特许权使用免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号附件4第一条第（三）款，向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务适用增值税零税率。公司向境外公司提供技术开发服务适用零税率。

公司其他经营租赁服务适用税率11%/10%，其他现代服务适用税率6%。

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》财税[2018]32号规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

2、企业所得税

（1）本公司于2014年9月4日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：

GR201431000169，有效期：三年。本公司可于2014年9月4日至2017年9月3日减按15.00%税率征收企业所得税。

本公司于2017年11月23日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201731001462，本公司可于2017年11月23日至2020年11月22日减按15.00%税率征收企业所得税。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），本公司符合国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的认定标准并向主管税务机关备案，2016-2018年度减按10.00%的适用税率缴纳企业所得税。

（2）子公司澜起苏州法定企业所得税率为25.00%，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），公司自弥补累计税务认定亏损后的首个获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。2012年度为澜起苏州弥补累计税务认定亏损后的首个获利年度。因此，2012年度和2013年度免征企业所得税，2014年至2016年减半征收企业所得税，税率为12.50%。2017及2018年度适用税率25.00%。

（三）公司主要税种税款缴纳情况

单位：万元

税种	报告期间	年初应缴数	已缴税额	年末应缴数
增值税	2018年度	182.88	203.38	-
	2017年度	-	2,033.05	182.88
	2016年度	-	-	-
增值税小计		182.88	2,236.44	182.88
企业所得税	2018年度	1,284.40	4,199.53	4,633.38
	2017年度	462.19	1,392.38	1,284.40
	2016年度	344.21	329.05	462.19
企业所得税小计		2,090.80	5,920.96	6,379.97

合计	2,273.68	8,157.40	6,562.85
----	-----------------	-----------------	-----------------

注：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司预缴企业所得税 42,618.40 元。

报告期内，公司主要税种已缴税额合计为 8,157.40 万元，其中已缴增值税额为 2,236.44 万元，已缴企业所得税额 5,920.96 万元。报告期末公司增值税应缴税额为 0 元，企业所得税应缴税额为 4,633.38 万元。

如果税务主管部门对相关税收优惠政策进行调整，或者公司不再满足享受税收优惠政策的条件，则将对公司的经营业绩产生一定影响。

五、主要财务指标

（一）基本财务指标

主要财务指标	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度	2016-12-31/ 2016 年度
流动比率（倍）	9.57	5.32	4.90
速动比率（倍）	9.29	4.83	3.73
资产负债率	13.51%	19.51%	21.25%
应收账款周转率（次/年）	9.75	13.79	18.94
存货周转率（次/年）	4.09	2.94	1.61
息税折旧摊销前利润（万元）	80,803.11	38,152.00	11,343.48
归属于母公司股东的净利润（万元）	73,687.84	34,691.60	9,280.43
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	69,844.59	27,437.43	315.40
研发投入占营业收入的比例	15.74%	15.34%	23.46%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.95	0.30	0.51
每股净现金流量（元）	2.59	0.31	0.21
基本每股收益（元）	0.87	0.46	0.12
稀释每股收益（元）	0.87	0.46	0.12
归属于母公司股东的每股净资产（元）	3.56	1.57	1.17
加权平均净资产收益率	37.11%	33.52%	11.35%

注：上述财务指标计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- （3）资产负债率=（总负债/总资产）×100%
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- （6）息税折旧摊销前利润=净利润+企业所得税+利息支出+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费

用摊销

(7) 研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

(8) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

(9) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

(10) 基本每股收益= $P \div S$

$S=S_0+S_1+S_2 \div 2+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（未超出期初净资产部分）；S₂ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（超出期初净资产部分）；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

(11) 报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(12) 归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末总股本

(13) 加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。

六、经营成果分析

报告期内随着云计算和人工智能对服务器需求的持续增长，推动服务器内存及内存接口芯片需求的持续增长。

公司经过多年的技术积累，是全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，公司发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC（全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准。因此，随着产品竞争力的不断提高，报告期内公司内存接口芯片的市场占有率不断提升，从而推动公司收入快速增长。

公司坚持自主创新并注重知识产权保护，截至2019年4月1日，公司已获授权专利90项，获集成电路布图设计证书39项。2016年度、2017年度和2018年度，公司研发投入分别为19,822.69万元、18,826.93万元和27,669.52万元，研发投入较大，且占营业收入的比例保持在15%以上，高研发投入形成了公司的核心竞争力，使得公司的内存接口芯片毛利率维持在较高水平。

报告期内公司客户和供应商关系稳定，且主要客户均为国际知名企业，综合实力较强，业务规模较大，有利于公司业务发展的稳定性和持续性。而且公司主要客户的资产规模较大，信用状况良好，应收账款均可按相关约定及时回款，从而保障报告期内公司经营现金流三年总额与净利润总额相匹配，体现了较高的盈利质量。

（一）营业收入结构及趋势分析

1、营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

单位：万元

产品名称	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务	175,766.46	100.00%	115,517.45	94.11%	84,314.84	99.79%
内存接口芯片	174,865.26	99.49%	93,466.80	76.14%	55,832.67	66.08%
消费电子芯片	-	-	21,291.01	17.34%	28,482.17	33.71%
津逮 [®] 服务器平台	901.20	0.51%	759.64	0.62%	-	-
其他业务	-	-	7,234.04	5.89%	179.62	0.21%
合计	175,766.46	100.00%	122,751.49	100.00%	84,494.46	100.00%

2016 年至 2017 年公司的产品包括内存接口芯片和消费电子芯片。2017 年 7 月，公司对消费电子芯片业务资产进行了转让，转让完成后公司的产品包括内存接口芯片和津逮[®]服务器平台。2016 年、2017 年和 2018 年度，主营业务收入占当期营业收入的比重分别为 99.79%、94.11%和 100.00%，主营业务突出，其中公司内存接口芯片收入占比分别为 66.08%、76.14%和 99.49%，为报告期内公司的主要产品。

2016 年至 2018 年，公司分别实现营业收入 84,494.46 万元、122,751.49 万元和 175,766.46 万元。2017 年公司营业收入较 2016 年增长 38,257.03 万元，上升 45.28%，2018 年公司营业收入较 2017 年增长 53,014.97 万元，上升 43.19%。随着信息技术创新进入新一轮加速期，物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术和应用开始在全球范围内普及，促使新建数据中心数量大幅增加，并向大规模、超大规模的方向发展，进而带动了全球服务器及其核心部件内存接口芯片市场需求增加。报告期内营业收入保持平稳快速增长，主要原因是全球内存接口芯片的市场需求持续增长，同时公司的产品竞争优势日趋明显，促使公司在内存接口芯片全球市场占有率进一步提升，从而推动公司营业收入的快速增长。

2017 年公司其他业务收入较高，主要原因是公司向成都澜至和 Montage Group 转售消费电子芯片业务资产中原材料和半成品形成的收入。

2、主营业务收入的销售模式构成

报告期内，公司分主要产品及销售模式的具体情况如下：

单位：万元

产品类别	销售模式	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
内存接口芯片	直销	138,045.67	78.54%	65,650.52	56.83%	48,036.29	56.97%
	代销	36,819.58	20.95%	27,816.28	24.08%	7,796.39	9.25%
	经销	-	-	-	-	-	-
	合计	174,865.26	99.49%	93,466.80	80.91%	55,832.67	66.22%
消费电子芯片	直销	-	-	12,492.88	10.81%	6,057.65	7.18%
	代销	-	-	8,795.66	7.61%	19,001.96	22.54%
	经销	-	-	2.48	0.00%	3,422.56	4.06%
	合计	-	-	21,291.01	18.43%	28,482.17	33.78%

公司消费电子芯片采取代销为主的销售模式，而内存接口芯片采取直销为主的销售模式。2016 年至 2018 年，内存接口芯片直销收入占比分别为 56.97%、56.83% 和 78.54%，2017 年和 2018 年内存接口芯片代销收入逐年上升，主要系 2017 年代销商富昌电子的采购上升所致；2017 年消费电子芯片直销收入上升主要系公司 2017 年转让消费电子芯片业务相关资产所致。

公司发出商品系代销模式下公司已发给代销商，但代销商未销售至最终客户的存货部分。2016 年、2017 年和 2018 年，公司各期末发出商品金额分别为 2,349.50 万元、2,211.10 万元和 62.11 万元。公司 2018 年末发出商品金额大幅下降主要原因如下：

2018 年，公司内存接口芯片业务的主要代销商为富昌电子，富昌电子是最终客户美光科技指定的与公司合作的代销商（买方代理）。经过多年合作，公司已成为美光科技合格供应商。2018 年末美光科技经与公司、富昌电子协商确定，后续由公司直销给美光科技，从而结束与富昌电子的代销关系。因此，2018 年末开始，公司直接将内存接口芯片发货给美光科技，公司不再向代销商富昌电子继续发货，且存放在富昌电子的产品基本已经销售给美光科技，导致公司 2018 年末发出商品大幅下降。综上，发出商品金额大幅减少具有合理性。

3、主营业务收入分产品分析

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
内存接口芯片	174,865.26	99.49%	93,466.80	80.91%	55,832.67	66.22%
消费电子芯片	-	-	21,291.01	18.43%	28,482.17	33.78%
津逮 [®] 服务器平台	901.20	0.51%	759.64	0.66%	-	-
合计	175,766.46	100.00%	115,517.45	100.00%	84,314.84	100.00%

（1）内存接口芯片

2016 年、2017 年、2018 年，公司内存接口芯片实现销售收入 55,832.67 万元、93,466.80 万元、174,865.26 万元，占主营业务收入比例分别为 66.22%、80.91%和 99.49%。2017 年和 2018 年内存接口芯片收入同比增长分别为 67.41%和 87.09%。报告期内，全球数据中心服务器内存市场需求的持续增长，公司凭借在 DDR4 内存接口芯片的技术先进性、可靠性和良好口碑，市场份额持续提升，因此报告期内公司内存接口芯片实现了销售额的快速提升，有力地推动了公司营业收入的大幅增长。

（2）消费电子芯片

2016 年至 2017 年 7 月公司曾从事家庭娱乐领域的消费电子芯片研发和销售，2016 年实现销售收入 28,482.17 万元；2017 年 1-7 月实现销售收入 21,291.01 万元。根据公司经营战略的调整，为了集中资源聚焦内存接口芯片和津逮[®]服务器平台的研发和销售，公司在 2017 年 7 月完成了消费电子芯片业务资产的转让。

4、营业收入国家和地区分布

单位：万元

序号	国别或地区	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
1	中国大陆	56,802.16	32.32%	49,414.00	40.26%	27,121.70	32.10%
2	韩国	51,522.89	29.31%	28,929.27	23.57%	43,232.96	51.17%
3	新加坡	37,400.30	21.28%	27,716.45	22.58%	7,572.90	8.96%
4	菲律宾	13,760.43	7.83%	1,623.96	1.32%	116.89	0.14%
5	美国	7,969.77	4.53%	8,077.69	6.58%	2,724.46	3.22%
6	其他	8,310.91	4.73%	6,990.13	5.69%	3,725.56	4.41%
	总计	175,766.46	100.00%	122,751.49	100.00%	84,494.46	100.00%

公司经过多年的发展，在行业内建立了良好口碑，积累了较为丰富的客户资源，销

售区域覆盖中国大陆、亚洲、欧洲、美洲等地，其中 2016 年公司在韩国、中国大陆和新加坡的销售收入占比较高，占比分别为 51.17%、32.10%和 8.96%；2017 年公司在中国大陆、韩国和新加坡的销售收入占比较高，占比分别为 40.26%、23.57%和 22.58%；2018 年公司在大陆、韩国和新加坡的销售收入占比较高，占比分别为 32.32%、29.31%和 21.28%。公司的境外销售区域主要包括韩国、新加坡、菲律宾和美国等地，其中 2017 年韩国销售占比下降主要系 2017 年原三星电子相关业务由三星苏州作为交易主体向公司进行采购所致；2017 年新加坡销售占比上升主要系 2017 年新加坡经销商富昌电子的采购上升所致；2018 年韩国及新加坡的销售占比较上年基本保持平稳，菲律宾销售占比上升主要系部分客户将产能转移到菲律宾公司所致。公司在菲律宾地区的销售主要来源于客户 SFA semicon Philippines Corporation，该客户为三星电子在菲律宾的委外加工厂。

公司主要通过澜起澳门进行境外采购和销售，暂未受到中美贸易摩擦的影响。

5、营业收入分客户分析

公司的主要客户是富昌电子、海力士、海太半导体、金士顿、淇诺科技、三星电子、中电器材（按照客户名称的首字母拼音排序）等。

（1）报告期内主要客户销售占比

1) 内存接口芯片报告期前五名客户情况

报告期内，发行人内存接口芯片主要客户为富昌电子、海力士、海太半导体、金士顿、三星电子、Hanyang Digitech Co.,Ltd 等。

①2018 年内存接口芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户A	47,335.46	26.93%	是
2	客户B	44,462.00	25.30%	是
3	客户C	36,518.00	20.78%	否
4	客户D	15,882.96	9.04%	是
5	客户E	14,150.43	8.05%	是
合计		158,348.84	90.10%	

注：上述销售金额按照同一控制下企业合并计算，下同

②2017年内存接口芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户A	29,245.46	23.82%	是
2	客户C	27,733.52	22.59%	否
3	客户B	21,680.19	17.66%	是
4	客户E	8,062.88	6.57%	是
5	客户D	2,361.08	1.92%	是
合计		89,083.13	72.57%	

③2016年内存接口芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户A	23,456.88	27.76%	是
2	客户B	13,645.89	16.15%	是
3	客户C	7,576.79	8.97%	否
4	客户D	4,414.16	5.22%	是
5	客户F	3,520.70	4.17%	是
合计		52,614.42	62.27%	

2) 消费电子芯片报告期前五名客户情况

报告期内，发行人消费电子芯片主要客户为成都澜至、北京东方广视科技股份有限公司、虹日科技、巨联信息科技（上海）有限公司、淇诺科技、中电器材、ILDO Korea Co., Ltd.等。

①2017年消费电子芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	成都澜至	15,621.38	12.73%	否
2	淇诺科技	5,794.89	4.72%	否
3	中电器材	1,915.58	1.56%	否
4	北京东方广视科技股份有限公司	1,280.84	1.04%	是
5	虹日科技	1,087.66	0.89%	否
合计		25,700.35	20.94%	

注：成都澜至销售金额包括成都澜至和 Montage Group

②2016年消费电子芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	淇诺科技	9,837.03	11.64%	否
2	虹日科技	4,607.12	5.45%	否
3	中电器材	4,560.85	5.40%	否
4	ILDO Korea Co., Ltd.	2,609.48	3.09%	否
5	巨联信息科技（上海）有限公司	1,771.36	2.10%	是
合计		23,385.84	27.68%	

报告期内，内存接口芯片前五名客户基本保持稳定，且均保持了长期的合作关系。2017年7月，发行人转让消费电子芯片业务相关的存货给成都澜至及其关联方，从而使其变成2017年消费电子芯片业务第一大客户。

报告期内，公司前五大客户销售相对集中，主要原因系根据相关行业统计数据，2018年前三季度，在DRAM市场，三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名，市场占有率合计超过90%，该行业集中度较高。而三星电子、海力士、美光科技均为公司的客户，因此造成公司客户收入占比较高。发行人已经覆盖了下游市场的主要参与者，报告期内发行人第一大客户占公司营业总收入的比重始终未超过30%，不存在对单一客户重大依赖的情形。

2016年以来，澜起科技与英特尔及清华大学鼎力合作，研发出津逮[®]系列服务器CPU。基于津逮[®]CPU及澜起科技的混合安全内存模组而搭建的津逮[®]服务器平台，实现了芯片级实时安全监控功能，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。该系列产品已于2018年底研发成功，目前正在市场推广阶段。随着相关产品的推广，相关服务器厂商将成为公司的客户。

公司始终坚持以技术研发为核心，不断研发新产品，丰富产品多样性，同时加强市场及客户拓展力度，增加下游客户多样性，从而降低客户集中度较高的风险。

6、营业收入季节性分析

发行人报告期内的各季度的主营业务收入变化情况如下：

季度	2018年度	2017年度	2016年度
----	--------	--------	--------

季度	2018年度	2017年度	2016年度
第一季度	33,705.61	23,999.83	17,475.95
第二季度	37,207.48	31,234.01	18,837.43
第三季度	54,206.42	35,622.14	20,155.38
第四季度	50,646.95	24,661.47	27,846.08
合计	175,766.46	115,517.45	84,314.84

根据上表显示，公司一季度销售金额相对其它季度较低，下半年销售金额比上半年销售金额相对较高，主要原因是受下游行业周期性及季节性需求波动影响。

（二）营业成本构成及趋势分析

1、营业成本结构分析

报告期内，公司营业成本总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	51,773.40	100.00%	49,861.19	87.33%	41,051.29	99.56%
其他业务成本	-	-	7,234.04	12.67%	179.62	0.44%
合计	51,773.40	100.00%	57,095.23	100.00%	41,230.91	100.00%

2016年、2017年和2018年，公司营业成本为41,230.91万元、57,095.23万元和51,773.40万元，主营业务成本占营业成本的比例分别为99.56%、87.33%和100.00%。2017年公司营业成本有所上升主要系主营业务中内存接口芯片销售规模增长，对应业务成本有所增加，同时2017年公司转让消费电子芯片相关原材料和半成品等相关资产时其相关成本计入其他业务成本所致。

2、主营业务成本分产品分析

单位：万元

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内存接口芯片	51,021.05	98.55%	31,928.76	64.04%	20,657.30	50.32%
消费电子芯片	-	-	17,354.33	34.81%	20,393.99	49.68%
津逮®服务器平台	752.35	1.45%	578.09	1.16%	-	-
合计	51,773.40	100.00%	49,861.19	100.00%	41,051.29	100.00%

2016年至2018年，公司内存接口芯片营业成本占比分别为50.32%、64.04%和98.55%，占比逐年上升，主要系公司于2017年完成了消费电子芯片业务资产转让，且内存接口芯片销售规模持续扩大所致。

3、主营业务成本分类别分析

报告期内公司的主营业务成本按照类别的金额构成如下：

单位：万元

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	20,676.55	39.94%	25,965.03	52.07%	23,244.85	56.62%
封装测试	28,979.03	55.97%	21,761.21	43.64%	16,728.21	40.75%
制造费用	2,117.83	4.09%	2,134.95	4.28%	1,078.23	2.63%
合计	51,773.40	100.00%	49,861.19	100.00%	41,051.29	100.00%

由于技术架构及工艺不同，公司的内存接口芯片成本构成中封装测试占比较大，消费电子芯片成本构成中晶圆占比较大。2017年7月公司将消费电子芯片业务资产进行了转让，此后不再从事消费电子芯片相关业务。因此，报告期内公司晶圆等直接材料的成本金额占比均呈下降趋势。随着内存接口芯片销售量不断提升，封装测试的成本金额占比均呈上升趋势。

2017年制造费用较2016年上升主要系内存接口芯片产品的成品测试费用增加所致。2018年制造费用较2017年基本保持稳定。

（三）营业毛利及毛利率分析

1、毛利分析

2016年度、2017年度和2018年度，公司营业毛利分别为43,263.55万元、65,656.26万元和123,993.06万元。2017年相比2016年增长22,392.71万元，上升51.76%，2018年相比2017年增长58,336.80万元，上升88.85%。报告期内，公司营业毛利持续增长，盈利能力不断增强，主要系公司内存接口芯片产品凭借其先进性能受到了市场的广泛认可，市场占有率不断上升，销售规模持续扩大且毛利率始终保持较高水平导致。

报告期内，公司营业毛利主要来源于主营业务，公司主营业务毛利按产品分类如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
内存接口芯片	123,844.21	99.88%	61,538.04	93.73%	35,175.37	81.30%
消费电子芯片	-	-	3,936.68	6.00%	8,088.18	18.70%
津逮®服务器平台	148.85	0.12%	181.54	0.28%	-	-
合计	123,993.06	100.00%	65,656.26	100.00%	43,263.55	100.00%

2016年至2018年内存接口芯片毛利占比分别为81.30%、93.73%和99.88%，内存接口芯片毛利占比逐年上升，主要系报告期内公司的内存接口芯片销售规模持续增长，同时2017年7月公司完成了消费电子芯片业务资产转让所致。

2、毛利率分析

报告期内，本公司毛利率情况如下表所示：

业务类别	2018 年度	2017 年度	2016 年度
主营业务	70.54%	56.84%	51.31%
其他业务	-	0.00%	-
合计	70.54%	53.49%	51.20%

2016年、2017年、2018年，公司综合毛利率分别为51.20%、53.49%和70.54%。2017年公司综合毛利率较2016年小幅上升，主要系公司毛利率较高的内存接口芯片销售占比上升所致；2018年公司综合毛利率较2017年有所上升，主要系2017年公司转让了消费电子芯片业务资产不再从事相关业务所致。

3、主营业务毛利率分析

报告期内，发行人主营业务分主要产品的毛利率数据分析如下表：

项目		报告期毛利率		
		2018 年度	2017 年度	2016 年度
主营业务 毛利率	内存接口芯片	70.82%	65.84%	63.00%
	消费电子芯片	-	18.49%	28.40%

内存接口芯片某一代具体产品的生命周期里，销售单价逐步降低；但随着技术迭代后，新产品因技术先进而导致售价将有所提高，因此内存接口芯片产品的平均销售单价在报告期内稳中有升，从而推动报告期内公司内存接口芯片毛利率逐年上升。2016年、2017年、2018年，公司内存接口芯片的毛利率分别为63.00%、65.84%和70.82%。

2016年至2018年公司内存接口芯片销售占比分别为66.08%、76.14%和99.49%，随着发行人的内存接口芯片收入及其占总收入的比重逐年提高，报告期内公司综合毛利率快速上升。

4、同行业可比公司对比分析

集成电路设计行业国内A股上市公司中，尚无公司与本公司研发销售相同的产品。公司选取的可比公司为汇顶科技（603160）和兆易创新（603986），虽然两家可比公司与本公司在终端应用、上下游细分市场情况、竞争状况等方面存在一定差异，但其经营规模、业务模式和盈利能力与本公司具有可比性，相关公司基本情况如下：

（1）汇顶科技

汇顶科技成立于2002年5月，总部位于深圳，是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案，并已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商。汇顶科技于2016年10月在上海证券交易所上市。根据2018年年报披露，汇顶科技2018年营业收入372,129.17万元，净利润74,249.86万元。

（2）兆易创新

兆易创新成立于2005年4月，总部位于北京，主要从事各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。兆易创新同样采用Fabless模式，产品应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边等领域，于2016年8月在上海证券交易所上市。根据2018年年报披露，兆易创新2018年营业收入为224,578.63万元，净利润为40,397.76万元。

发行人的境外主要竞争对手情况如下：

（1）IDT（IDTI.O）

IDT成立于1980年，总部位于美国，是一家为通信、计算机和消费类行业提供组合信号半导体解决方案的公司。IDT可提供DDR3和DDR4 LRDIMM存储器接口解决方案、Serial RapidIO[®]、PCI Express[®]交换机和网桥、信号完整性产品和电源管理解决方案，以满足企业服务器应用的需求。根据2019年财年前三季度定期报告统计，IDT 2019财年前三季度营业收入70,458.70万美元，净利润8,782.60万美元，其中内存接口芯片领域收入为20,678.70万美元，约占总收入比为30%。

（2）Rambus（RMBS.O）

Rambus成立于1990年，总部位于美国，是一家技术解决方案研发公司，并同时提供IP授权、安全研发、面向服务器的内存接口芯片组、高级LED照明设备和显示器以及拟真移动媒体领域的产品于服务。Rambus从创立之初便致力于高端存储产品的研究与开发，目前产品应用于高性能个人电脑、图形工作站、服务器和其他对带宽和时间延迟有一定要求的设备。根据Rambus 2018年年报披露，其2018年营业收入23,120.10万美元，净利润-15,795.70万美元，其中内存接口芯片领域收入为3,640.00万美元，约占总收入比例为15%。

发行人的境外主要竞争对手为IDT和Rambus，同行业可比公司与本公司的综合毛利率比较情况如下：

产品/服务名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Rambus	76.77%	79.87%	80.07%
IDT	60.95%	57.76%	60.46%
汇顶科技	52.18%	47.12%	47.14%
兆易创新	38.25%	39.16%	26.72%
行业本期平均毛利率	57.04%	55.98%	53.60%
澜起科技	70.54%	53.49%	51.20%
与平均毛利率差异	13.50%	-2.49%	-2.40%

注：Rambus、汇顶科技和兆易创新均采用 2018 年度数据，IDT 由于截至本招股说明书签署日前尚未公告 2019 财年年报，因此 IDT 采用 2018.4.2-2018.12.30（三季度）数据

汇顶科技和兆易创新与本公司在终端应用、上下游细分市场情况、竞争状况等方面存在一定差异，且发行人产品在其细分市场上技术先进且具有较强的市场竞争力，因此毛利率有所差异。公司竞争对手IDT和Rambus仅披露了综合毛利率，没有披露内存接口芯片的产品毛利率。总体来看，Rambus、IDT和澜起科技三家公司均体现了高毛利特征。其中IDT产品线较多，内存接口芯片占其收入比重为30%左右，而Rambus主要收入来源为IP版税收入且版税业务的毛利率较高，因此毛利率与发行人有所差异。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用情况如下表：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
----	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	12,721.64	7.24%	6,892.73	5.62%	5,223.70	6.18%
管理费用	11,278.44	6.42%	5,179.05	4.22%	4,775.41	5.65%
研发费用	27,669.52	15.74%	18,826.93	15.34%	19,822.69	23.46%
财务费用	-3,451.59	-1.96%	307.53	0.25%	-1,466.72	-1.74%
合计	48,218.01	27.43%	31,206.23	25.42%	28,355.08	33.56%

注：占比为占同期营业收入的比例

2016年、2017年、2018年，公司的期间费用分别28,355.08万元、31,206.23万元、48,218.01万元，占营业收入的比重分别为33.56%、25.42%和27.43%。2017年公司期间费用占营业收入的比例有所下降，主要系公司转让了消费电子芯片业务资产，相关职工薪酬和研发费用有所减少所致。2018年期间费用占营业收入的比例有所增加，主要系销售额增加导致销售佣金上升，且2018年公司业绩较好导致职工薪酬及福利增长所致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	4,354.40	34.23%	2,937.12	42.61%	3,064.94	58.67%
销售佣金	7,268.71	57.14%	2,795.95	40.56%	810.96	15.52%
专业服务及咨询费	305.21	2.40%	230.52	3.34%	230.57	4.41%
差旅费	231.65	1.82%	251.06	3.64%	330.51	6.33%
市场推广费	117.15	0.92%	25.03	0.36%	94.97	1.82%
物流相关费用	99.79	0.78%	135.62	1.97%	189.45	3.63%
业务招待费	35.84	0.28%	60.79	0.88%	89.31	1.71%
交通与通讯	11.04	0.09%	21.43	0.31%	29.70	0.57%
折旧	1.95	0.02%	3.92	0.06%	4.30	0.08%
其他	295.91	2.33%	431.28	6.26%	378.99	7.26%
合计	12,721.64	100.00%	6,892.73	100.00%	5,223.70	100.00%

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司的销售费用分别为 5,223.70 万元、6,892.73 万元和 12,721.64 万元，占同期营业收入的比例分别为 6.18%、5.62%和 7.24%，

公司销售费用控制较好。

报告期内，公司的销售费用主要由销售人员的职工薪酬、销售佣金和专业服务及咨询费等构成。其中销售佣金系公司委托境外销售服务代理机构进行市场开拓、客户服务而支付的佣金。2017年销售费用较2016年增加1,669.02万元，上升31.95%；2018年销售费用较2017年增加了5,828.92万元，上升84.57%，销售费用有所上升主要系内存接口芯片销售规模增加，公司支付的销售佣金费用随着销售金额的增加而上升。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	8,774.98	77.80%	2,826.39	54.57%	2,225.87	46.61%
租赁费	773.44	6.86%	904.82	17.47%	1,110.43	23.25%
专业服务及咨询费	765.19	6.78%	615.08	11.88%	600.55	12.58%
IT 软硬件费	228.10	2.02%	51.68	1.00%	70.59	1.48%
折旧	126.28	1.12%	194.68	3.76%	218.43	4.57%
差旅费	112.96	1.00%	130.22	2.51%	98.50	2.06%
办公及会议费	72.84	0.65%	60.54	1.17%	75.54	1.58%
水电物业费	64.67	0.57%	52.87	1.02%	128.44	2.69%
交通与通讯	63.78	0.57%	51.40	0.99%	57.23	1.20%
业务招待费	33.94	0.30%	27.17	0.52%	24.75	0.52%
其他	262.26	2.33%	264.19	5.10%	165.07	3.46%
合计	11,278.44	100.00%	5,179.05	100.00%	4,775.41	100.00%

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司的管理费用分别为 4,775.41 万元、5,179.05 万元和 11,278.44 万元，占同期营业收入的比例分别为 5.65%、4.22%和 6.42%。

公司的管理费用主要由职工薪酬、租赁费、专业服务及咨询费等构成。2017 年公司的管理费用较 2016 年增加 403.64 万元，上升 8.45%，因为公司总体薪资水平有所提升，因此管理费用合计较 2016 年小幅上升。2018 年公司的管理费用较 2017 年增加 6,099.39 万元，上升 117.77%，主要系公司当年业绩完成情况良好，支付的绩效奖金及员工年金较多所致。其中，报告期内租赁费下降，主要是由于转让消费电子芯片业务相关资产后，所需办公场所面积减少所致；报告期内专业服务及咨询费增长，主要是公

司聘请中介机构产生的相关费用。

管理费用中专业服务及咨询费的主要构成如下表：

单位：万元

主要构成	2018 年度	2017 年度	2016 年度
咨询顾问费	290.78	333.64	396.5
法律服务费	312.37	118.81	48.43
审计费及资产评估费	118.83	137.54	117.19
人力资源服务费	43.21	25.01	38.42
合计	765.19	615.08	600.55

3、研发费用

报告期内，公司研发费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	17,659.63	63.82%	9,973.58	52.98%	11,827.03	59.66%
工程费用	3,774.74	13.64%	4,646.75	24.68%	3,948.09	19.92%
协作开发费	1,568.70	5.67%	1,059.69	5.63%	1,368.25	6.90%
工具费	1,546.67	5.59%	215.68	1.15%	394.35	1.99%
许可证费	1,265.43	4.57%	975.05	5.18%	371.17	1.87%
IT 软硬件费	754.76	2.73%	779.62	4.14%	801.57	4.04%
折旧费	469.32	1.70%	478.56	2.54%	558.03	2.82%
专业服务及咨询费	156.89	0.57%	140.51	0.75%	138.80	0.70%
差旅费	88.02	0.32%	137.88	0.73%	224.67	1.13%
其他	385.36	1.39%	419.61	2.23%	190.74	0.96%
合计	27,669.52	100.00%	18,826.93	100.00%	19,822.69	100.00%

2016年、2017年、2018年，公司研发费用分别为19,822.69万元、18,826.93万元、27,669.52万元，占营业收入的比例分别为23.46%、15.34%和15.74%。报告期内，公司持续地进行研发投入，以保持公司技术前瞻性、领先性和核心竞争优势。公司的研发费用主要由职工薪酬、工程费用和协作开发费等构成。2017年研发费用较2016年略有下降，主要系2017年消费电子芯片业务资产转让使得公司研发技术人员人数阶段性减少所致。2018年研发费用较2017年有所上升，主要系公司研发部门人数增长且当年公司业绩较好导致职工薪酬有所增长。此外，工程费用先上升后下降，工程费用主要是流

片费用，流片费用的产生主要受研发项目的进度影响，一旦达到流片阶段就需列支工程费用。因此，该费用的波动具有合理性。研发费用中协作开发费先下降后上升，2017年协作开发费下降主要系公司不再从事消费电子芯片业务后，相关委托第三方协作开发项目终止；2018年协作开发费上升主要系公司开发津逮®服务器CPU需采购部分第三方技术开发服务所致。

研发费用中工程费用、协作开发费、工具费、许可证费的主要构成及变动原因如下：

项目	主要构成	具体用途	变动原因
工程费用	相关光罩、晶圆、封测等费用	研发工程样品试生产	产品更新换代，研发需要
协作开发费	委托对外技术开发服务	研发中需要的技术	产品更新换代，研发需要
工具费	研发工具采购	研发需要的工具	产品更新换代，研发需要
许可证费	短期及长期 IP 授权的许可费及摊销	研发所用 EDA 软件、License	产品更新换代，研发需要

报告期内，公司研发支出占营业收入的比重与同行业可比公司的比较情况如下：

公司名称	证券代码	2018年度	2017年度	2016年度
汇顶科技	603160.SH	22.53%	16.21%	10.00%
兆易创新	603986.SH	9.26%	7.08%	6.87%
行业平均		15.90%	11.64%	8.44%
澜起科技		15.74%	15.34%	23.46%

报告期内公司研发支出占营业收入的比例均高于行业平均值，主要系公司致力于集成电路设计领域的科技创新，注重研发的持续高投入，公司研发部门人数占总员工人数的70.98%，研发驱动也是公司保持核心竞争力的关键因素之一，因此研发投入占比较高具有合理性。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	2,109.70	722.38	36.12
汇兑损益	-1,353.40	1,015.91	-1,448.93
其他	11.51	14.00	18.33

合计	-3,451.59	307.53	-1,466.72
----	-----------	--------	-----------

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司的财务费用分别为-1,466.72 万元、307.53 万元和-3,451.59 万元。公司财务费用主要由利息收入和汇兑损益构成，2016 年美元兑人民币升值，公司产生的汇兑收益为 1,448.93 万元，2017 年美元兑人民币贬值，公司相应产生的汇兑损失为 1,015.91 万元，2018 年美元兑人民币升值，公司产生的汇兑收益为 1,353.40 万元。报告期内，公司利息收入主要来源于公司将短期闲置资金转为定期存款产生的利息收入，报告期内金额分别为 36.12 万元、722.38 万元和 2,109.70 万元。报告期内，公司财务费用占营业收入比例分别为-1.74%、0.25%、-1.96%，占比较低。

（五）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失构成明细如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
坏账损失	197.27	478.24	14.12
存货跌价损失	1,134.11	4,896.10	5,525.86
合计	1,331.39	5,374.34	5,539.98

公司资产减值损失主要由存货跌价损失和坏账损失构成。2016 年、2017 年、2018 年，公司存货跌价损失分别为 5,525.86 万元、4,896.10 万元和 1,134.11 万元，存货跌价损失逐年下降，2016 年及 2017 年公司的存货跌价损失较多主要系公司在大力开发拓展市场、全力抢占市场份额的发展阶段采用了积极的备货策略，由于部分产品技术迭代更新速度较快，公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备，造成存货跌价损失较大。2018 年存货跌价损失有所减少主要系公司优化了库存管理，有效地控制了公司有减值迹象的存货水平。报告期内，公司计提的坏账损失分别为 14.12 万元、478.24 万元和 197.27 万元，坏账损失占应收款项比例较小。

（六）其他收益

2016 年、2017 年、2018 年，公司其他收益为 0 元、1,201.76 万元和 2,198.42 万元，主要为政府补助，2018 年公司政府补助增长的主要系公司部分政府支持项目在 2018 年达到验收条件，在验收通过后计入当期损益所致，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度	与资产/收益 相关
2015 年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	200.00	-	-	与收益相关
2016 年上海市科委项目	592.80	-	-	与收益相关
2015 年上海市企业技术中心能力建设项目	80.00	-	-	与收益相关
2016 年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	500.00	-	-	与收益相关
个税手续费返还	82.81	-	-	与收益相关
上海市知识产权局专利资助	12.28	48.18	-	与收益相关
上海市徐汇区财政局科技创新发展	8.75	5.50	-	与收益相关
上海市商委中小企业资金	19.03	10.58	-	与收益相关
上海市科学技术委员会创新券	1.50	-	-	与收益相关
集成电路布图设计登记资助	0.54	1.50	-	与收益相关
昆山集成电路检测中心补贴资金	562.71	-	-	与资产相关
昆山财政局奖励十佳科技创新企业	100.00	-	-	与收益相关
昆山市商务局品牌产品进口交易会一事一议补助	38.00	-	-	与收益相关
2014-2015 年上海市科委科技企业培育项目	-	30.00	-	与收益相关
2013 核高基重大专项	-	1,026.00	-	与收益相关
2015 年姑苏创新创业领军人才专项	-	30.00	-	与收益相关
上海市徐汇区财政局资助经费	-	50.00	-	与收益相关
合计	2,198.42	1,201.76	-	

注：根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》财会（2017）15 号（以下简称“政府补助准则”）的通知，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据政府补助准则进行调整；2016 年公司的政府补贴在“营业外收入”科目列示。

（七）投资收益

2016年、2017年、2018年，公司投资收益分别为47.32万元、619.58万元和1,730.46万元，主要是为提高资金使用效率、购买理财产品产生的收益。

（八）资产处置收益

2017年公司资产处置收益为5,681.04万元，系在消费电子芯片业务资产转让过程中向成都澜至及其关联方出售固定资产、无形资产和其他资产形成的收益。

公司相关资产转让定价公允，公司作为资产处置方将处置资产的公允价值与账面价值的差额确认为处置损益，如实反映和计量了消费电子芯片业务相关资产出售的情况，

符合《企业会计准则》的相关规定。

（九）营业外收入及营业外支出

报告期内，公司营业外收支情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业外收入	335.93	1.00	982.01
其中：客户质量奖励	335.73	-	-
政府补助	-	1.00	971.76
其他	0.20	-	10.26
二、营业外支出	3.03	34.24	10.07
三、营业外收支净额	332.91	-33.24	971.94

报告期内，公司营业外收入分别为 971.94 万元、-33.24 万元和 332.91 万元，其中 2016 年公司的营业外收入较大主要系当年政府补助计入营业外收入导致。2017 年和 2018 年营业外收支净额分别为-33.24 万元和 332.91 万元，占营业收入比例较小，对公司的整体盈利能力影响较小。

政府补助具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
苏州园区奖励组织奖	-	1.00	-
2012-2014 年上海市重点技术改造项目专项资金	-	-	150.30
2013 年科技创新行动计划	-	-	300.00
2014-2015 年上海市科委科技企业培育项目	-	-	30.00
2014 年度上海市科技小巨人项目	-	-	225.00
2015 年科技型中小企业技术创新项目	-	-	130.00
上海市知识产权局专利资助	-	-	20.87
徐汇区财政局 2015 年度专利产业化项目	-	-	27.90
上海市商委中小企业资金	-	-	3.57
上海市科学技术委员会创新券	-	-	0.50
集成电路布图设计登记资助	-	-	2.00
2015 年稳岗补贴	-	-	8.32
个税手续费返还	-	-	73.29

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
合计	-	1.00	971.76

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》财会（2017）15 号（以下简称“政府补助准则”）的通知，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据政府补助准则进行调整。

（十）所得税费用

报告期内，公司所得税费用如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	7,195.87	2,225.38	442.02
递延所得税影响	-2,260.49	-679.97	186.80
合计	4,935.38	1,545.41	628.82

报告期内，公司的当期所得税费用持续上升，主要系公司的营业收入规模持续增长，推动利润总额持续上升，应纳税所得额随之增长所致。2017 年公司的递延所得税影响为-679.97 万元，主要系 2017 年子公司的可抵扣亏损有所增加所致，2018 年公司的递延所得税影响分别为-2,260.49 万元，主要系 2018 年政府补助形成的递延所得税资产上升所致。

（十一）非经常性损益对公司盈利的影响

报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
非流动性资产处置损益	-	5,661.71	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	82.81	-	73.29
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,115.61	1,202.76	898.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	153.81	468.81	-

项目	2018年	2017年	2016年
委托他人投资或管理资产的损益	3,044.71	619.58	47.32
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-	8,051.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,314.25	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332.91	-14.91	0.19
所得税影响额	-572.34	-683.79	-105.54
归属于母公司股东的非经常性损益	3,843.25	7,254.16	8,965.03
净利润	73,687.84	34,691.60	9,280.43
占净利润的比例	5.22%	20.91%	96.60%

2016年、2017年和2018年，公司扣除所得税影响额的非经常性损益金额分别为8,965.03万元、7,254.16万元和3,843.25万元，占净利润的比例分别为96.60%、20.91%和5.22%。

2016年公司的非经常性损益对公司净利润影响金额较大，主要为公司受让同一控制下企业澜起开曼的100%股权，澜起开曼年初至合并日的净损益构成非经常性收益。2017年公司的非经常性损益主要为转让消费电子芯片业务资产所产生的非流动性资产处置损益、对非金融企业收取的资金占用费、委托他人投资或管理资产的损益以及计入当期损益的政府补助。2018年公司的非经常性损益主要为政府补助、理财产品收益和远期结售汇损失等，占公司净利润的比例较小。

七、资产质量分析

（一）资产结构总体分析

报告期各期末，公司主要资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	408,653.23	97.75%	142,620.40	96.71%	107,847.60	96.18%
非流动资产	9,412.51	2.25%	4,848.92	3.29%	4,286.81	3.82%

总计	418,065.74	100.00%	147,469.33	100.00%	112,134.41	100.00%
----	------------	---------	------------	---------	------------	---------

报告期内，随着业务规模的扩张，公司资产总额呈快速增长态势，2016年末、2017年末和2018年末，公司总资产分别为112,134.41万元、147,469.33万元和418,065.74万元。2017年，公司资产总额增长35,334.92万元系由于公司收入和利润规模不断提高，滚存利润持续增加所致。2018年，公司资产总额增长270,596.41万元主要系股东增资和滚存利润增加所致。

公司属于集成电路设计行业，以轻资产模式运营，资产以流动资产为主，2016年末、2017年末和2018年末，流动资产占总资产的比例分别为96.18%、96.71%和97.75%。上述资产结构符合公司Fabless模式的业务特点。

（二）流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产及构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	367,999.13	90.05%	68,778.59	48.22%	45,435.09	42.13%
应收票据及应收账款	24,114.92	5.90%	11,925.79	8.36%	5,879.64	5.45%
预付款项	112.76	0.03%	26.94	0.02%	303.12	0.28%
其他应收款	3,003.08	0.73%	25,355.49	17.78%	2,036.76	1.89%
存货	12,067.35	2.95%	13,251.29	9.29%	25,606.94	23.74%
其他流动资产	1,355.98	0.33%	23,282.30	16.32%	28,586.04	26.51%
合计	408,653.23	100.00%	142,620.40	100.00%	107,847.60	100.00%

报告期内，公司流动资产主要为货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产和存货。2016年末、2017年末和2018年末，五项合计占流动资产的比例分别为99.72%、99.98%和99.97%。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

库存现金	0.82	0.00%	1.03	0.00%	1.67	0.00%
银行存款	367,014.81	99.73%	68,657.53	99.82%	45,378.74	99.88%
其他货币资金	983.50	0.27%	120.03	0.17%	54.69	0.12%
合计	367,999.13	100.00%	68,778.59	100.00%	45,435.09	100.00%

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司货币资金分别为 45,435.09 万元、68,778.59 万元和 367,999.13 万元。货币资金中主要为银行存款，报告期内占比在 99% 以上。截至 2018 年 12 月 31 日，公司的所有权受到限制的货币资金为其他货币资金，合计 983.50 万元，其中公司二级子公司澜起电子昆山缴存保函保证金人民币 963.50 万元；公司助学基金专户 20.00 万元，受限期间为 2016 年 7 月 4 日至 2019 年 7 月 4 日。同时截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买结构性存款 3.46 亿元。

货币资金 2017 年末较 2016 年末增加 23,343.50 万元，同比增长 51.38%，主要原因系发行人内存接口芯片业务收入规模扩大且款项回收情况良好，2017 年经营活动现金流净额为 22,683.14 万元。货币资金 2018 年末较 2017 年末增加 299,220.54 万元，同比增长 435.05%，主要原因为：①发行人 2018 年进行了两轮增资，2018 年筹资活动现金流净额为 169,223.85 万元；②发行人经营情况较好，内存接口芯片业务收入规模进一步扩大且款项回收情况良好，2018 年经营活动现金流净额为 96,914.70 万元。

2、应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
应收账款账面余额	24,536.81	12,258.49	5,882.40
应收账款账面净值	24,114.92	11,925.79	5,879.64
应收账款坏账准备	421.88	332.69	2.75
应收账款占流动资产比例	5.90%	8.36%	5.45%
应收账款余额占营业收入比例	13.96%	9.99%	6.96%

（1）应收账款变动分析

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司应收账款分别为 5,879.64 万元、11,925.79 万元和 24,114.92 万元。公司结合集成电路设计行业特点和实际经营情况综合制定信用政策，并严格地执行信用政策，应收账款回收情况良好。

应收账款 2017 年末较 2016 年末增长 6,046.15 万元，同比增长 102.83%，主要原

因是由于 2017 年 7 月发行人转让消费电子芯片业务产品给成都澜至和 Montage Group 产生的应收账款 7,594.84 万元按照协议未到还款期限所致。剔除该笔应收账款影响后，2017 年应收账款余额占营业收入比例为 4.37%，比 2016 年末的 6.96% 降低了 2.59 个百分点。

应收账款 2018 年末较 2017 年末增长 12,189.13 万元，同比增长 102.21%，主要原因是 2018 年第四季度的销售同比增长较快所致。公司给客户的信用账期一般不超过 90 天，所以每年第四季度的营业收入对当年末应收账款的影响较大。2017 年第四季度营业收入 24,661.47 万元，2018 年第四季度营业收入 50,646.95 万元，增长 105.37%。2017 年末及 2018 年末公司应收账款分别为 11,925.79 万元、24,114.92 万元，同比增长 102.21%，与销售增长基本同步。

（2）应收账款分类分析

公司应收账款分类如下表所示：

单位：万元

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,114.92	11,925.79	5,879.64
其中：按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	24,114.92	10,984.79	5,879.64
其中：按照其他组合计提坏账准备的应收账款	-	941.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-
合计	24,114.92	11,925.79	5,879.64

按照其他组合计提坏账准备的应收账款主要系 Montage Group 由于发行人于 2017 年 7 月转让消费电子芯片业务资产引起的欠款。截至 2017 年 12 月 31 日，Montage Group 与发行人仍是母子公司关系，因此 2017 年末该部分应收账款计入其他组合计提坏账准备。2018 年按照其他组合计提坏账准备的应收账款金额为 0 万元。

（3）应收账款账龄分析

各期末应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2018-12-31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值

3 个月以内	20,317.96	82.81%	-	20,317.96
3-12 个月	-	-	-	-
1-2 年	4,218.84	17.19%	421.88	3,796.96
合计	24,536.81	100.00%	421.88	24,114.92
账龄	2017-12-31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
3 个月以内	4,663.64	41.21%	-	4,663.64
3-12 个月	6,653.84	58.79%	332.69	6,321.15
1-2 年	-	-	-	-
合计	11,317.48	100.00%	332.69	10,984.79
账龄	2016-12-31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
3 个月以内	5,827.33	99.06%	-	5,827.33
3-12 个月	55.07	0.94%	2.75	52.31
1-2 年	-	-	-	-
合计	5,882.40	100.00%	2.75	5,879.64

公司应收账款质量良好，回收风险较低，且应收账款坏账准备政策较为谨慎。2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司的坏账准备金额分别为 2.75 万元、332.69 万元和 421.88 万元。2017 年末，发行人账龄在 3-12 个月应收账款金额较大主要系发行人 2017 年进行了资产转让，导致成都澜至对发行人发生欠款。2018 年末，发行人账龄在 1-2 年的应收账款金额较大主要系成都澜至欠款根据协议还未到期所致。

发行人 2016 年末应收账款在 2017 年 3 月末已回款 97.94%；2017 年期末剔除因转让消费电子芯片相关资产按照协议约定未到期的应收账款余额 7,594.84 万元，则在 2018 年 3 月末已回款 99.97%；2018 年末应收账款剔除因转让消费电子芯片相关资产按照协议约定未到期的应收账款余额 4,218.84 万元，则在 2019 年 3 月末已回款 99.08%。应收账款的期后回款情况与发行人给予客户的信用政策基本一致。

截至本招股说明书签署日，2018 年末的应收账款已全部收回。

（4）应收账款主要客户分析

发行人应收账款主要客户为成都澜至、富昌电子、海力士、海太半导体、三星电子、SFA Semico Philippines Corporation 及 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. el 等。

截至2018年12月31日，公司前五名应收账款余额客户情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
客户 B	8,886.39	36.22%	3 个月以内
客户 A	4,285.38	17.47%	3 个月以内
成都澜至	4,218.84	17.19%	1-2 年
客户 C	2,653.30	10.81%	3 个月以内
客户 D	1,861.19	7.58%	3 个月以内
合计	21,905.10	89.27%	

截至2017年12月31日，公司前五名应收账款余额客户情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
成都澜至	6,653.84	54.28%	3-12 个月
客户 A	2,740.90	22.36%	3 个月以内
客户 E	1,500.91	12.24%	3 个月以内
Montage Group	941.00	7.68%	3-12 个月
客户 O	144.95	1.18%	3 个月以内
合计	11,981.60	97.74%	

截至2016年12月31日，公司前五名应收账款余额客户情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
客户 B	2,216.93	37.69%	3 个月以内
客户 A	1,575.36	26.78%	3 个月以内
客户 D	870.18	14.79%	3 个月以内
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. el	499.91	8.50%	1 年以内
客户 E	378.07	6.43%	3 个月以内
合计	5,540.45	94.19%	

报告期内，公司应收账款余额前五大客户欠款余额账龄大部分在3个月以内，应收账款余额账龄在3个月以上的公司主要是成都澜至及其关联方，主要系2017年7月转让消费电子芯片业务资产引起。公司主要应收账款欠款单位系信誉良好、资金实力雄厚的企业及机构，公司应收账款可回收性较高、发生坏账的可能性较小。

截至2018年12月31日，应收账款余额中涉及关联方的款项详见“第七节公司治理及独立性”之“八、关联方、关联关系和关联交易”。

3、预付款项

报告期内，公司预付款项，主要为日常经营提前预付给合作方的款项，2016年末、2017年末和2018年末，公司预付款项金额分别为303.12万元、26.94万元和112.76万元，金额较小。

4、其他应收款

2016年末、2017年末和2018年末，公司其他应收款分别为2,036.76万元、25,355.49万元和3,003.08万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
应收利息	391.03	147.80	5.13
其他应收款	2,612.05	25,207.69	2,031.63
合计	3,003.08	25,355.49	2,036.76

（1）应收利息

2016年末、2017年末和2018年末，公司应收利息金额分别为5.13万元、147.80万元和391.03万元。报告期内，公司应收利息金额较小，主要为CEC Tongshang Company Limited借款及购买结构性存款产生的利息。

（2）其他应收款

2016年末、2017年末和2018年末，公司其他应收款金额分别为2,031.63万元、25,207.69万元和2,612.05万元。报告期内，公司其他应收款主要系关联方往来款和资产转让款。其他应收款2017年末较2016年末增加23,176.06万元，同比上升1,140.76%，主要系公司于2017年度向CEC Tongshang Company Limited提供3000万美元借款，以及将相关固定资产、无形资产等转让给成都澜至及其关联方，形成相应的其他应收款项。其他应收款2018年末较2017年末下降22,595.64万元，主要系CEC Tongshang Company Limited于2018年将借款归还于发行人且成都澜至已按协议归还了部分其他应收款所致。截至本招股说明书签署日，成都澜至所欠公司其他应收款及其利息已全部还清。

1) 报告期内其他应收款余额具体性质如下：

单位：万元

款项性质	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
------	------------	------------	------------

款项性质	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
押金、保证金	242.77	206.37	428.73
关联方往来	-	20,386.70	106.40
资产转让款	2,604.82	4,710.59	-
员工备用金	30.88	31.72	5.26
股利退税款	-	-	820.00
出口退税款	-	29.58	681.20
其他	1.28	2.24	1.84
合计	2,879.75	25,367.20	2,043.44

发行人应收账款余额中，关联方往来款主要系向 CEC Tongshang Company Limited 提供 3000 万美元借款，资产转让款系将相关固定资产、无形资产等转让给成都澜至、澜至半导体和 MontageGroup，形成相应的其他应收款项。

2) 其他应收账款分类分析

单位：万元

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,612.05	25,207.69	2,031.63
其中：按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,390.06	3,817.27	1,655.66
其中：按照其他组合计提坏账准备的其他应收款	222.00	21,390.42	375.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-
合计	2,612.05	25,207.69	2,031.63

按照其他组合计提坏账准备的其他应收款主要系关联方往来款和房租押金。2017 年，发行人按照其他组合计提坏账准备的其他应收款金额较大，主要系向 CEC Tongshang Company Limited 提供的 3000 万美元的借款和资产转让导致的 Montage Group 欠发行人的欠款 1,616.25 万元。2018 年，CEC Tongshang Company Limited 和 Montage Group 归还了欠款。剩余其他组合计提坏账准备的其他应收款主要系房租押金，2016 年、2017 年和 2018 年房租押金分别为 375.97 万元、171.57 万元和 222.00 万元。

3) 其他应收账款账龄分析

发行人其他应收款主要为关联方往来款、房租押金和资产转让款。报告期各期末，公司其他应收款账龄结构如下：

单位：万元

账龄	2018-12-31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
3 个月内	4.25	0.16%	-	4.25
3-12 个月	1.00	0.04%	0.05	0.95
1-2 年	2,649.85	99.70%	264.98	2,384.86
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	2.66	0.10%	2.66	-
合计	2,657.76	100.00%	267.69	2,390.06
账龄	2017-12-31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
3 个月内	825.12	20.75%	-	825.12
3-12 个月	3,147.08	79.14%	157.35	2,989.73
1-2 年	0.70	0.02%	0.07	0.63
2-3 年	2.56	0.06%	0.77	1.79
3 年以上	1.31	0.03%	1.31	-
合计	3,976.77	100.00%	159.5	3,817.27
账龄	2016-12-31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
3 个月内	1,610.33	96.57%	-	1,610.33
3-12 个月	9.12	0.55%	0.46	8.67
1-2 年	40.74	2.44%	4.07	36.67
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	7.28	0.44%	7.28	-
合计	1,667.47	100.00%	11.81	1,655.66

2017 年，发行人账龄 3-12 个月其他应收款金额较大主要系资产转让款系将相关固定资产、无形资产转让给成都澜至等主体，形成相应的其他应收款项。账龄超过 1 年的其他应收款主要系员工备用金。

2018 年，发行人账龄 1-2 年其他应收款金额较大主要系向成都澜至转让资产形成的其他应收款，截至 2018 年 12 月 31 日，该款项仍在协议约定的付款期限内。2019

年3月，成都澜至已支付资产转让相关的其他应收款项。

4) 其他应收账款余额主要客户分析

发行人其他应收款客户主要系 CEC Tongshang Company Limited、成都澜至、上海新兴技术开发区联合发展有限公司（按首字母排序）等。

截至2018年12月31日，公司前五名其他应收账款余额客户情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
成都澜至	2,604.82	90.45%	1-2年
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	155.47	5.40%	6个月-3年以上
Myoungil Systems	42.88	1.49%	3-12个月
员工A（注）	30.88	1.07%	1-2年
CA-Metro Plaza Limited Partership	16.22	0.57%	3个月以内-3年以上
合计	2,850.27	98.98%	—

注：员工A系本公司韩国境外分支机构员工，借用公司备用金系用于出差租房的房租押金。

截至2017年12月31日，公司前五名其他应收账款余额欠款方情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
CEC Tong Shang Company Limited	19,602.60	77.28%	3-12个月
成都澜至	2,604.82	10.27%	3-12个月
Montage Group	1,616.25	6.37%	1年以内
Intel	784.10	3.09%	3个月以内
澜至半导体	489.52	1.93%	3-12个月
合计	25,097.29	98.94%	

截至2016年12月31日，公司前五名其他应收账款余额欠款方情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
应收股利退税	820.00	40.13%	3个月以内
出口退增值税款	681.20	33.34%	3个月以内
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	293.90	14.38%	3个月-3年以上
上海澜至	106.40	5.21%	3个月以内
苏州工业园区科技发展有限公司	37.51	1.83%	3年以上
合计	1,939.01	94.89%	

5、存货

（1）存货规模及变动情况分析

报告期各期末，公司存货的变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度	2016-12-31/ 2016 年度
原材料	1,432.00	573.16	7,744.06
委托加工物资	7,817.18	7,559.60	8,697.66
库存商品	2,756.06	2,907.43	6,815.72
发出商品	62.11	2,211.10	2,349.50
存货合计①	12,067.35	13,251.29	25,606.94
营业成本②	51,773.40	57,095.23	41,230.91
①/②	23.31%	23.21%	62.11%
存货较前期增幅	-8.93%	-48.25%	-
营业成本较前期增幅	-9.32%	38.48%	-

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司存货账面金额分别为 25,606.94 万元、13,251.29 万元和 12,067.35 万元，占营业成本的比例分别为 62.11%、23.21%和 23.31%。

发行人报告期存货主要分为原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品。原材料主要系晶圆；委托加工物资主要系公司 Fabless 模式下，外协代工商加工的产品；库存商品主要系产成品；发出商品主要系公司已发货至代销商，但代销商尚未销售给终端客户，因此未能确认销售的商品。

2016 年末存货金额较大，主要原因为公司消费电子芯片业务原材料和库存产品金额较大；公司 2017 年较 2016 年存货下降 12,355.65 万元，主要原因为：①公司于 2017 年 7 月进行了资产转让，将消费电子芯片业务相关的原材料、委托加工物资、产成品销售给成都澜至及其关联方；②由于内存接口芯片销售增速较快、库存消耗较大，公司营业成本增大、内存接口芯片业务相关存货下降。

公司 2018 年较 2017 年存货下降 1,183.94 万元，主要原因为公司内存接口芯片业务规模持续扩大，销售情况良好，库存周转速度进一步加快，且公司近两年致力于库存精细化管理的成效不断显现，因此存货的流动性得到了较大的提升，公司存货金额进一

步降低。

各报告期末，公司分产品类别的存货规模情况如下：

单位：万元

产品类型	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
内存接口芯片	18,259.40	21,739.32	17,814.67
消费电子芯片			16,317.21
津逮 [®] 服务器平台	1,884.31	23.10	
合计	20,143.71	21,762.42	34,131.88

2016年和2017年，公司存货期末余额分别为34,131.88万元和21,762.42万元，2017年较2016年下降12,369.46万元，其主要原因系公司将消费电子芯片业务相关的存货转让给成都澜至及其关联方，2016年底消费电子芯片存货金额合计16,317.21万元。同时，公司内存接口芯片业务增长迅速，公司积极备货，2017年内存接口芯片存货余额21,739.32万元较2016年内存接口芯片存货余额17,814.67万元增加了3,924.65万元。

2018年，公司存货期末余额为20,143.71万元，2018年末较2017年末存货余额下降1,618.71万元，主要系公司根据产品的生产周期和交货周期对存货进行优化管理。公司会根据客户采购预测数据和实际订单情况制定备货计划，在满足按时向客户交货的同时，通过加强存货管理，控制库存，从而提高存货周转率。同时，公司2018年下半年销售收入为104,853.37万元，同比增长103.62%，对库存消耗较大。综合上述两个原因，从而导致内存接口芯片业务相关存货期末金额下降。

报告期内发行人每年末对存货进行盘点，报告期内无存货的盘盈亏情况。

（2）存货减值分析

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按二者差额提取存货跌价准备。

报告期各期末公司存货构成及存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

2018-12-31				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	占存货比例
原材料	3,136.35	1,704.35	1,432.00	11.87%

委托加工物资	10,989.04	3,171.86	7,817.18	64.78%
库存商品	5,956.20	3,200.14	2,756.06	22.84%
发出商品	62.11	-	62.11	0.51%
合计	20,143.71	8,076.35	12,067.35	100.00%
2017-12-31				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	占存货比例
原材料	1,945.91	1,372.74	573.16	4.33%
委托加工物资	10,015.08	2,455.48	7,559.60	57.05%
库存商品	7,590.32	4,682.90	2,907.43	21.94%
发出商品	2,211.10	-	2,211.10	16.69%
合计	21,762.42	8,511.12	13,251.29	100.00%
2016-12-31				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	占存货比例
原材料	7,798.17	54.11	7,744.06	30.24%
委托加工物资	8,881.10	183.44	8,697.66	33.97%
库存商品	15,103.12	8,287.39	6,815.72	26.62%
发出商品	2,349.50	-	2,349.50	9.18%
合计	34,131.88	8,524.94	25,606.94	100.00%

2016年、2017年和2018年，公司存货跌价准备分别为8,524.94万元、8,511.12万元和8,076.35万元，分别占各期末存货比重为24.98%、39.11%和40.09%。公司存货跌价准备金额较大系由于公司产品迭代较快，公司对存在减值迹象的老一代产品计提跌价准备。由于公司加强了存货管理且销售持续向好，在报告期内，存货账面余额逐年下降，从而造成存货跌价准备计提比例逐年提高。

公司从晶圆代工厂采购的晶圆作为原材料核算，原材料发往封装测试厂进行封装测试服务后到产成品产出前计入委托加工物资核算。

报告期内委托加工物资跌价准备主要为DDR4 Gen1.0子代和DDR4 Gen1.5子代。2016年、2017年和2018年，公司各期末委托加工物资跌价准备余额分别为183.44万元、2,455.48万元和3,171.86万元。其中DDR4 Gen1.0子代和DDR4 Gen1.5子代委托加工物资合计跌价准备为0.00万元、2,455.48万元和3,171.86万元，占总委托加工物资跌价准备比例为0.00%、100.00%和100.00%。

DDR4 Gen1.0子代、DDR4 Gen1.5子代产品在报告期内逐步进入生命周期末端，

其销量迅速减少且单价迅速降低，故公司在2017年和2018年对DDR4 Gen1.0子代、DDR4 Gen1.5子代产品的委托加工物资足额计提了存货跌价准备。因此，委托加工物资跌价准备余额逐期增大。

6、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
增值税待抵扣进项税	1,046.49	63.57	712.46
预缴企业所得税	-	-	4.26
待摊费用	309.50	218.73	558.32
理财产品	-	23,000.00	27,311.00
合计	1,355.98	23,282.30	28,586.04

2016年末、2017年末和2018年末，公司其他流动资产金额分别为28,586.04万元、23,282.30万元和1,355.98万元。2018年随着理财产品到期赎回后转入货币资金，至年末其他流动资金余额减少。

（三）非流动资产分析

报告期内，公司非流动资产及构成情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	2,315.03	24.60%	732.37	15.10%	1,216.42	28.38%
在建工程	335.46	3.56%	-	-	-	-
无形资产	2,597.07	27.59%	2,078.84	42.87%	1,794.81	41.87%
长期待摊费用	170.28	1.81%	334.50	6.90%	200.25	4.67%
递延所得税资产	3,994.67	42.44%	1,703.21	35.13%	1,075.33	25.08%
合计	9,412.51	100.00%	4,848.92	100.00%	4,286.81	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产和递延所得税资产构成，2016年末、2017年末和2018年末，以上三项合计占非流动资产的比例分别为95.33%、93.10%和94.63%。

1、固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子设备	2,160.83	93.34%	536.38	73.24%	1,086.20	89.29%
办公设备	154.19	6.66%	195.99	26.76%	130.22	10.71%
合计	2,315.03	100.00%	732.37	100.00%	1,216.42	100.00%

报告期内，公司固定资产为电子设备和办公设备。固定资产账面价值 2017 年末较 2016 年末减少 484.05 万元，同比下降 39.79%，主要系 2017 年公司完成了消费电子芯片业务相关固定资产的转让所致。2018 年末较 2017 年末增加了 1,582.66 万元，同比上升 216.10% 主要系发行人 2018 年购置新设备所致。

截至报告期期末，公司固定资产成新率情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
电子设备	3,920.67	1,759.84	2,160.83	55.11%
办公设备	467.03	312.83	154.19	33.02%
合计	4,387.70	2,072.68	2,315.03	52.76%

公司固定资产整体成新率为 52.76%，成新率较高，报告期末固定资产不存在减值的情形。

2、在建工程

报告期内，公司仅 2018 年存在在建工程项目，主要为公司的办公室装修，金额合计 335.46 万元，金额较小。

3、无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件	15.04	0.58%	93.56	4.50%	252.03	14.04%
IP 授权	2,546.10	98.04%	1,933.97	93.03%	1,470.16	81.91%

离岸业务执照	35.93	1.38%	51.31	2.47%	72.63	4.05%
合计	2,597.07	100.00%	2,078.84	100.00%	1,794.81	100.00%

2016年末、2017年末和2018年末，公司无形资产分别为1,794.81万元、2,078.84万元和2,597.07万元。报告期内，公司无形资产主要系向非关联第三方购买的IP授权，分别占当期无形资产的比重为81.91%、93.03%和98.04%。

IP授权主要是发行人研发设计所需使用的电子设计自动化（EDA）工具，授权方包括Synopsys、Cadence及Mentor等。EDA工具为芯片设计的辅助软件工具。利用EDA工具，设计工程师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，大量工作可以通过计算机完成，并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图的整个过程的计算机上自动处理完成。

4、长期待摊费用

2016年末、2017年末和2018年末，公司长期待摊费用金额分别为200.25万元、334.50万元和170.28万元。公司的长期待摊费用主要为办公室装修费用等，报告期各期末金额较小。

5、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	702.09	72.55	489.91	48.99	100.23	10.08
存货内部未实现销售利润	343.25	85.81	-	-	-	-
固定资产计提折旧的时间性差异	135.95	16.33	148.10	15.49	251.07	23.94
应付职工薪酬	406.94	59.01	290.70	39.55	420.71	62.24
可抵扣亏损	1,860.36	533.62	5,197.74	1,357.74	1,919.88	764.68
递延收益	13,788.38	3,227.34	1,982.80	220.78	-	-
股权激励款	-	-	73.84	20.66	538.22	214.40
合计	17,236.96	3,994.67	8,183.10	1,703.21	3,230.11	1,075.33

2016年末、2017年末和2018年末，公司递延所得税资产分别为1,075.33万元、1,703.21万元和3,994.67万元。递延所得税资产2017年末较2016年末有所增长，主

主要原因系澜起昆山因研发投入较大引起的亏损导致可抵扣亏损增加，以及政府补助增加导致递延收益增加所致。递延所得税资产 2018 年末较 2017 年末有所增长主要系政府补助产生的递延收益所致。

八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债结构总体分析

报告期各期末，公司主要负债构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	42,702.39	75.59%	26,785.76	93.11%	22,023.21	92.41%
非流动负债	13,788.38	24.41%	1,982.80	6.89%	1,808.80	7.59%
合计	56,490.76	100.00%	28,768.56	100.00%	23,832.01	100.00%

报告期内，随着公司业务规模的扩大，负债规模也相应保持增长。公司总体负债水平合理，财务风险较小。

公司负债以流动负债为主，报告期各期末流动负债占负债总额的比例在 75%以上。

（二）流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债规模与结构如下：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据及应付账款	7,437.76	17.42%	10,731.33	40.06%	11,221.04	50.95%
预收款项	-	-	5,608.29	20.94%	2,936.69	13.33%
应付职工薪酬	17,895.85	41.91%	5,803.20	21.67%	3,392.32	15.40%
应交税费	4,743.15	11.11%	1,645.29	6.14%	1,129.22	5.13%
其他应付款	12,625.62	29.57%	2,997.65	11.19%	3,343.94	15.18%
合计	42,702.39	100.00%	26,785.76	100.00%	22,023.21	100.00%

报告期各期末，公司流动负债规模不断增长，主要是由于与经营规模密切相关的应付职工薪酬、其他应付款和应交税费等，随业务规模的扩张而增长。

1、应付票据及应付账款

2016年末、2017年末和2018年末，公司无应付票据，应付账款账面余额分别为11,221.04万元、10,731.33万元和7,437.76万元。

公司应付账款主要是应付供应商即外协厂商的货款及加工费。公司的供应商主要为晶圆制造厂商、封装测试委托加工供应商等，大部分为行业内具有较强实力的知名厂商。公司与供应商均保持长期良好的合作关系，目前的应付账款均为合约未到结算期的正常负债。

公司应付账款2018年末较2017年末下降了3,293.57万元，同比下降30.69%，主要系公司对存货进行精细化管理，严格根据销售计划，控制备货数量，从而导致应付供应商的账款余额下降。

报告期各期末，公司应付账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,437.76	100.00%	10,731.33	100.00%	11,221.04	100.00%
合计	7,437.76	100.00%	10,731.33	100.00%	11,221.04	100.00%

报告期各期末，公司应付账款账龄均为1年以内。报告期内，公司应付账款逐年下降主要系发行人对存货进行精细化管理，严格根据销售计划，控制备货数量。

2、预收款项

2016年末、2017年末和2018年末，公司预收账款金额分别为2,936.69万元、5,608.29万元和0.00万元。

公司预收账款主要为代销商预付的货款。预收账款2017年末较2016年末增长2,671.60万元，同比增长90.97%，主要原因为当期内存接口芯片业务销售规模提升，预收代销商的货款增加较多所致。2018年末无预收款项，主要系由于公司与代销商于2018年末结束代销关系，转为与终端客户直接交易，已结清所有的预收款项导致。

3、应付职工薪酬

2016年末、2017年末和2018年末，公司应付职工薪酬金额分别为3,392.32万元、5,803.20万元和17,895.85万元。公司报告期内应付职工薪酬余额主要为尚未发放的应付职工的工资、奖金、津贴、补贴和离职后福利等。

应付职工薪酬2017年末较2016年末上升2,410.88万元，同比增长71.07%，主要原因系公司整体绩效情况良好，员工薪酬及福利提升导致。2018年末较2017年末增加12,092.65万元，同比增长208.38%，主要原因为公司2018年业绩增长较快，用于激励员工的尚未发放的年终奖及年金产品金额较大。

发行人依据公司经营情况和盈利水平为公司员工购买企业年金是为了奖励员工，保留关键人才，支付金额与发行人的盈利能力相符合，参与对象全部为除发行人高管外的员工。报告期内，公司首笔企业年金（3,350万元）已于2018年5月落实到实际受益人，并于2018年7月27日向太平养老保险股份有限公司支付。第二笔企业年金（2,400万元）于2018年10月30日向太平养老保险股份有限公司支付，第三笔企业年金（1亿元）于2019年1月7日向太平养老保险股份有限公司支付，第二笔及第三笔企业年金已于2019年5月分配至各部门，正在落实到实际受益人。上述年金计划已完成内部公告，已构成对员工不可撤销的支付义务。

截至报告期末，公司不存在属于拖欠性质的应付职工薪酬。

4、应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
增值税	-	182.88	-
企业所得税	4,633.38	1,284.40	466.46
个人所得税	79.94	147.38	200.40
城市维护建设税	-	13.64	-
教育费附加	-	9.74	-
印花税	29.84	7.25	462.37
合计	4,743.15	1,645.29	1,129.22

2016年末、2017年末和2018年末，公司应交税费金额为1,129.22万元、1,645.29万元和4,743.15万元，公司应交税费主要为应交企业所得税。报告期内公司应交税费增长的原因主要系公司利润快速增长，期末应缴纳的企业所得税相应增加所致。

5、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
普通股股利	5,844.04	-	-
销售佣金	4,968.51	1,681.13	140.53
代付员工股权激励款	528.16	49.12	2,225.46
专业服务及咨询费	580.73	919.78	389.20
质保金	264.87	147.39	213.68
员工报销款	120.46	72.47	63.87
其他	318.85	127.75	311.20
合计	12,625.62	2,997.65	3,343.94

2016年末、2017年末和2018年末，公司其他应付款分别为3,343.94万元、2,997.65万元和12,625.62万元。报告期内，公司其他应付款主要为普通股股利、销售佣金和专业服务及咨询费。

公司其他应付款 2017 年末较 2016 年末减少 346.29 万元，主要系公司 2017 年代付员工股权激励款减少导致。2018 年末较 2017 年末增长 9,627.97 万元，主要原因为：

（1）2018 年度公司内存接口芯片销售规模增加，公司支付的销售佣金费用随着销售金额的增加而上升；（2）公司 2018 年度普通股股东分红尚有 5,844.04 万元未支付。

（三）非流动负债的构成与变化

报告期内，公司非流动负债为递延收益，2016年末、2017年末和2018年末金额分别为1,808.80万元、1,982.80万元和13,788.38万元，主要为尚未验收的政府补助项目。

（四）最近一期末银行借款、关联方借款、合同承诺债务、或有负债等主要债项的金额、期限、利率及利息费用等情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在银行借款、关联方借款、合同承诺债务、或有负债等债务情况。

（五）报告期股利分配的具体实施情况

2018 年 7 月 30 日，公司通过董事会决议，将共计人民币 29,827.09 万元可分配利润分配给股东。

（六）现金流量分析

最近三年公司的现金流量简要情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	96,914.70	22,683.14	38,708.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,992.46	3,771.56	-22,267.24
筹资活动产生的现金流量净额	169,223.85	-	-2,952.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,610.97	-3,176.55	2,510.10
现金及现金等价物净增加额	263,757.07	23,278.15	15,998.60
期末现金及现金等价物余额	332,415.63	68,658.55	45,380.41

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金净流量与净利润情况如下：

单位：万元

	2018 年度	2017 年度	2016 年度
净利润	73,687.84	34,691.60	9,280.43
加：资产减值准备	1,331.39	5,374.34	5,539.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	611.51	630.07	665.59
无形资产摊销	1,404.17	1,107.73	620.30
长期待摊费用摊销	164.22	177.20	148.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-5,681.04	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	19.33	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,731.30	1,015.91	-1,448.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,730.46	-619.58	-47.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,291.46	-627.89	116.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-502.57	8,326.62	-6,033.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,228.19	-23,693.76	23,297.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,743.17	1,962.61	6,570.26
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	96,914.70	22,683.14	38,708.48

2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额为38,708.48万元，同期净利润为9,280.43万元，差异为29,428.05万元，主要系应收账款和其他应收款回款较多，新增应付账款较多所致。

2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额为22,683.14万元，同期净利润为

34,691.60万元，差异为-12,008.46万元，主要系公司经营性应收项目增加了23,693.76万元所致。公司经营性应收项目增加主要系公司向CEC Tongshang Company Limited借款，以及向成都澜至等主体销售商品新增应收款项所致。

2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为96,914.70万元，同期净利润为73,687.84万元，差异为23,226.86万元，主要系公司经营性应付项目增加19,743.17万元所致。公司经营性应付项目金额增加主要原因系：（1）2018年业绩增长较快，职工薪酬增长加大，至年末尚未发放的年终奖及年金金额较大；（2）公司销售规模扩大、经营业绩提升后，至年末尚未支付的销售佣金和企业所得税增长较快。

2、投资活动现金流量分析

2016年度、2017年度和2018年度，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为-22,267.24万元、3,771.56万元和-9,992.46万元。2016年和2018年，公司投资活动产生的现金流量净额为负主要系公司新增理财产品和结构性存款所致，2017年度，公司投资活动产生的现金流量净额为正，主要系公司收回理财产品及相关收益及转让消费电子芯片业务相关资产所致。

报告期内，发行人投资支付现金的资金来源全部是发行人的自有资金，主要投资是购买银行等金融机构的理财产品，在保证流动性的基础上提高闲置资金的回报率，购买的理财产品大部分属于保本型理财产品，安全性和流动性较好。利息收入和投资收益的变化具有合理性，与货币资金、投资规模相匹配。

3、筹资活动现金流量分析

2016年度、2017年度和2018年度，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,952.73万元、0元和169,223.85万元。2018年公司筹资活动产生的现金流量净额较多主要系2018年公司进行了两次增资所致。

（七）重大资本性支出分析

1、最近三年重大资本性支出

2016年度、2017年度和2018年度，本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为461.26万元、5,763.49万元和1,789.44万元。

除上述支出外，本公司在报告期内无其他重大资本性支出。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资的新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目和人工智能芯片研发项目。在募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划分期进行投资，具体情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用与未来发展规划”之“一、本次发行募集资金运用计划”。

（八）公司流动性的重大变化或风险趋势

1、公司的流动性分析

主要财务指标	2018-12-31 2018 年度	2017-12-31 2017 年度	2016-12-31 2016 年度
流动比率（倍）	9.57	5.32	4.90
速动比率（倍）	9.29	4.83	3.73
资产负债率	13.51%	19.51%	21.25%
息税折旧摊销前利润（万元）	80,803.11	38,152.00	11,343.48
利息保障倍数	-	-	-

报告期各期末，公司流动比率分别为4.90、5.32和9.57，速动比率分别为3.73、4.83和9.29，2018年公司的偿债能力指标均大幅提升，主要系公司在2018年完成了两轮增资所致。公司资产流动性高，短期偿债能力强。

报告期内，公司资产负债率分别为 21.25%、19.51%和 13.51%。资产负债率处于较低水平，财务风险低。

公司在流动性方面不存在重大不利变化或风险因素。

2、同行业可比上市公司偿债能力指标分析

财务指标	公司名称	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动比率	汇顶科技	3.77	4.45	6.29
	兆易创新	2.82	2.58	4.54
	同行业平均	3.30	3.52	5.42
	澜起科技	9.57	5.32	4.90
速动比率	汇顶科技	3.43	3.87	5.10
	兆易创新	1.82	1.45	3.25
	同行业平均	2.63	2.66	4.18

财务指标	公司名称	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
	澜起科技	9.29	4.83	3.73
资产负债率	汇顶科技	23.16%	21.10%	14.89%
	兆易创新	33.68%	31.74%	23.39%
	同行业平均	28.42%	26.42%	19.14%
	澜起科技	13.51%	19.51%	21.25%

2016年，公司流动比率和速动比率略低于同行业可比公司平均水平，资产负债率略高于同行业可比公司平均水平，主要系2016年公司仍处于高速发展期，且尚未发行上市所致。

2017年，公司流动比率、速动比率、资产负债率与同行业可比公司相比，公司流动比率和速动比率较高，资产负债率较低，主要原因系公司2017年将消费电子芯片业务资产进行了转让，优化了资产结构。

2018年，公司流动比率、速动比率、资产负债率与同行业可比公司相比，公司流动比率和速动比率较高，资产负债率较低，主要原因系2018年进行了两轮增资，流动资产大幅上升。

（九）公司在持续经营能力方面是否存在重大不利变化或风险因素

公司致力于数据中心和云计算领域核心芯片的研发、设计和销售。公司内存接口芯片产品技术领先，全球市场占有率保持领先，体现了公司强大的技术研发实力和管理能力。未来公司将继续立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用的升级，推动形成全新的高成长市场，为公司业务的提升和扩大营造充分的发展空间。随着募集资金投资项目的实施，公司新一代内存接口芯片和津速[®]服务器CPU芯片将继续保持竞争优势、赢取更大的市场份额，有助于增加公司利润新的增长点，进一步提升公司持续盈利能力。如募集资金投资项目能够达到预期效益，公司的主营业务将获得巨大的发展，市场竞争力大为提升，并在未来较长时间内保持较强的盈利能力。

公司资产质量良好，运营管理能力较强，报告期内资产规模持续扩大，盈利能力不断增强。如果本次募集资金项目得以成功实施，公司资金实力将明显增强，资产规模将快速增长，为公司的持续创新和跨越发展奠定坚实的资金基础。但是，募集资金投资项目的效益实现需要一定周期，效益实现存在一定的滞后性，项目建设过程中的部分不确定性，在募集资金投入初期，受新增固定资产折旧、无形资产摊销等因素的影响，募集

资金投资项目业绩存在未能按预期完全达标的风险。项目实际建成后，相关产品的市场推广和销售情况也可能与公司的预测发生差异，致使项目的投资收益率低于预期水平，进而影响到公司业务发展目标顺利实现。

（十）资产周转能力分析

1、报告期内公司资产周转能力指标

主要财务指标	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次/年）	9.75	13.79	18.94
存货周转率（次/年）	4.09	2.94	1.61
应收账款周转天数（天）	37.44	26.47	19.27
存货周转天数（天）	89.24	124.15	226.71

2016年、2017年和2018年度，公司应收账款周转率分别为18.94次/年、13.79次/年和9.75次/年。公司不同产品采取不同的信用政策，其中消费电子芯片产品主要为款到发货，应收账款周转率保持在较高水平，内存接口芯片产品采取的信用账期为30天左右。2017年，公司应收账款周转率下降主要系公司将消费电子芯片业务相关的存货销售给成都澜至及其关联方，形成应收账款尚未收回。2018年，公司应收账款周转率下降主要系公司不再销售消费电子芯片产品所致，应收账款周转率与内存接口芯片的信用政策基本一致，具有合理性。

2016年、2017年和2018年度，公司存货周转率分别为1.61次/年、2.94次/年和4.09次/年。2017年，公司存货周转率上升主要系消费电子芯片产品存货周转率较低且2017年公司将消费电子芯片业务相关存货销售给成都澜至及其关联方所致。2018年公司存货周转率进一步提升系由于公司优化了存货管理制度，降低了存货金额。

2、与同行业可比公司比较

财务指标	公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次/年）	汇顶科技	5.96	6.93	7.29
	兆易创新	22.77	20.59	12.94
	同行业平均	14.37	13.76	10.12
	澜起科技	9.75	13.79	18.94
存货周转率（次/年）	汇顶科技	3.83	3.62	4.70
	兆易创新	2.21	2.39	3.48

财务指标	公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
	同行业平均	3.02	3.01	4.09
	澜起科技	4.09	2.94	1.61

2016年，公司应收账款周转率高于同行业可比公司，主要原因系由于公司严格地执行信用政策，应收账款回收情况良好。2017年，公司的应收账款周转率与同行业可比公司平均水平基本一致。2018年公司的应收账款周转率略低于同行业可比公司平均水平，主要系公司将消费电子芯片业务相关的产成品销售给成都澜至及其关联方，形成应收账款尚未收回，2019年4月4日，成都澜至支付发行人资产转让的全部余款及其利息，至此发行人对成都澜至的应收账款已全部收回。

2016年，公司存货周转率与同行业可比公司平均水平偏低，主要原因系公司处于高速发展期，公司积极备货导致期末存货数量较大所致。2017年，公司存货周转率与同行业可比公司平均水平基本一致。2018年公司的存货周转率优于同行业可比公司平均水平，主要系公司改善了销售计划与销量预测的机制，优化了相关备货制度所致。

九、公司重大资产重组情况

公司重大资产重组情况具体参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“五、发行人重大资产重组情况”。

十、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2019年2月26日，公司收到 Intel Capital 增资款 35,074,860.00 美元。

2019年3月4日，本公司因资产转让对成都澜至产生的其他应收款 26,048,232.48 元已收回。

截至本招股说明书签署日，2018年末的应收账款已全部收回。

2、利润分配情况

2019年3月5日，本公司召开第一届董事会第五次会议，批准2018年度利润分配预案，分配现金股利人民币 233,871,475 元（税前）。该年度分红预案已经发行人

2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。截至本招股说明书签署日，本次分红已向全体股东发放完毕。

3、2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经公司第一届董事会第四次会议于2019年2月22日决议通过，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

（二）重要承诺事项

（1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，根据公司因租赁办公场所而签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：			
1年以内（含1年）	5,978,070.54	7,536,523.60	10,933,104.53
1年以上2年以内（含2年）	2,560,343.89	5,978,070.54	7,536,523.60
2年以上3年以内（含3年）	147,654.03	2,560,343.89	5,978,070.54
以后年度（3年以上）		147,654.03	2,560,343.89
合计	8,686,068.46	16,222,592.06	27,008,042.56

（2）其他承诺事项

截至2018年12月31日，公司无需要披露的其他承诺事项。

（三）或有事项及其他重要事项

1、或有事项

截至2018年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

2、其他重要事项

（1）年金计划

本公司根据2018及以前年度的业绩情况，为鼓励员工，保留关键人才，经总经理办公会通过并向员工公示，在2018年7月27日、2018年10月30日及2019年1月7日向太平养老保险股份有限公司购买金额为3,350.00万元、2,400.00万元及10,000.00万元的太平金世久久养老保障产品。

根据公司与受托人太平养老保险股份有限公司签订的《太平金世久久集合型团体养老保障管理产品合同》，约定：该养老保障管理方案以留才激励为目的；交通银行股份有限公司为资产托管人，太平资产管理有限公司、太平养老保险股份有限公司为投资管理人，各方管理人于合同存续期间内，负责企业年金基金的管理运作。

（2）终止经营

1) 终止经营基本情况

①2017年终止经营情况

单位：万元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

消费电子芯片业务	28,525.06	25,043.78	3,481.27	470.99	3,010.29	3,010.29
----------	-----------	-----------	----------	--------	----------	----------

②2016 年终止经营情况

单位：万元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
消费电子芯片业务	28,661.79	39,000.03	-10,338.24	-837.72	-9,500.52	-9,500.52

2) 终止经营的处置情况

2017 年终止经营的处置情况：

单位：万元

项目	处置损益总额	处置相关税费	所得税费用	处置净损益
存货	625.44	200.24	50.92	374.29
固定资产	499.20	16.24	44.45	438.51
无形资产	5,179.42	32.63	462.39	4,684.39
其他资产	2.42	0.28	0.54	1.60
合计	6,306.48	249.38	558.30	5,498.80

3) 归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益

单位：万元

期间	归属于母公司所有者的持续经营损益	归属于母公司所有者的终止经营损益
2017 年度	31,681.31	3,010.29
2016 年度	18,780.94	-9,500.52

(3) 分部信息

1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：①该部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮[®]服务器 CPU 以及混合安全内存模组。报告期内公司产品曾包括消费电子芯片。其业务主要在中国大陆、中国澳门、韩国及美国等地区发生，而本公司在内部结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定配置资源及评价业绩时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。故公司未区分不同的经营分部，无需列报分部报告。

十一、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况

（一）2019 年一季度经营情况

公司2019年3月31日的合并资产负债表及2018年1-3月和2019年1-3月合并利润表、合并现金流量表未经审计，但已经瑞华会计师审阅，并出具了“瑞华阅字[2019]01500002号”审阅报告，经审阅的主要财务信息及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比率
资产总额	437,821.28	418,065.74	4.73%
所有者权益	405,522.98	361,574.98	12.15%
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比变动
营业收入	40,471.71	33,705.61	20.07%
营业利润	23,454.34	16,165.42	45.09%
利润总额	23,454.43	16,499.80	42.15%
净利润	22,574.04	15,894.65	42.02%
归属于母公司股东的净利润	22,574.04	15,894.65	42.02%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	21,580.78	15,170.52	42.25%
经营活动产生的现金流量净额	8,746.61	14,114.10	-38.03%

2019年3月末，公司资产总额为43.78亿元，较2018年末增长4.73%，公司所有者权益为40.55亿元，较2018年末增长12.15%。

2019年1-3月，公司实现营业收入4.05亿元，较2018年1-3月同比增长20.07%，主要系随着公司在内存接口芯片领域技术优势的逐步体现，产品质量稳定可靠，下游客户加大了对公司产品的采购量，从而推动收入相应增长；2019年1-3月公司实现归属于母公司股东的净利润2.26亿元，较2018年1-3月同比增长42.02%；2019年1-3月公司实现

扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2.16亿元，较2018年1-3月同比增长42.25%，主要系公司销售的内存接口芯片产品收入增长且毛利率上升所致；2019年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为0.87亿元，较2018年1-3月同比下降38.03%，主要系公司2018年业绩完成情况良好，2019年1-3月支付的绩效奖金及员工年金较多，2019年1-3月公司支付给职工以及为职工支付的现金为1.99亿元，而2018年1-3月公司支付给职工以及为职工支付的现金为0.44亿元。

公司2019年1-3月及2018年1-3月非经常性损益的构成及对比如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	471.62	0.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	149.82
委托他人投资或管理资产的损益	701.89	291.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.09	334.38
小计	1,173.60	776.64
所得税影响额	180.34	52.51
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	993.27	724.13
净利润	22,574.04	15,894.65
非经常性损益占净利润的比例	4.40%	4.56%

2018年1-3月和2019年1-3月，公司扣除所得税影响额的非经常性损益金额分别为724.13万元和993.27万元，占净利润的比例分别为4.56%和4.40%，非经常性损益占净利润的比例较小。

公司财务报告审计截止日为2018年12月31日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营模式，各项业务经营情况，资产规模，税收政策等均未发生重大不利变化。

（二）2019年1-6月主要经营情况预测

综合公司已完成的收入、利润情况以及目前在执行订单情况审慎评估，在假设不发生其他重大变化的前提下，预计公司2019年1-6月的营业收入约为8.20亿元至8.80亿元，实现归属于母公司股东的净利润约为4.20亿元至5.00亿元，扣除非经常性损益

后的归属于母公司股东的净利润约为 4.00 亿元至 4.90 亿元，公司 2018 年 1-6 月的主要经营数据及 2019 年 1-6 月的主要经营数据预测值均未经审计，具体情况如下：

单位：亿元

项目	2019 年 1-6 月预测	2018 年 1-6 月	变动幅度
营业收入	8.20-8.80	7.09	16%~24%
归属于母公司股东的净利润	4.20-5.00	3.17	32%~58%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	4.00-4.90	3.04	32%~61%

2019年1-6月，公司经营情况良好，公司预计实现的营业收入较2018年同期有所增长，主要原因是公司内存接口芯片业务收入持续上升；2019年1-6月公司预计实现归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较2018年同期有所增长，主要原因是公司销售的内存接口芯片产品收入增长且毛利率上升所致。

第九节 募集资金运用与未来发展规划

一、本次发行募集资金运用计划

（一）募集资金总量及投资方向

发行人是基于 Fabless 模式的芯片设计公司，集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化。

经本公司 2019 年 3 月 5 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定申请首次公开发行不超过 11,298.1389 万股人民币普通股（A 股）。本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金投入 金额(万元)	备案号
1	新一代内存接口芯片研发及产业化项目	101,785.00	101,785.00	2019-320562-65-03-507042
2	津逮 [®] 服务器 CPU 及其平台技术升级项目	74,520.16	74,520.16	2019-310104-65-03-001008
3	人工智能芯片研发项目	53,713.90	53,713.90	2019-310114-65-03-000853
	合计	230,019.06	230,019.06	

（二）募集资金投资使用安排

单位：万元

项目名称	投资总额	第一年	第二年	第三年
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	101,785.00	44,438.98	21,344.80	36,001.22
津逮 [®] 服务器 CPU 及其平台技术升级项目	74,520.16	22,315.54	27,356.77	24,847.85
人工智能芯片研发项目	53,713.90	24,584.55	11,625.25	17,504.10
合计	230,019.06	91,339.07	60,326.82	78,353.17

上述项目总投资金额为 230,019.06 万元，第一年投资 91,339.07 万元，第二年投资 60,326.82 万元，第三年投资 78,353.17 万元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次拟公开发行股票募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述 3 个项目的投资需要，资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若

实际募集资金（扣除对应的发行费用后）超过上述 3 个项目的投资需要，则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后做出适当处理。

2019 年 3 月 5 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金项目的议案》。同时，为了规范公司募集资金管理，切实保护广大投资者的利益，此次会议还审议通过了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》，待发行上市募集资金到位后严格遵照执行。

（三）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金的运用有利于优化公司的产品结构，通过已有产品的更新换代和新产品的研发，增强公司的核心竞争力和提高市场份额。本公司无控股股东及实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形，本次募集资金投资项目的实施亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（四）募集资金使用管理制度

公司于 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》。该管理办法对于募集资金使用管理的具体规定如下：

“第八条 公司应当依照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

第九条 公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。

出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报上海证券交易所并公告。

出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）：

- 1、募投项目涉及的市场环境发生重大变化；
- 2、募投项目搁置时间超过 1 年；
- 3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%；

4、募投项目出现其他异常情形。

第十条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：

（一）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

（四）违反募集资金管理规定的其他行为。

第十一条 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。

置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

第十二条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

第十三条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；

（二）募集资金使用情况；

（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；

（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

第十四条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：

（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（三）单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；

（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。

公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

第十五条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

第十六条 超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、超募金额及投资计划等；

- （二）募集资金使用情况；
- （三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划；
- （四）在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺；
- （五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响；
- （六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

第十七条 公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业务，并比照适用本制度第二十条至第二十三条的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，及时履行信息披露义务。

第十八条 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

第十九条 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”

二、募集资金投资项目与目前公司主营业务的关系

本次募集资金将投向于新一代内存接口芯片的研发及产业化项目、津逮[®]服务器 CPU 及其平台技术升级项目和人工智能芯片研发项目。其中，内存接口芯片的更新换代将有利于巩固公司在细分领域的领先地位；津逮[®]服务器 CPU 及其平台的技术升级将有利于公司更好地为云计算时代提供高性能、高安全的服务器 CPU 及其平台产品；人工智能芯片研发项目将围绕客户需求，瞄准产业发展方向，为公司储备新的业务增长点。本次募投项目的顺利实施可以为公司未来新产品新技术的研发，以及业务领域的拓展提供了必要的技术和研发资源支撑，是公司技术驱动业务发展战略的需要。

本次募集资金投资项目的实施系基于公司发展规划要求制定，是对公司现有产品平台的完善和提升，进一步推进产品迭代和技术创新，扩张公司主营业务规模，进而全面提升企业核心竞争力和市场占有率。本次募集资金投资项目是对现有产品体系的发展和完善，与公司的研发能力、销售能力、运营能力和管理能力相适应。公司经过多年的发展，积累了丰富的研发经验，拥有专业的技术和管理团队，具备从事募投项目所需的市场、人员、技术、管理经验。

三、本次募集资金投资项目的具体情况介绍

（一）新一代内存接口芯片研发及产业化项目

1、项目基本情况

内存接口芯片是服务器内存子系统的关键组件，跟随内存产业的发展而发展。截至 2018 年底，全球各大主要内存芯片厂商都已经公布了各自的 DDR5 研发进度。随着 DDR5 内存量产排上日程，要求内存接口芯片供应商加快新一代 DDR5 内存接口芯片的研发。

本项目将在公司现有内存接口芯片产品的基础上，开展新一代 DDR4 内存接口芯片、面向 DDR5 寄存式双列内存模组（RDIMM）和减载双列直插内存模组（LRDIMM）的 DDR5 内存接口芯片的研发，包括高性能、低功耗的 DB 芯片和寄存时钟驱动器 RCD 芯片研发，本项目研发的芯片将符合 JEDEC 内存接口芯片标准，能够大幅提升高端云计算服务器及高速存储子系统所需的运行性能、系统扩展性和功耗效率。

本项目的建设投入包括购置研发所需的场地和软硬件设备，以及研发过程中所需的产品试制费、测试费、软件使用费以及研发人员工资等。根据公司的发展规划，本项目的所需场地将采用购置方式在江苏省昆山市取得。

2、项目建设内容及投资概算

本项目预计建设期为3年，项目总投资101,785.00万元，其中，29,376.00万元用于工程建设，40,809.92万元用于研发费用，基本预备费1,403.72万元，铺底流动资金30,195.36万元。投资具体内容见下表：

序号	投资项目	金额（万元）	投资比重
1	工程建设费用	29,376.00	28.86%
2	研发费用	40,809.92	40.09%
3	基本预备费	1,403.72	1.38%
4	铺底流动资金	30,195.36	29.67%
	合计	101,785.00	100.00%

3、募集资金备案程序的履行情况

本项目已在昆山经济技术开发区管理委员会进行了备案。

4、项目环境保护情况

本项目不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

5、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目主要产品内存接口芯片是跟随服务器内存产业而发展的，随着内存由DDR2、DDR3演进到DDR4，数据传输速度由800MT/s、1600MT/s演进到3200MT/s，工作电压由1.8V、1.5V演进到目前业界最低电压1.2V，由于服务器内存子系统面临的主要瓶颈仍然是高速度、大容量、低功耗下的信号完整性问题，所以需要进行不断的产品升级。

公司是全球内存接口芯片的主要供应商之一，公司凭借领先的技术水平，在DDR4阶段逐渐确立了技术领先优势。公司为保持领先的行业地位，将研发新一代DDR4内存接口芯片及DDR5内存接口芯片并实现产业化。本项目研发的新一代内存接口芯片能够有效支持DDR4、DDR5的高速、低功耗等要求，并且配合市场导入速度规划各代产品的研发及产业化计划，从而推动公司业务的持续稳定增长。

公司从 2004 年开始内存接口芯片的研发，经过十几年的产品升级，不断推动行业技术标准的提升，从而形成了较高的技术壁垒，建立了公司的技术领先地位。通过本项目建设，公司将对高速、高可靠性和低功耗等产品关键技术以及新一代产品的封装测试工艺技术进行研发，从而进一步提高产品的技术门槛，维持公司领先的市场地位，通过提升产品的技术含量保障公司合理的利润空间，实现公司业绩的稳定增长。

（二）津逮[®]服务器 CPU 及其平台技术升级项目

1、项目基本情况

本项目将依据数据中心对数据安全的更高要求，对公司津逮[®]服务器 CPU 及其平台进行技术升级，包括可重构计算处理器及混合安全内存模组的升级研发。本项目相关产品具备高性能、高可靠性、高安全性等优势，同时为用户提供芯片级实时安全监控功能。

本项目的建设投入包括研发所需场地的租赁和软硬件设备购置，以及研发过程中所需的模具费、产品试制费、知识产权授权使用费以及研发人员费用等。

2、项目建设内容及投资概算

本项目预计建设期为 3 年，项目总投资 74,520.16 万元，其中，6,717.39 万元用于工程建设，44,693.34 万元用于研发费用，基本预备费 1,028.21 万元，铺底流动资金 22,081.22 万元，投资具体内容见下表：

序号	投资项目	金额（万元）	投资比重
1	工程建设费用	6,717.39	9.01%
2	研发费用	44,693.34	59.97%
3	基本预备费	1,028.21	1.38%
4	铺底流动资金	22,081.22	29.63%
	合计	74,520.16	100.00%

3、募集资金备案程序的履行情况

本项目已在上海市徐汇区发展和改革委员会进行了备案。

4、项目环境保护情况

本项目不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

5、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

基于公司自有的内存数据安全管理和保护技术，结合我国对自主知识产权的安全、可信、可控服务器平台的迫切需求，公司联合清华大学和英特尔共同开发基于 x86 架构的服务器 CPU 及其平台，满足我国数据中心市场对高安全性、可扩展性和高可靠性服务器的需求。

6、未来津逮®服务器 CPU 量产不会导致公司对 Intel 的重大依赖

津逮®服务器CPU及其平台包括津逮®服务器CPU及混合安全内存模组，其中津逮®服务器CPU使用的内核CPU来源于Intel，但也包含了公司自主研发的核心技术；混合安全内存模组产品为公司自主研发。公司对津逮®服务器CPU及其平台技术升级项目的投资金额占公司本次募集资金总额的比例为32.40%，其中部分用于津逮®服务器CPU的研发。该系列产品主要是为了丰富公司的产品线布局，储备未来业务的增长点，提升公司的综合竞争能力，该产品的量产仅是公司未来业务增长点之一，是增量不是存量，不会造成公司对Intel的重大依赖。

（三）人工智能芯片研发项目

1、项目基本情况

2017年12月，工业和信息化部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称“《行动计划》”），指出新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段，智能化成为技术和产业发展的重要方向。《行动计划》提出到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化。

本项目将凭借公司在高速、低功耗、内存子系统芯片设计领域的技术和人才基础，开发用于云端数据中心的 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。

在集成电路设计领域，公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

此外，公司培养了一批在高速、低功耗、内存子系统芯片设计领域的专业技术人才，建立了一支高学历、高层次、高素质、专业化的核心研发团队，公司采用创新型人才培养机制，搭建创新型人才梯队，已经形成了金字塔结构的研发团队组织模式，有效保障

核心研发团队的稳定性。根据未来行业发展趋势，公司已将人工智能芯片领域作为未来战略发展方向之一，建立了以二十多人为骨干的研发团队，并将根据研发进度及募集资金到位情况进一步扩充研发团队。

本项目的建设投入包括购置研发所需的场地和软硬件设备，以及研发过程中所需的产品试制费、测试费以及研发人员工资等。根据公司的发展规划，本项目的所需场地将采用购置方式在上海市嘉定区取得。

2、项目建设内容及投资概算

本项目预计建设期为3年，项目总投资53,713.90万元，其中，19,642.50万元用于工程建设，33,018.18万元用于研发费用，基本预备费1,053.22万元，投资具体内容见下表：

序号	投资项目	金额（万元）	投资比重
1	工程建设费用	19,642.50	36.57%
2	研发费用	33,018.18	61.47%
3	基本预备费	1,053.22	1.96%
	合计	53,713.90	100.00%

3、募集资金备案程序的履行情况

本项目已在上海市嘉定区发展和改革委员会进行了备案。

4、项目环境保护情况

本项目不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

5、项目的具体研发内容

公司研发部具体研发方向及拟实施的研发项目如下表所示：

产品	研发目标
高能效比可编程AI处理器及SoC芯片系列	可编程AI处理器芯片和SoC芯片。AI处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。
用于数据中心的AI处理器芯片	AI处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。

（四）募集资金投资项目工程建设费用情况

公司募集资金投资项目工程建设费用情况如下：

项目	工程建设费用明细	金额（万元）
----	----------	--------

项目	工程建设费用明细	金额（万元）
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	场地购置费	19,500.00
	场地装修费	3,900.00
	硬件设备	5,794.50
	软件	181.50
津逮 [®] 服务器 CPU 及其平台技术升级项目	场地租赁费	2,236.89
	场地装修费	1,458.00
	硬件设备	2,768.50
	软件	254.00
人工智能芯片研发项目	场地购置费	16,250.00
	场地装修费	1,950.00
	硬件设备	1,442.50

为了能够专注研发提高技术水平，公司在资金实力有限的情况下，集中资金用于研发投入和日常经营周转，控制大额设备购置，通过房屋租赁获取办公场所的方式，保证日常经营的顺利进行。随着业务规模的扩大，公司员工人数迅速增加，由 2017 年末的 204 人发展至 2018 年末的 255 人，同比增加 25%，办公场地的需求也持续扩大，目前的办公及实验环境已经无法满足公司进一步扩大业务发展的需要，公司需要拓展新的研发办公场地和实验室。

公司拟通过本次募集资金加大固定资产投资，以购置、租赁的方式获取研发办公场地、实验室，较好地改善办公环境和研发条件，在吸引更多的优秀技术人才加盟的同时，也可以提高工作效率并保证工作质量，提升公司未来几年内持续开发、维护、更新产品的能力，进一步提高公司的市场竞争力。

本次募集资金，工程建设费用支出占总募集资金的比重为 24.23%，占比不高。如果本次募集资金成功且如期实施，公司固定资产占资产总额的比重仍不会超过 10%，符合公司轻资产运营的业务模式。

四、业务发展目标

（一）战略规划

公司将专注于集成电路设计领域的科技创新，围绕云计算及人工智能领域，不断满足客户对高性能芯片的需求，在持续积累中实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。

公司未来三年的发展目标是通过持续不断的研发创新，提升公司在细分行业的市场地位和影响力。其中，在内存接口芯片业务领域，巩固公司的市场领先地位，在未来三年完成第一代 DDR5 内存接口芯片的研发和产业化；在数据中心业务领域，持续升级津逮[®]服务器 CPU 及其平台，为数据中心提供高性能、高安全、高可靠性的 CPU、混合安全内存模组等产品，持续提升市场份额；在人工智能芯片领域，公司将聚焦客户需求，挖掘潜在商机，研发有竞争力的芯片解决方案，为公司的可持续发展提供新的业务增长点。

（二）为实现战略目标已采取的措施及实施效果

公司现有业务是公司实现战略目标的基础，而战略规划是对现有业务的延伸与拓展。公司为实现战略目标已采取的措施包括进一步实现技术升级、拓展上下游合作伙伴、加强人才团队建设等，有效提高了公司的竞争力与市场占有率。

公司战略规划的实施充分利用了现有业务的技术条件、人员储备和管理经验，体现了与现有业务之间紧密的衔接。公司经营规模的扩大，从纵向上增强了公司现有业务的深度，为公司进一步发展奠定了基础；从横向上使公司产品和服务围绕目前主营业务，向规模化和多元化发展，优化了公司产品服务的结构；从总体上提升了公司的可持续发展能力，提升了公司在国内外同行业中的地位。现有业务的开展和发展计划的实施都将促进公司持续、健康、稳定的发展。

（三）未来规划采取的措施

公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，通过不断技术创新保持在业内的领先优势，当前行业正处于快速发展阶段，公司只有不断推出适应市场需求的新技术、新产品，才能保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势。根据募集资金投资项目的安排，具体技术研发安排如下：

（1）公司拟在现有内存接口芯片产品的基础上，对原有 DDR4 内存接口芯片进行升级，同时开展面向 DDR5 寄存式双列内存模组（RDIMM）和减载双列直插内存模组（LRDIMM）的 DDR5 内存接口芯片的研发，包括高性能、低功耗的数据缓冲器芯片和寄存时钟驱动器芯片研发等，推出符合 JEDEC 内存接口芯片标准的产品，从而大幅提升高端云计算服务器及高速存储子系统所需的运行性能、系统扩展性和功耗效率，进而推进公司的产品升级换代以及提升公司产品性价比，提高公司产品市场竞争力。

（2）公司已推出第一代津逮[®]服务器 CPU，并将持续进行技术升级。同时公司将结合自身在内存接口芯片上的研发优势，推出混合安全内存模组配合津逮[®]服务器 CPU 在芯片级实现实时动态安全监控，满足高安全级别数据中心对数据安全和内存容量的要求。

（3）公司将凭借在服务器 CPU 和高速、低功耗、内存子系统芯片设计领域的技术和人才基础，开发用于云端数据中心的 AI 处理器芯片和 SoC 芯片，为公司未来的发展储备业务增长点。

第十节 投资者保护

一、投资者权益保护情况

为保护投资者依法享有的权利，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》的要求，结合公司实际情况制定了保护投资者权益的措施。具体如下：

（一）建立健全内部信息披露制度和流程

2019年2月22日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《澜起科技股份有限公司信息披露制度》，对发行人信息披露的总体原则、管理和责任、具体程序、披露内容、保密制度、存档管理等事项进行了详细规定，确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程。

（二）投资者沟通渠道

2019年2月22日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《澜起科技股份有限公司投资者关系管理制度》，公司由董事会秘书担任投资者关系管理负责人；董事会办公室是本公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责本公司投资者关系管理日常事务。董事会办公室有专用的场地及设施，设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道。

（三）未来开展投资者关系管理的规划

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

二、股利分配政策

（一）发行人本次发行前的股利分配政策

根据《公司章程》的相关规定，本公司的利润分配政策如下：

第一百四十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十条 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。

（二）发行人本次发行后的股利分配政策

本次发行后，本公司将根据《公司法》、《公司章程》、《股东分红回报规划》进行股利分配。

1、利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配的计划

（1）利润的分配方式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式；

（2）现金分红的具体条件和比例：

公司在满足下列条件时，可以进行分红：

1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况确定。

（3）现金分红的比例和期间间隔

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（4）股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（5）决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

（6）公司利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得

违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

- 1) 因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
- 2) 因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
- 3) 因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；
- 4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

3、规划的制定周期

公司拟以每三年为一个周期，根据公司章程规定的利润分配政策及公司经营的实际情况，结合股东（尤其是中小股东）和独立董事的意见，制定股东分红回报规划，经公司董事会审议通过后提交股东大会审批。

三、报告期内的股利分配情况

报告期内，公司于 2018 年 7 月 30 日召开董事会并通过决议，将共计人民币 298,270,863 元（税前）可分配利润分配给股东。

2019 年 3 月 5 日，本公司召开第一届董事会第五次会议，批准 2018 年度利润分配预案，分配现金股利人民币 233,871,475 元（税前），该年度分红预案已经发行人 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。截至本招股说明书签署日，本次分红已向全体股东发放完毕。

报告期内现金分红的资金来源于公司未分配利润且为公司自有资金，分红资金由发行人在履行其应尽的代扣代缴义务后支付给全体股东。现金分红的资金流转情况符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定。

发行人报告期内重要子公司系形成规模化利润的子公司，分别系澜起澳门、澜起开曼和澜起半导体，其主要子公司《公司章程》中分红政策如下：

序号	公司名称	分红政策
1	澜起澳门	公司章程中未具体约定股利分配政策，但重大事项均可以由股东决定，且在符合当地法律法规的情况下，对分红没有做出限制性约定
2	澜起开曼	董事将负责制定澜起开曼股息分配方案，并以现金或支票的方式支付给股东，相应的股息不可超出澜起开曼经营利润，且股息不产生任何利息
3	澜起半导体	公司不设股东大会和董事会，由股东指定一名执行董事，并由其制定公司的利润分配方案

目前公司子公司均为公司直接或间接 100%持有，公司可在满足各子公司当地法律法规的前提下，对其分红政策具有控制权，且相关子公司的公司章程中未对分红进行限制。

报告期内重要子公司向发行人的现金分红仅有一笔，系 2018 年 12 月 24 日，经澜起开曼股东（即发行人）决定，澜起开曼向澜起科技分配未分配利润合计 4,000 万美元。根据公司资金安排，该笔分红尚未实际支付。

四、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票并上市前所滚存的可供股东分配的利润（不含已经公司股东大会决议分配的利润）由发行后的新老股东按照持股比例共享。

五、股东投票机制的建立情况

公司通过采用累积投票、网络投票、征集投票等方式，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。

1、累积投票制度

根据《股东大会议事规则》相关规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、提供股东大会网络投票方式

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

3、征集投票权的相关安排

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

六、相关承诺事项

（一）关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、主要股东承诺

公司主要股东中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）；WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.承诺：

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。

2、发行人股东 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 承诺

(1) 若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本单位对公司增资的工商变更登记手续完成之日不超过 6 个月，则自上述增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首发前股份，也不由公司回购本单位所持该部分股份；若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本单位对公司增资的工商变更登记手续完成之日超过 6 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首发前股份，也不由公司回购本单位所持该部分股份。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。

3、发行人除上述股东外的其他股东承诺

自公司股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本单位/本人持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。

(2) 上述规定的锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。

5、直接或间接持有公司股份的核心技术人员杨崇和、山岗、常仲元、史刚承诺

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内不得转让本公司首发前股份；

(2) 自本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

(3) 本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人員股份转让的其他规定。

(二) 关于公司稳定股价的预案及相关承诺

根据发行人 2019 年 3 月 5 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，公司稳定股价的预案如下：

1、本预案的有效期

本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

2、启动股价稳定措施的具体条件和程序

(1) 启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度未经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会、25 个交易日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

(2) 停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于公司上一年度未经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

3、具体措施和方案

稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票。

(1) 公司回购股票

1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2) 公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的 10 个交易日内实施稳定股价的具体方案。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

3) 在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下列情形之一，公司有权终止执行该次回购股票方案：

①通过回购公司股票，公司股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；

②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

4) 在触发稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的措施，公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 董事、高级管理人员增持公司股票

1) 公司回购股票方案实施完毕后的连续 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

2) 公司董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起 10 个交易日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，公司董事、高级管理人员应在公告之日的下一个交易日启动增持。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司董事、高级管理人员单一年度用于增持股票的资金金额不高于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的50%。

3) 在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案：

①通过增持公司股票，公司股票连续7个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；

②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。

4) 在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件满足时，如其未采取上述稳定股价的措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

(3) 本稳定股价预案对未来新聘任的董事、高级管理人员同样具有约束力。公司新聘从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将要求其根据本预案签署相关承诺。

4、主要股东承诺

公司主要股东中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）；WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.承诺：

(1) 在公司实施完毕《关于公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》中规定的方案后的连续5个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，本单位应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

(2) 本单位在上述本单位增持公司股票的条件成就之日起 10 日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，本单位应在公告之日的下一个交易日启动增持。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，本单位单一年度用于增持股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。

(3) 在本单位实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，本单位有权终止执行该次增持股票方案：

1) 通过增持公司股票，公司股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；

2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。

(4) 在触发本单位增持公司股票的条件满足时，如本单位未采取上述稳定股价的措施，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有）。

(三) 关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施

1、发行人承诺

(1) 公司承诺：

若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起（以较晚完成日期为准）六个月内完成回购。公司承诺，将按照市场价格且不低于首次公开发行上市时的价格进行回购。公司首次公开发行上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，且回购价格将相应进行调整。

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。

(2) 回购新股、赔偿损失义务的触发条件：

经证券监管部门或司法机关认定，公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司负有承诺的回购新股、赔偿损失等义务。

(3) 公告程序：

公司应在本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券监管部门或司法机关认定的当日就该等事项进行公告，并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。

2、主要股东承诺

公司主要股东中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）；WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P. 承诺：

(1) 公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将依法购回已转让的原限售股份。

(2) 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺

公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

（四）关于持股意向及减持意向的承诺

1、主要股东承诺

公司主要股东中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）；WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.；承诺：

（1）本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。

（2）本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。

（3）本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

（4）若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。

2、发行人除上述股东外的 5%以上股东承诺

公司除前述主要股东以外的5%以上股东，包括 Intel Capital Corporation、嘉兴蔺石一号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴蔺石二号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴蔺石三号投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司承诺：

（1）本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。

（2）本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，本单位减持所持有公司股票的价格应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。

（3）本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

（4）若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。

（五）关于业绩摊薄的填补措施及承诺

本次发行完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩。

具体公司填补回报的措施如下：

1、加强募集资金管理

本次发行的募集资金到账后，公司董事会将通过募集资金专项账户进行管理，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。

2、完善利润分配制度，强化投资者回报制度

为明确本次发行后投资者的回报，《公司章程（草案）》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款；为更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了《关于澜起科技股份有限公司股东未来分红

回报规划的议案》。公司上市后将严格按照《公司章程（草案）》的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

3、积极实施募投项目

本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以其自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。

4、积极提升公司竞争力和盈利水平

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

5、关于后续事项的承诺

公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

公司主要股东、董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承诺

公司主要股东、董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保公司填补回报措施的切实履行作出了承诺，维护公司和全体股东的合法权益。

公司主要股东中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）； WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.承诺如下：

1、本单位将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；

2、若本单位违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本单位将给予充分、及时而有效的补偿。

公司董事、高级管理人员承诺如下：

1、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；

2、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

（六）公司及其董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东相关承诺的约束措施

1、发行人承诺

本公司在首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：

- （1）立即采取措施消除违反承诺事项；
- （2）提出并实施新的承诺或补救措施；
- （3）按监管机关要求的方式和期限予以纠正；
- （4）造成投资者损失的，依法赔偿损失。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

本人在澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因，由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：

（1）立即采取措施消除违反承诺事项；

（2）提出并实施新的承诺或补救措施；

（3）公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请延长本人所持公司股份的锁定期。

3、公司持股 5%以上股东承诺

公司 5%以上股份的股东：中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）；WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙），上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙），嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.，Intel Capital Corporation，嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）及其关联方嘉兴臻石二号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）和中信证券投资有限公司承诺：

本单位在发行人首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本单位将及时向公司说明原因，由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：

（1）立即采取措施消除违反承诺事项；

（2）提出并实施新的承诺或补救措施；

(3) 公司有权直接按本单位承诺内容向交易所或证券登记机构申请延长本单位所持公司股份的锁定期；

(4) 造成投资者损失的，依法赔偿损失。

(七) 对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人关于欺诈上市的股份购回承诺

(1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

(八) 间接持有公司股权的董事、监事和高级管理人员的亲属杨崇颐、Tai kuai Lap、Chao long Wa、李新岗的承诺

杨崇颐、Tai kuai Lap、Chao long Wa、李新岗作出了相关承诺如下：

1、关于关联交易问题的承诺函

本人现就澜起科技关联交易问题作出如下承诺：

(1) 本人及本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本人及本人所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。

(2) 对于本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

(3) 本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

（4）本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止该等关联交易。

2、持股锁定承诺

本人现就直接或间接所持公司股份锁定事宜出具承诺如下：

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。

（2）上述规定的锁定期满后，在本人近亲属担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人近亲属离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。

（3）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。

（三）关于未履行公开承诺的约束性措施

本人在澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因，由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：

（1）立即采取措施消除违反承诺事项；

（2）提出并实施新的承诺或补救措施；

（3）公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请延长本人所持公司股份的锁定期。

（九）其他承诺事项

1、保荐机构承诺

中信证券股份有限公司作为本次发行并上市的保荐机构，特此承诺如下：

“本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司为澜起科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

2、发行人律师承诺

国浩律师（上海）事务所作为本次发行并上市的律师，特此承诺如下：

“如国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩”）在澜起科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。”

3、发行人审计机构承诺

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行并上市的审计机构，特此承诺如下：

“如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于澜起科技股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。”

4、发行人资产评估机构承诺

上海申威资产评估有限公司作为本次发行并上市的资产评估机构，特此承诺如下：

“上海申威资产评估有限公司作为本次澜起科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的资产评估机构，为本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

第十一节 其他重要事项

一、重大合同

公司重大合同的确定标准如下：报告期内，（1）公司已履行的金额超过人民币 5000 万的合同，（2）截至到首次申报时，公司前五大客户、供应商正在履行的典型合同，以及（3）正在履行的对公司业务未来发展具有重要影响的合同。具体情况如下，

（一）正在执行的销售合同

截至 2019 年 4 月 1 日，公司与主要客户签署的在执行的销售订单情况如下：（因涉及客户保密要求，下属订单中的客户名称用代号表示）

1、2019 年 1 月 26 日，客户 B 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 8,200,800 美元。

2、2018 年 7 月 5 日，客户 E 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 1,892,240 美元。

3、2019 年 2 月 8 日，客户 A 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 677,688.00 美元。

4、2019 年 2 月 12 日，客户 D 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 433,680 美元。

5、2019 年 2 月 12 日，客户 J 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 119,000 美元。

（二）正在执行的采购合同

截至 2019 年 4 月 1 日，公司与主要供应商签署的在执行的采购订单情况如下：（因涉及保密要求，下属订单中的供应商名称用代号表示）

1) 2018 年 7 月 6 日，澜起澳门向供应商 G 发出采购订单，采购 CPU 产品，订单金额 1,820,250 美元。

2) 2019 年 1 月 14 日，澜起澳门向供应商 H 发出采购订单，采购晶圆（Wafer），订单金额 261,700 美元。

3) 2019年2月3日, 澜起澳门向供应商 I 发出采购订单, 采购晶圆 (Wafer), 订单金额 163,550.00 美元。

4) 2019年2月19日, 澜起澳门向供应商 K 发出采购订单, 采购晶圆凸块 Bump 服务, 订单金额 8,250 美元。

5) 2019年2月19日, 澜起澳门向供应商 L 发出采购订单, 采购封测服务, 订单金额 92,395 美元。

(三) 已履行完毕的合同

1) 2018年2月8日, 客户 B 向澜起澳门发出采购订单, 向澜起澳门采购内存接口芯片, 订单金额 33,754,560 美元。

2) 2018年7月3日, 客户 B 向澜起澳门发出采购订单, 向澜起澳门采购内存接口芯片, 订单金额 23,041,800 美元。

3) 2017年6月29日, 客户 B 向澜起澳门发出采购订单, 向澜起澳门采购内存接口芯片, 订单金额 13,641,591 美元。

4) 2018年7月26日, 客户 D 向澜起澳门发出采购订单, 向澜起澳门采购内存接口芯片, 订单金额 11,623,240 美元。

(四) 正在履行的对公司业务未来发展具有重要影响的合同

2015年9月, 公司与清华大学、Intel 于就合作事宜签署谅解备忘录, 三方约定, 将基于英特尔 x86 架构的可重构计算研究与关于存储缓冲器的研究进行结合, 以提供一个整体服务器平台解决方案。2016年1月, 发行人与 Intel 就合作细节签署了合作协议, 双方就合作的具体事宜如分工、知识产权保护及归属等权利义务进行了约定。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日, 公司不存在对外担保事项。

三、重大诉讼、仲裁事项

截至本招股说明书签署日, 公司不存在对公司财务状况、生产经营、经营成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼、仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年不涉及行政处罚、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查情况。

第十二节 声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事签字：

 杨崇和	 Stephen Kuong-lo Tai	 邓向东
 李荣信	 Yao SUN	 李亚军
 Brent Alexander Young	 尹志尧	 吕长彦
 刘敬东	 俞波	



澜起科技股份有限公司

2019年6月23日

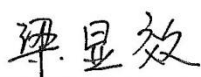
全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体监事签字：



夏晓燕



梁显效



施懿



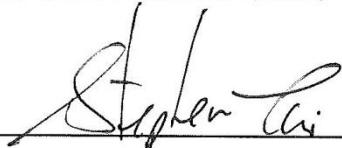
澜起科技股份有限公司

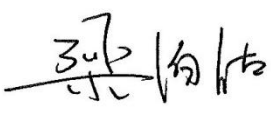
2019年6月23日

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体高级管理人员签字：


Stephen Kuong-lo Tai


梁铂钻


苏琳

澜起科技股份有限公司

2019年6月23日

主要股东声明

本单位或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为股东声明之签署页）



中国电子投资控股有限公司

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）



嘉兴芯电投资合伙企业(有限合伙)

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）



WLT Partners, L.P.

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）



2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

李 彦 军



上海临理投资合伙企业（有限合伙）

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

李 强 军



上海临丰投资合伙企业（有限合伙）

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

李 彦 军



上海临骥投资合伙企业（有限合伙）

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

李 强



上海临利投资合伙企业（有限合伙）

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

李 华



上海临国投资合伙企业（有限合伙）

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

李 勇 军

上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）



2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

李 亚 军



上海临齐投资合伙企业（有限合伙）

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）



袁霞

嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）



莫奈

嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）

Xia Yuan

Xinyun Capital Fund, L.P.

2019年6月23日

（本页无正文，为股东声明之签署页）


Xita Yuan

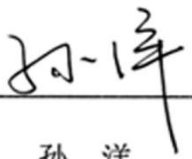
Xinyun Capital Fund III, L.P.

2019年6月23日

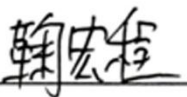
保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 
张佑君

保荐代表人： 
孙 洋


王建文

项目协办人： 
鞠宏程



2019年6月23日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



杨明辉



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：


张佑君



2019年6月23日

联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：


毕明建



联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



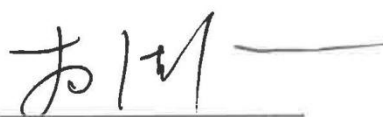
王常青



联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



杨德红



联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



李玮



中泰证券股份有限公司

2019年6月23日

发行人律师声明

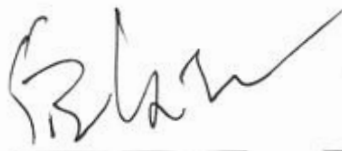
本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



李 强

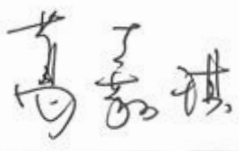
经办律师：



倪俊骥



陈晓纯



葛嘉琪



蔡 诚





通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于招股说明书引用审计报告及其他报告的 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”），确认招股说明书中引用的经审计的财务报表、经审核的内部控制评估报告、经鉴证的非经常性损益明细表的内容，与本所出具的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019]01500039号）、内部控制鉴证报告（报告编号：瑞华核字[2019]01500004号）、非经常性损益的鉴证报告（报告编号：瑞华核字[2019]01500001号）及审阅报告（报告编号：瑞华阅字[2019]01500002号）的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对澜起科技股份有限公司在招股说明书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供澜起科技股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所申请首次公开发行 A 股股票使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



会计师事务所负责人：

刘贵彬

中国注册会计师：

徐超玉60

中国·北京

中国注册会计师：

李建长

2019年6月23日

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

修雪嵩

陈毅夫

资产评估机构负责人：

马丽华



2019年6月23日



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
 Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
 邮政编码 (Post Code): 100077
 电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于招股说明书引用验资报告的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”），确认招股说明书中引用的验资报告的内容，与本所出具的验资报告（报告编号：瑞华验字[2018]01500004号和瑞华验字[2019]01500003号）的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对澜起科技股份有限公司在招股说明书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供澜起科技股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所申请首次公开发行 A 股股票使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

会计师事务所负责人：

刘贵彬

中国注册会计师：

徐超玉

中国注册会计师：

李建长

李建长

2019年 6月 23日

第十三节 附件

一、本招股说明书的备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报表及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （七）内部控制鉴证报告；
- （八）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （九）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

投资者可于本次发行承销期间，到公司和保荐机构（主承销商）的办公地点查阅。

公司住所：上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6

保荐机构住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

三、查阅时间

除法定节假日以外的每日上午 10:00-12:00，下午 2:00-5:00。